

AFE7903 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC、400MHz IBW 的 2T2R 5MHz 至 7.4GHz 射频采样 AFE

1 特性

- [申请完整数据表](#)
- 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 双通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 每 TX 或 RX 信号带宽上限：400MHz
- 射频频率范围：5MHz 至 7.4GHz
- 数字步进衰减器 (DSA)：
 - TX：40dB 范围，0.125dB 步长
 - RX：25dB 范围，0.5dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 每个 TX/RX 为 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO，提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- Sysref 对齐检测器
- 串行器/解串器数据接口：
 - 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
 - 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
 - 子类 1 多器件同步
- 封装：17mm × 17mm FCBGA，间距为 0.8mm

2 应用

- [雷达](#)
- [导引头前端](#)
- [无线电防御](#)
- [战术通信基础设施](#)
- [无线通信测试](#)

3 说明

AFE7903 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器，集成了两个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 7.4 GHz 的工作频率，支持直接在 HF、VHF、UHF、L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样，无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项，提供高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC (数模转换器)，通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可选增益放大器 (TX DSA)。

每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA (数字步进衰减器)，后跟一个 3GSPS ADC (模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器，可辅助外部或内部自主的自动增益控制器，以及射频过载检测器，用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 400 MHz (对于两个 RX) 的数据带宽优化。

该器件包含一个 SYSREF 时序检测器，用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。

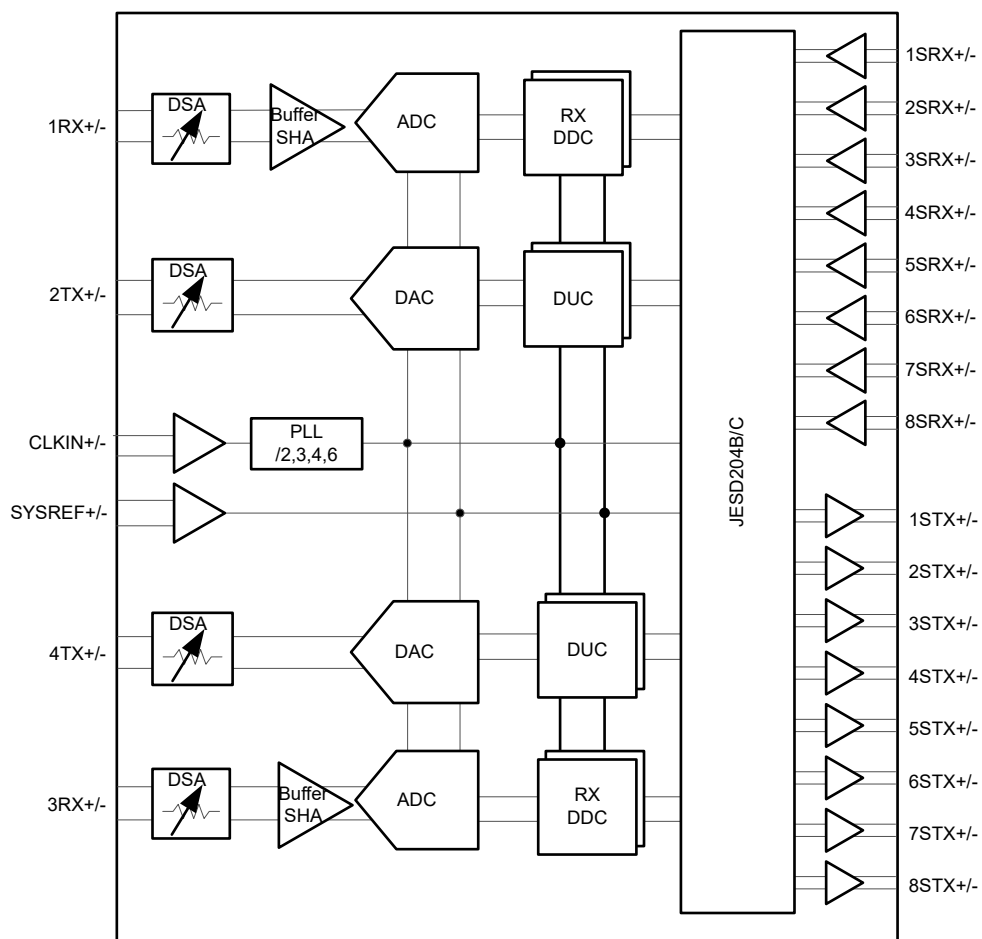
封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
AFE7903	FC-BGA	17mm × 17mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。





功能方框图

内容

1 特性	1	4.9 电源电气特性	25
2 应用	1	4.10 时序要求	30
3 说明	1	4.11 开关特性	31
4 规格	4	4.12 典型特性	32
4.1 绝对最大额定值.....	4	5 器件和文档支持	157
4.2 ESD 等级.....	4	5.1 接收文档更新通知.....	157
4.3 建议运行条件.....	5	5.2 支持资源.....	157
4.4 热性能信息.....	5	5.3 商标.....	157
4.5 发送器电气特性.....	6	5.4 静电放电警告.....	157
4.6 射频 ADC 电气特性.....	15	5.5 术语表.....	157
4.7 PLL/VCO/时钟电气特性.....	21	6 修订历史记录	157
4.8 数字电气特性.....	23	7 机械、封装和可订购信息	158

4 规格

4.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压范围	DVDD0P9、VDDT0P9	-0.3	1.2	V
	VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML	-0.3	1.4	V
	VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVC0、VDD1P8FB、VDD1P8FBCML、VDD1P8GPIO、VDDA1P8	-0.5	2.1	V
引脚电压范围	{1/3}RXIN+/-	-0.5	VDDR1P8+0.3	V
	{1/3}TXOUT+/-	-0.5	VDDTX1P8+0.3	V
	REFCLK+/-、SYSREF+/-	-0.3	1.4	V
	{1:8}SRX+/-	-0.3	1.4	V
	{1:8}STX+/-	-0.3	1.4	V
	GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1	-0.5	VDD1P8GPIO + 0.3	V
	IFORCE、VSENSE	-0.3	VDDCLK1P8 + 0.3	V
	SRDAMUX1、SRDAMUX2	-0.3	VDDA1P8+0.3	V
P _{MAX} (xRXIN+/-)	f _{IN} = 5MHz, DSA = 20dB		19.7	dBm
	f _{IN} = 30MHz, DSA = 20dB		17.8	
	f _{IN} = 410MHz, DSA = 20dB		17.6	
	f _{IN} = 830MHz, DSA = 20dB		16.7	
	f _{IN} = 1760MHz, DSA = 20dB		17.0	
	f _{IN} = 2610MHz, DSA = 20dB		18	
	f _{IN} = 3610MHz, DSA = 20dB		18.5	
	f _{IN} = 4910MHz, DSA = 20dB		19.3	
峰值输入电流	任意输入		20	mA
T _J	结温		150	°C
T _{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在**建议运行条件**以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出**建议运行条件**但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。

4.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 ⁽¹⁾	1000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚	150	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

4.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
DVDD0P9、VDDT0P9	电源电压 0.9V	0.9	0.925	0.95	V
VDD1P2{RX/TXCLK/TXENC/FB/PLL/ PLLCLKREF/FBCML/RXCML}	电源电压 1.2V	1.15	1.2	1.25	V
VDD1P8{RX/RXCLK/TX/TXDAC/ TXENC/PLL/PLLVCO/FB/FBCLK/ GPIO}、VDDA1P8	电源电压 1.8V	1.75	1.8	1.85	V
T _A	环境温度	-40		85	°C
T _J	工作结温			110 ⁽¹⁾	°C
	最高工作结温	125			°C

(1) 长时间等于或高于此结温使用可能会增加器件的时基故障 (FIT) 率。有关更多详细信息，请参阅 [SBAA403 应用手册](#)

4.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		17x17mm FC-BGA	单位
		400 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	16.2	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳 (顶部) 热阻	0.42	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	4.85	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	0.12	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	4.6	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用报告。

4.5 发送器电气特性

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时速率为 500MSPS，低于 6GHz 时 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ ，高于 6GHz 时为 9GSPS；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅值为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DAC _{RES}	DAC 分辨率			14		位
f_{RFout}	RF 输出频率范围	$f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$ ，第一奈奎斯特区域	5		6000	MHz
		$f_{\text{DAC}} = 9\text{GSPS}$ ，第一奈奎斯特区域	5		4500	
		$f_{\text{DAC}} = 9\text{GSPS}$ ，第二奈奎斯特区域	4500		7400	
		$f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ ，第一奈奎斯特区域	5		3000	
		$f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ ，第二奈奎斯特区域	3000		6000	
$P_{\text{max_FS}}$	器件引脚上的最大满量程输出功率，单音最大增益	$f_{\text{out}} = 10\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ ，-0.1dBFS		6.5		dBm
		$f_{\text{out}} = 30\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ ，-0.1dBFS		6.5		dBm
		$f_{\text{out}} = 400\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ ，-0.1dBFS		5.6		dBm
		$f_{\text{out}} = 850\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS		4.3		dBm
		$f_{\text{out}} = 1800\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS		3.2		dBm
		$f_{\text{out}} = 2600\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS		2.3		dBm
		$f_{\text{out}} = 3500\text{MHz}$ ，-0.5dBFS		2.9		dBm
		$f_{\text{out}} = 4900\text{MHz}$ ，-0.5dBFS		-0.6		dBm
		$f_{\text{out}} = 3500\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS，直接模式		-2.3		dBm
		$f_{\text{out}} = 4900\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS，直接模式		-3.4		dBm
		$f_{\text{out}} = 4900\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，-0.5dBFS，直接模式		-3.9		dBm
R_{TERM}	输出端接电阻器	默认设置		100		Ω
ATT _{range}	DSA 衰减范围			40		dB
ATT _{step}	DSA 模拟衰减步长			1.0		dB
	DSA 衰减步长精度 (DNL) ⁽¹⁾	校准后 $0 < \text{Atten} < 40\text{dB}$		± 0.1		dB
		校准前 $0 < \text{Atten} < 40\text{dB}$		± 0.2		
ATT _{step}	DSA 增益步长相位精度，任何 8dB 范围 ⁽¹⁾	$f_{\text{out}} = 30\text{MHz}$		± 1		度
		$f_{\text{out}} = 400\text{MHz}$		± 1		度
		$f_{\text{out}} = 850\text{MHz}$		± 1		度
		$f_{\text{out}} = 1800\text{MHz}$		± 1		度
		$f_{\text{out}} = 2600\text{MHz}$		± 1		度
		$f_{\text{out}} = 3500\text{MHz}$		± 1		
		$f_{\text{out}} = 4900\text{MHz}$		± 1		度
G_{flat}	增益平坦度	任何 20MHz		0.1		dB
		600MHz 带宽， $F_{\text{out}} < 4.9\text{G}$		1.2		

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IMD3	三阶互调失真	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 5\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-48		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 30\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-47		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 400\text{MHz} \pm 2\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-51		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-61		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-62		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-64		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-63		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -7dBFS	-64		dBc
		$f_{out} = 5\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-72		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 30\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-71		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 400\text{MHz} \pm 2\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-72		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-73		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-75		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-79		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-77		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$, 单音幅值为 -13dBFS	-77		dBc
SFDR	无杂散动态范围 (在奈奎斯特区域内)	$f_{out} = 30\text{MHz}$, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 交错模式, 20Gbps 串行器/解串器速率	45		dBc
		$f_{out} = 400\text{MHz}$, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 交错模式, 20Gbps 串行器/解串器速率	48		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$	62		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$	56		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$	39		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$	42		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$	60		dBc

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_s/2 - f_{OUT}$	交错图像	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式		-47		dBc
		$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式		-43		dBc
		$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式		-43		dBc
HD2	二阶谐波失真 (在奈奎斯特区域内)	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 5\text{MHz}$		-72		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 30\text{MHz}$		-75		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 100\text{MHz}$		-73		dBc
		$f_{out} = 400\text{MHz}$		-46		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$		-65		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$		-68		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$		-47		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$		-59		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$		-48		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-74		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-67		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-58		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-69		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-59		dBc
HD3	三阶谐波失真 (在奈奎斯特区域内)	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 5\text{MHz}$		-46		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 30\text{MHz}$		-48		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 100\text{MHz}$		-49		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 400\text{MHz}$		-49		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$		-56		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$		-58		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$		-60		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$		-63		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$		-66		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 5\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-83		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 30\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-83		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 100\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-82		dBc
		$f_{DAC} = 6\text{GSPS}$, $f_{out} = 400\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-79		dBc
		$f_{out} = 850\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87		dBc
		$f_{out} = 1800\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-84		dBc
		$f_{out} = 2600\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-79		dBc
		$f_{out} = 3500\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-84		dBc
		$f_{out} = 4900\text{MHz}$, $A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-88		dBc

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HDn, n >= 4	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 5\text{MHz}$		-58		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 30\text{MHz}$		-60		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 100\text{MHz}$		-61		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 400\text{MHz}$		-50		dBc
	$f_{out} = 850\text{MHz}$		-85		dBc
	$f_{out} = 1800\text{MHz}$		-90		dBc
	$f_{out} = 2600\text{MHz}$		-84		dBc
	$f_{out} = 3500\text{MHz}$		-86		dBc
	$f_{out} = 4900\text{MHz}$		-87		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 5\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-92		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 30\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-94		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 100\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-93		dBc
	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 400\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-85		dBc
	$f_{out} = 850\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-89		dBc
	$f_{out} = 1800\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-92		dBc
	$f_{out} = 2600\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-87		dBc
	$f_{out} = 3500\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-88		dBc
	$f_{out} = 4900\text{MHz}, A_{OUT} = -12\text{dBFS}$		-89		dBc
SFDR +/- 250MHz	$f_{DAC} = 6\text{GSPS}, f_{out} = 400\text{MHz}$		87		dBc
	$f_{out} = 850\text{MHz}, f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		84		dBc
	$f_{out} = 1800\text{MHz}, f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		78		dBc
	$f_{out} = 2600\text{MHz}, f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		80		dBc
	$f_{out} = 3500\text{MHz}, f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		81		dBc
$f_s/4$	$f_{out} = 4900\text{MHz}, f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$		74		dBc
	固定杂散				
	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/4-50\text{MHz}$		-95		dBFS
$f_s/2$	$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/4-50\text{MHz}$		-88		dBFS
	$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/4-50\text{MHz}$		-76		dBFS
	固定杂散				
$f_s/2$	$f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/2-50\text{MHz}$		-52		dBFS
	$f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/2-50\text{MHz}$		-45		dBFS
	$f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}, f_{OUT} = f_{DAC}/2-50\text{MHz}$		-49		dBFS

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$3*f_s/4$	固定杂散	第二奈奎斯特, $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, $f_{\text{OUT}} = 3*f_{\text{DAC}}/4 - 50\text{MHz}$		-82		dBFS
		第二奈奎斯特, $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, $f_{\text{OUT}} = 3*f_{\text{DAC}}/4 - 50\text{MHz}$		-75		dBFS
		第二奈奎斯特, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, $f_{\text{OUT}} = 3*f_{\text{DAC}}/4 - 50\text{MHz}$		-49		dBFS
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{\text{out}} = 0.85\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-70		dBc
		Atten=20dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-66		dBc
		Atten=28dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-62		dBc
		Atten=39dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-51		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{\text{out}} = 1.8425\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-71		dBc
		Atten=20dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-66		dBc
		Atten=28dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-61		dBc
		Atten=39dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-50		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{\text{out}} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-72		dBc
		Atten=20dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-66		dBc
		Atten=28dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-60		dBc
		Atten=39dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-49		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{\text{out}} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-71		dBc
		Atten=20dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-65		dBc
		Atten=28dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-58		dBc
		Atten=39dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-47		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), LTE 20MHz E-TM1.1 载波 $f_{\text{out}} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-69		dBc
		Atten=20dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-64		dBc
		Atten=28dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-58		dBc
		Atten=39dB, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-47		dBc

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-65		dBc
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-59		dBc
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-53		dBc
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-41		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-63		dBc
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-56		dBc
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-49		dBc
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-38		dBc
ACPR _{1xcarr}	ACPR (单载波), NR 100MHz E-TM1.1 载波 $f_{out} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-63		dBc
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-56		dBc
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-51		dBc
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-41		dBc
EVM	误差矢量幅度, 1x 20MHz E-TM3.1/3.1a, 无参考时钟噪声	$F_{out} = 0.85\text{GHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.16		%
		$F_{out} = 1.8425\text{GHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.21		%
		$F_{out} = 2.6\text{GHz}$, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.24		%
		$F_{out} = 3.5\text{GHz}$, $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.27		%
		$F_{out} = 4.9\text{GHz}$, $P_{OUT} = -13\text{dBFS}$		0.38		%
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 5\text{MHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-148		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-143		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-139		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-129		dBFS/Hz

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时速率为 500MSPS，低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$ ，高于 6GHz 时为 9GSPS；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅值为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 30\text{MHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-154		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-146		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-142		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-132		dBFS/Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 100\text{MHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-158		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-150		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-146		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-136		dBFS/Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 400\text{MHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-160		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-153		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-150		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 6000\text{MSPS}$, 20Gbps 串行器/解串器速率, Pout = -12dBFS		-139		dBFS/Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 0.85\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout = -13dBFS		-158.8		dBFS/Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout = -13dBFS		-152.7		dBFS/Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout = -13dBFS		-148.7		dBFS/Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout = -13dBFS		-137.9		dBFS/Hz

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS, 高于 6GHz 时速率为 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, 高于 6GHz 时为 9GSPS; 低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式, 高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式; 第一奈奎斯特区域为交错模式, 第二奈奎斯特区域为非交错混合模式, 标称电源; 单音幅值为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB, 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 1.8\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-157.9		dBFS/ Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-151.3		dBFS/ Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-145.6		dBFS/ Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 5898.24\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-134.8		dBFS/ Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-158.3		dBFS/ Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-151.6		dBFS/ Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-144.9		dBFS/ Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 8847.36\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-134.0		dBFS/ Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $F_{out} = 3.5\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-158.2		dBFS/ Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-150.9		dBFS/ Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-144.4		dBFS/ Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-133.4		dBFS/ Hz
NSD _{dBFS}	噪声频谱密度 20MHz 偏移 $F_{out} = 4.9\text{GHz}$	Atten=0dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-154.6		dBFS/ Hz
		Atten=20dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-147.0		dBFS/ Hz
		Atten=28dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-140.7		dBFS/ Hz
		Atten=39dB, $f_{DAC} = 11796.48\text{MSPS}$, Pout= -13dBFS		-129.9		dBFS/ Hz
S22	输出回波损耗, +/- fc * 10%	含匹配		-12		dB

4.5 发送器电气特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$ ；低于 6GHz 时 TX 输入速率 = 491.52MSPS，高于 6GHz 时速率为 500MSPS，低于 6GHz 时 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ ，高于 6GHz 时为 9GSPS；低于 6GHz 输出频率时为 PLL 时钟模式，高于 6GHz 输出频率时为外部时钟模式；第一奈奎斯特区域为交错模式，第二奈奎斯特区域为非交错混合模式，标称电源；单音幅值为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
隔离	远通道： 2TXOUT 至 4TXOUT	$f_{\text{out}} = 10\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ ，直接模式 ⁽²⁾		-104		dB
		$f_{\text{out}} = 30\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ ，直接模式 ⁽²⁾		-100		dB
		$f_{\text{out}} = 100\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ ，直接模式 ⁽²⁾		-105		dB
		$f_{\text{out}} = 400\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ ，直接模式 ⁽³⁾		-97		dB
		$f_{\text{out}} = 900\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式		-90		dB
		$f_{\text{out}} = 1850\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式		-91		dB
		$f_{\text{out}} = 2600\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式		-93		dB
		$f_{\text{out}} = 3500\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式		-94		dB
		$f_{\text{out}} = 4900\text{MHz}$ ， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ，直接模式		-83.2		dB
PN _{TXADD}	附加相位噪声外部时钟模式 ⁽⁴⁾	$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 100\text{Hz}$		-97		dBc/Hz
		$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 1\text{kHz}$		-106		dBc/Hz
		$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 10\text{kHz}$		-117		dBc/Hz
		$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 100\text{kHz}$		-128		dBc/Hz
		$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 1\text{MHz}$		-138		dBc/Hz
		$f_{\text{out}} = 3.7\text{GHz}$ ， $f_{\text{OFFSET}} = 10\text{MHz}$		-144		dBc/Hz

(1) 执行 DSA 已校准程序后

(2) 使用 1 μH 直流馈电电感器测得

(3) 使用 0.39 μH 直流馈电电感器测得

(4) 减去输入时钟相位噪声。

4.6 射频 ADC 电气特性

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$ ；高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS，低于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$ ，以及高于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$ ；低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ；高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式， $f_{\text{CLK}} = 9\text{GHz}$ ；标称电源；DSA 设置 = 3dB；串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ADC _{RES}	ADC 分辨率			14		位
F _{RFin}	RF 输入频率范围		5		7400	MHz
P _{FS_CW,min}	器件引脚上的最小满量程输入功率 ⁽¹⁾	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$ ，DSA = 0dB， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$ ，抽取因子为 48		-0.4		dBm
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$ ，DSA = 0dB， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$ ，抽取因子为 24		-2.2		dBm
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$ ，DSA = 0dB， $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$ ，抽取因子为 12		-2.5		dBm
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-2.9		dBm
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-2.8		dBm
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-1.8		dBm
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$ ，DSA=0dB		-0.4		dBm
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$ ，DSA=0dB		0.1		dBm
R _{TERM}	输入基准阻抗			100.0		Ω
ATT _{range}	DSA 衰减范围			25.0		dB
ATT _{step}	DSA 衰减步长			0.5		dB
	DSA 衰减步长精度	校准后 $\Delta = G_{\text{att}}(X) - G_{\text{att}}(X-1)$ ， $F_{\text{in}} = 3610\text{MHz}$		0.1		dB
	DSA 增益步长相位精度任何 8dB 范围	校准后 $F_{\text{in}} = 3610\text{MHz}$		0.9		度
	DSA 增益步长相位精度任何 8dB 范围	校准后 $F_{\text{in}} = 4910\text{MHz}$		1.8		度
G _{flat}	增益平坦度	在 80MHz 带宽上测得		0.2		dB
		在 200MHz 带宽上测得		0.5		dB
		在 400MHz 带宽上测得		1.1		dB

4.6 射频 ADC 电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$, 以及高于 6GHz 时 $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$; 低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式, $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$; 高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式, $f_{CLK} = 9\text{GHz}$; 标称电源; DSA 设置 = 3dB; 串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NSD	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, DSA = 3dB, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-147.1		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 30\text{MHz}$, DSA = 3dB, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-150.7		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 410\text{MHz}$, DSA = 3dB, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-155.4		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 830\text{MHz}$, DSA = 3dB		-156.2		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 1760\text{MHz}$, DSA = 3dB		-156.0		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 2610\text{MHz}$, DSA = 3dB		-155.4		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 3610\text{MHz}$, DSA = 3dB		-155.1		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 4910\text{MHz}$, DSA = 3dB		-155.1		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48, $3 \leq \text{Atten} \leq 22$		-147.8		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24, $3 \leq \text{Atten} \leq 22$		-151.5		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 22$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-156.6		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 830\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 22$		-156.0		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 1760\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 25$		-155.8		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 2610\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 25$		-155.7		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 3610\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 25$		-155.4		dBFS/Hz
	$f_{IN} = 4910\text{MHz}$, $3 \leq \text{Atten} \leq 25$		-155.8		dBFS/Hz
NF _{min}	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		29.4		dB
	$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		24.5		dB
	$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		19.3		dB
	$f_{IN} = 830\text{MHz}$		19.1		dB
	$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		19.0		dB
	$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		20.9		dB
	$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		22.8		dB
	$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		22.4		dB

4.6 射频 ADC 电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$; 高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$, 以及高于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$; 低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$; 高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式, $f_{\text{CLK}} = 9\text{GHz}$; 标称电源; DSA 设置 = 3dB; 串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
NF	噪声系数 ⁽⁴⁾ DSA 衰减 = 4dB	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48	30.6		dB
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24	25.1		dB
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24	20.1		dB
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$	20.0		dB
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$	20.6		dB
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$	21.9		dB
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$	23.5		dB
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$	22.3		dB
NF _{max}	噪声系数 DSA Atten=20dB	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48	45.9		dB
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24	40.2		dB
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24	35.0		dB
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$	34.7		dB
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$	35.2		dB
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$	36.0		dB
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$	37.3		dB
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$	37.6		dB
IMD3	$f_{\text{IN}} \pm 10\text{MHz}$ 时三阶双音互调 单音幅度为 -7dBFS	$f_{\text{IN}} = 30 \pm 1\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24	-82		dBc
		$f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$ 和 405MHz , $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24	-75		dBc
		$f_{\text{IN}} = 840\text{MHz}$	-82		dBc
		$f_{\text{IN}} = 1770\text{MHz}$	-84		dBc
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$	-74		dBc
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$	-77		dBc
		$f_{\text{IN}} = 4920\text{MHz}$	-76		dBc
SFDR	无杂散动态范围 在输出带宽范围内, $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48	78		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24	100		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24	94		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$	88		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$	81		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$	88		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$	84		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$	79		dBFS

4.6 射频 ADC 电气特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^\circ\text{C}$ 至 $T_{J,MAX} = +110^\circ\text{C}$; 高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{ADC} = 2949.12\text{MSPS}$, 以及高于 6GHz 时 $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$; 低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式, $f_{REF} = 491.52\text{MHz}$; 高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式, $f_{CLK} = 9\text{GHz}$; 标称电源; DSA 设置 = 3dB; 串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HD2	二次谐波失真 $A_{IN} = -3\text{dBFS}^{(2)}$	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-84		dBFS
		$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-91		dBFS
		$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-90		dBFS
		$f_{IN} = 830\text{MHz}$		-86		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		-90		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		-88		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		-87		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		-84		dBFS
HD3	三次谐波失真 $A_{IN} = -3\text{dBFS}$	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-78		dBFS
		$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-96		dBFS
		$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-94		dBFS
		$f_{IN} = 830\text{MHz}$		-80		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		-85		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		-86		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		-78		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		-75		dBFS
HDn, n>3	SFDR (不包括 HD2 和 HD3) $A_{IN} = -3\text{dBFS}$	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-94		dBFS
		$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-94		dBFS
		$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-94		dBFS
		$f_{IN} = 830\text{MHz}$		-88		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		-81		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		-88		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		-84		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		-82		dBFS
SFDR	无杂散动态范围 $A_{IN} = -13\text{dBFS}$	$f_{IN} = 5\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		101		dBFS
		$f_{IN} = 30\text{MHz}$, $f_{ADC} = 1500\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		105		dBFS
		$f_{IN} = 410\text{MHz}$, $f_{ADC} = 3000\text{MSPS}$, $f_{NCO} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		95		dBFS
		$f_{IN} = 830\text{MHz}$		89		dBFS
		$f_{IN} = 1760\text{MHz}$		89		dBFS
		$f_{IN} = 2610\text{MHz}$		95		dBFS
		$f_{IN} = 3610\text{MHz}$		87		dBFS
		$f_{IN} = 4910\text{MHz}$		90		dBFS

4.6 射频 ADC 电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$; 高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$, 以及高于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$; 低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$; 高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式, $f_{\text{CLK}} = 9\text{GHz}$; 标称电源; DSA 设置 = 3dB; 串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HD2	二次谐波失真 ⁽²⁾ $A_{\text{IN}} = -13\text{dBFS}$	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-104		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-91		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-104		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$, 含电路板修整		-79		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$, 含电路板修整		-102		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$, 含电路板修整		-100		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$, 含电路板修整		-101		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$, 含电路板修整		-99		dBFS
HD3	三次谐波失真 $A_{\text{IN}} = -13\text{dBFS}$	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-103		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-84		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 381\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, 旁路模式 (仅 TI 测试模式)		-91		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$		-95		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$		-95		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$		-98		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$		-97		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$		-94		dBFS
HD _n , $n > 3$	SFDR (不包括 HD2 和 HD3) $A_{\text{IN}} = -13\text{dBFS}$	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-104		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-105		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 410\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-95		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$		-89		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$		-89		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$		-95		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$		-90		dBFS
		$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$		-90		dBFS

4.6 射频 ADC 电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$; 高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS, 低于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$, 以及高于 6GHz 时 $f_{\text{ADC}} = 3000\text{MSPS}$; 低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$; 高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式, $f_{\text{CLK}} = 9\text{GHz}$; 标称电源; DSA 设置 = 3dB; 串行器/解串行器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TX-RX 隔离	$f_{\text{IN}} = 5\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 17\text{MHz}$, 抽取因子为 48		-105		dB
	$f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$, $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 30\text{MHz}$, 抽取因子为 24		-101		dB
	$f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$		-99		dB
	$f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$		-86		dB
	$f_{\text{IN}} = 1760\text{MHz}$		-87		dB
	$f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$		-84		dB
	$f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$		-82		dB
	$f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$		-82		dB

- 通过向 DSA 添加数字增益范围, 可以降低最小衰减时的输入满量程, 从而扩展 DSA 的有用范围。噪声系数在数字增益范围内保持恒定。
- 在特定印刷电路板上进行 HD2 修整之后。
- 在 DSA = 3dB 至 0dB 范围内, DSA 每降低 1dB, NSD 增加 1dB
- DSA 大于 3dB 时, 每增加 1dB, NF 增加 1dB

4.7 PLL/VCO/时钟电气特性

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T_{A,MIN} = -40°C 至 T_{J,MAX} = +110°C；参考时钟输入频率 491.52MHz（除非另有说明），f_{DAC} = f_{VCO}，f_{OUT} = f_{DAC}/4，归一化为 f_{VCO}。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{VCO1}	VCO1 最小频率				7.2	GHz
	VCO1 最大频率		7.68			GHz
f _{VCO2}	VCO2 最小频率				8.848	GHz
	VCO2 最大频率		9.216			GHz
f _{VCO3}	VCO3 最小频率				9.8304	GHz
	VCO3 最大频率		10.24			GHz
f _{VCO4}	VCO4 最小频率				11.7965	GHz
	VCO4 最大频率		12.288			GHz
DIV _{DAC}	DAC 采样率分频器			1、2 或 3 个		
DIV _{RXADC}				1、2、 3、4、6 或 8		
PN _{VCO}	闭环相位噪声 F _{PLL} = 11.79848GHz F _{REF} =491.52MHz	600kHz		-113		dBc/Hz
		800kHz		-116		dBc/Hz
		1MHz		-119		dBc/Hz
		1.8MHz		-125		dBc/Hz
		5MHz		-133		dBc/Hz
		50MHz		-141		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F _{PLL} =8.84736GHz F _{REF} =491.52MHz	600kHz		-114		dBc/Hz
		800kHz		-118		dBc/Hz
		1MHz		-120		dBc/Hz
		1.8MHz		-127		dBc/Hz
		5MHz		-135		dBc/Hz
		50MHz		-142		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F _{PLL} = 9.8403GHz F _{REF} =491.52MHz	600kHz		-113		dBc/Hz
		800kHz		-116		dBc/Hz
		1MHz		-119		dBc/Hz
		1.8MHz		-125		dBc/Hz
		5MHz		-134		dBc/Hz
		50MHz		-140		dBc/Hz
	闭环相位噪声 F _{PLL} = 7.86432GHz F _{REF} =491.52MHz	600kHz		-116		dBc/Hz
		800kHz		-119		dBc/Hz
		1MHz		-122		dBc/Hz
		1.8MHz		-127		dBc/Hz
		5MHz		-136		dBc/Hz
		50MHz		-143		dBc/Hz
F _{rms}	时钟 PLL 集成相位误差 ⁽¹⁾	f _{PLL} =11.79848GHz、[1KHz、100MHz]		-43.4		dBc/Hz
		f _{PLL} =8.8536GHz、[1KHz、100MHz]		-47.6		dBc/Hz
		f _{PLL} =9.8304GHz、[1KHz、100MHz]		-46.2		dBc/Hz
f _{PFD}	PFD 频率		100		500	MHz
PN _{pll_flat}	归一化 PLL 平坦噪声	f _{VCO} = 11796.48MHz		-226.5		dBc/Hz

4.7 PLL/VCO/时钟电气特性（续）

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C；参考时钟输入频率 491.52MHz（除非另有说明），fDAC = fVCO，fOUT = fDAC/4，归一化为 fVCO。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
FREF	输入时钟频率		0.1		12	GHz
VSS	输入时钟电平		0.6		1.8	Vppdiff
耦合			仅交流耦合			
	REFCLK 输入阻抗 ⁽²⁾	并联电阻		100		Ω
		并联电容		0.5		pF

- (1) 单边带，不包括参考时钟贡献
- (2) 有关阻抗与频率间的关系，请参阅 TI 提供的 S11 数据

4.8 数字电气特性

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T_{A,MIN} = -40°C 至 T_{J,MAX} = +110°C (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CML 串行器/解串器输入 [8:1]SRX+/-						
V _{SRDIFF}	串行器/解串器接收器输入振幅	差分	100		1200	mVpp
V _{SRCOM}	串行器/解串器输入共模			400		mV
Z _{SRdiff}	串行器/解串器内部差分终端 ⁽¹⁾			100		Ω
F _{SerDes}	串行器/解串器比特率	全速率模式	19		29.5	Gbps
		半速率模式	9.5		16.25	
		四分之一速率模式	4.75		8.125	
		第 1/8	2.375		4.062	
		第 1/16	1.1875		2.031	
	插入损耗容差 ⁽²⁾	串行器/解串器电源 = 1.8V		25		dB
T _J	总抖动容差				0.42	UI
CML 串行器/解串器输出 [8:1]STX+/-						
V _{STDIFF}	串行器/解串器发送器输出振幅	差分	500		1000	mVpp
V _{STCOM}	串行器/解串器输出共模		0.4	0.45	0.55	V
Z _{STdiff}	串行器/解串器输出阻抗			100		Ω
TRF	输出上升和下降时间	20-80%	8			ps
TEQS	均衡范围				7	dB
TTJ	输出总抖动				0.21	UI
CMOS I/O : GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPIDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1						
V _{IH}	高电平输入电压		0.6×VDD1 P8GPIO			V
V _{IL}	低电平输入电压			0.4×VDD1 P8GPIO		V
I _{IH}	高电平输入电流		-250		250	μA
I _{IL}	低电平输入电流		-250		250	μA
C _L	CMOS 输入电容			2		pF
V _{OH}	高电平输入电压		VDD1P8G PIO-0.2			V
V _{OL}	低电平输入电压				0.2	V
差分输入 : SYSREF+/- 模式 A						
F _{SYSREFMAX}	SYSREF 输入频率最大值			40		MHz
V _{SWINGSRMAX}	SYSREF 输入摆幅最大值			1.8		Vppdiff ⁽³⁾
V _{SWINGSRMIN}	SYSREF 输入摆幅最小值	f _{REF} < 500MHz		0.3		Vppdiff ⁽³⁾
V _{SWINGSRMIN}	SYSREF 输入摆幅最小值	f _{REF} > 500MHz		0.6		Vppdiff ⁽³⁾
V _{COMSRMAX}	SYSREF 输入共模电压最大值			0.8		V
V _{COMSRMIN}	SYSREF 输入共模电压最小值			0.6		V
Z _T	输入端接	差分		100 ⁽¹⁾		Ω
C _L	输入电容	每个引脚端接至 GND		0.5		pF
LVDS 输入 : 0SYNCIN+/- 和 1SYNCIN+/-						
V _{ICOM}	输入共模电压			1.2		V
V _{ID}	差分输入电压摆幅			450		Vppdiff ⁽³⁾
Z _T	输入端接	差分		100		Ω
LVDS 输出 : 0SYNCOUT+/- 和 1SYNCOUT+/-						

4.8 数字电气特性 (续)

TA = +25°C 时的典型值，整个温度范围为 T_{A,MIN} = -40°C 至 T_{J,MAX} = +110°C (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OCOM}	输出共模电压			1.2		V
V _{OD}	差分输出电压摆幅			500		V _{ppdiff} ⁽³⁾
Z _T	内部端接			100		Ω

- (1) SYSREF 端接可在 100 Ω、150 Ω 和 300 Ω 之间进行编程
- (2) 损耗容差为从 STX 到 SRX 的凸点间容差
- (3) V_{ppdiff} 是最大差分电压 (正值) 与最小差分电压 (负值) 之间的差值。

4.9 电源电气特性

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 1a: 2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX: 125MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 3\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 1.5\text{GSPS}$ 、12 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$ 串行器/解串器: 8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS : 1-4-8-1		260		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			297		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0			70		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			89		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			288		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			76		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			536		mA
P_{diss}	功率耗散			2166		mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 1b: 2T2R - TX 处于有源模式，RX 处于待机模式 TX: 125MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 3\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 1.5\text{GSPS}$ 、12 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$ 串行器/解串器: 8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS : 1-4-8-1		205		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			282		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0			71		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			21		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			365		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			76		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			499		mA
P_{diss}	功率耗散			2014		mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 1c: 2T2R - RX 处于有源模式，TX 处于待机模式 TX: 125MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 3\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 1.5\text{GSPS}$ 、12 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$ 串行器/解串器: 8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS : 1-4-8-1		315		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			313		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0			70		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			157		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			211		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			76		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			573		mA
P_{diss}	功率耗散			2318		mW

4.9 电源电气特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$ 至 $T_{A,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$; 标称电源; 单音幅度为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB; 串行器/解串器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 2: 2T2R - FDD TX: 125MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 3\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 1.5\text{GSPS}$ 、12 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = 400\text{MHz}$ 、 $f_{\text{IN}} = 500\text{MHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS: 1-4-8-1	458			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		335			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO		71			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX		158			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		386			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		77			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		728			mA
P_{diss}	功率耗散		2974			mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 3a: 2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX: 500MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、6 倍抽取、500MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 2-4-4-1	307			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		321			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO		73			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX		157			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		397			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		89			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		1108			mA
P_{diss}	功率耗散		3047			mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 3b: 2T2R - TX 处于有源模式, RX 处于待机模式 TX: 500MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$ RX: $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、6 倍抽取、500MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 2-4-4-1	266			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		293			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO		73			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX		26			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		545			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		89			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		1061			mA
P_{diss}	功率耗散		2899			mW

4.9 电源电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,MIN} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{A,MAX} = +110^{\circ}\text{C}$; 标称电源; 单音幅度为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB; 串行器/解串器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 3c: 2T2R - RX 处于有源模式, TX 处于待机模式 TX: 500MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{DAC} = 12\text{GSPS}$ RX: $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ 、6 倍抽取、500MSPS 输出 $f_{OUT} = f_{IN} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS : 2-4-4-1		349		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8			350		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO			73		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			287		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			248		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			89		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			1155		mA
P_{diss}	功率耗散			3195		mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 4: 2T2R - FDD TX: 500MSPS 输入、24 倍插值、 $f_{DAC} = 12\text{GSPS}$ RX: $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ 、6 倍抽取、500MSPS 输出 $f_{OUT} = 3.5\text{GHz}$ 、 $f_{IN} = 3.7\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS : 2-4-4-1		550		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8			371		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO			73		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			288		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			567		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			89		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			1568		mA
P_{diss}	功率耗散			4354		mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 5a: 2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX: 双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、 $f_{DAC} = 6\text{GSPS}$ 、混频模式 RX: 双通道 $f_{ADC} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{OUT} = f_{IN} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS : 1-8-16-1		307		mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8			312		mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO			73		mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX			157		mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			370		mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			88		mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9			1051		mA
P_{diss}	功率耗散			2948		mW

4.9 电源电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{A,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$; 标称电源; 单音幅度为 -1dBFS; DSA 衰减 = 0dB; 串行器/解串器速率 = 24.33Gbps; 除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 5b: 2T2R-TX 处于有源模式, RX 处于待机模式 TX: 双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ 、混频模式 RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	265			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		284			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0		73			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX	RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	26			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		507			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		88			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		969			mA
P_{diss}	功率耗散		2749			mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 5c: 2T2R-RX 处于有源模式, TX 处于待机模式 TX: 双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ 、混频模式 RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 和 3.5GHz 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	348			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		341			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0		73			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX	RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 和 3.5GHz 串行器/解串器: 8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	287			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		234			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		88			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		1133			mA
P_{diss}	功率耗散		3146			mW
I_{VDD1P8}	3A 组: VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 6: 2T2R-FDD TX: 双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、 $f_{\text{DAC}} = 6\text{GSPS}$ 、混频模式 RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	550			mA
	3B 组: VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8		362			mA
	3C 组: VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0		73			mA
I_{VDD1P2}	2A 组: VDD1P2FB + VDD1P2RX	RX: 双通道 $f_{\text{ADC}} = 3\text{GSPS}$ 、24 倍抽取、125MSPS 输出 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}} = 3.5\text{GHz}$ 串行器/解串器: 8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS: 1-8-16-1	289			mA
	2B 组: VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC		530			mA
	2C 组: VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF		89			mA
I_{VDD0P9}	1A 组: DVDD0P9 + VDDT0P9		1518			mA
P_{diss}	功率耗散		4253			mW

4.9 电源电气特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{VDD1P8}	3A 组：VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX	模式 7：配置与模式 2 “睡眠模式” 相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。		16		mA
	3B 组：VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8			174		mA
	3C 组：VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVC0			12		mA
I_{VDD1P2}	2A 组：VDD1P2FB + VDD1P2RX			4		mA
	2B 组：VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC			33		mA
	2C 组：VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF			37		mA
I_{VDD0P9}	1A 组：DVDD0P9 + VDDT0P9			155		mA
P_{diss}	功率耗散			596		mW

4.10 时序要求

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^{\circ}\text{C}$ ；TX 输入速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ； $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

		最小值	标称值	最大值	单位
时序：SYSREF+/-					
$t_s(\text{SYSREF})$	建立时间，SYSREF+/- 有效至 CLK+/- 上升沿		50		ps
$t_h(\text{SYSREF})$	保持时间，CLK+/- 上升沿之后 SYSREF+/- 有效		50		ps
时序：串行端口					
$t_s(\text{SDEN})$	建立时间，SDEN 至 SCLK 上升沿		15		ns
$t_h(\text{SDEN})$	保持时间，SCLK ⁽¹⁾ 最后一个上升沿之后的 SDEN		$5 + t_{\text{SCLK}}$		ns
$t_s(\text{SDIO})$	建立时间，SDIO 有效至 SCLK 上升沿		15		ns
$t_h(\text{SDIO})$	保持时间，SCLK 上升沿之后 SDIO 有效		5		ns
$t_{\text{SCLK_W}}$	最小 SCLK 周期：寄存器写入		25		ns
$t_{\text{SCLK_R}}$	最小 SCLK 周期：寄存器读取		50		ns
$t_d(\text{data_out})$	SCLK 下降沿之后的最小数据输出延迟		0		ns
	SCLK 下降沿之后的最大数据输出延迟		15		ns
t_{RESET}	最小 RESETZ 脉冲宽度		1		ms

(1) SDEN 需要在最后一个 SCLK 边沿再保持一个额外的时钟周期

4.11 开关特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值，整个温度范围为 $T_{A,\text{MIN}} = -40^\circ\text{C}$ 至 $T_{J,\text{MAX}} = +110^\circ\text{C}$ ；TX 输入速率 = 491.52MSPS， $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$ ； $f_{\text{ADC}} = 2949.12\text{MSPS}$ ；标称电源；单音幅度为 -1dBFS；DSA 衰减 = 0dB；串行器/解串器速率 = 24.33Gbps；除非另有说明。

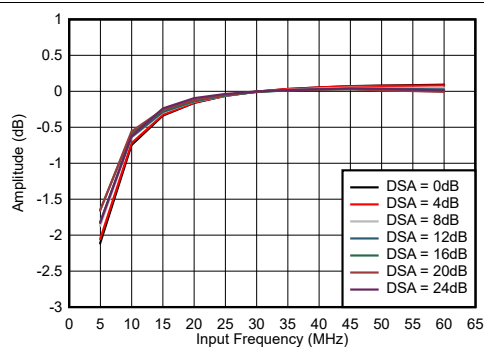
参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TX 通道延迟						
	串行器/解串器接收器模拟延迟	全速率		2.8		ns
t _{JESD TX}	JESD 到 TX 输出延迟	LMFSHd=2-8-8-1，368.64MSPS 输入速率，24 倍插值，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		152		接口时钟周期 ⁽¹⁾
		LMFSHd=8-16-4-1，491.52MSPS 24 倍插值，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		176		
		LMFSHd=4-16-8-1，245.76MSPS 48 倍插值，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		124		
		LMFSHd=2-16-16-1，122.88MSPS 96 倍插值，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		97		
RX 通道延迟						
t _{JESD RX}	RX 输入至 JESD 输出延迟	LMFS=2-16-16-1，122.88MSPS，24 倍抽取，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		92		接口时钟周期 ⁽¹⁾
		LMFS=4-16-8-1，245.76MSPS，12 倍抽取，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		108		
		LMFS=2-8-8-1，368.64MSPS，8 倍抽取，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		118		
		LMFS=4-8-4-1，491.52MSPS，6 倍抽取，串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C)		153		
	串行器/解串器发送器模拟延迟			3.6		ns

(1) 接口时钟周期是数字接口时钟速率的时段，例如 1GSPS = 1ns。

4.12 典型特性

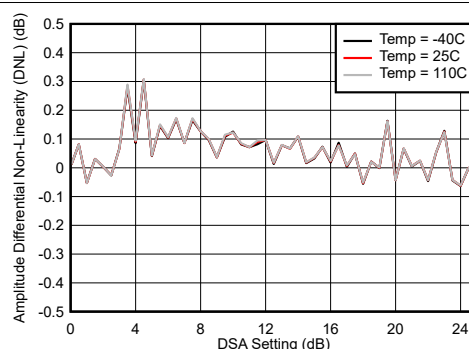
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



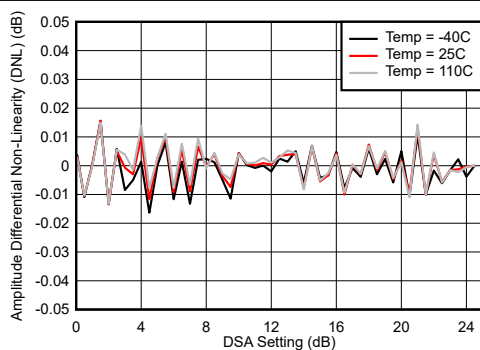
标准化为 30MHz

图 4-1. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 30\text{MHz}$



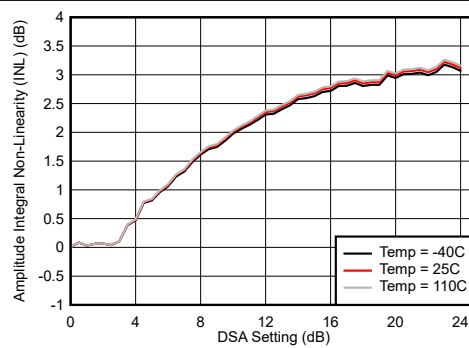
差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-2. 30MHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



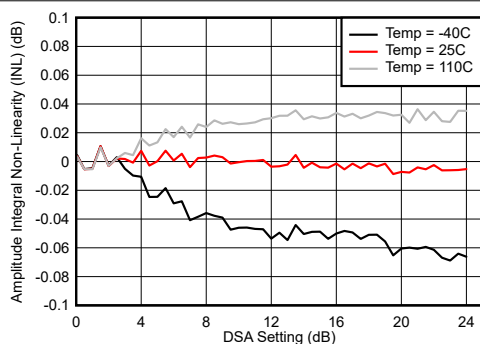
差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-3. 30MHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



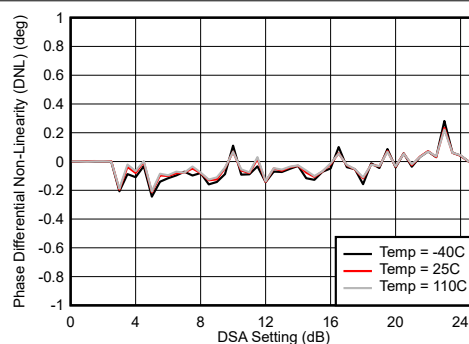
积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-4. 30MHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-5. 30MHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

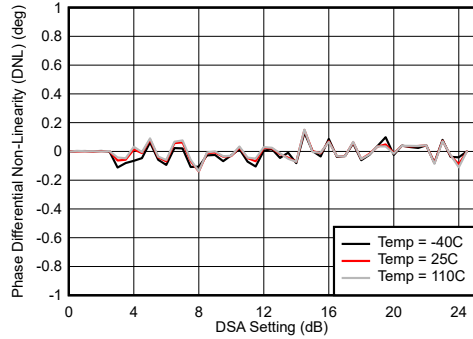


差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-6. 30MHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系

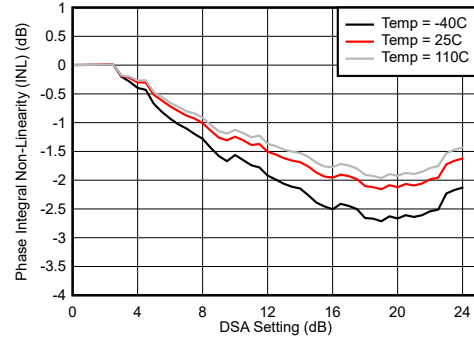
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



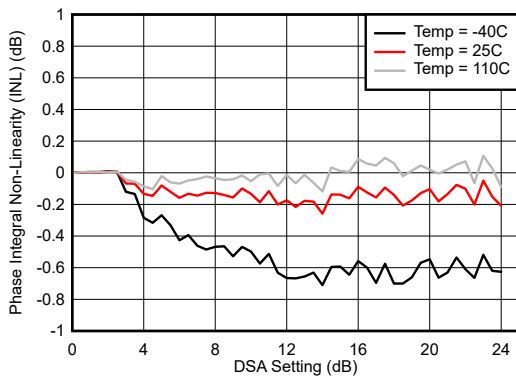
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-7. 30MHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

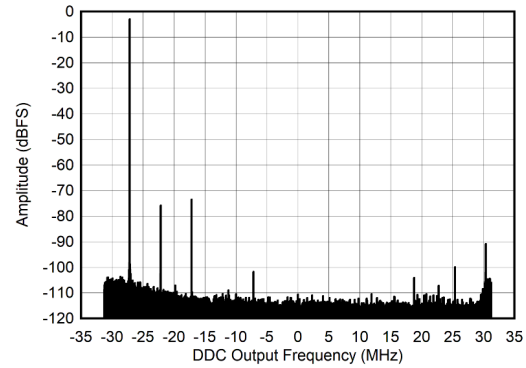
图 4-8. 30MHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-9. 30MHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系

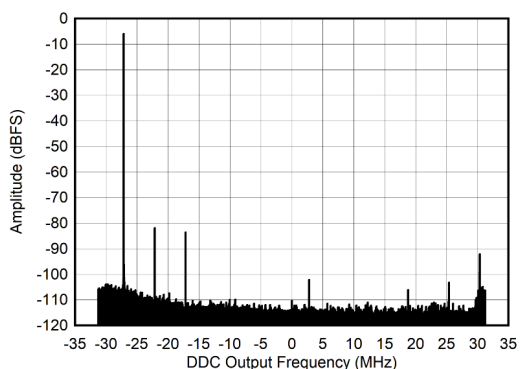


$A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-10. 5MHz 条件下的 RX 输出 FFT

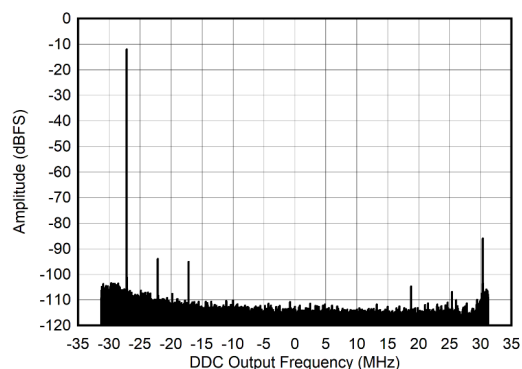
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



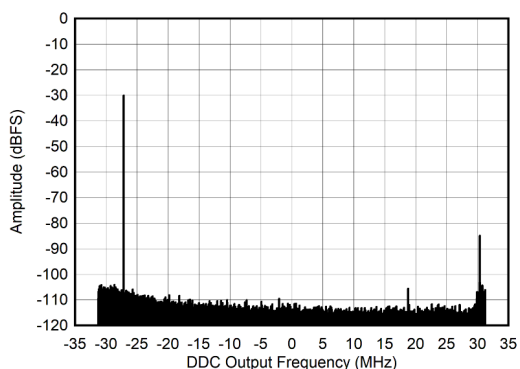
$A_{\text{IN}} = -6\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32$ 。抽取因子为 24x

图 4-11. 5MHz 条件下的 RX 输出 FFT



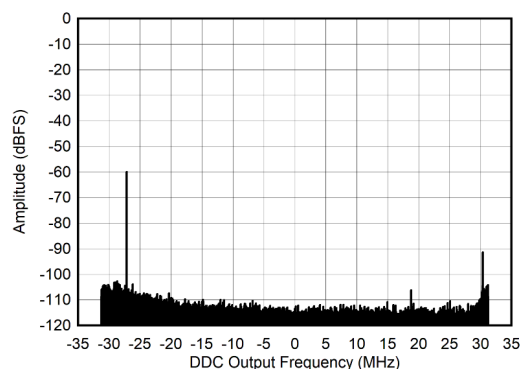
$A_{\text{IN}} = -12\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-12. 5MHz 条件下的 RX 输出 FFT



$A_{\text{IN}} = -30\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-13. 5MHz 条件下的 RX 输出 FFT

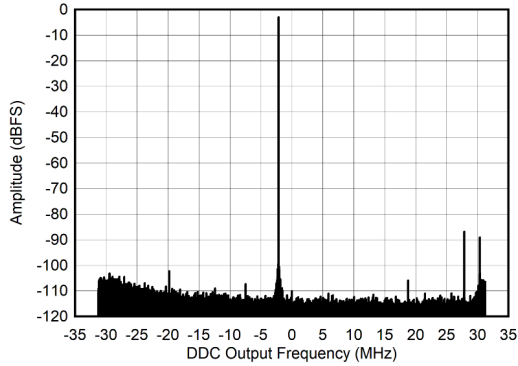


$A_{\text{IN}} = -60\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-14. 5MHz 条件下的 RX 输出 FFT

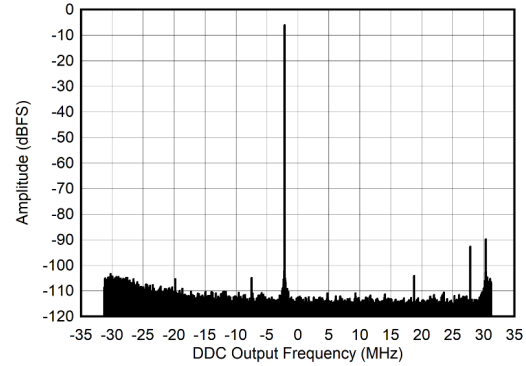
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS (抽取因子为 24x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS (抽取因子为 12x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



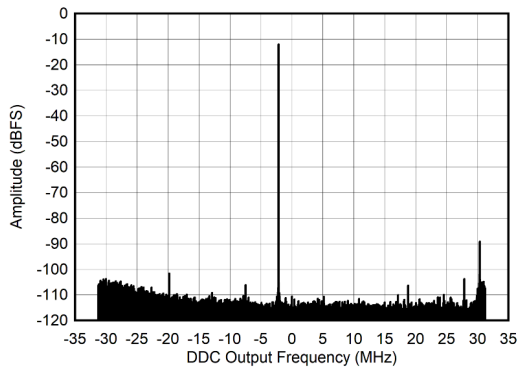
$A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-15. 30MHz 条件下的 RX 输出 FFT



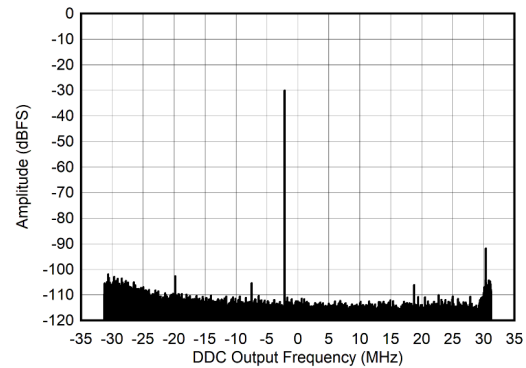
$A_{\text{IN}} = -6\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-16. 30MHz 条件下的 RX 输出 FFT



$A_{\text{IN}} = -12\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-17. 30MHz 条件下的 RX 输出 FFT

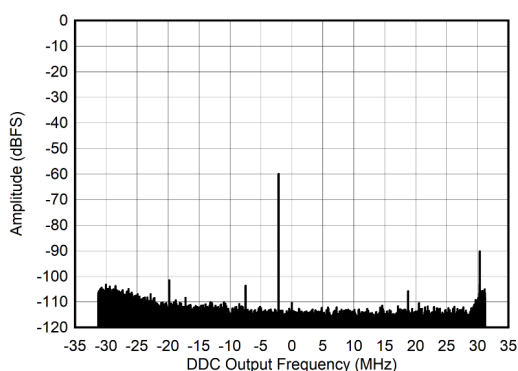


$A_{\text{IN}} = -30\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-18. 30MHz 条件下的 RX 输出 FFT

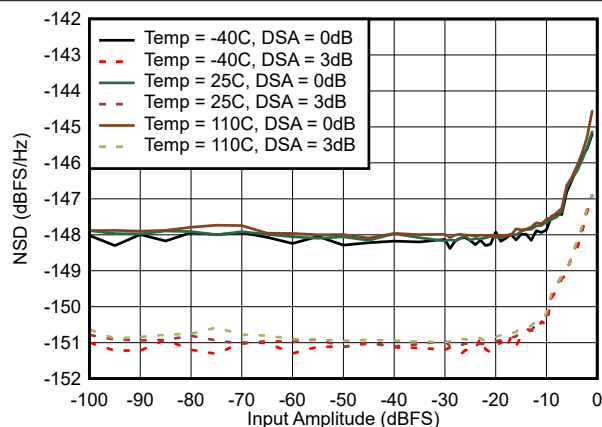
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



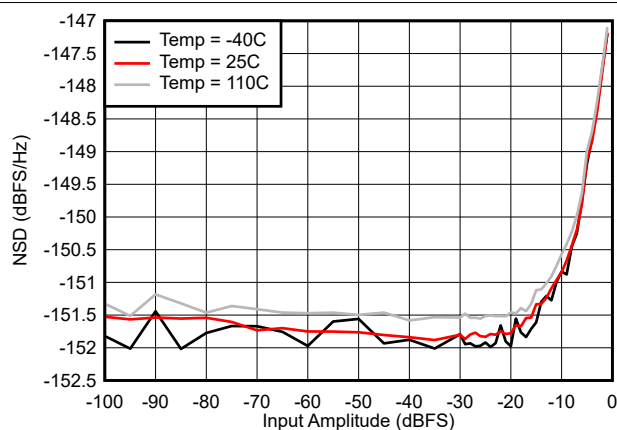
$A_{\text{IN}} = -60\text{dBFS}$ ， $f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-19. 30MHz 条件下的 RX 输出 FFT



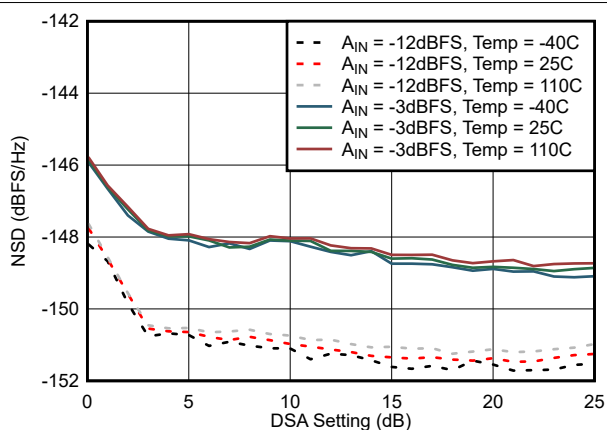
$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-20. 30MHz、DSA = 0dB 和 3dB 条件下 NSD 与输入振幅间的关系



$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-21. 30MHz、DSA = 12dB 条件下 NSD 与输入振幅间的关系

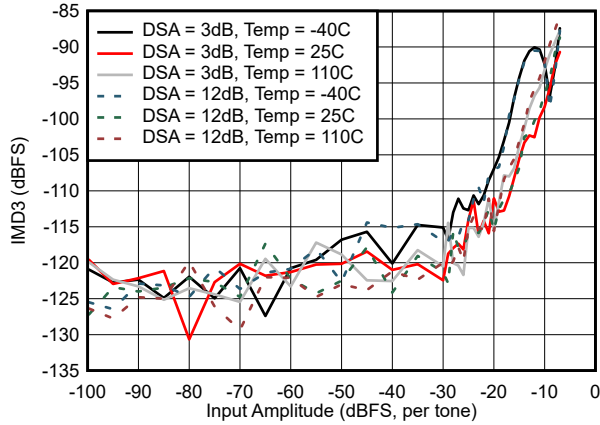


$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$ ， $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$ ，抽取因子为 24x

图 4-22. 30MHz 条件下 NSD 与 DSA 衰减间的关系

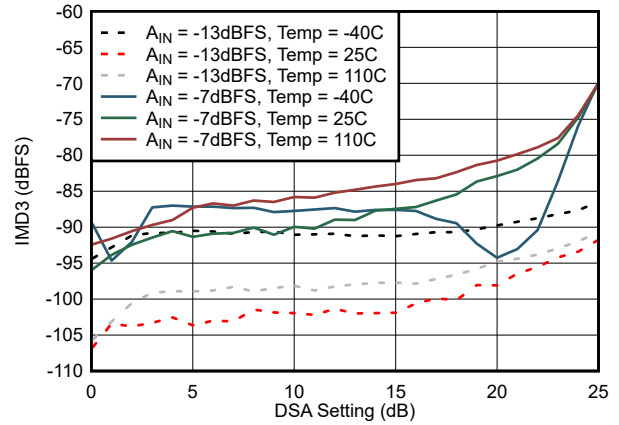
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



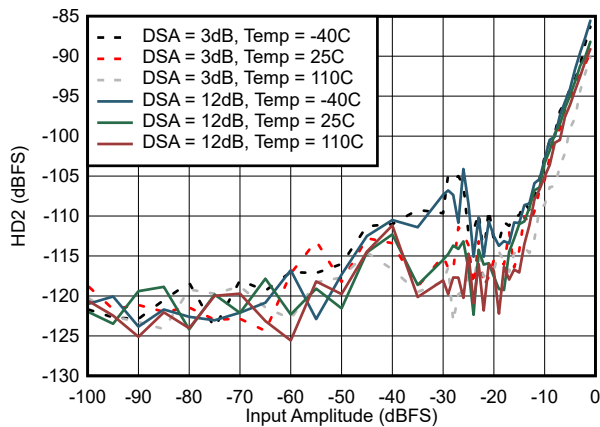
$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$, 抽取因子为 24x

图 4-23. 30MHz 条件下 IMD3 与输入振幅间的关系



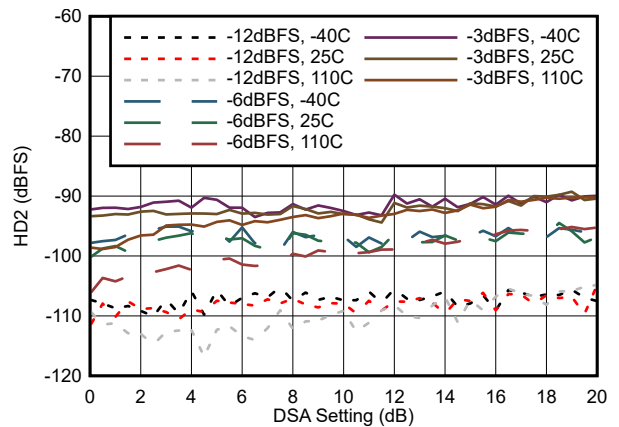
$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$, 抽取因子为 24x

图 4-24. 30MHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置间的关系



$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$, 抽取因子为 24x

图 4-25. 30MHz 条件下 HD2 与输入振幅间的关系

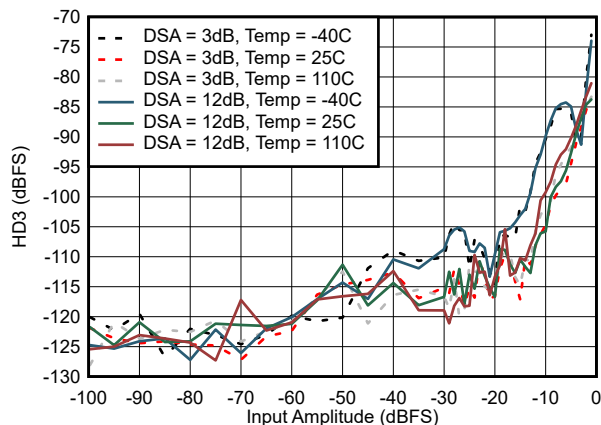


$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32$, 抽取因子为 24x

图 4-26. 30MHz 条件下 HD2 与 DSA 设置间的关系

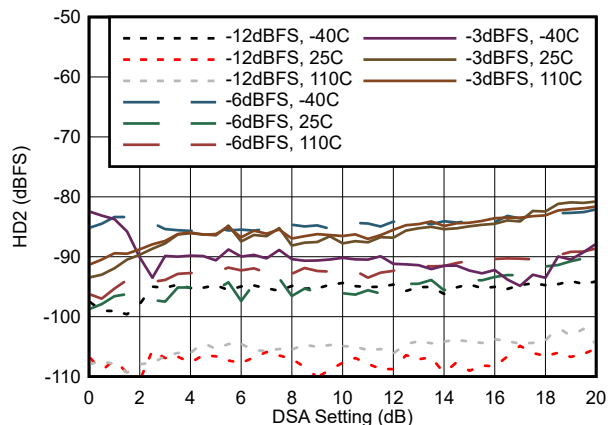
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



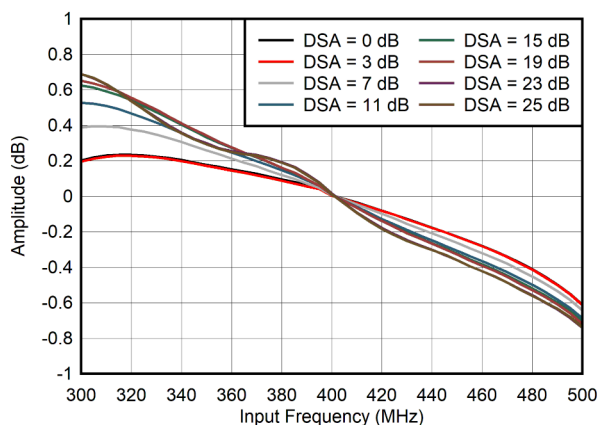
$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$, 抽取因子为 24x

图 4-27. 30MHz 条件下 HD3 与输入振幅间的关系



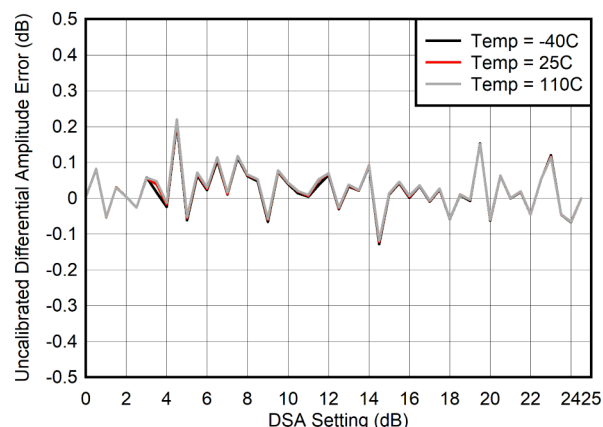
$f_{\text{ADC}} = 1500\text{MSPS}$, $f_{\text{NCO}} = 32.13\text{MHz}$, 抽取因子为 24x

图 4-28. 30MHz 条件下 HD3 与 DSA 设置间的关系



标准化为 400MHz

图 4-29. RX 带内增益平坦度, $f_{\text{IN}} = 400\text{MHz}$

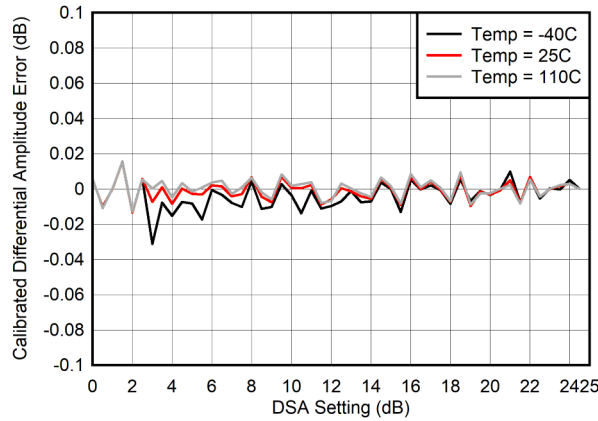


差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-30. 30MHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系

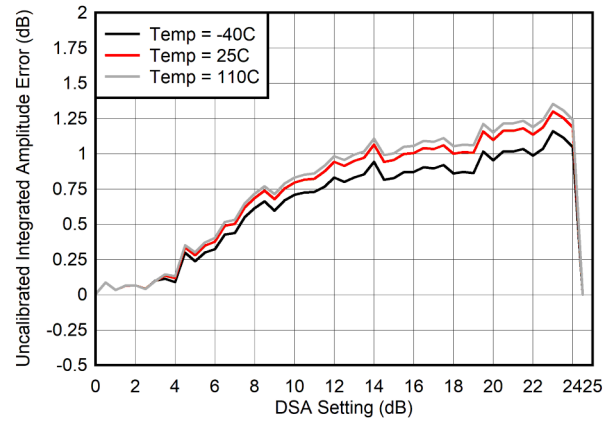
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



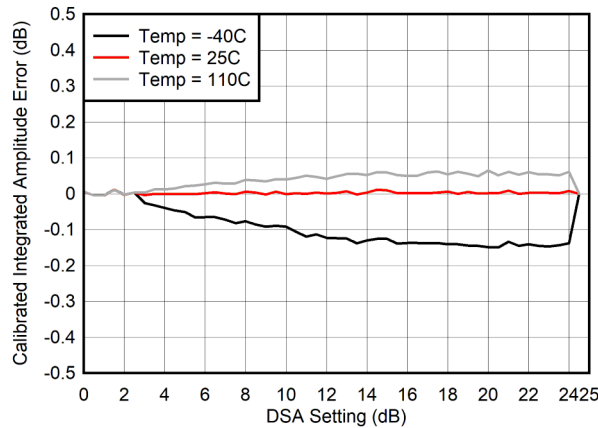
$$\text{差分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$$

图 4-31. 400MHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



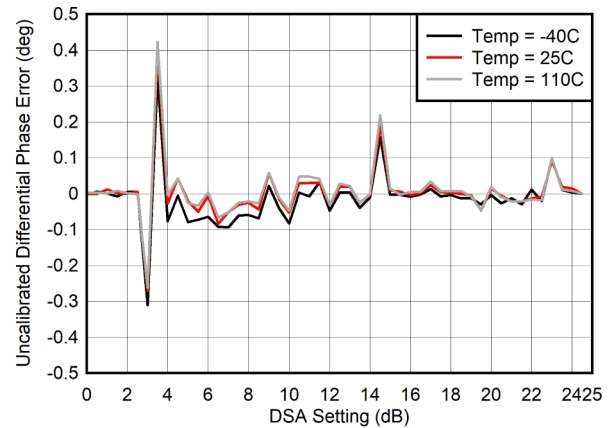
$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 4-32. 400MHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



$$\text{积分振幅误差} = P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

图 4-33. 400MHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

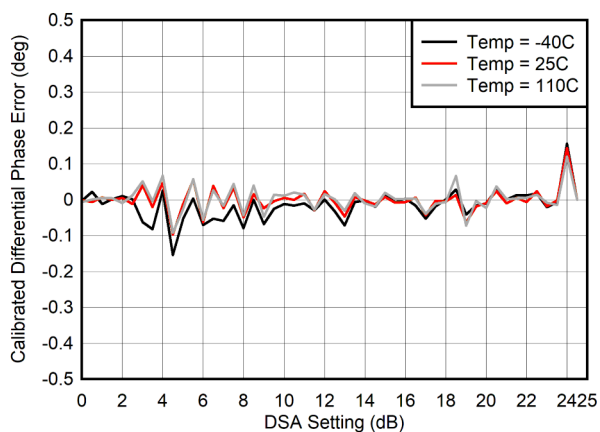


$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$$

图 4-34. 400MHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系

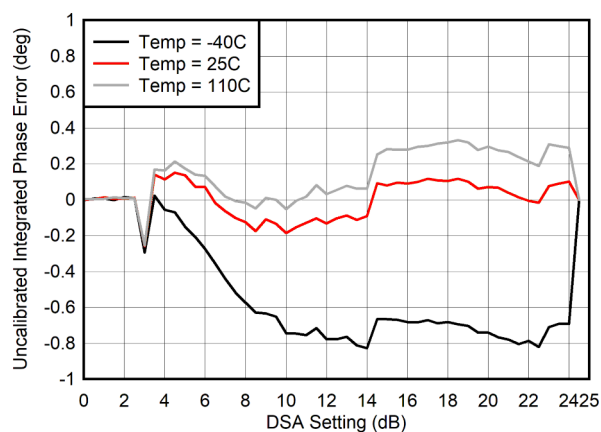
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



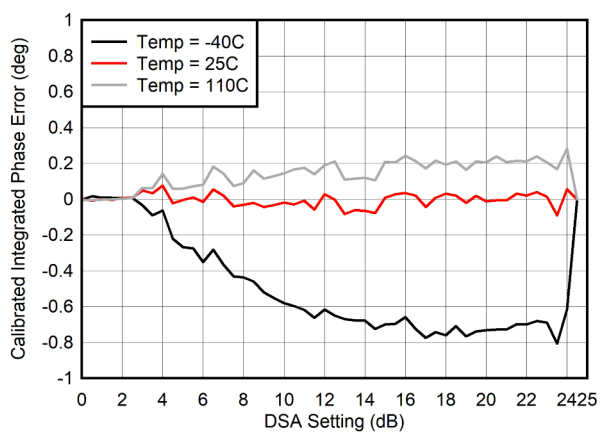
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-35. 400MHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



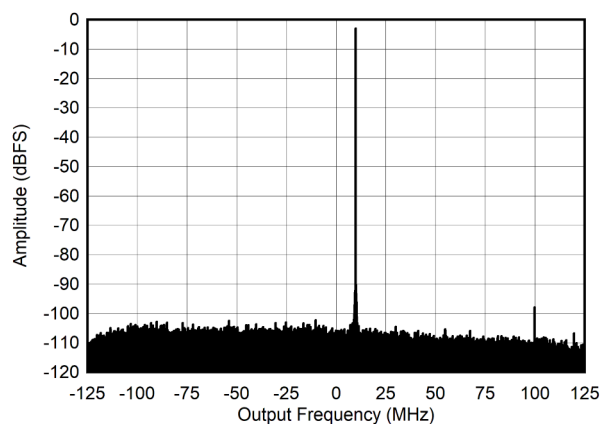
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-36. 400MHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-37. 400MHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系

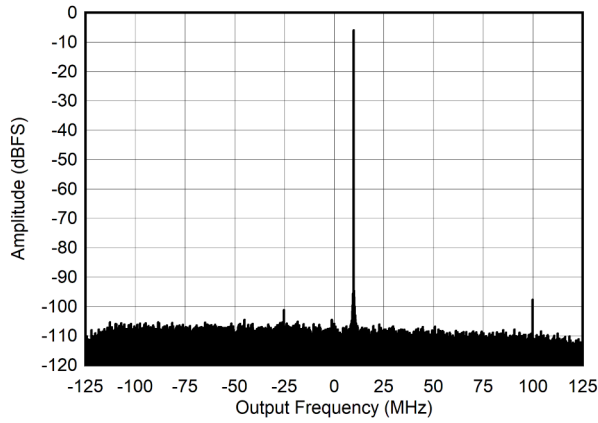


$f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$

图 4-38. 405MHz 和 -3dBFS 条件下的 RX 输出 FFT

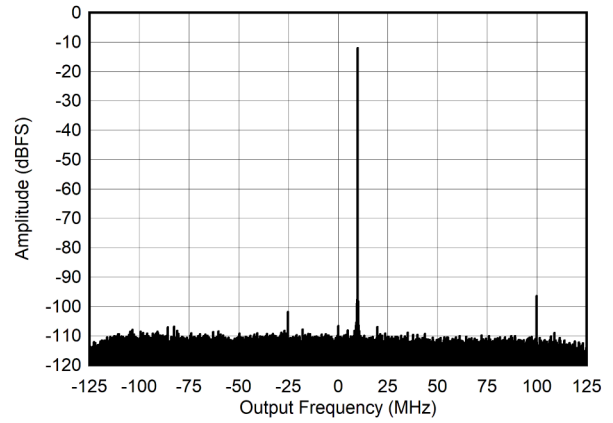
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS (抽取因子为 24x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS (抽取因子为 12x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



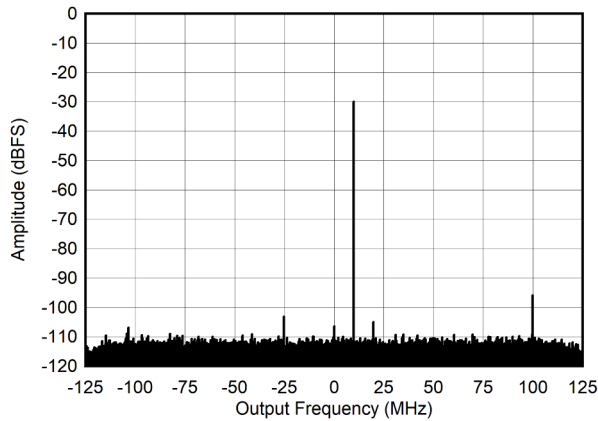
$f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$

图 4-39. 405MHz 和 -6dBFS 条件下的 RX 输出 FFT



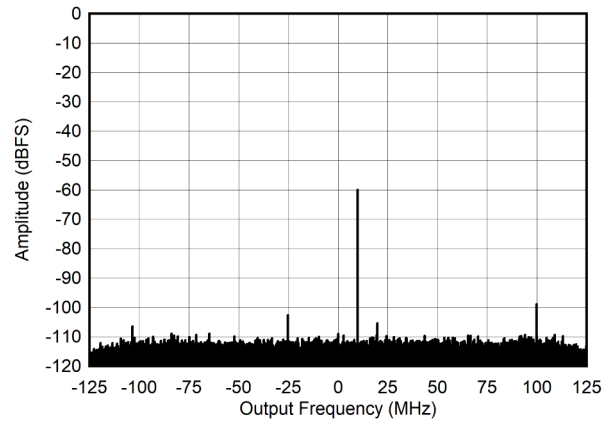
$f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$

图 4-40. 405MHz 和 -12dBFS 条件下的 RX 输出 FFT



$f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$

图 4-41. 405MHz 和 -30dBFS 条件下的 RX 输出 FFT

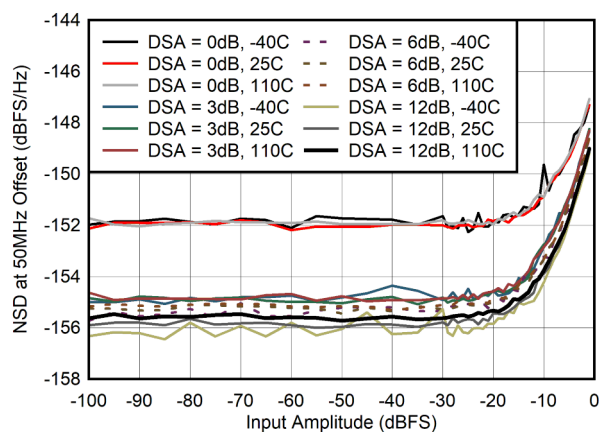


$f_{\text{NCO}} = 400\text{MHz}$

图 4-42. 405MHz 和 -60dBFS 条件下的 RX 输出 FFT

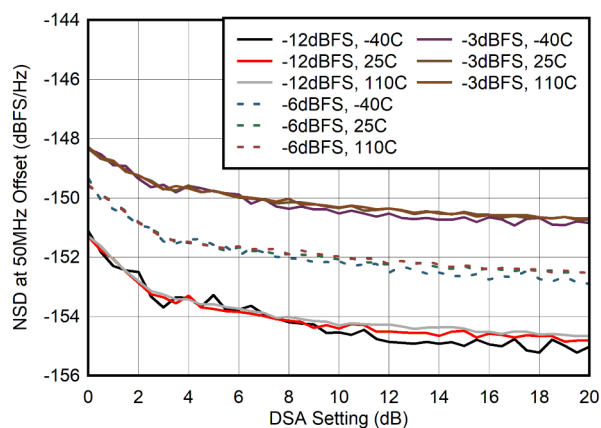
4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS（抽取因子为 24x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS（抽取因子为 12x），PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。



$f_{\text{OFFSET}} = 50\text{MHz}$

图 4-43. 400MHz 条件下 NSD 与输入振幅间的关系



$f_{\text{OFFSET}} = 50\text{MHz}$

图 4-44. 400MHz 条件下 NSD 与 DSA 设置间的关系

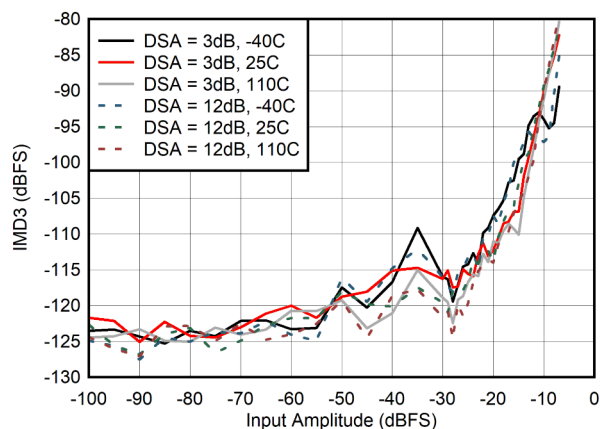


图 4-45. 400MHz 条件下 IMD3 与输入振幅间的关系

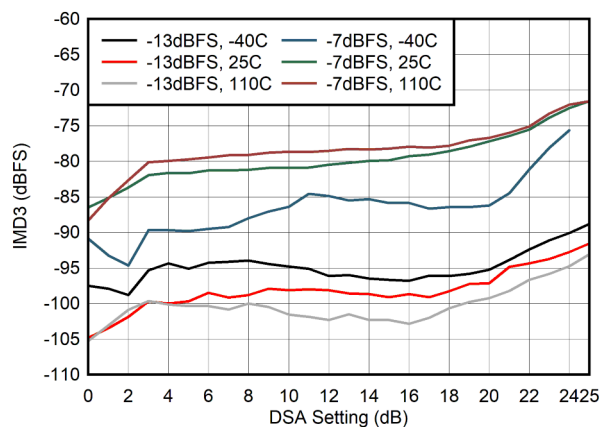


图 4-46. 400MHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置间的关系

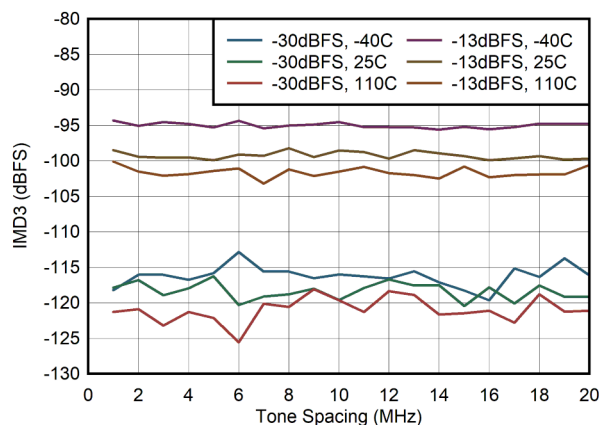


图 4-47. 400MHz 条件下 IMD3 与子载波间隔间的关系

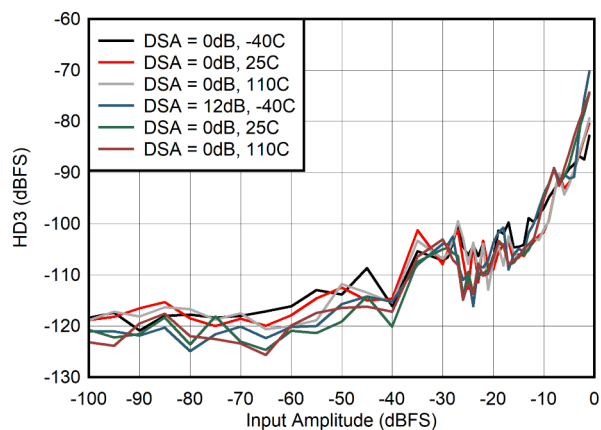


图 4-48. 400MHz 条件下 HD3 与输入振幅间的关系

4.12.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 62.5MSPS (抽取因子为 24x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。400MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 1500MSPS，输出采样率 = 125MSPS (抽取因子为 12x)，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 3dB。

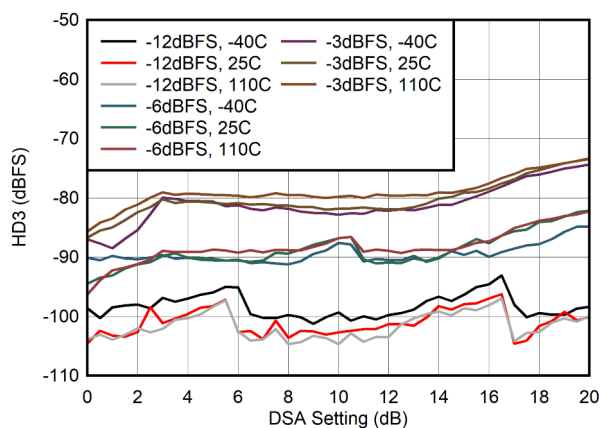
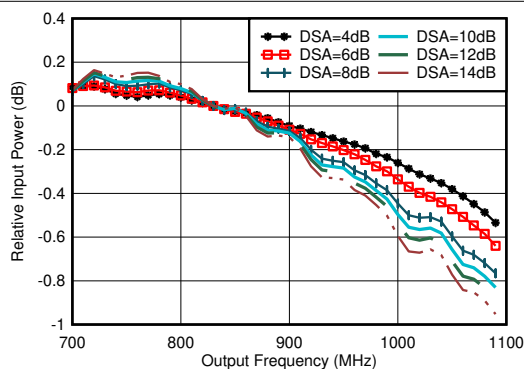


图 4-49. 400MHz 条件下 HD3 与 DSA 设置间的关系

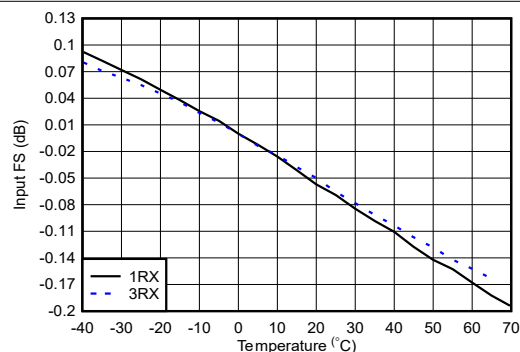
4.12.2 800MHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



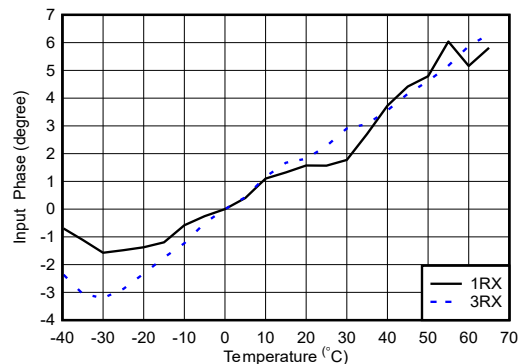
使用 0.8GHz 匹配时，标准化为 830MHz

图 4-50. 通道 1RX 的 RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 830\text{MHz}$



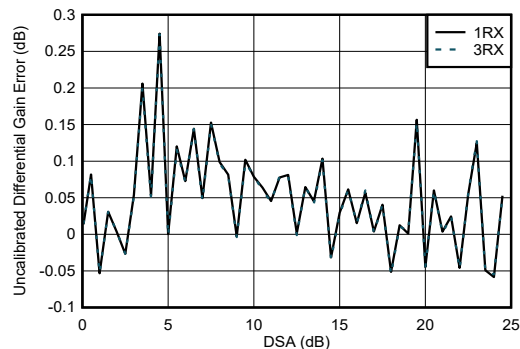
使用 0.8GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 4-51. 800MHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位

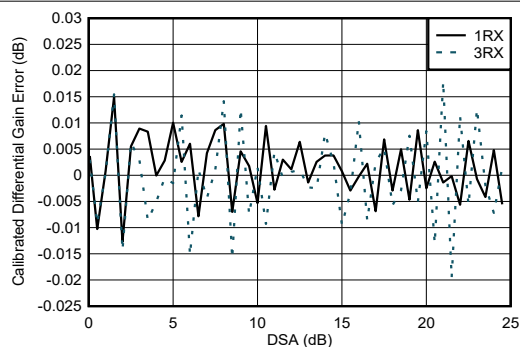
图 4-52. $f_{\text{OUT}} = 0.8\text{GHz}$ 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系



使用 0.8GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

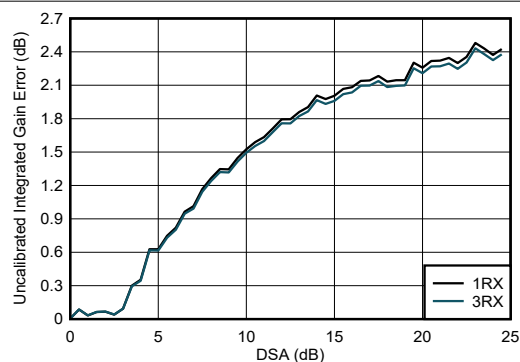
图 4-53. 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-54. 0.8GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



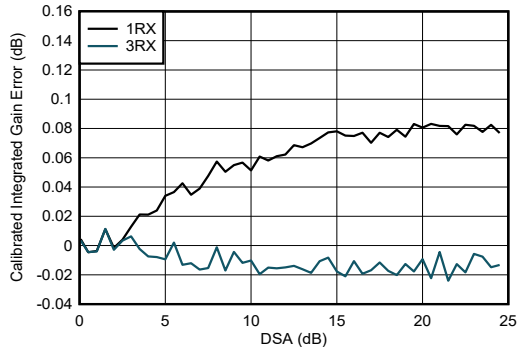
使用 0.8GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-55. 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

4.1.2.2 800MHz 下的RX 典型特性 (续)

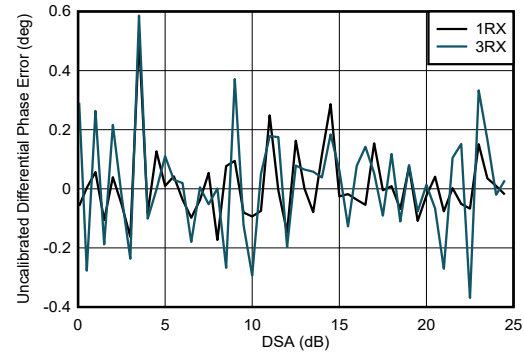
$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 0.8GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

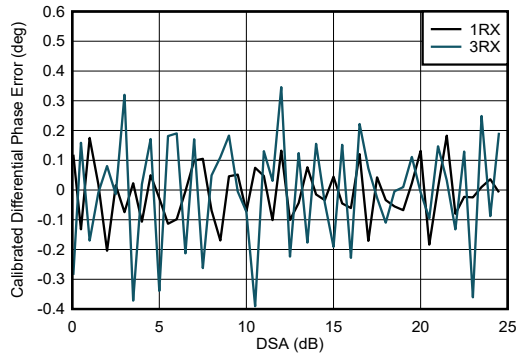
图 4-56. 2.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

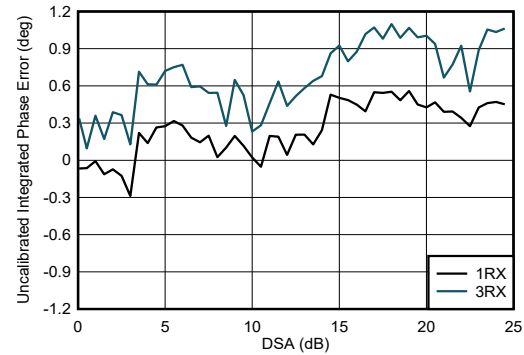
图 4-57. 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 0.8GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-58. 0.8GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



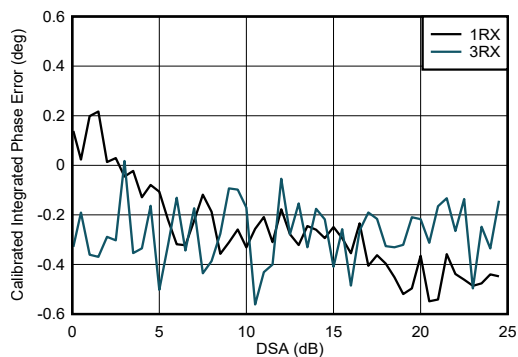
使用 0.8GHz 匹配

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-59. 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系

4.12.2 800MHz 下的 RX 典型特性 (续)

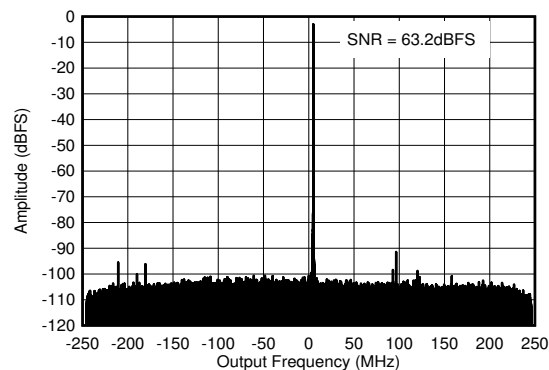
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 0.8GHz 匹配

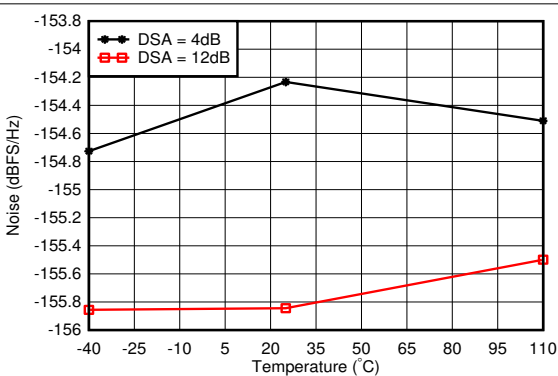
积分相位误差 = Phase (DSA 设置) - Phase (DSA 设置 = 0)

图 4-60. 0.8GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



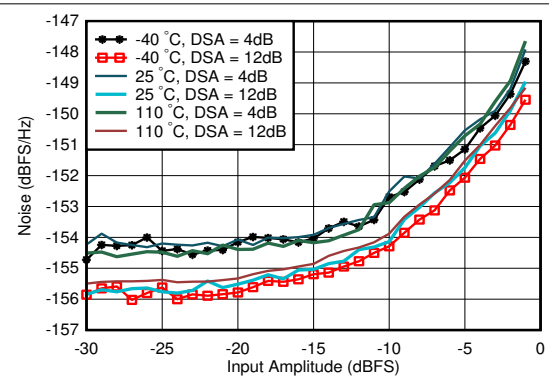
使用 0.8GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 840\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 4-61. 0.8GHz 条件下的 RX 输出 FFT



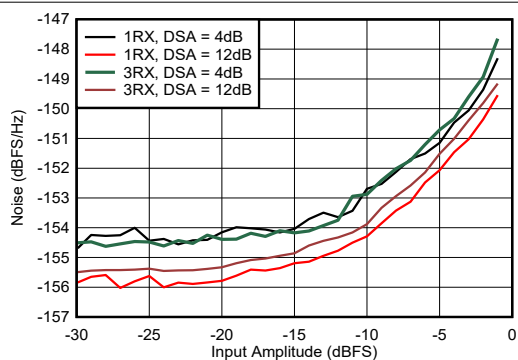
使用 0.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-62. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系



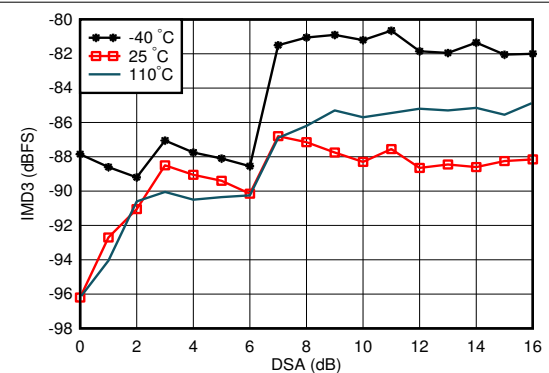
使用 0.8GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 4-63. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-64. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系

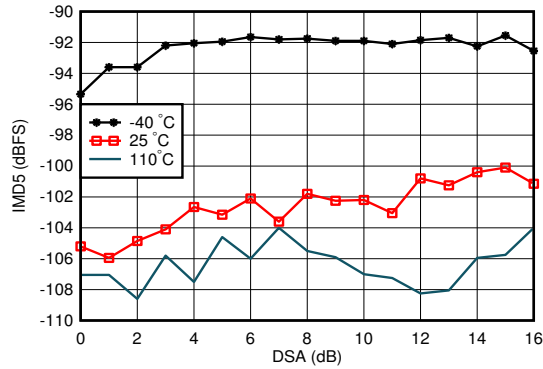


A. 使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 4-65. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系

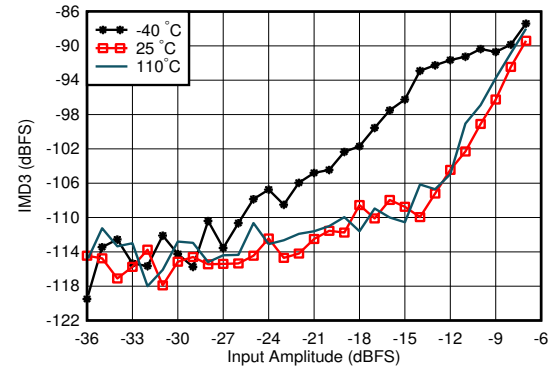
4.12.2 800MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



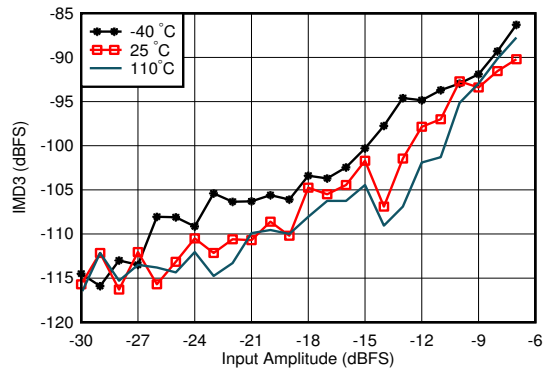
使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 4-66. 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与 DSA 设置和温度间的关系



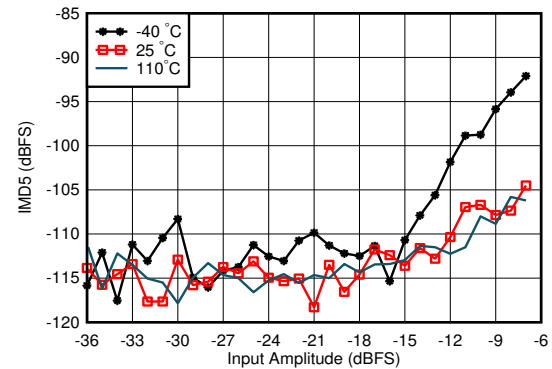
使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 4-67. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



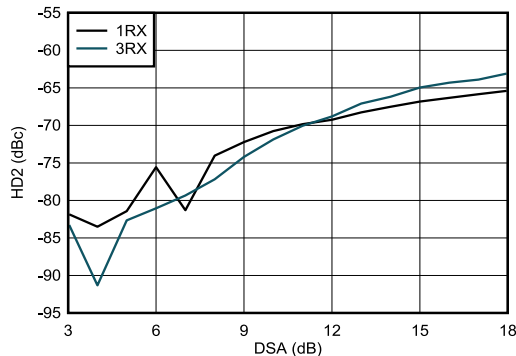
使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 4-68. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



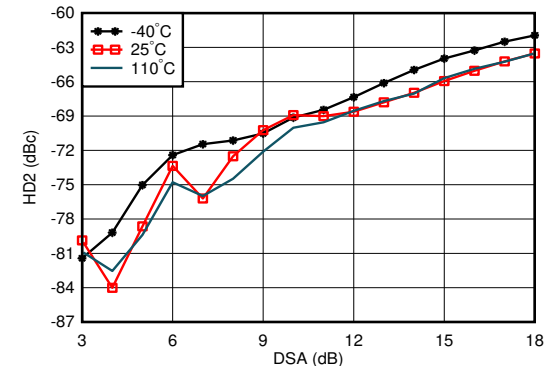
使用 0.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 4-69. 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与输入电平和温度间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-70. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系

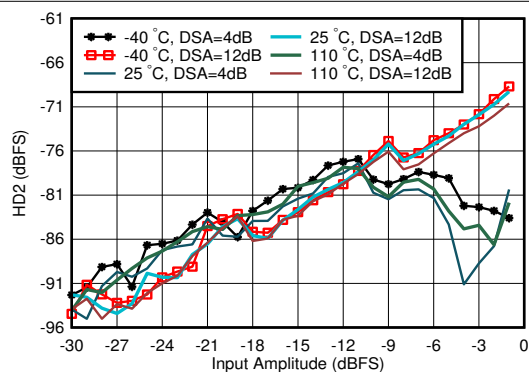


使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-71. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系

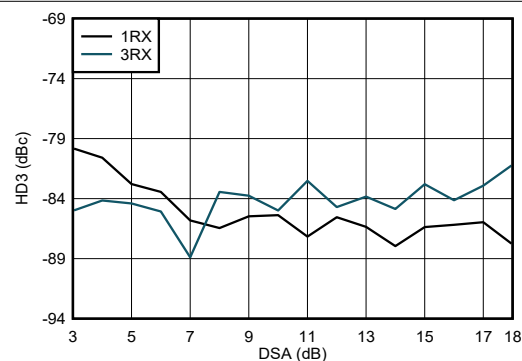
4.12.2 800MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



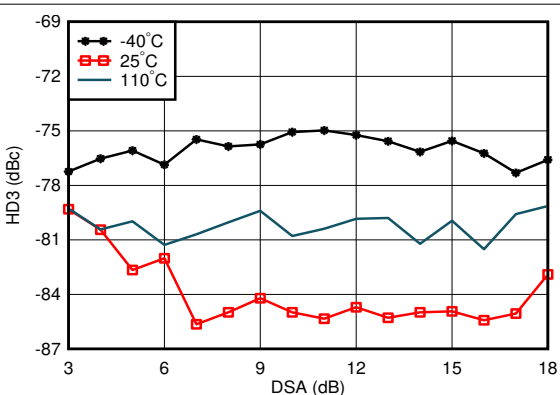
使用 0.8GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-72. 0.8GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系



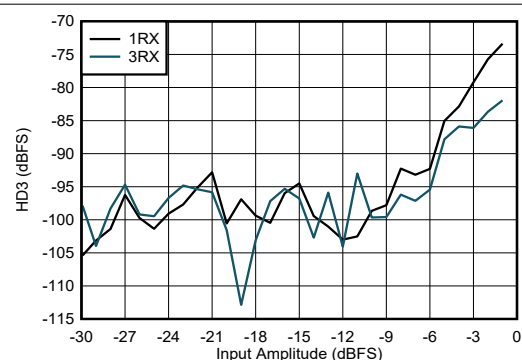
使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-73. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系



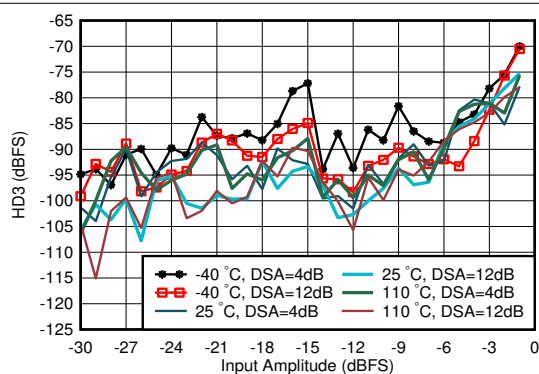
使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-74. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系



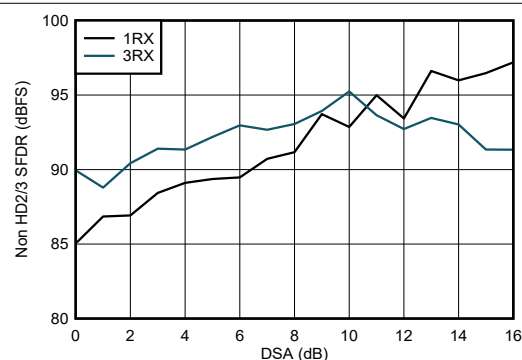
使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-75. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-76. 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系

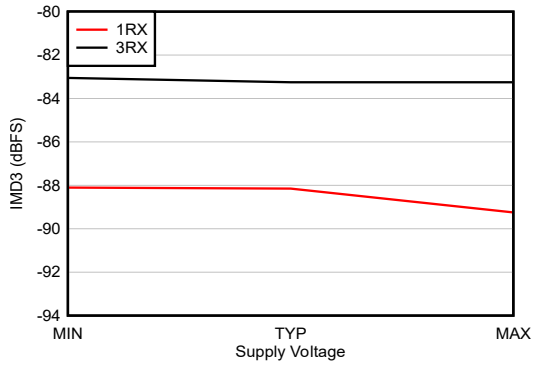


使用 0.8GHz 匹配

图 4-77. 0.8GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系

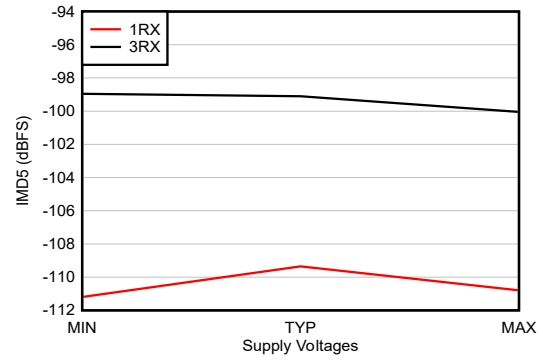
4.12.2 800MHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



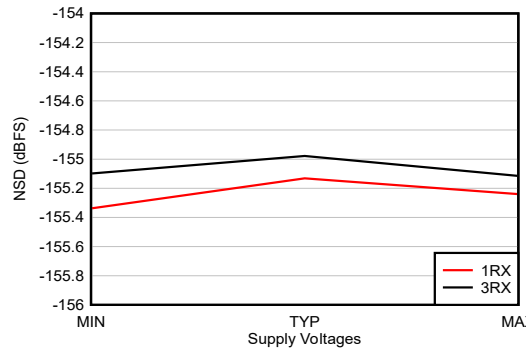
使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-78. 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系



使用 0.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-79. 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与电源和通道间的关系

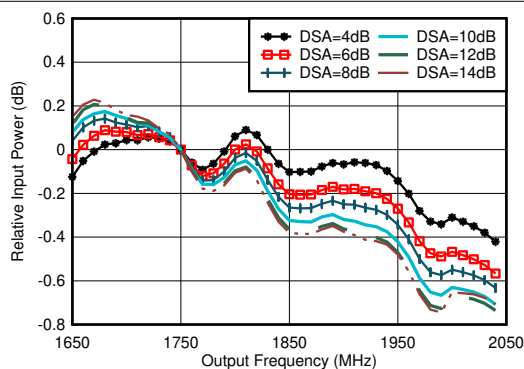


使用 0.8GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-80. 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系

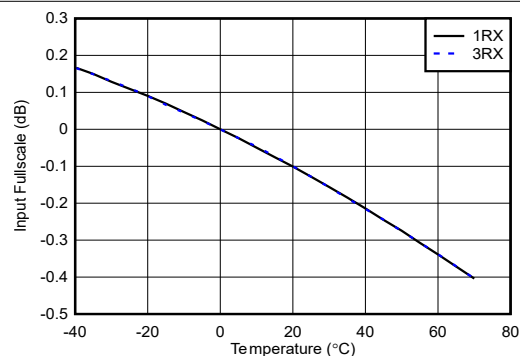
4.12.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS（抽取因子为 6），PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



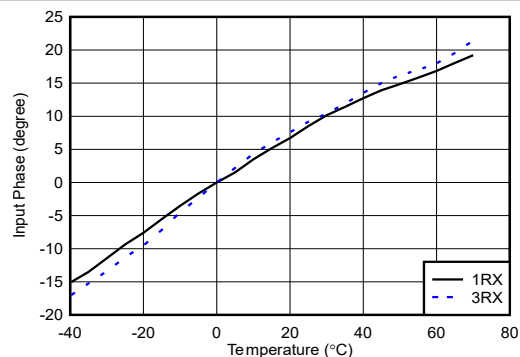
使用 1.8GHz 匹配时，标准化为 1.75GHz

图 4-81. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 1750\text{MHz}$



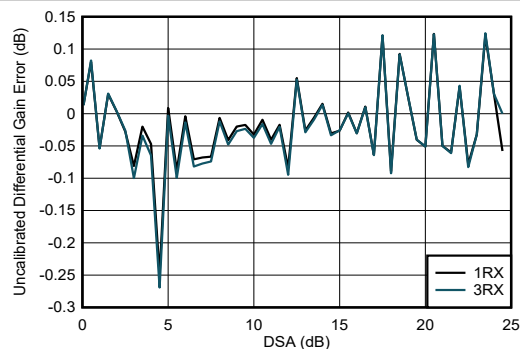
使用 1.8GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 4-82. 1.75GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 1.8GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位

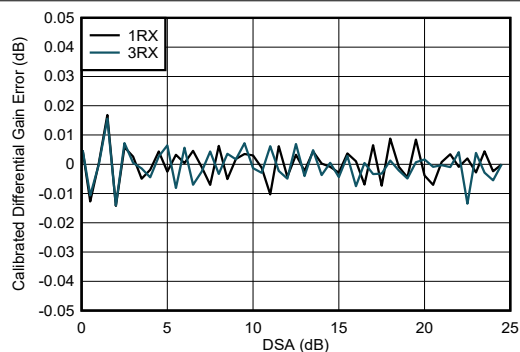
图 4-83. $f_{\text{IN}} = 1.75\text{GHz}$ 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系



使用 1.8GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

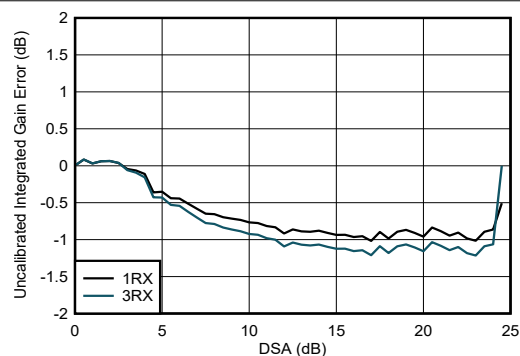
图 4-84. 1.75GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-85. 1.75GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



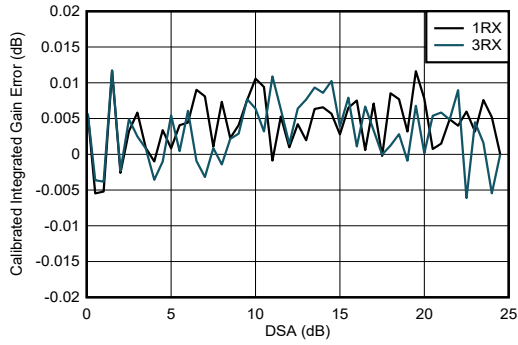
使用 1.8GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-86. 1.75GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

4.12.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (续)

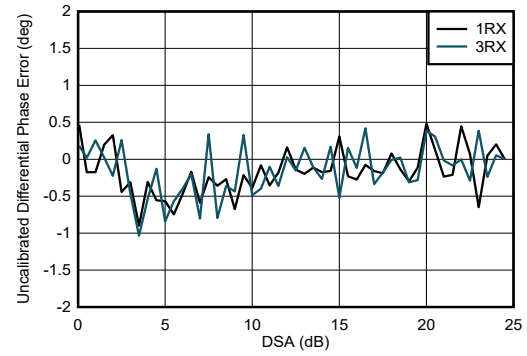
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 1.8GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

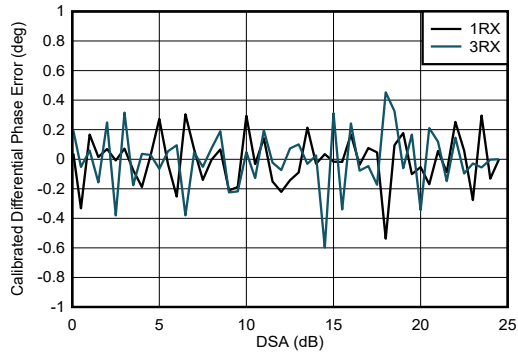
图 4-87. 1.75GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

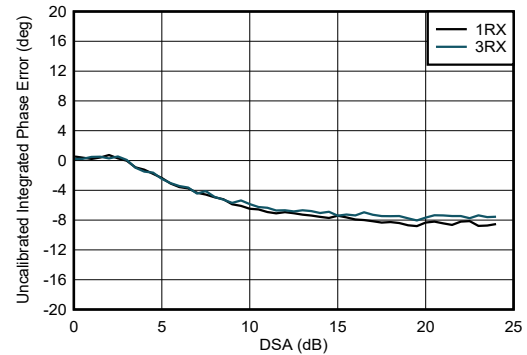
图 4-88. 1.75GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-89. 1.75GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



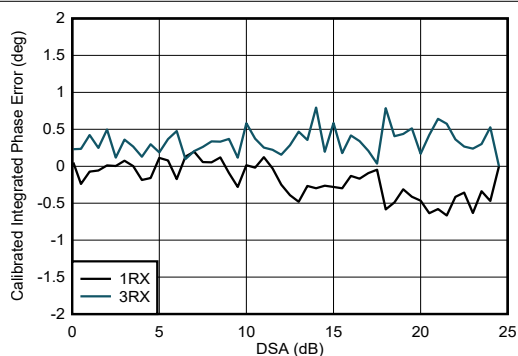
使用 1.8GHz 匹配

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-90. 1.75GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系

4.1.2.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (续)

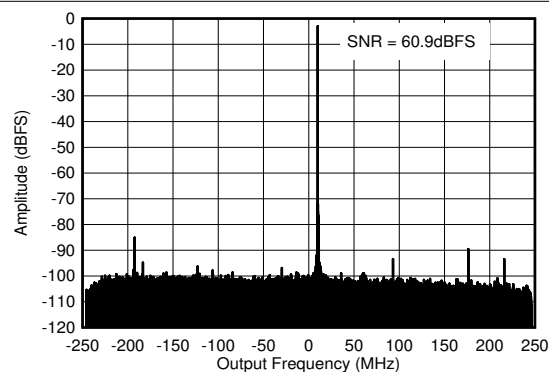
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 1.8GHz 匹配

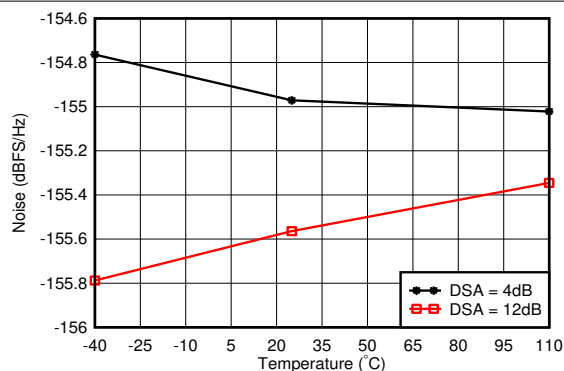
积分相位误差 = Phase (DSA 设置) - Phase (DSA 设置 = 0)

图 4-91. 1.75GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



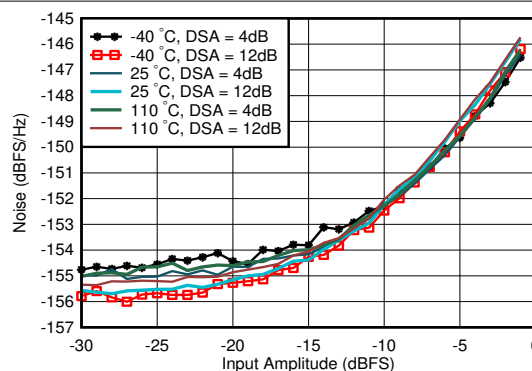
使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 4-92. 1.75GHz 条件下的 RX 输出 FFT



使用 1.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-93. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系

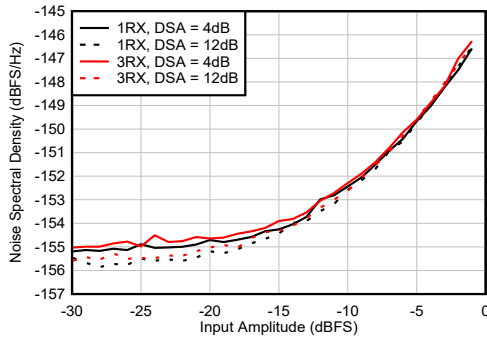


使用 1.8GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 4-94. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系

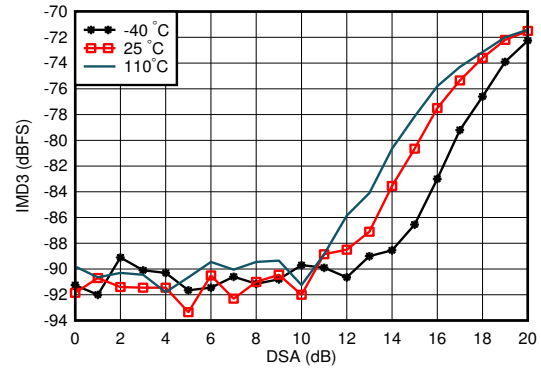
4.1.2.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



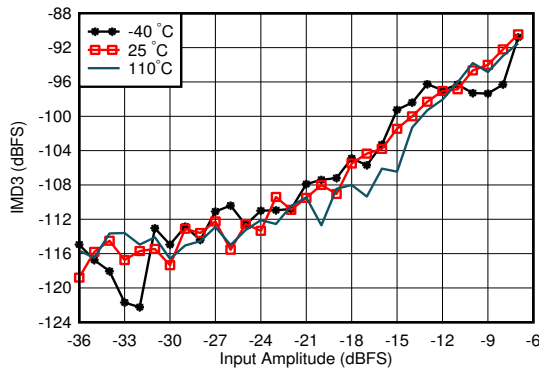
使用 1.8GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-95. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系



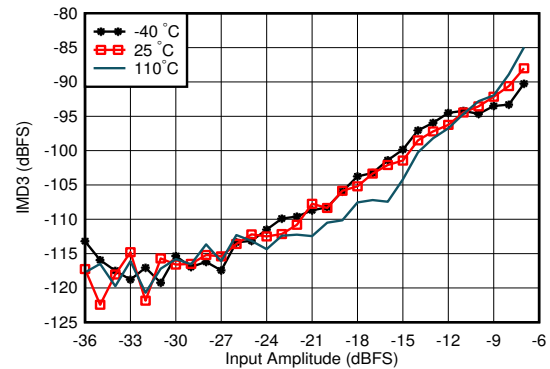
使用 1.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 4-96. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系



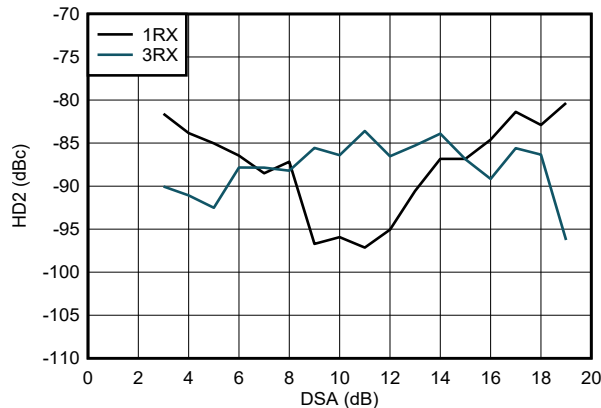
使用 1.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 4-97. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



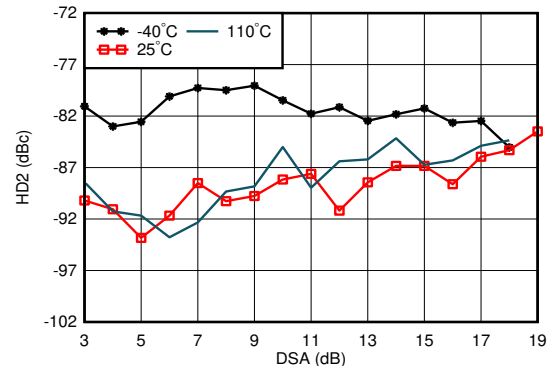
使用 1.8GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 4-98. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-99. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系

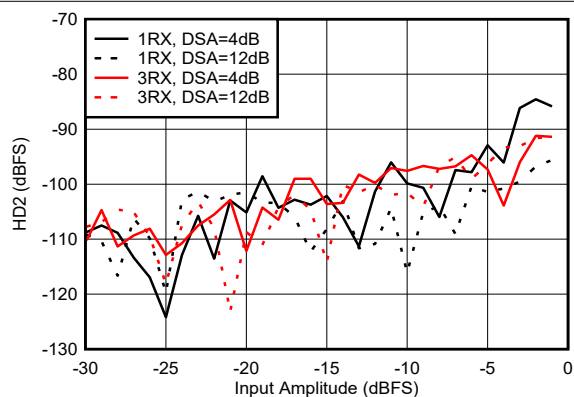


使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-100. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系

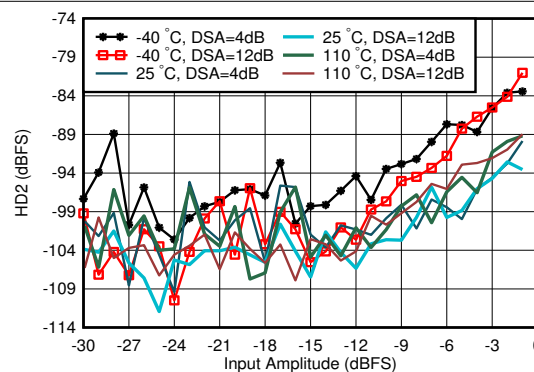
4.1.2.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



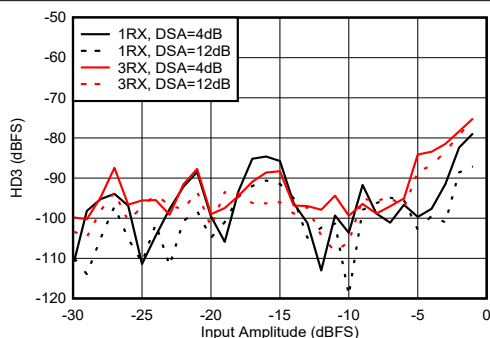
使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-101. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与输入幅度和通道间的关系



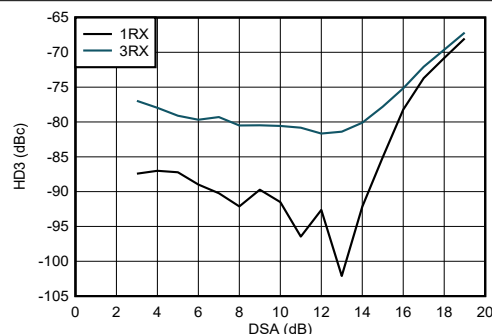
使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-102. 1.9GHz 条件下 RX HD2 与输入幅度和温度间的关系



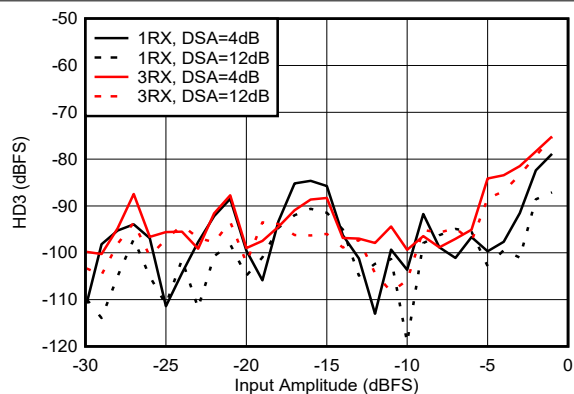
使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-103. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系



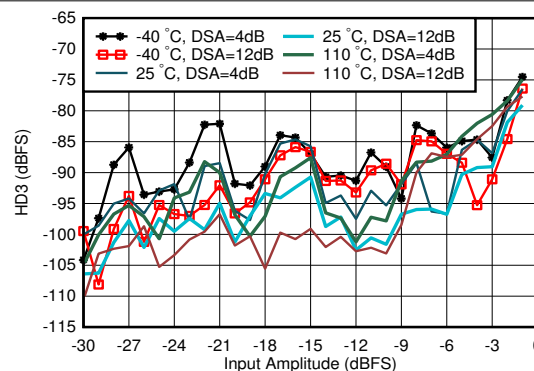
使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-104. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系



使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-105. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系

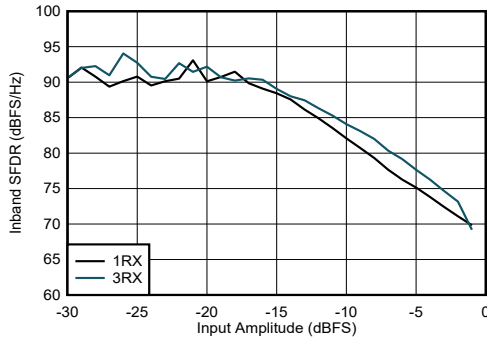


使用 1.8GHz 匹配时， $f_{\text{in}} = 1900\text{MHz}$ ，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-106. 1.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系

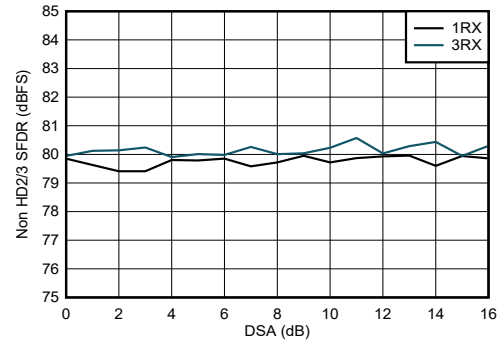
4.12.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



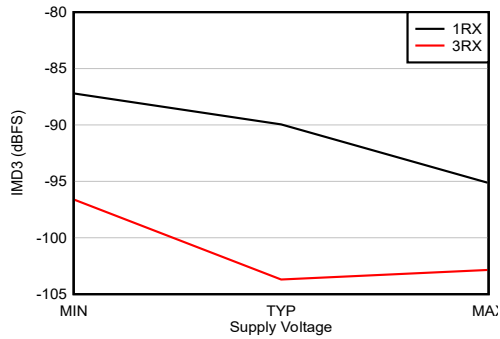
使用 1.8GHz 匹配时，抽取因子为 3

图 4-107. 1.75GHz 条件下 RX 带内 SFDR ($\pm 400\text{MHz}$) 与输入振幅间的关系



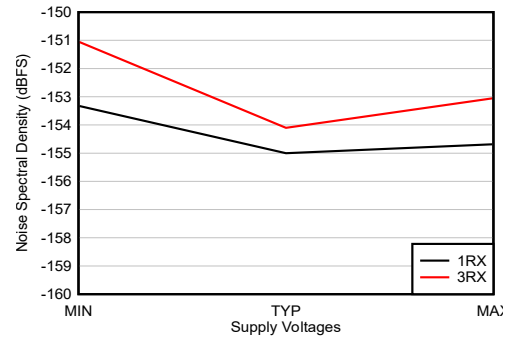
使用 1.8GHz 匹配

图 4-108. 1.75GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系



使用 1.8GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-109. 1.75GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系

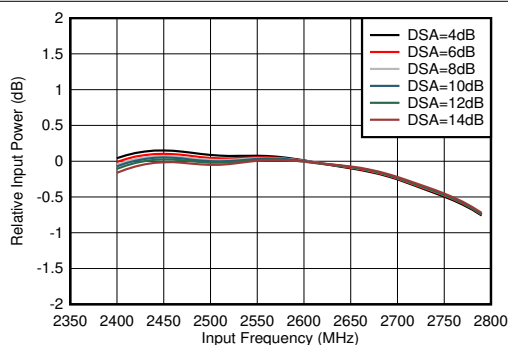


使用 1.8GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-110. 1.75GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系

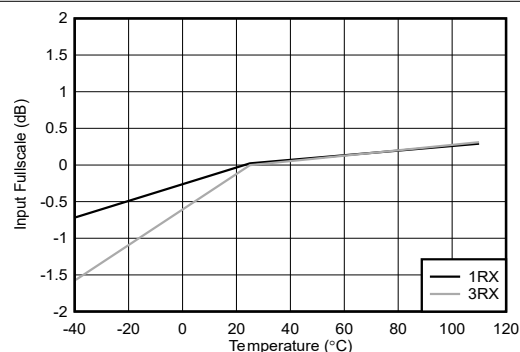
4.12.4 2.6GHz 下的 RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



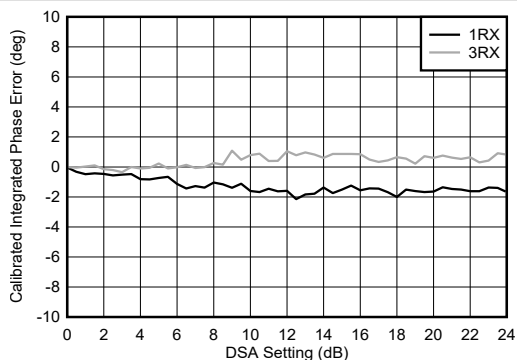
通过匹配，为每个 DSA 设置标准化为 2.6 GHz 下的功率

图 4-111. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 2600\text{MHz}$



使用 2.6GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

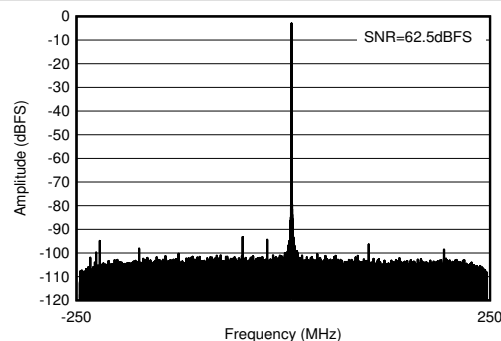
图 4-112. 2.6GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 2.6GHz 匹配

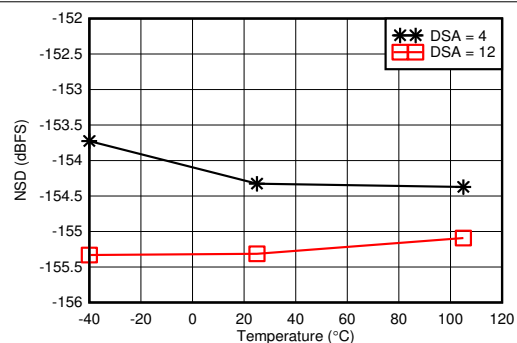
积分相位误差 = Phase (DSA 设置) - Phase (DSA 设置 = 0)

图 4-113. 2.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



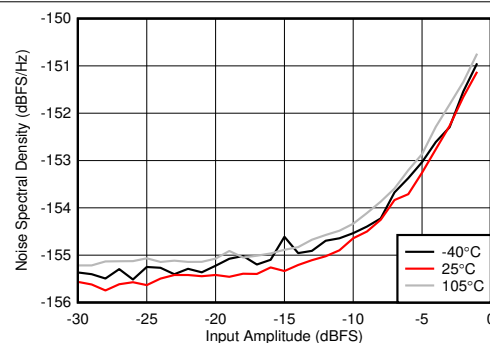
使用 2.6GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 2610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 4-114. 2.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT



使用 2.6GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-115. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系

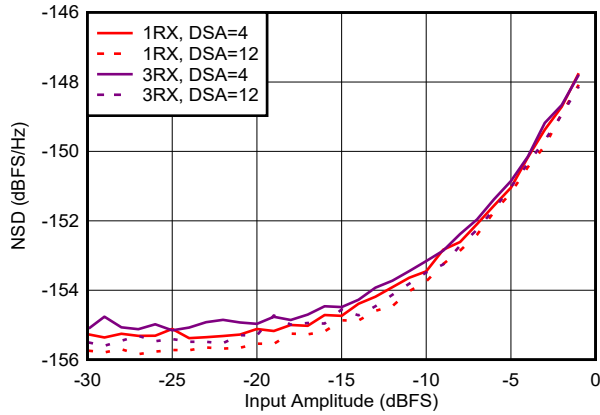


使用 2.6GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 4-116. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系

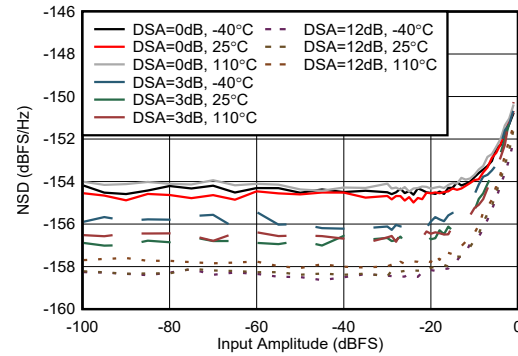
4.12.4 2.6GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



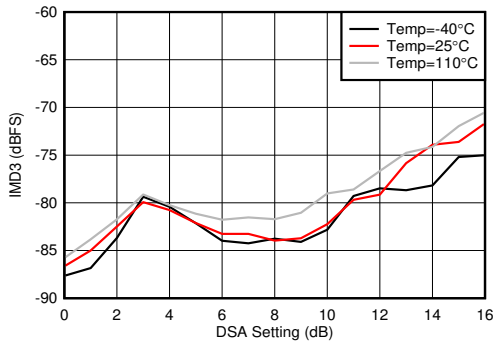
使用 2.6GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-117. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系



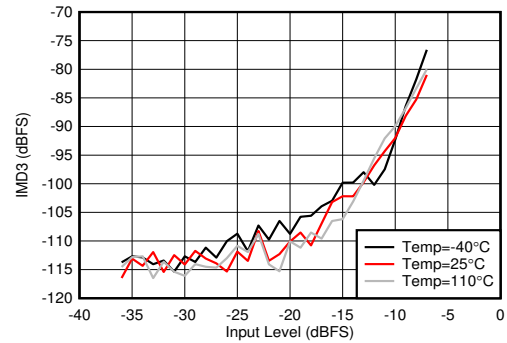
相对于子载波偏移 50MHz，外部时钟模式

图 4-118. 2.61GHz (外部时钟) 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅间的关系



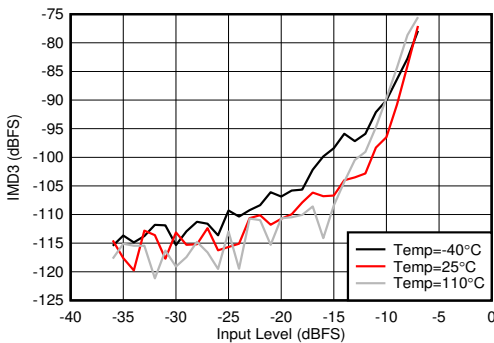
使用 2.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 4-119. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系



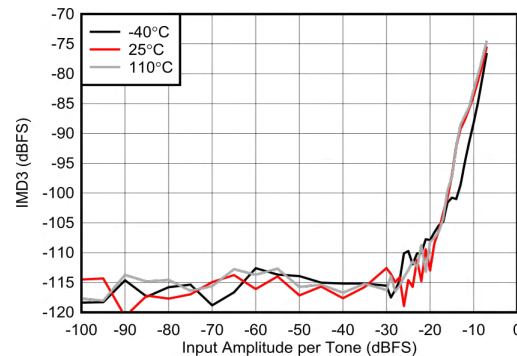
使用 2.6GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 4-120. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 4-121. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系

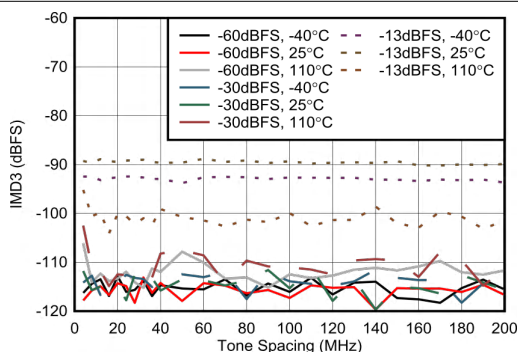


子载波间隔 = 50MHz，外部时钟模式

图 4-122. 2.6GHz (外部时钟) 条件下 RX IMD3 与输入电平间的关系

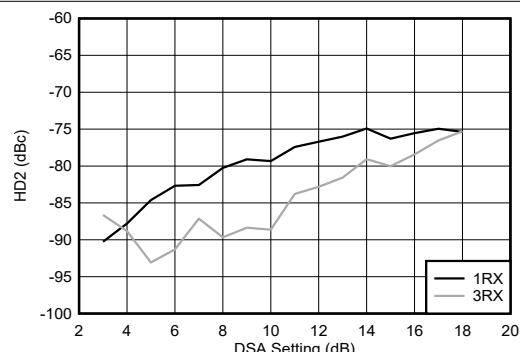
4.12.4 2.6GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



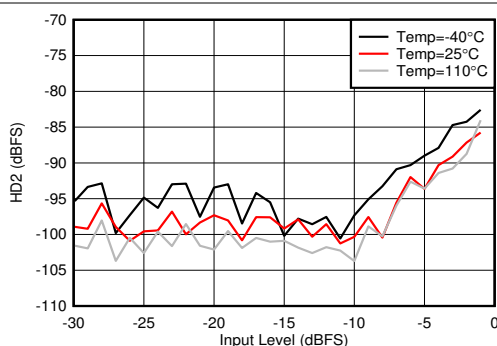
外部时钟模式

图 4-123. 2.6GHz (外部时钟) 条件下 RX IMD3 与子载波间隔间的关系



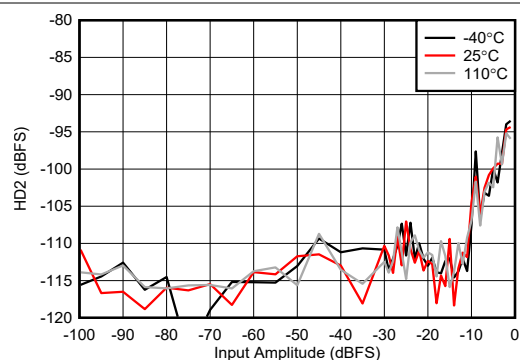
使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-124. 2.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系



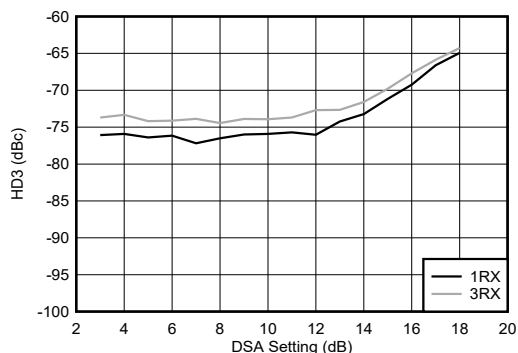
使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-125. 2.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系



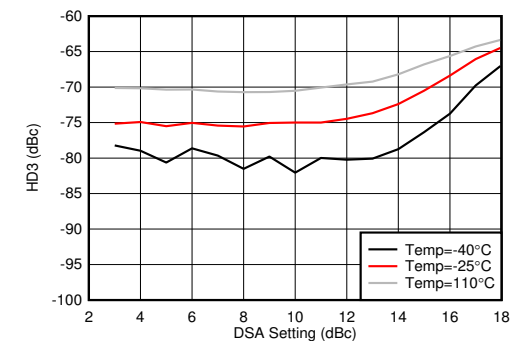
外部时钟模式

图 4-126. 2.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系



使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-127. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系

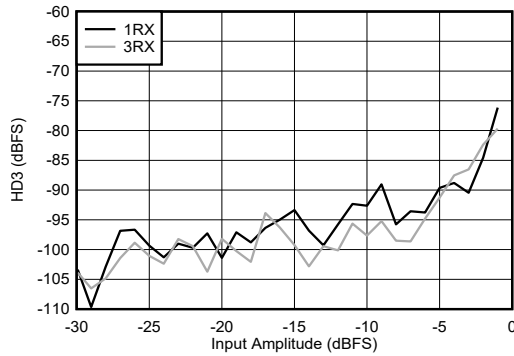


使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-128. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系

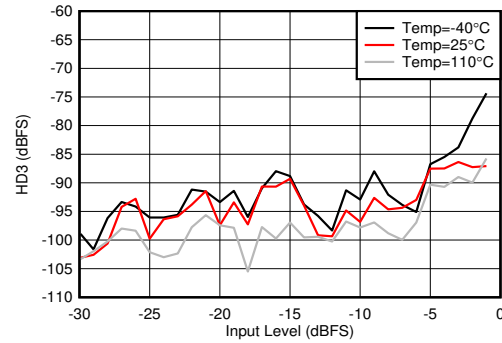
4.12.4 2.6GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



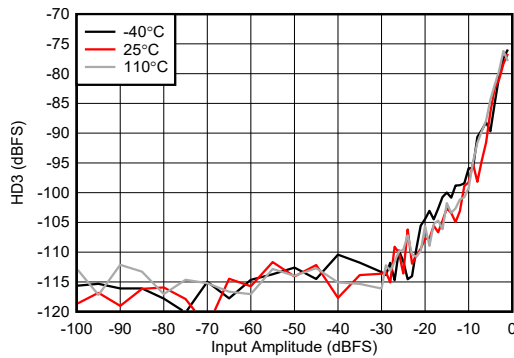
使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-129. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系



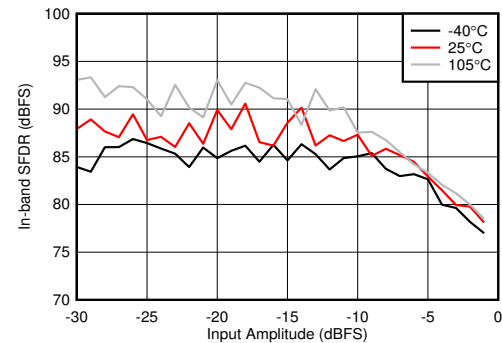
使用 2.6GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-130. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系



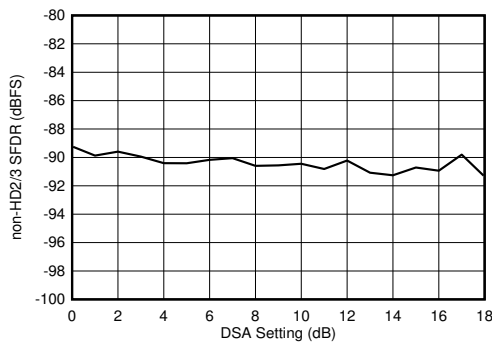
外部时钟模式

图 4-131. 2.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系



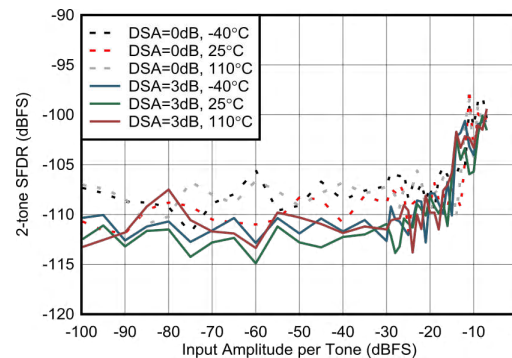
使用 2.6GHz 匹配时，抽取因子为 4

图 4-132. 2.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR ($\pm 300\text{MHz}$) 与输入振幅和温度间的关系



使用 2.6GHz 匹配

图 4-133. 2.6GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系

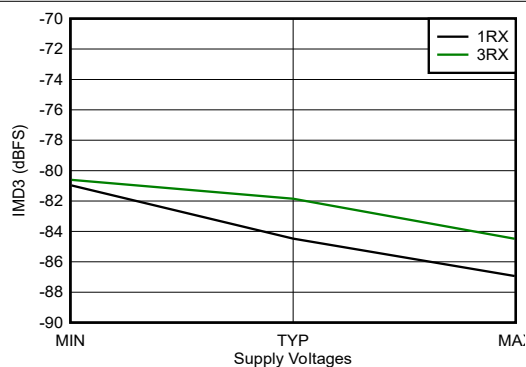


外部时钟模式，50MHz 子载波间隔，不包括三阶失真

图 4-134. 2.6GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅间的关系

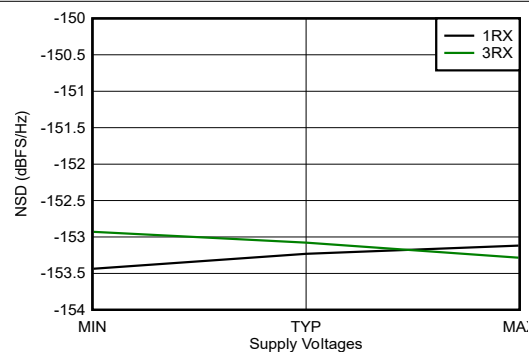
4.12.4 2.6GHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12kHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 2.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-135. 2.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系

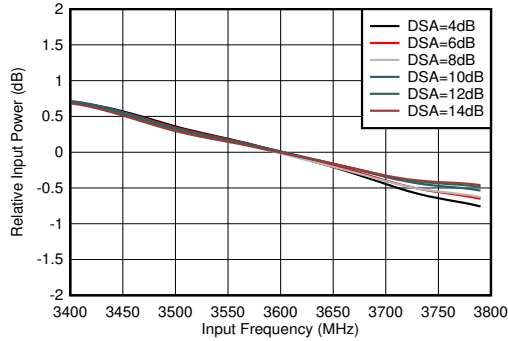


使用 2.6GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-136. 2.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系

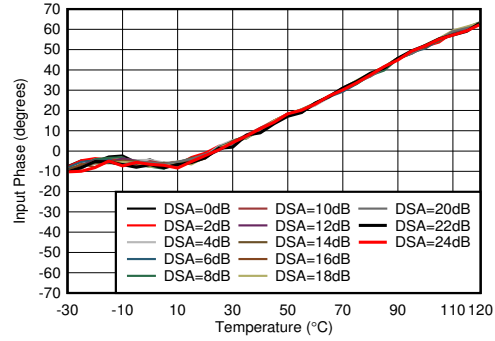
4.12.5 3.5GHz 下的RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



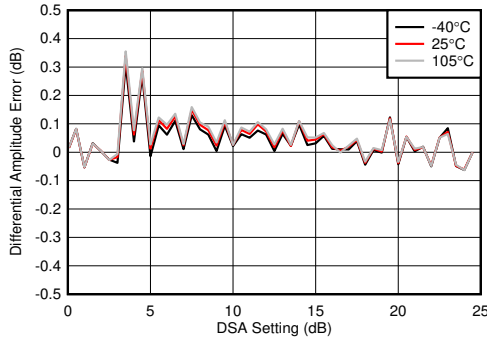
使用 3.6GHz 匹配时，标准化为 3.6GHz

图 4-137. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 3600\text{MHz}$



使用 3.6GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位

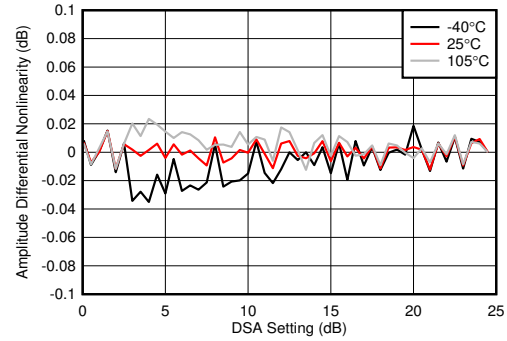
图 4-138. 3.6GHz 条件下 RX 输入相位与温度间的关系



使用 3.6GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

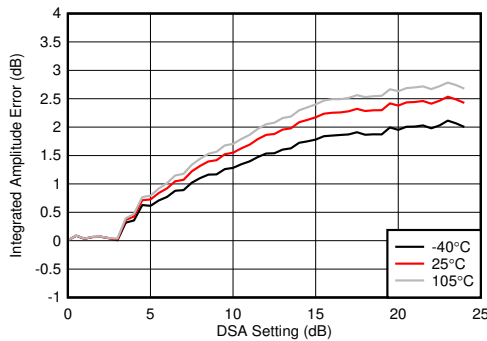
图 4-139. 3.6GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

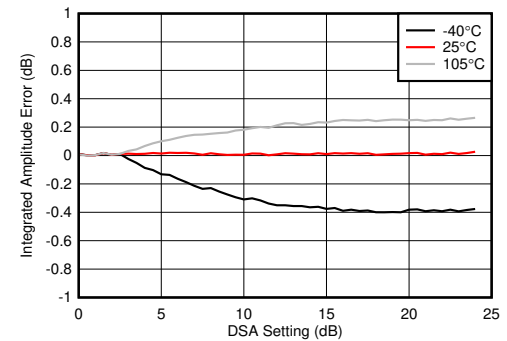
图 4-140. 3.6GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-141. 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



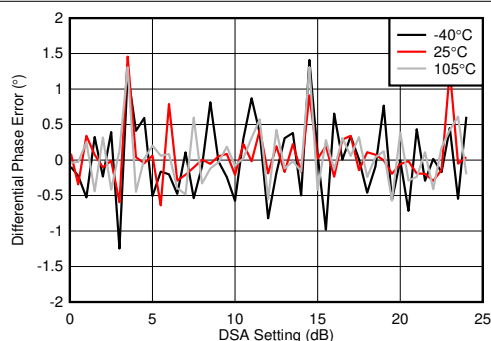
使用 3.6GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-142. 3.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

4.12.5 3.5GHz 下的 RX 典型特性 (续)

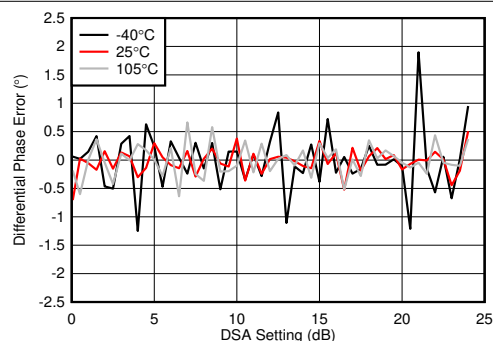
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 3.6GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

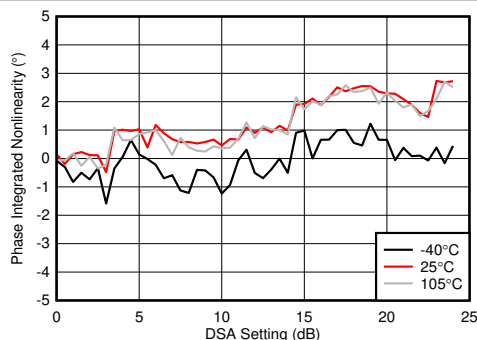
图 4-143. 3.6GHz 条件下 RX 未校准相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

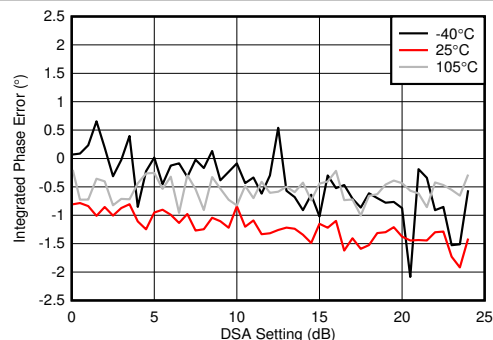
图 4-144. 3.6GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

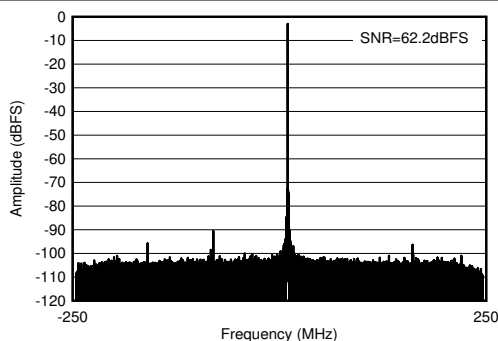
图 4-145. 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配

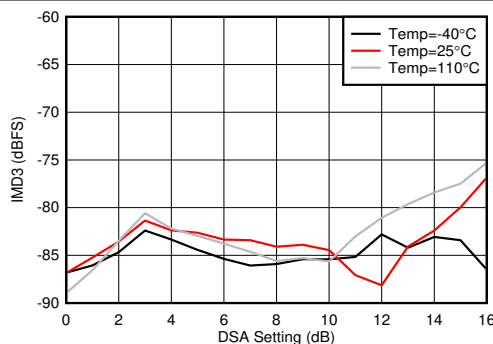
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-146. 3.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 3.6GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 3610\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 4-147. 3.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT

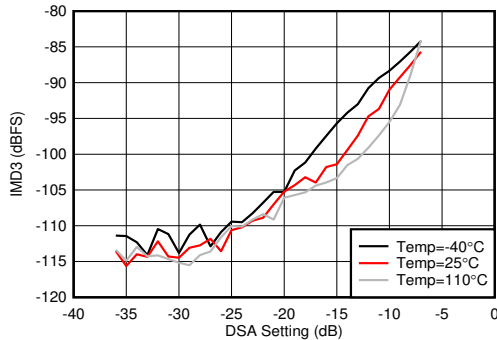


使用 3.5GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS ，频率间隔为 20MHz

图 4-148. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系

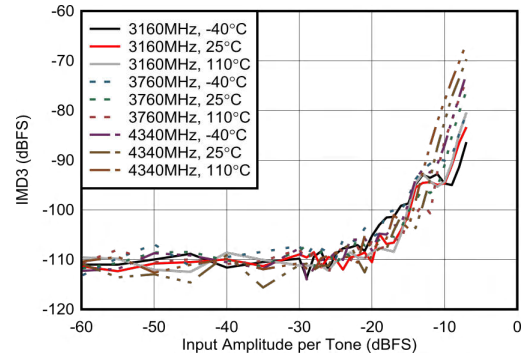
4.12.5 3.5GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



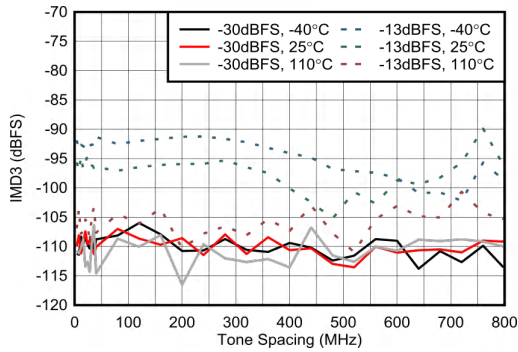
使用 3.5GHz 匹配时，频率间隔为 20MHz

图 4-149. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



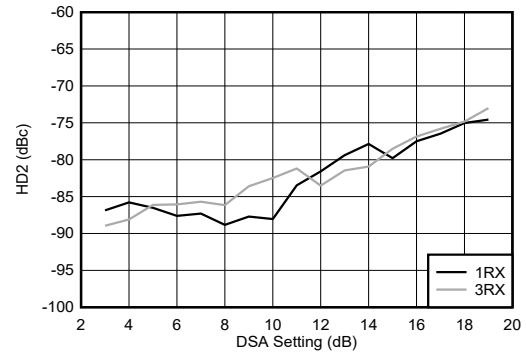
外部时钟模式，20MHz 子载波间隔，2 倍抽取

图 4-150. RX IMD3 与输入电平间的关系



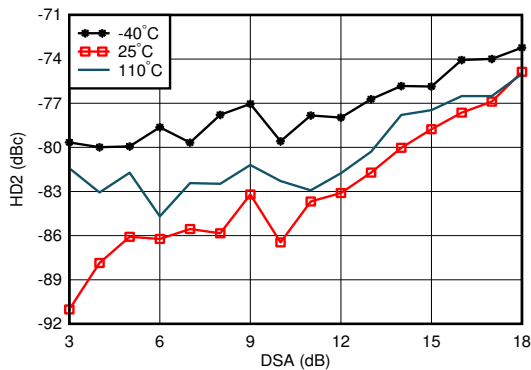
外部时钟模式，2 倍抽取

图 4-151. 3.76 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系



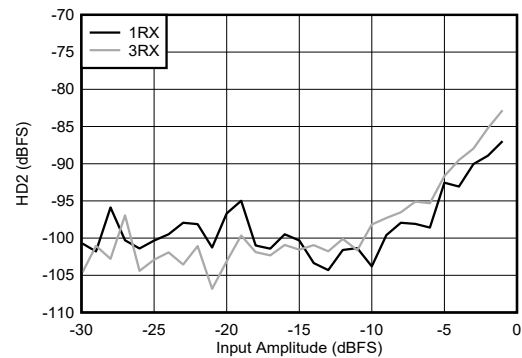
使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-152. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系



使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-153. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系

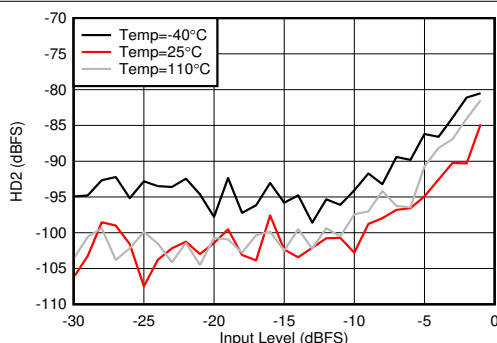


使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-154. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和通道间的关系

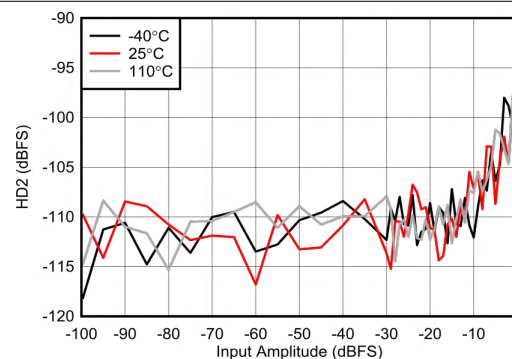
4.12.5 3.5GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



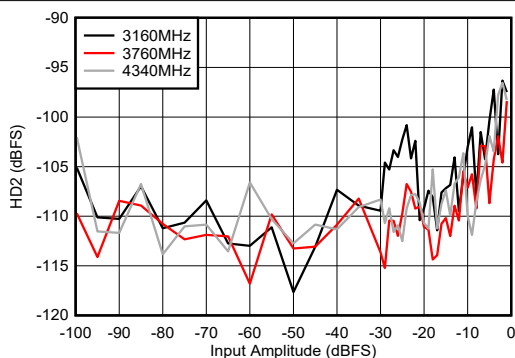
使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-155. 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系



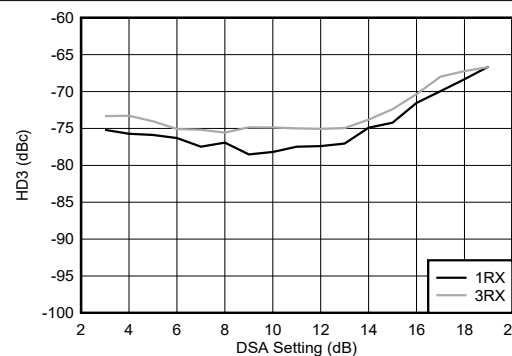
外部时钟模式，2 倍抽取

图 4-156. 3.76GHz 条件下 RX HD2 与输入电平间的关系



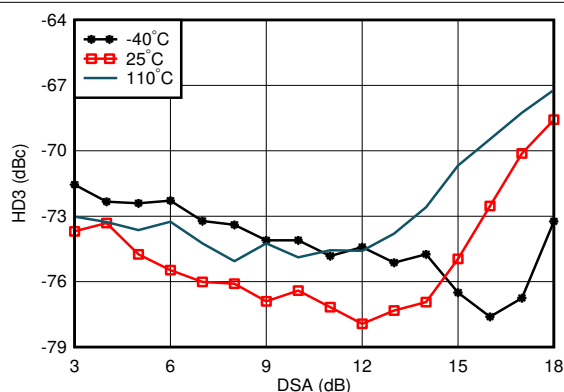
外部时钟模式，25°C，2 倍抽取

图 4-157. RX HD2 与输入电平间的关系



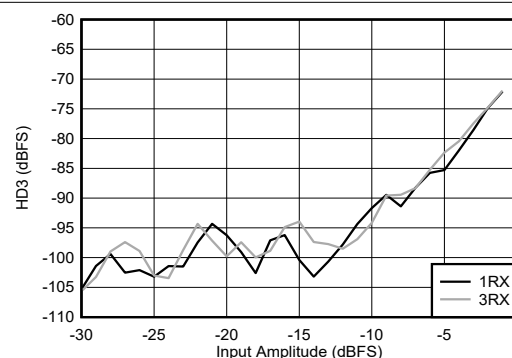
使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-158. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系



使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-159. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系

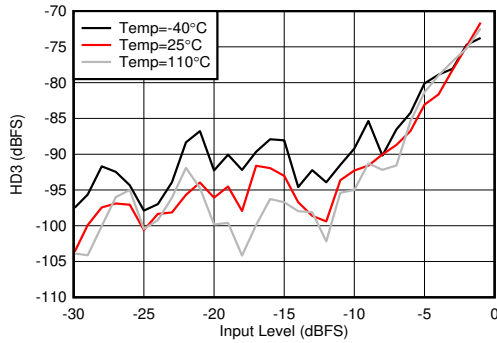


使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-160. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系

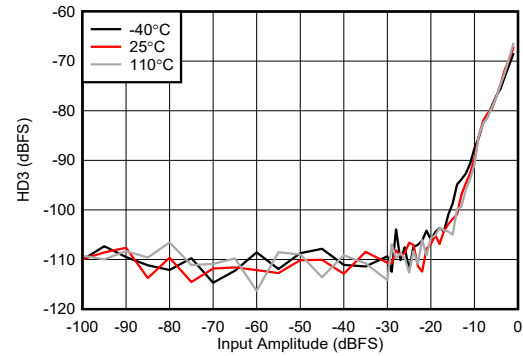
4.12.5 3.5GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



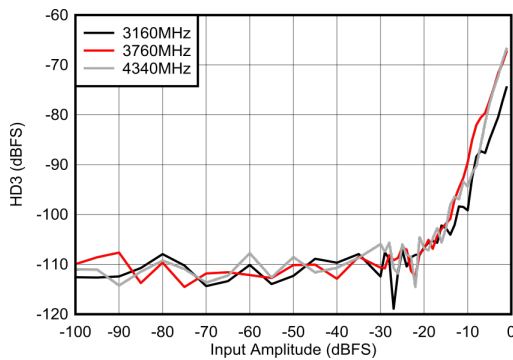
使用 3.5GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-161. 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系



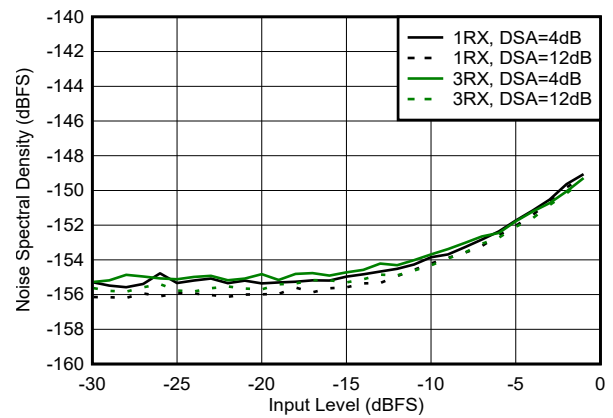
外部时钟模式，2 倍抽取

图 4-162. 3.76GHz 条件下 RX HD3 与输入电平间的关系



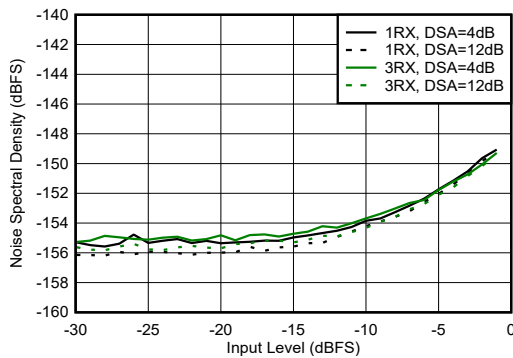
外部时钟模式，25°C，2 倍抽取

图 4-163. RX HD3 与输入电平间的关系



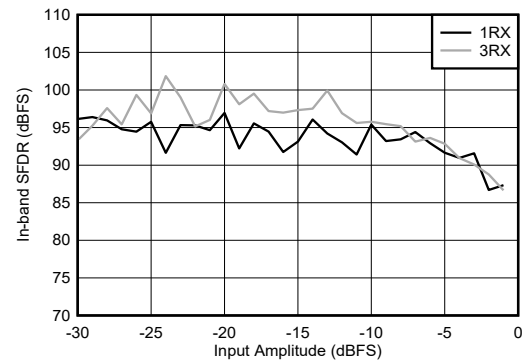
使用 3.5GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-164. 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平和 DSA 设置间的关系



外部时钟模式，25°C，2 倍抽取

图 4-165. 3.76GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平间的关系

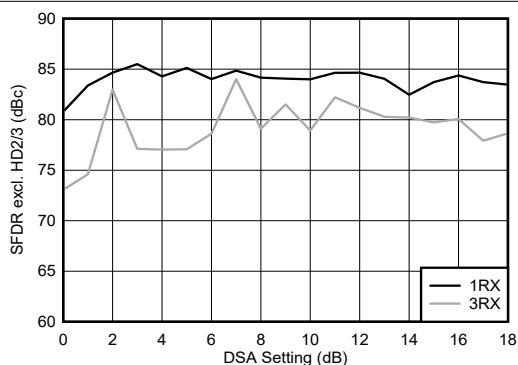


使用 3.5GHz 匹配

图 4-166. 3.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR ($\pm 200\text{MHz}$) 与输入电平和通道间的关系

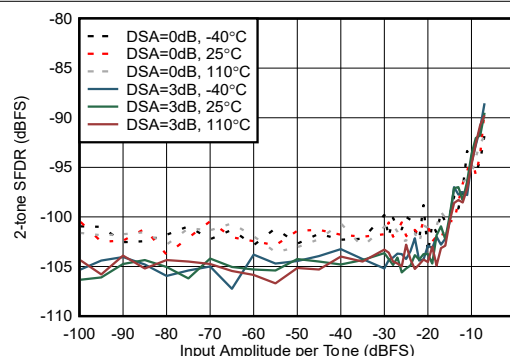
4.12.5 3.5GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



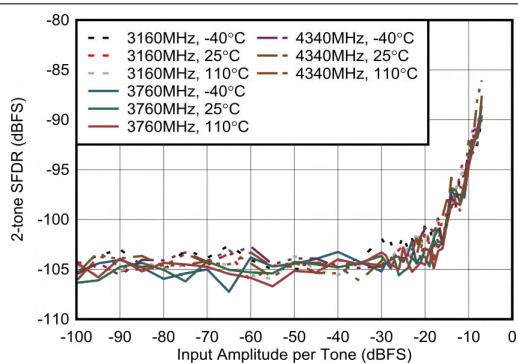
使用 3.5GHz 匹配

图 4-167. RX SFDR，在 3.6GHz 时不包括 HD2/3 与 DSA 设置和通道间的关系



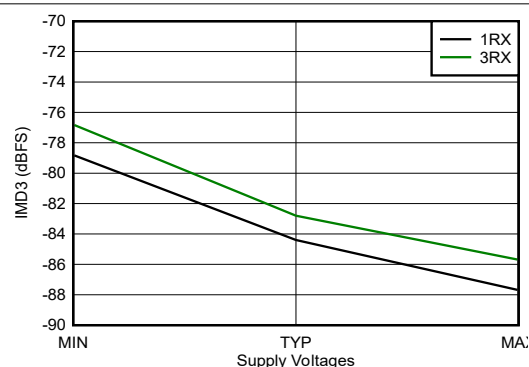
外部时钟模式，20MHz 子载波间隔，不包括三阶失真

图 4-168. 3.7GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅和 DSA 设置间的关系



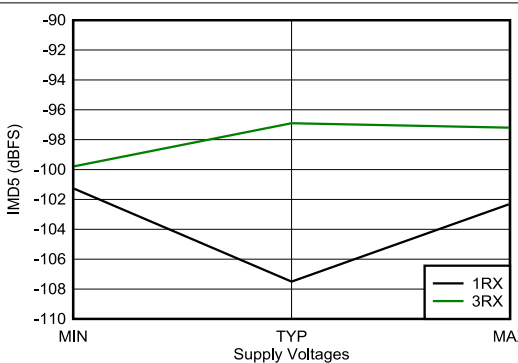
外部时钟模式，20MHz 子载波间隔，不包括三阶失真

图 4-169. 3.7GHz 条件下 RX 双频 SFDR 与输入振幅和频率间的关系



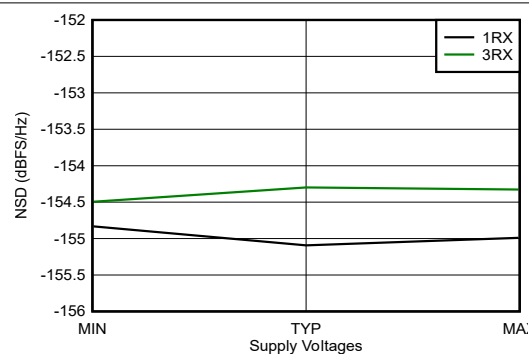
使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-170. 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源电压和通道间的关系



使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-171. 3.6GHz 条件下 RX IMD5 与电源电压和通道间的关系

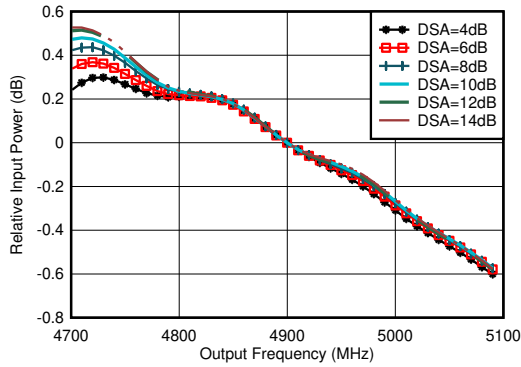


使用 3.6GHz 匹配时，单音幅度为 -20dBFS，偏移频率为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-172. 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源电压和通道间的关系

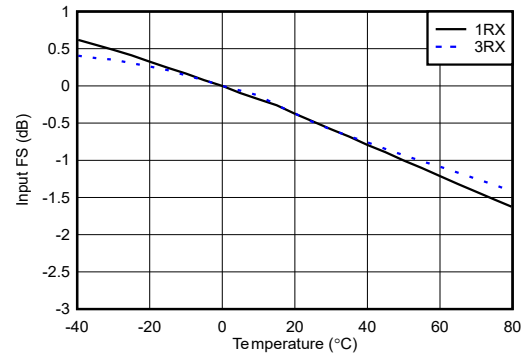
4.12.6 4.9GHz 下的RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



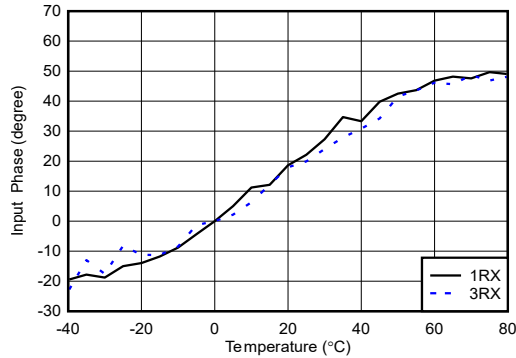
通过匹配，为每个 DSA 设置标准化为 4.9GHz 下的功率

图 4-173. RX 带内增益平坦度， $f_{\text{IN}} = 4900\text{MHz}$



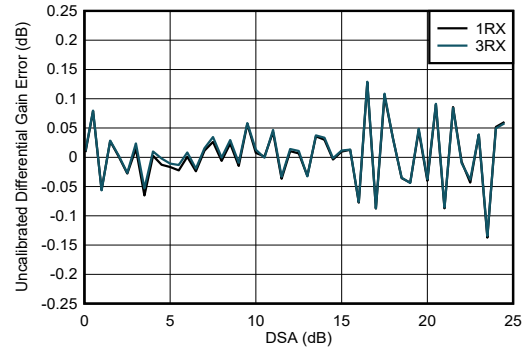
使用 4.9GHz 匹配时，为每个通道标准化为 25°C 时的满量程

图 4-174. 4.9GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，标准化为 25°C 时的相位

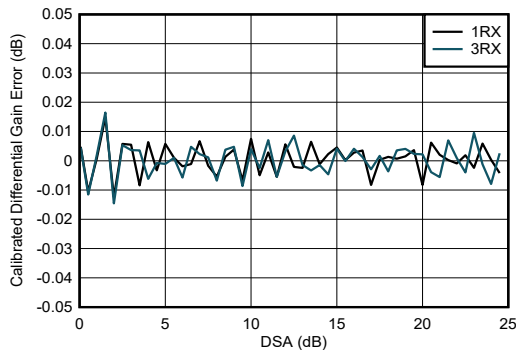
图 4-175. $f_{\text{OUT}} = 4.9\text{GHz}$ 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系



使用 4.9GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

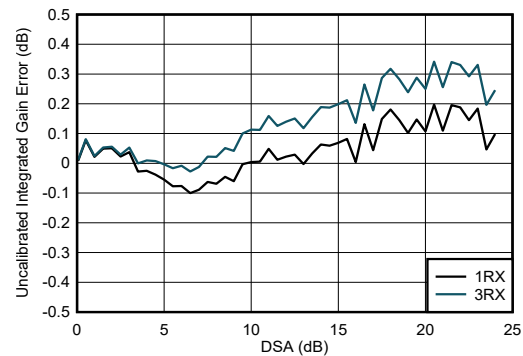
图 4-176. 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

差分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-177. 4.9GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系



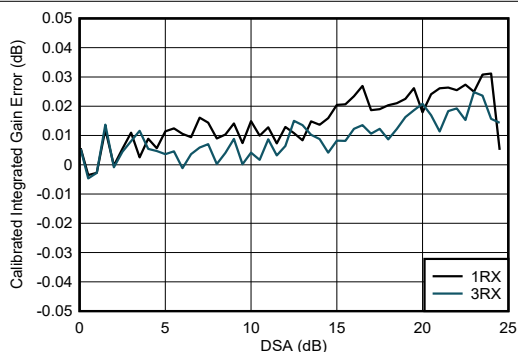
使用 4.9GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-178. 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系

4.12.6 4.9GHz 下的RX 典型特性 (续)

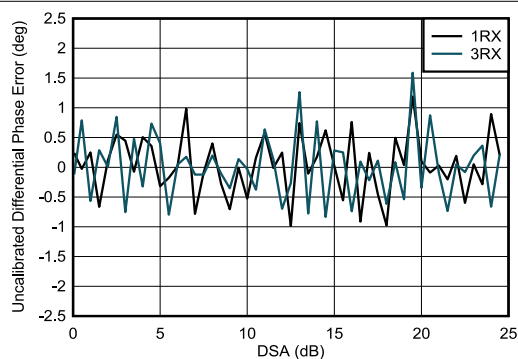
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



使用 4.9GHz 匹配

积分振幅误差 = $P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

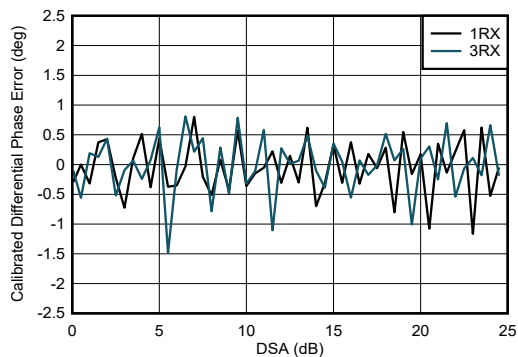
图 4-179. 4.9GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

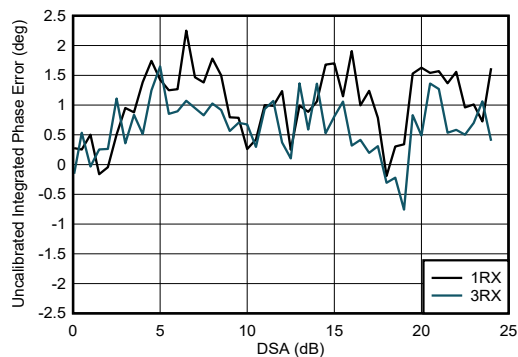
图 4-180. 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



使用 4.9GHz 匹配

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{IN}}(\text{DSA 设置})$

图 4-181. 4.9GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系



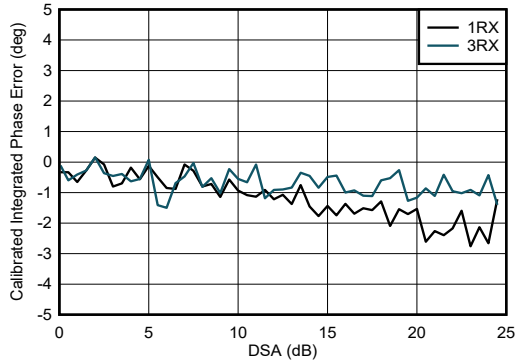
使用 4.9GHz 匹配

积分相位误差 = $\text{相位}(\text{DSA 设置}) - \text{相位}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-182. 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系

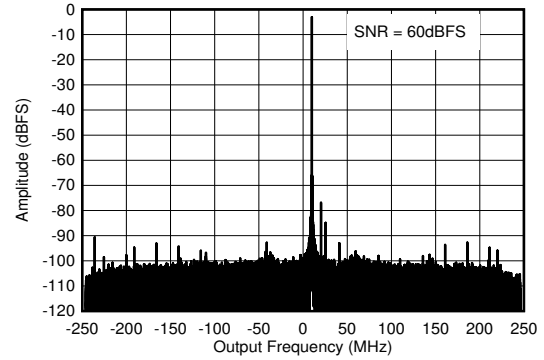
4.12.6 4.9GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



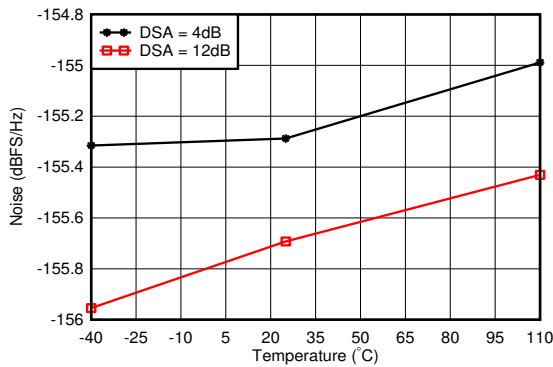
使用 4.9GHz 匹配
积分相位误差 = 相位 (DSA 设置) - 相位 (DSA 设置 = 0)

图 4-183. 4.9GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系



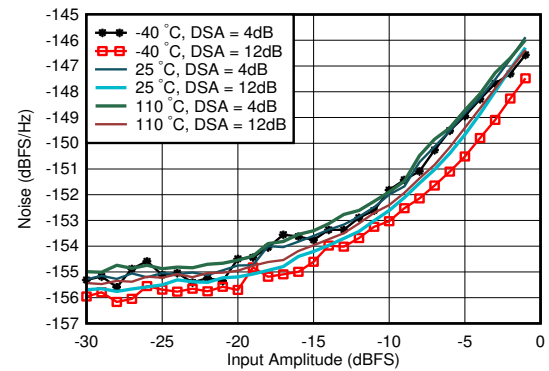
使用 4.9GHz 匹配时， $f_{\text{IN}} = 4910\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$

图 4-184. 4.9GHz 条件下的 RX 输出 FFT



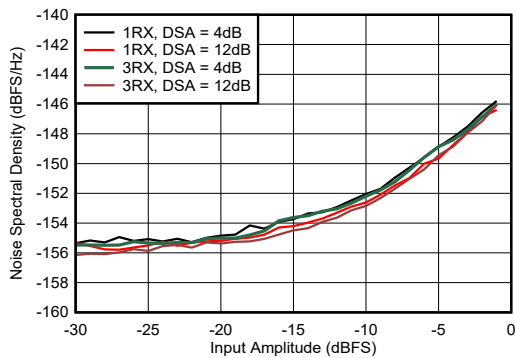
使用 4.9GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-185. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系



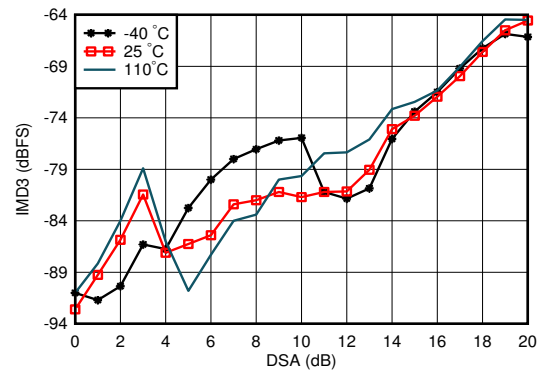
使用 4.9GHz 匹配时，DSA 设置 = 12dB，偏移频率为 12.5MHz

图 4-186. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，偏移频率为 12.5MHz

图 4-187. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系

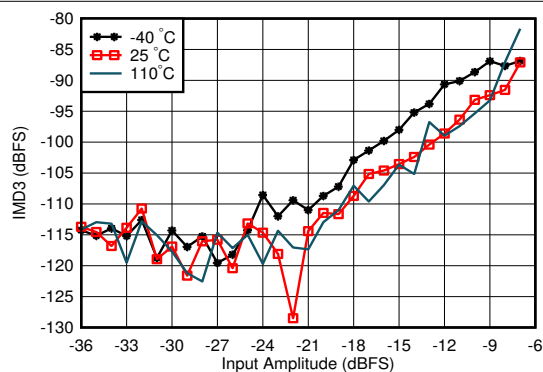


使用 4.9GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔 = 20MHz

图 4-188. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系

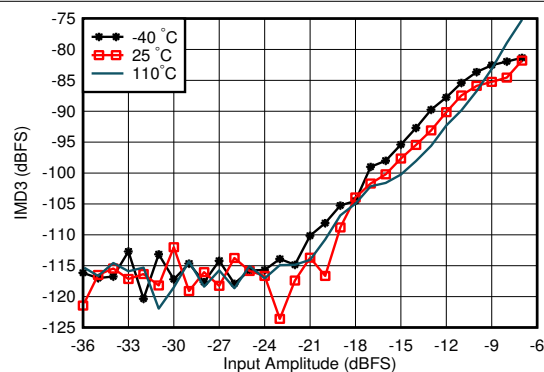
4.12.6 4.9GHz 下的 RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



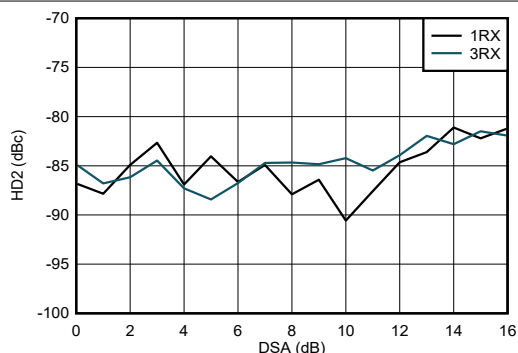
使用 4.9GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 4dB

图 4-189. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



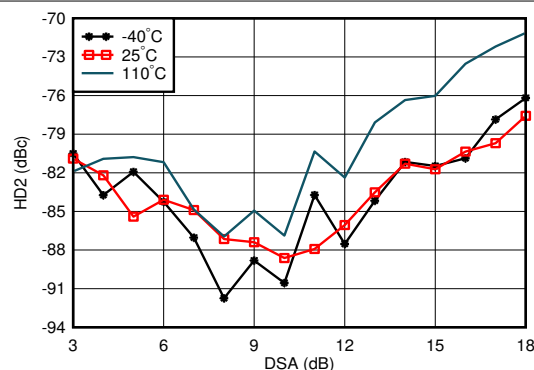
使用 4.9GHz 匹配时，频率间隔 = 20MHz，DSA = 12dB

图 4-190. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系



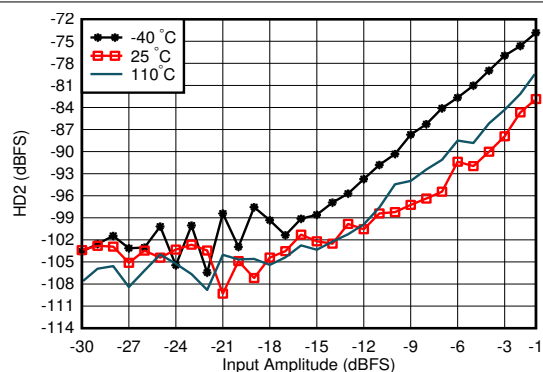
使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-191. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系



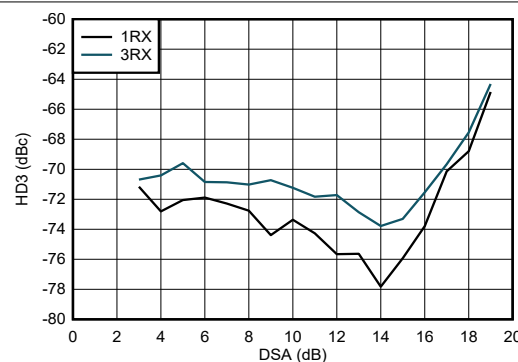
使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-192. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 和温度间的关系



使用 4.9GHz 匹配时，在 HD2 修整后测量，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-193. 4.9GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系

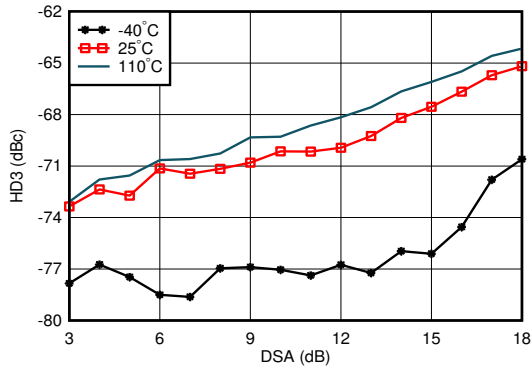


使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-194. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系

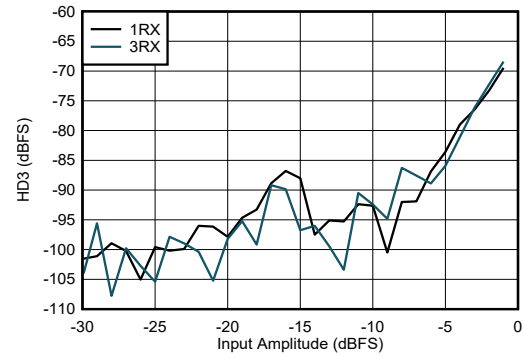
4.12.6 4.9GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。



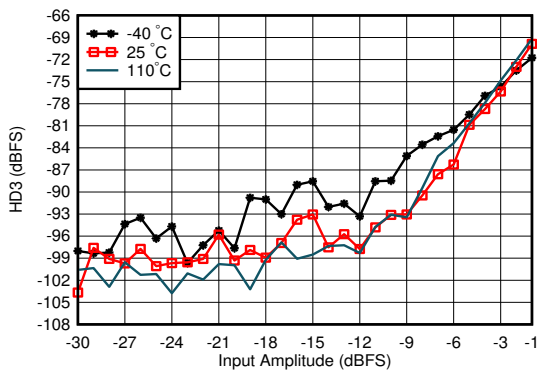
使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-195. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系



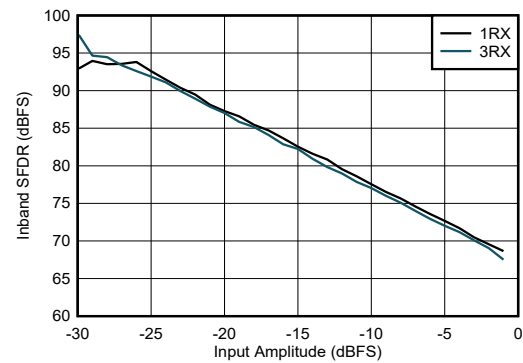
使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-196. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系



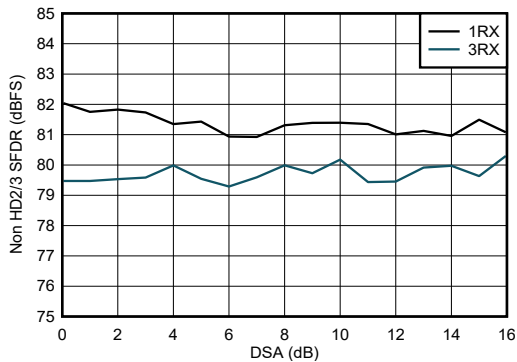
使用 4.9GHz 匹配时，DDC 旁路模式 (对于表征，仅 TI 模式)

图 4-197. 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系



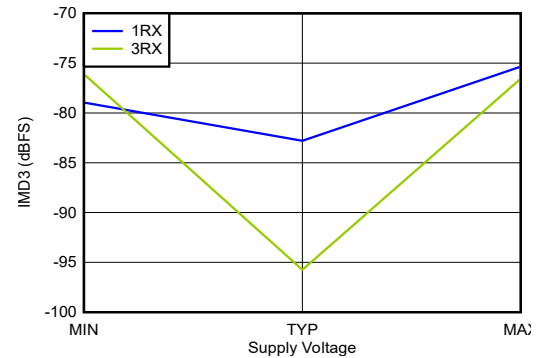
使用 4.9GHz 匹配时，抽取因子为 3

图 4-198. 4.9GHz 条件下 RX 带内 SFDR ($\pm 400\text{MHz}$) 与输入振幅和通道间的关系



使用 4.9GHz 匹配

图 4-199. 4.9GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系

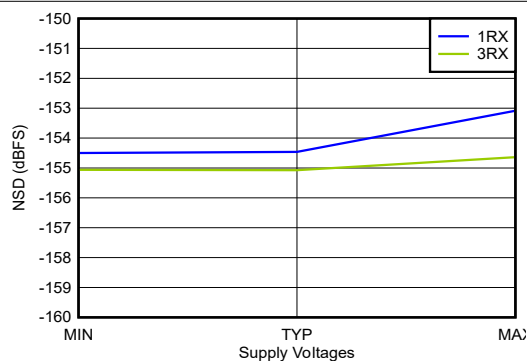


使用 4.9GHz 匹配时，单音幅度为 -7dBFS，频率间隔为 20MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-200. 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系

4.12.6 4.9GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 ADC 采样率 = 2949.12MHz 时的典型值。默认条件：输出采样率 = 491.52MSPS (抽取因子为 6)，PLL 时钟模式，其中 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$ ， $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ ，DSA 设置 = 4dB。

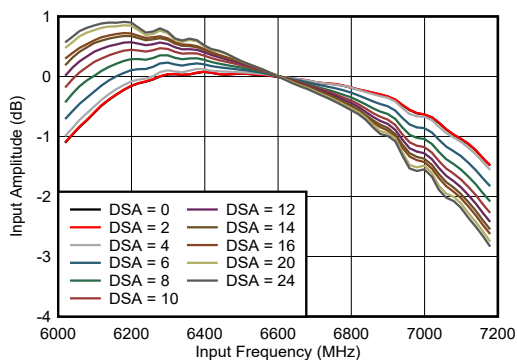


使用 4.9GHz 匹配时，偏移为 12.5MHz，所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压

图 4-201. 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系

4.12.7 6.8GHz 下的RX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 3000MSPS、输出采样率 = 500MSPS (抽取因子为 6x)、外部时钟模式、 $A_{\text{IN}} = -3\text{dBFS}$ 和 DSA 设置 = 3dB。



标准化为 6.6GHz

图 4-202. RX 带内增益平坦度

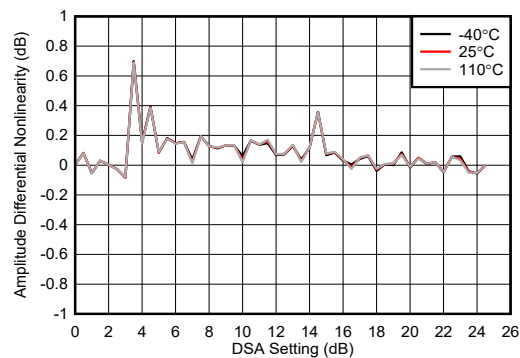
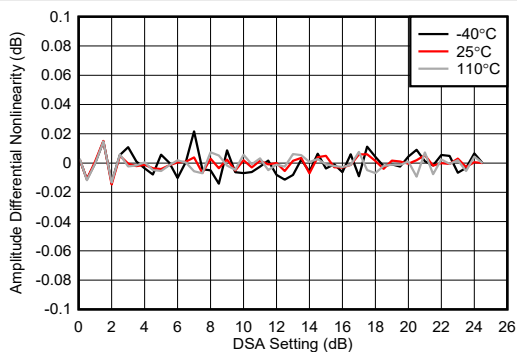


图 4-203. 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分振幅误差



在 25°C 时校准，在 -40°C 和 110°C 时保持

图 4-204. 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分振幅误差

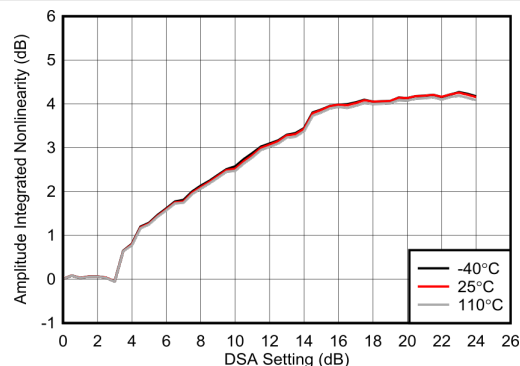
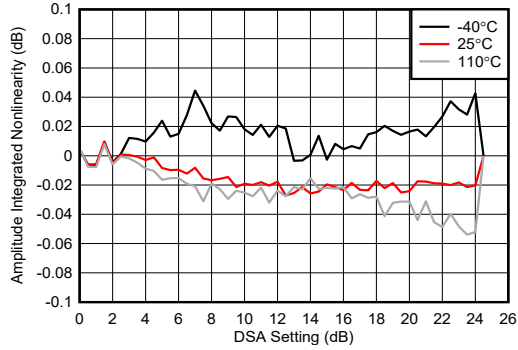


图 4-205. 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分振幅误差

4.12.7 6.8GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 3000MSPS、输出采样率 = 500MSPS (抽取因子为 6x)、外部时钟模式、 $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ 和 DSA 设置 = 3dB。



在 25°C 时校准，在 -40°C 和 110°C 时保持

图 4-206. 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分振幅误差

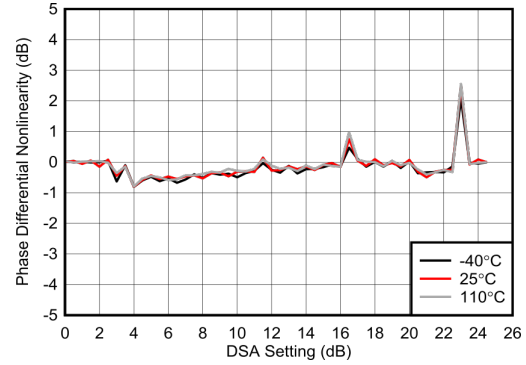
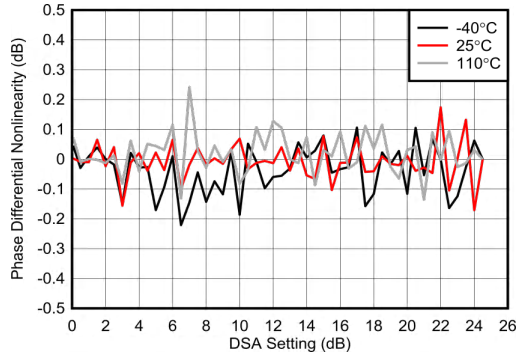


图 4-207. 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分相位误差



在 25°C 时校准，在 -40°C 和 110°C 时保持

图 4-208. 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分相位误差

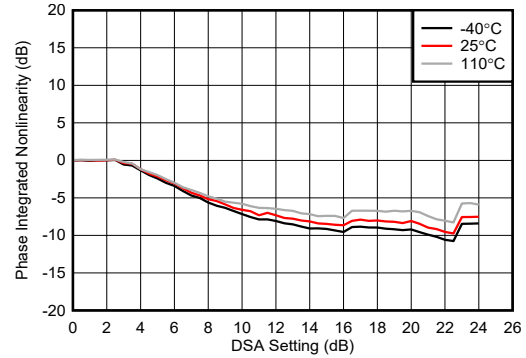
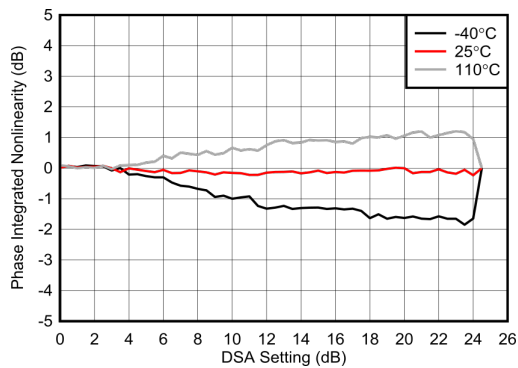
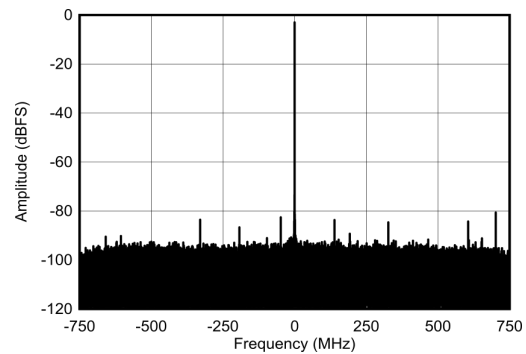


图 4-209. 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分相位误差



在 25°C 时校准，在 -40°C 和 110°C 时保持

图 4-210. 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分相位误差

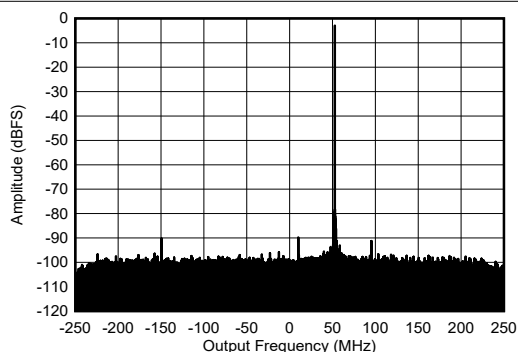


$F_{IN} = 6.851\text{GHz}$, $F_{NCO} = 6.85\text{GHz}$

图 4-211. 6.851GHz 和 -3dBFS 条件下的 RX 输出 FFT

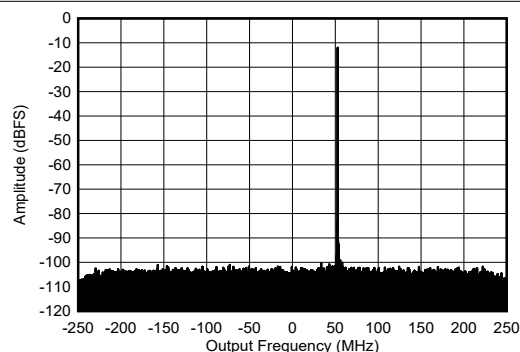
4.12.7 6.8GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 3000MSPS、输出采样率 = 500MSPS (抽取因子为 6x)、外部时钟模式、 $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ 和 DSA 设置 = 3dB。



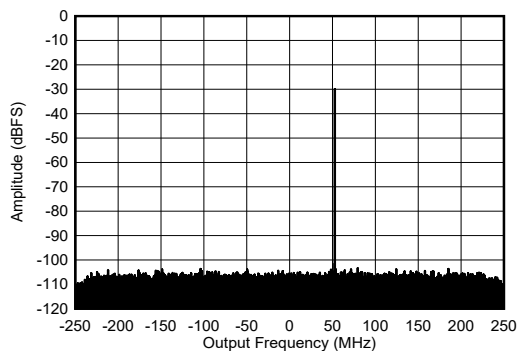
$F_{IN} = 6.851\text{GHz}$, $F_{NCO} = 6.85\text{GHz}$

图 4-212. 6.851GHz 和 -6dBFS 条件下的 RX 输出 FFT



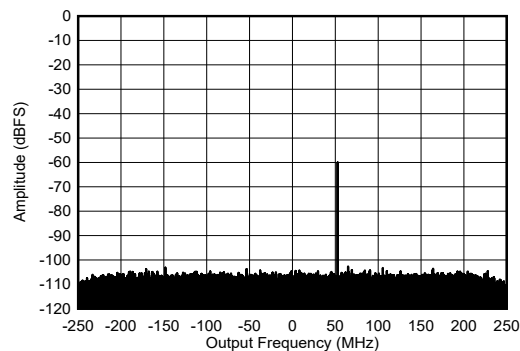
$F_{IN} = 6.851\text{GHz}$, $F_{NCO} = 6.85\text{GHz}$

图 4-213. 6.851GHz 和 -12dBFS 条件下的 RX 输出 FFT



$F_{IN} = 6.851\text{GHz}$, $F_{NCO} = 6.85\text{GHz}$

图 4-214. 6.851GHz 和 -30dBFS 条件下的 RX 输出 FFT



$F_{IN} = 6.851\text{GHz}$, $F_{NCO} = 6.85\text{GHz}$

图 4-215. 6.851GHz 和 -60dBFS 条件下的 RX 输出 FFT

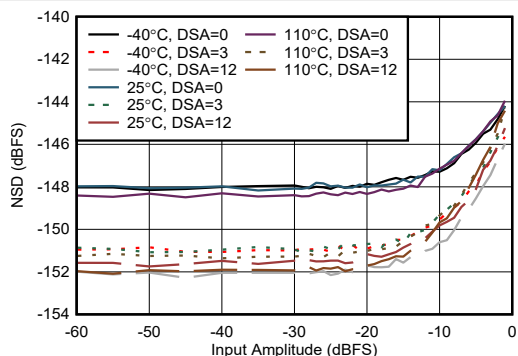
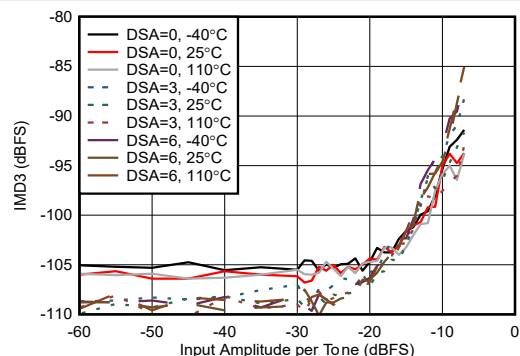


图 4-216. 6.851GHz 条件下 RX NSD 与输入振幅间的关系



100MHz 频率间隔

图 4-217. 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与输入振幅间的关系

4.12.7 6.8GHz 下的RX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值。30MHz 下的默认条件：ADC 采样率 = 3000MSPS、输出采样率 = 500MSPS (抽取因子为 6x)、外部时钟模式、 $A_{IN} = -3\text{dBFS}$ 和 DSA 设置 = 3dB。

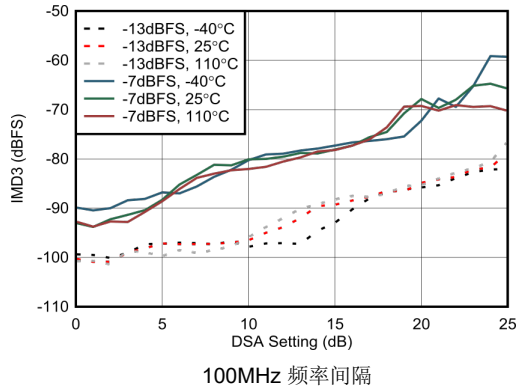


图 4-218. 6.851GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系

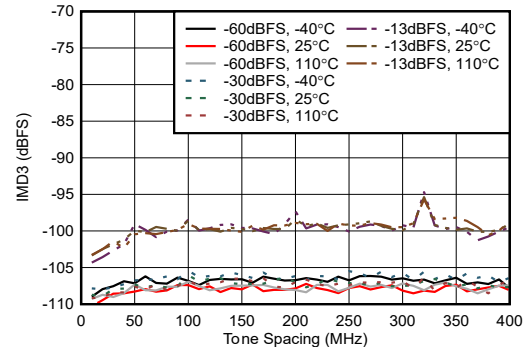


图 4-219. 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系

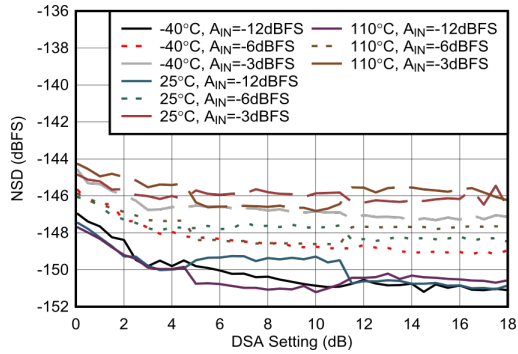


图 4-220. 6.851 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系

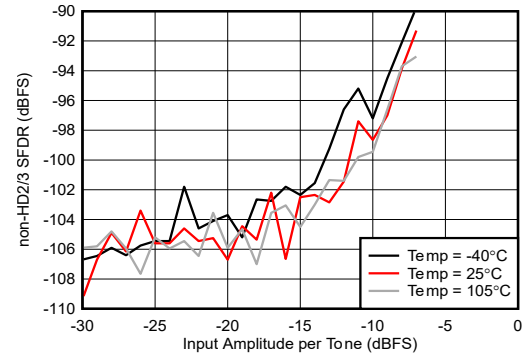


图 4-221. 6.85GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅间的关系

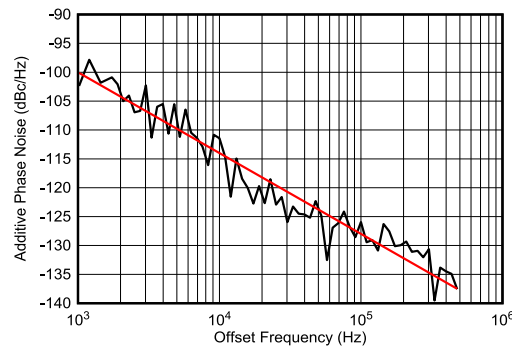
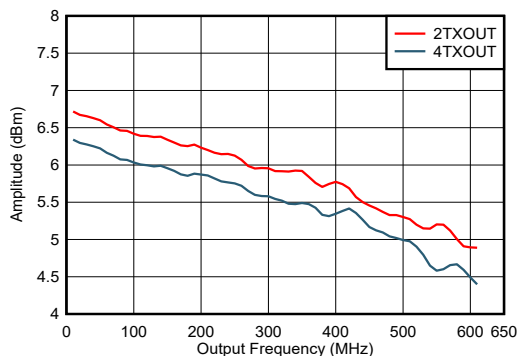


图 4-222. 6.85GHz 频率下的 RX 附加相位噪声

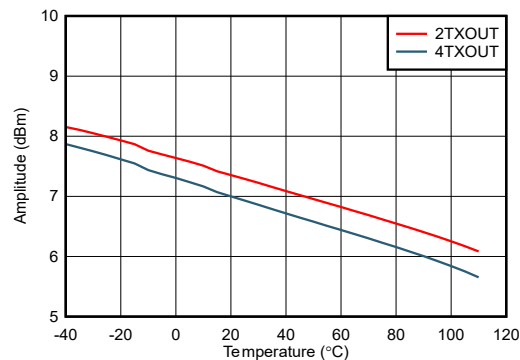
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



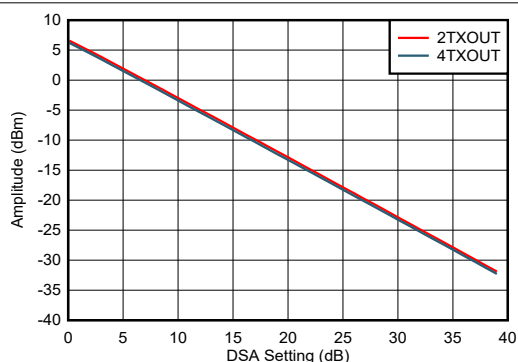
包括 PCB 和电缆损耗

图 4-223. TX 输出满量程与输出频率间的关系: 5MHz 至 600MHz



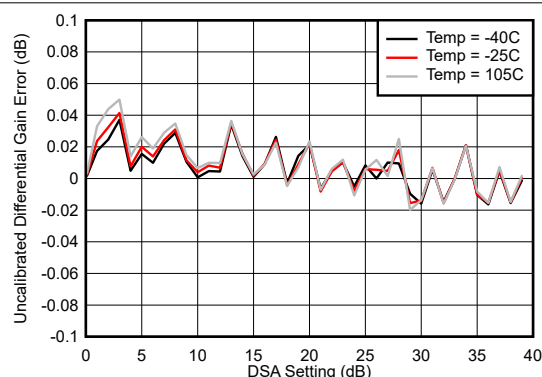
包括 PCB 和电缆损耗

图 4-224. 30MHz 条件下 TX 输出满量程与温度间的关系



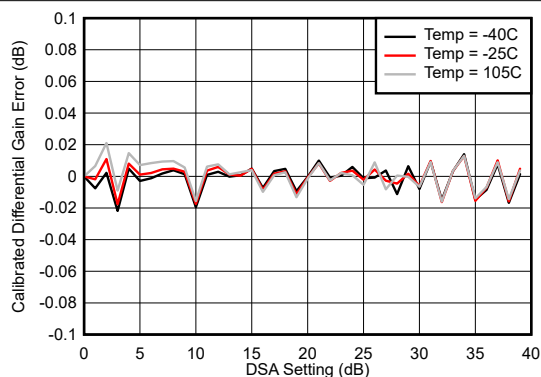
包括 PCB 和电缆损耗

图 4-225. 30MHz 条件下 TX 输出满量程与 DSA 设置间的关系



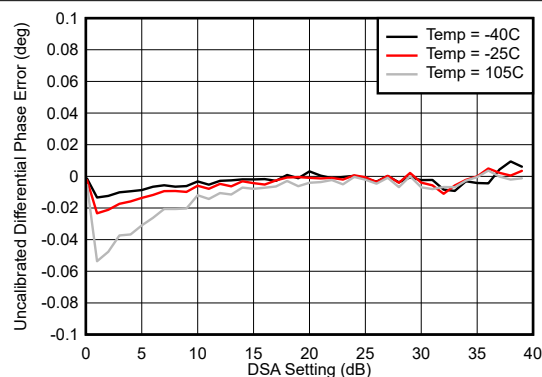
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-226. 30MHz 条件下的未校准 TX 差分增益误差 (DNL)



差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-227. 30MHz 条件下的校准 TX 差分增益误差 (DNL)

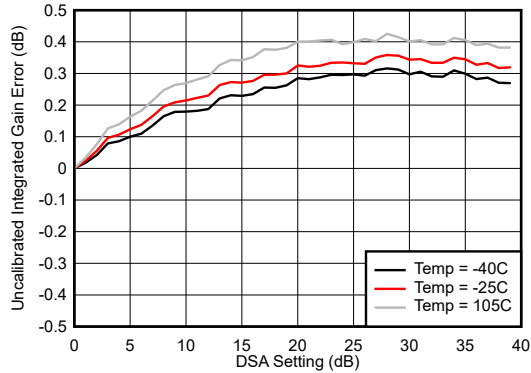


差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-228. 30MHz 条件下的校准 TX 差分增益误差 (DNL)

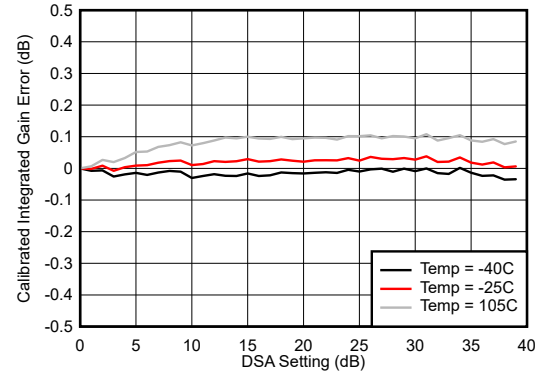
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



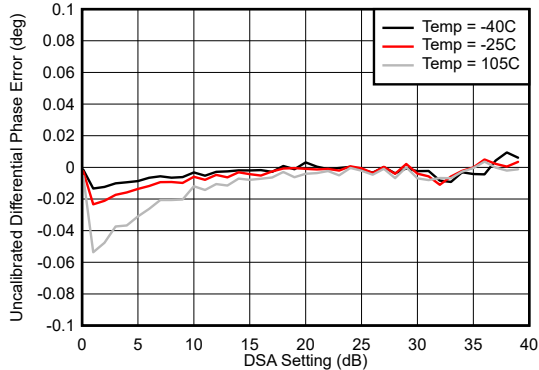
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-229. 30MHz 条件下的未校准 TX 积分增益误差 (INL)



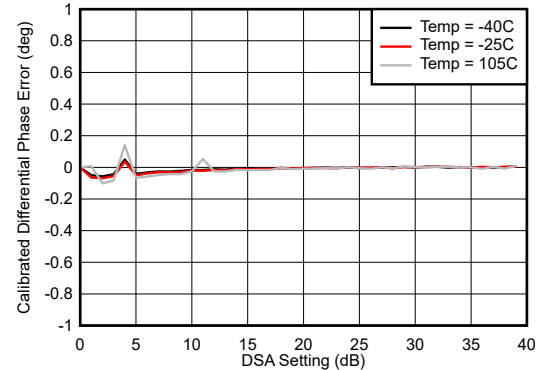
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-230. 30MHz 条件下的校准 TX 积分增益误差 (INL)



差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-231. 30MHz 条件下的未校准 TX 差分相位误差 (DNL)

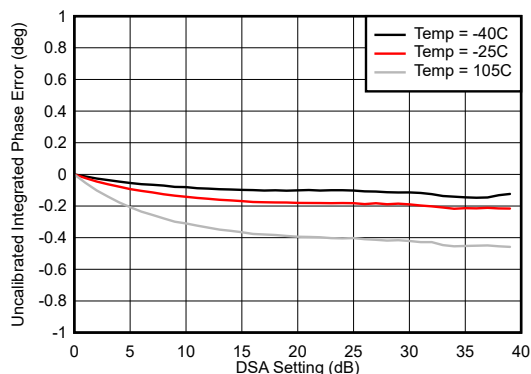


差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-232. 30MHz 条件下的校准 TX 差分相位误差 (DNL)

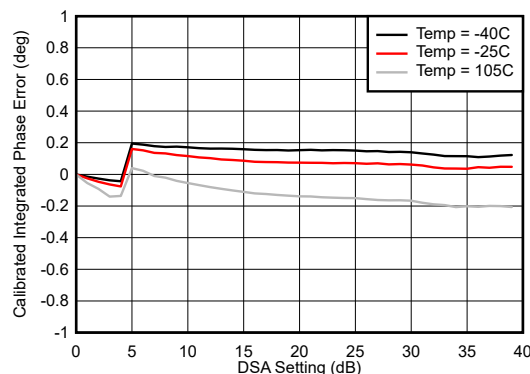
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-233. 30MHz 条件下的未校准 TX 积分相位误差 (INL)



积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-234. 30MHz 条件下的校准 TX 积分相位误差 (INL)

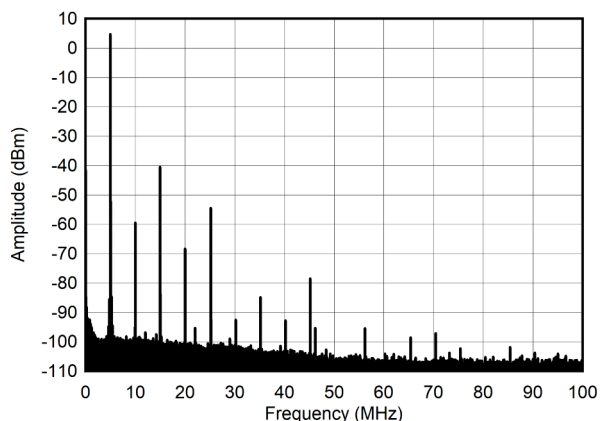


图 4-235. 5MHz 和 -1dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

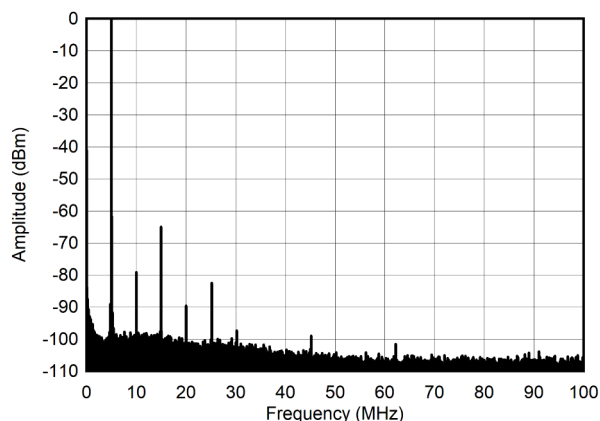


图 4-236. 5MHz 和 -6dBFS (0 - 100MHz) 下的单音频谱

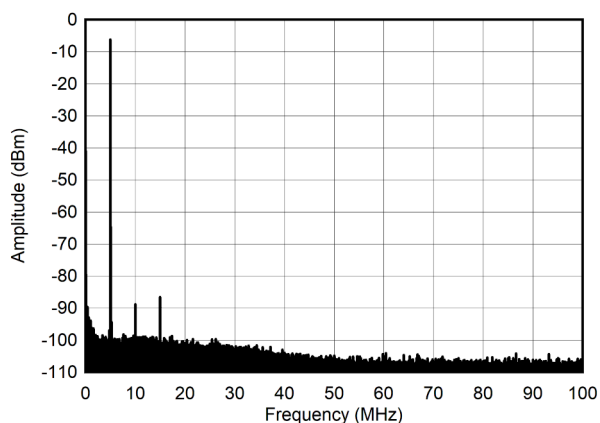


图 4-237. 5MHz 和 -12dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

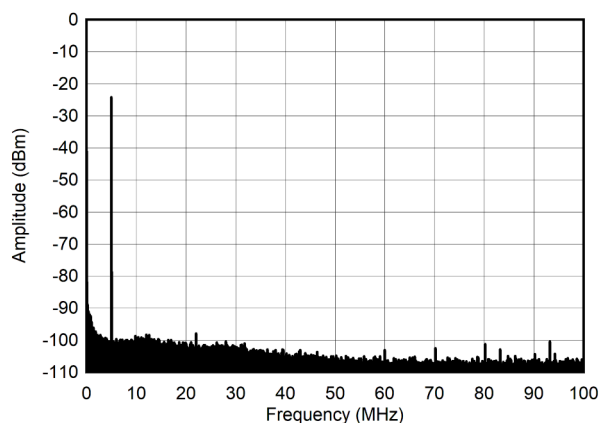


图 4-238. 5MHz 和 -30dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准

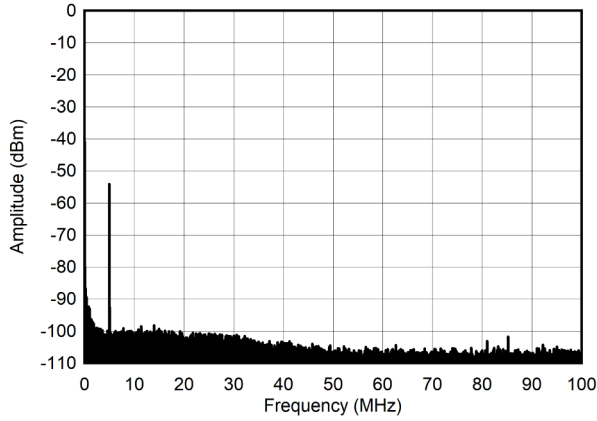


图 4-239. 5MHz 和 -60dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

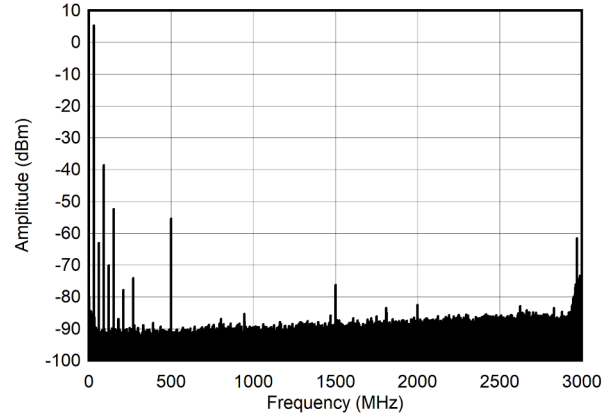


图 4-240. 30MHz 和 -1dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

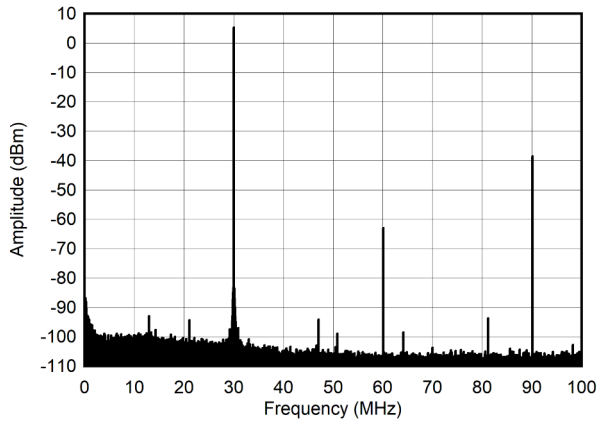


图 4-241. 30MHz 和 -1dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

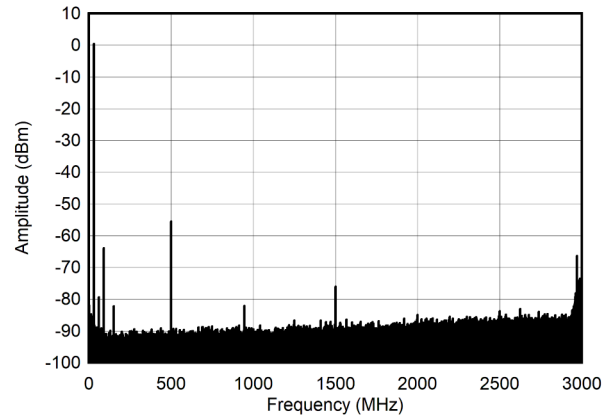


图 4-242. 30MHz 和 -6dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

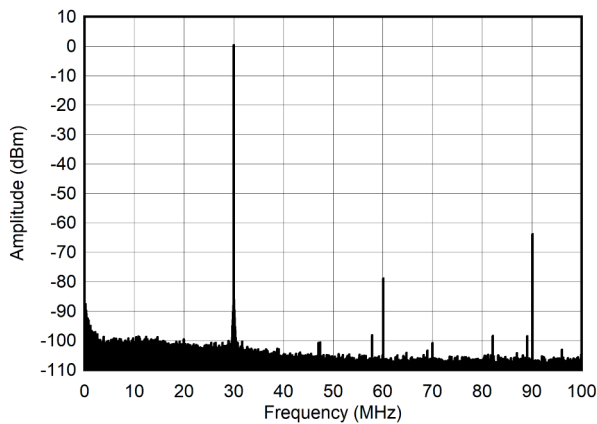


图 4-243. 30MHz 和 -6dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

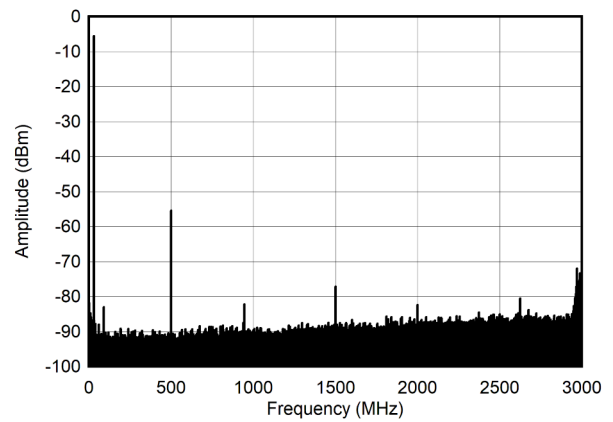


图 4-244. 30MHz 和 -12dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准

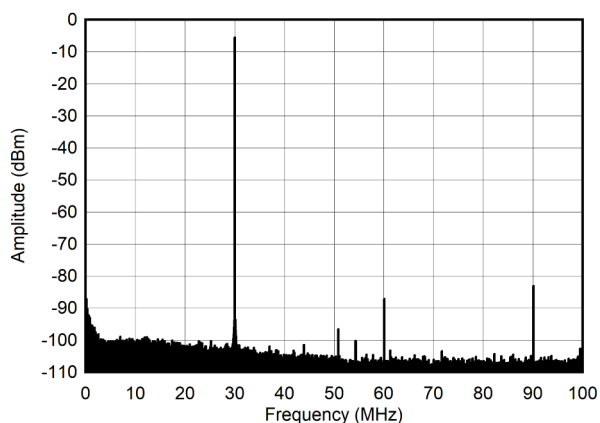


图 4-245. 30MHz 和 -12dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

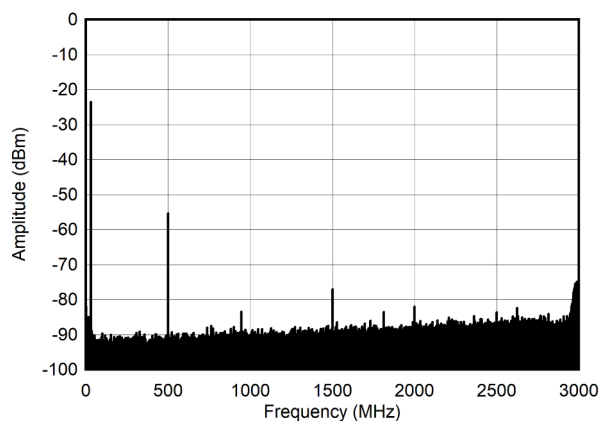


图 4-246. 30MHz 和 -30dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

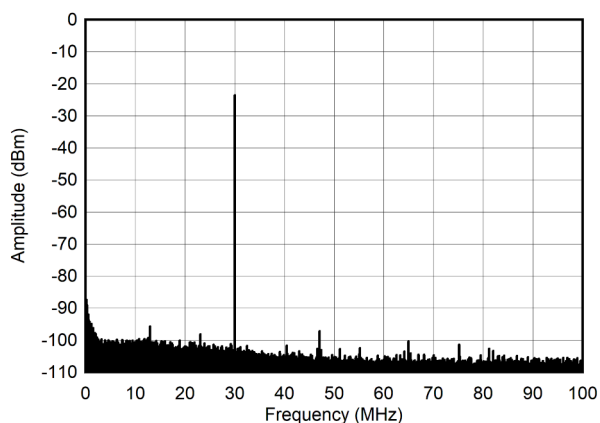


图 4-247. 30MHz 和 -30dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

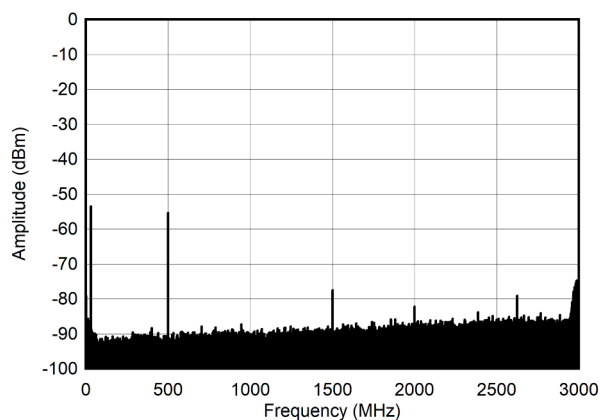


图 4-248. 30MHz 和 -60dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

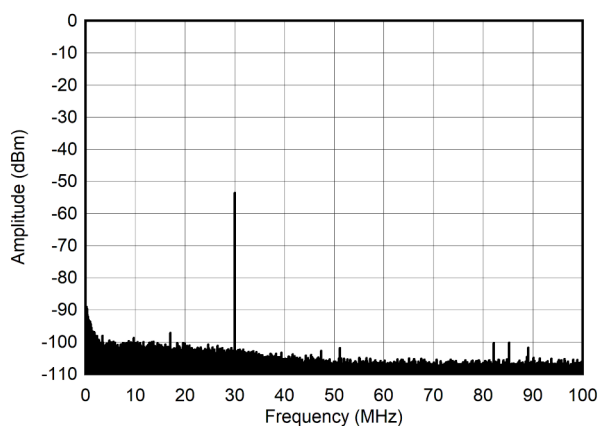


图 4-249. 30MHz 和 -60dBFS (0 - 100MHz) 条件下的单音频谱

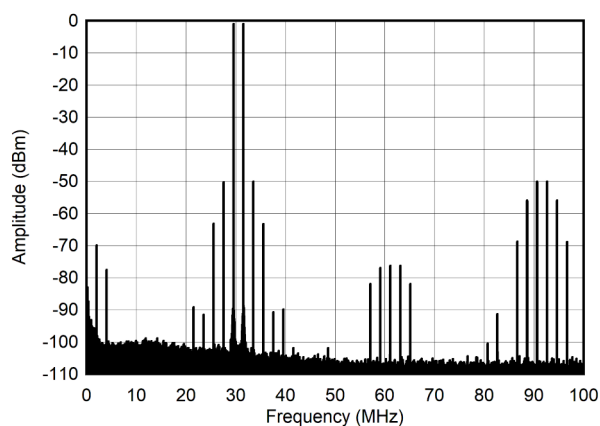


图 4-250. 30MHz 和 -7dBFS (0 - 100MHz) 条件下的双音频谱

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准

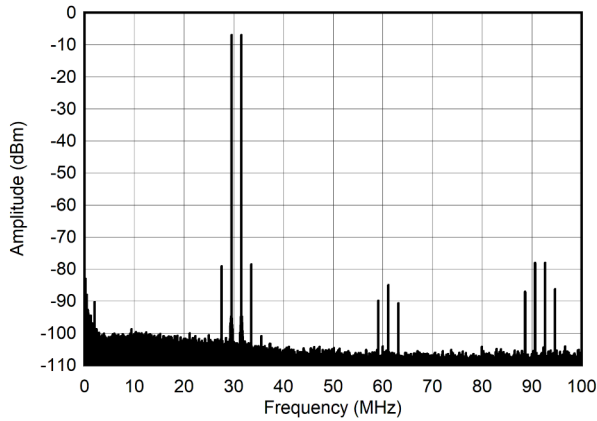


图 4-251. 30MHz 和 -13dBFS (0 - 100MHz) 条件下的双频频谱

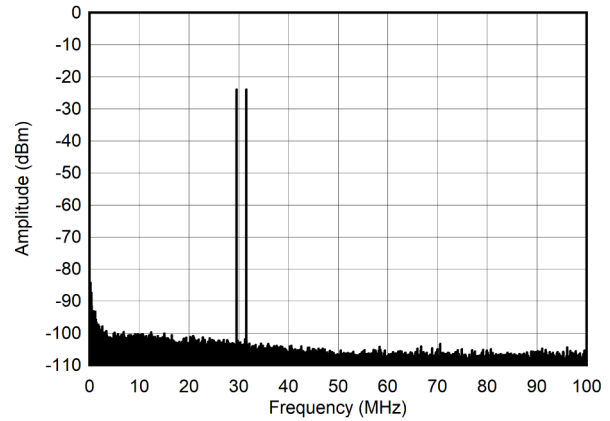


图 4-252. 30MHz 和 -30dBFS (0 - 100MHz) 条件下的双频频谱

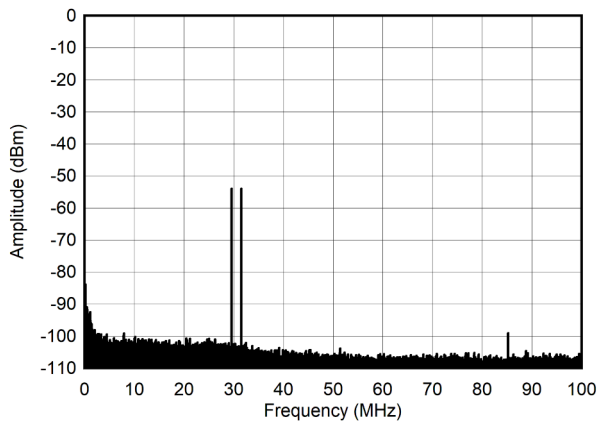
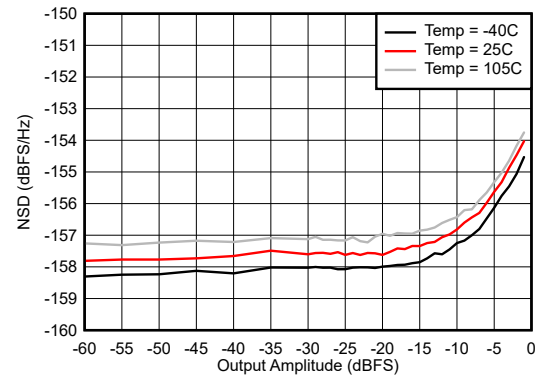
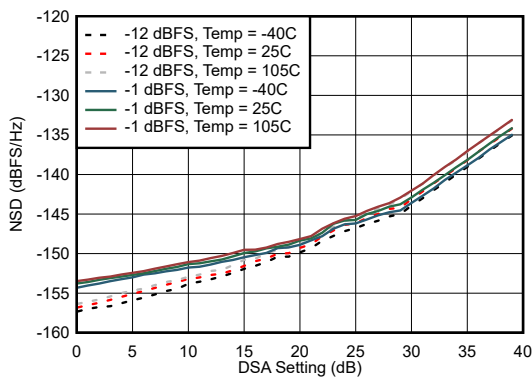


图 4-253. 30MHz 和 -60dBFS (0 - 100MHz) 条件下的双频频谱



在 +50MHz 偏移条件下测量

图 4-254. 30MHz 条件下的噪声频谱密度与数字振幅间的关系



在 +50MHz 偏移条件下测量

图 4-255. 30MHz 条件下的噪声频谱密度与 DSA 设置间的关系

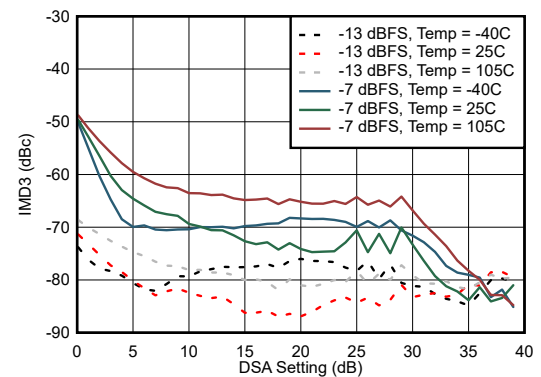


图 4-256. 30MHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置间的关系

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准

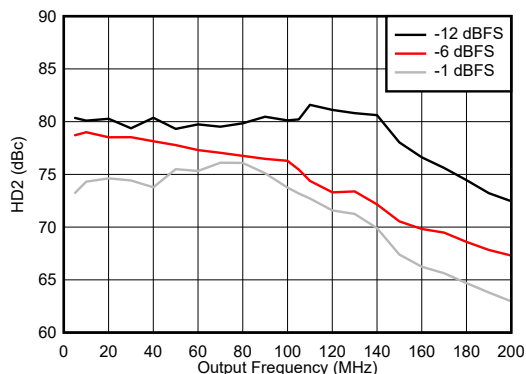


图 4-257. HD2 与频率 (0 - 200MHz) 间的关系

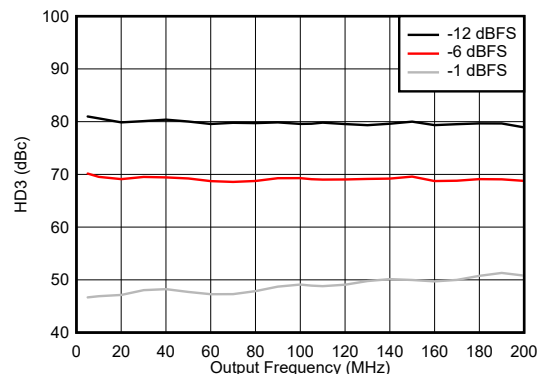
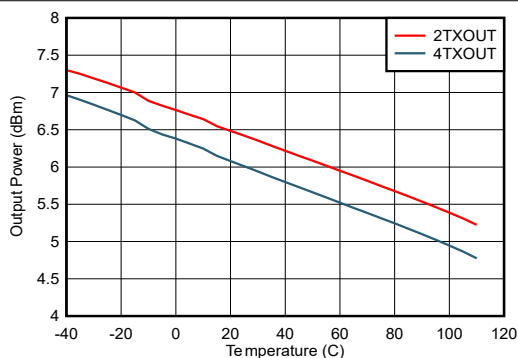
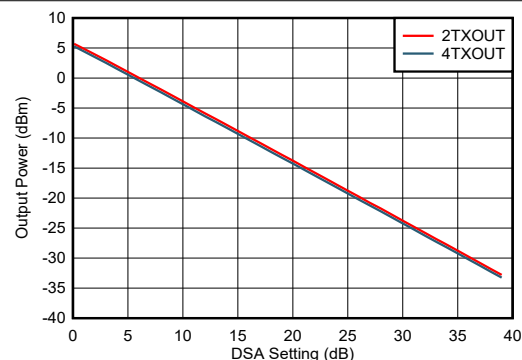


图 4-258. HD3 与频率 (0 - 200MHz) 间的关系



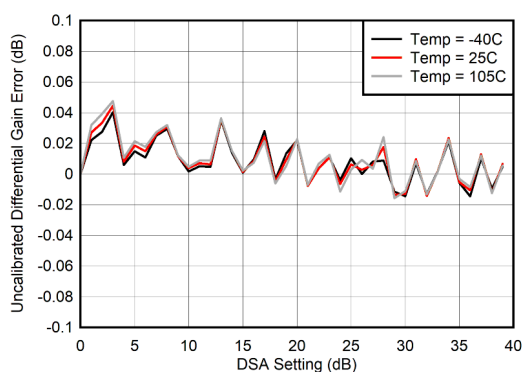
包括 PCB 和电缆损耗

图 4-259. 400MHz 条件下 TX 输出满量程与温度间的关系



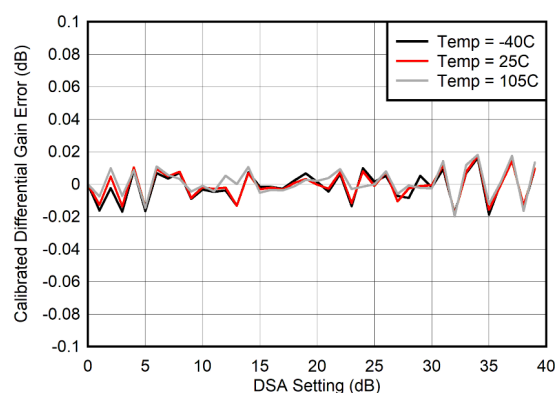
包括 PCB 和电缆损耗

图 4-260. 400MHz 条件下 TX 输出满量程与 DSA 设置间的关系



差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-261. 400MHz 条件下的未校准 TX 差分增益误差 (DNL)

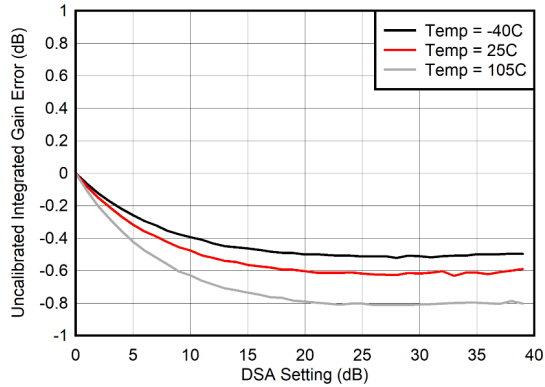


差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-262. 400MHz 条件下的校准 TX 差分增益误差 (DNL)

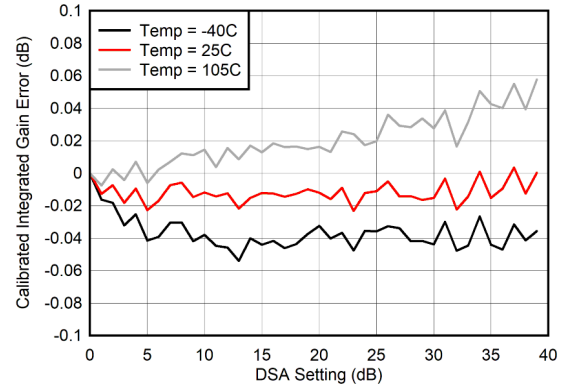
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



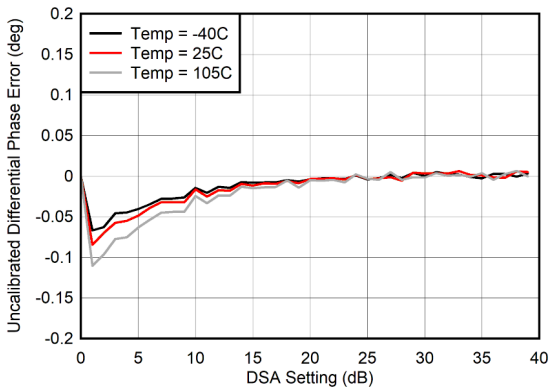
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-263. 400MHz 条件下的未校准 TX 积分增益误差 (INL)



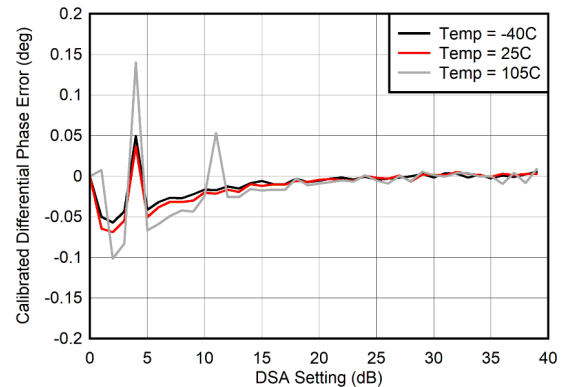
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-264. 400MHz 条件下的校准 TX 积分增益误差 (INL)



差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-265. 400MHz 条件下的未校准 TX 差分相位误差 (DNL)

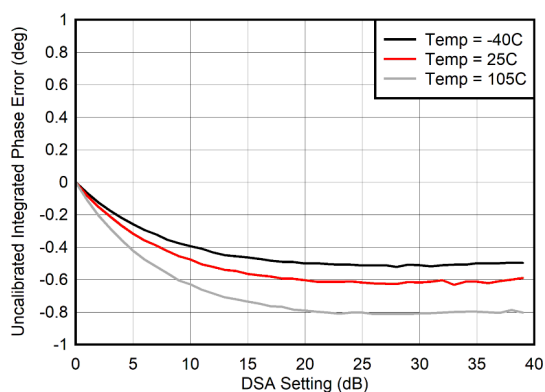


差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-266. 400MHz 条件下的校准 TX 差分相位误差 (DNL)

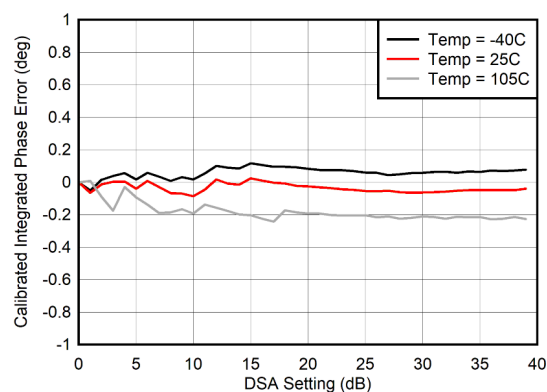
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-267. 400MHz 条件下的未校准 TX 积分相位误差 (INL)



积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-268. 400MHz 条件下的校准 TX 积分相位误差 (INL)

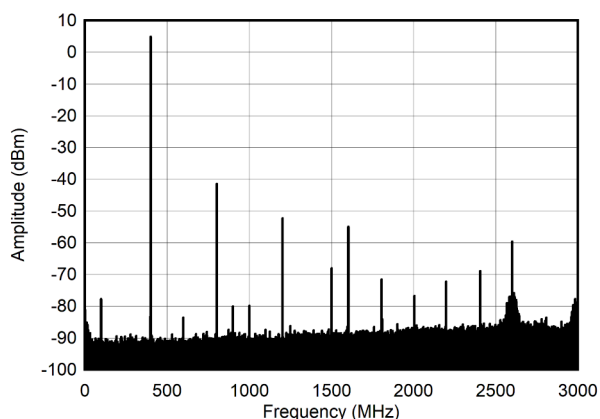


图 4-269. 400MHz 和 -1dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

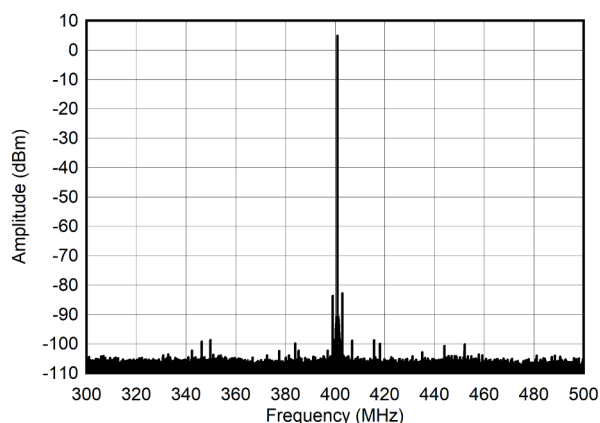


图 4-270. 400MHz 和 -1dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的单音频谱

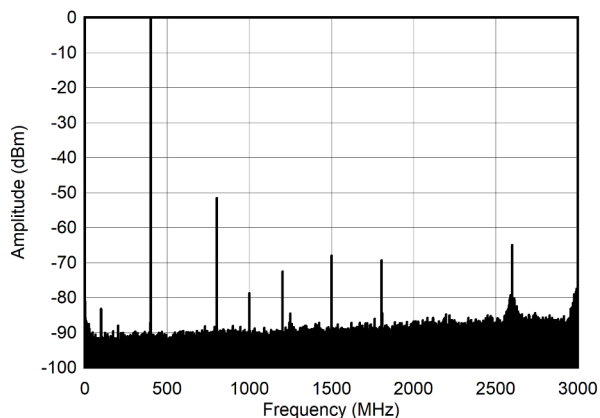


图 4-271. 400MHz 和 -6dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

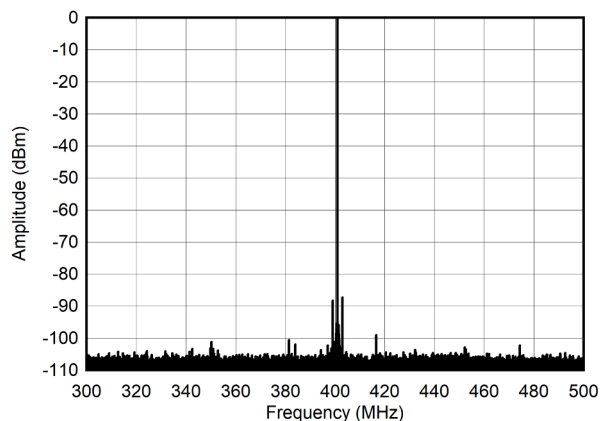


图 4-272. 400MHz 和 -6dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的单音频谱

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准

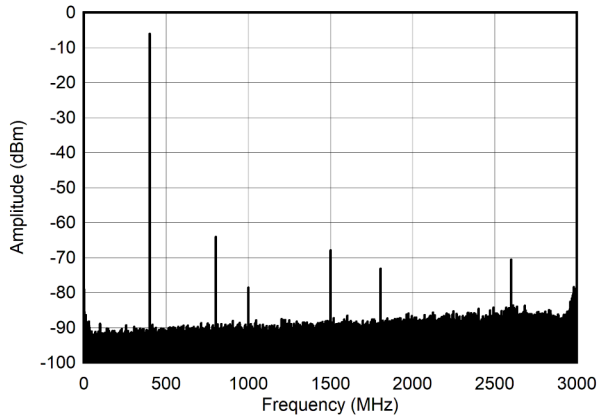


图 4-273. 400MHz 和 -12dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

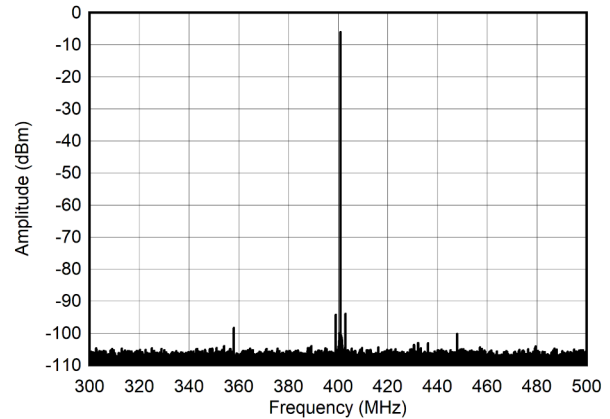


图 4-274. 400MHz 和 -12dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的单音频谱

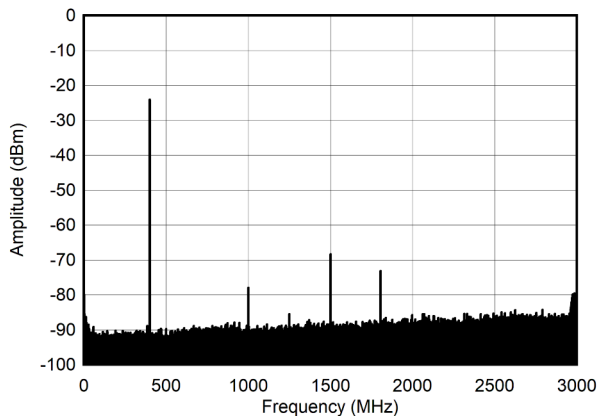


图 4-275. 400MHz 和 -30dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

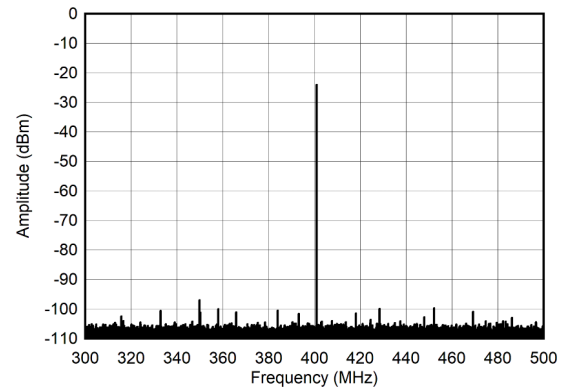


图 4-276. 400MHz 和 -30dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的单音频谱

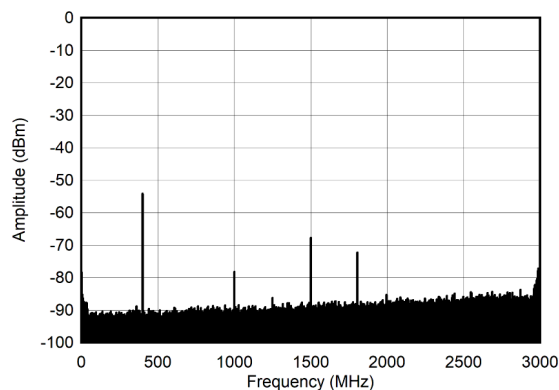


图 4-277. 400MHz 和 -60dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音频谱

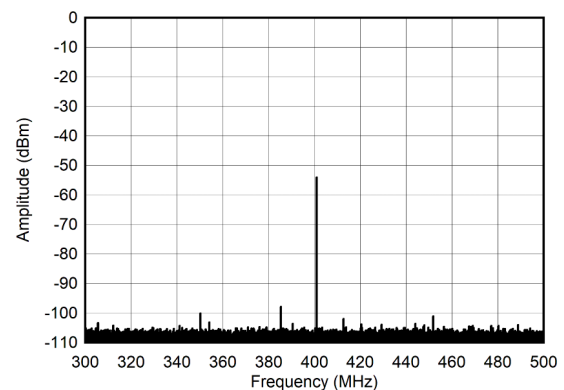
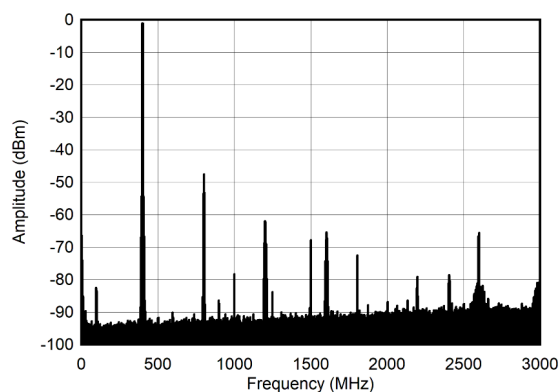


图 4-278. 400MHz 和 -60dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的单音频谱

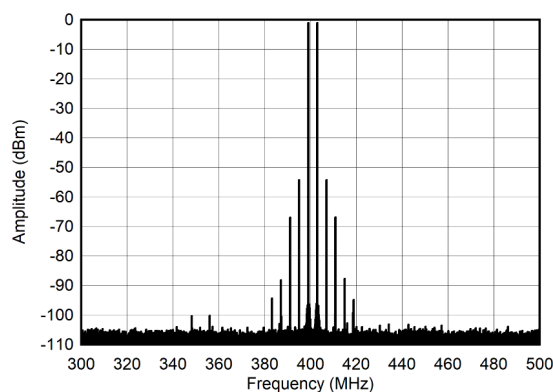
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



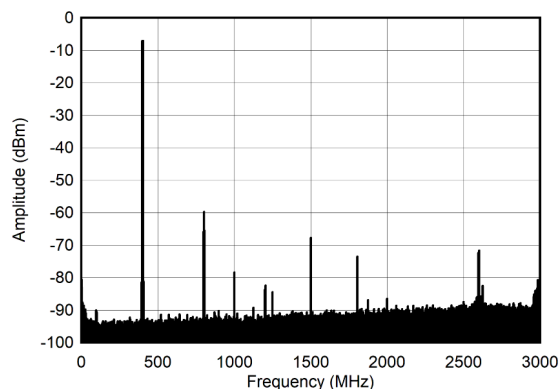
频率间隔 = 4MHz

图 4-279. 400MHz 和 -7dBFS (奈奎斯特) 条件下的双频频谱



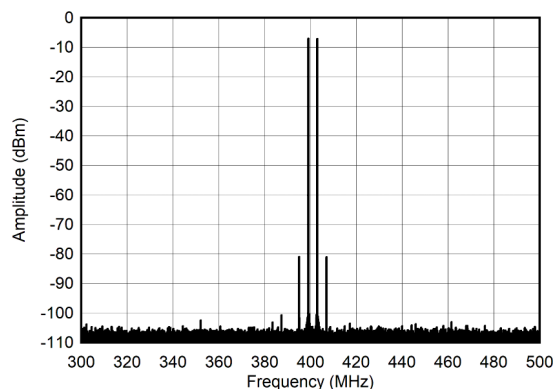
频率间隔 = 4MHz

图 4-280. 400MHz 和 -7dBFS (±100MHz) 条件下的双频频谱



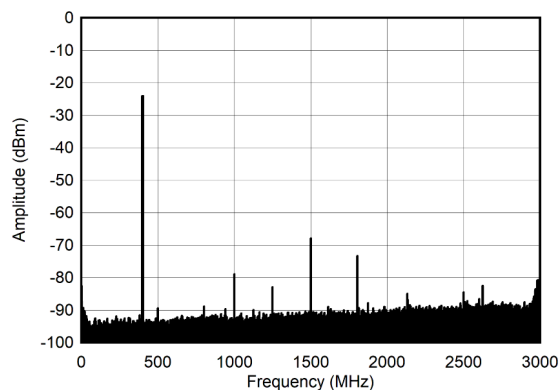
频率间隔 = 4MHz

图 4-281. 400MHz 和 -13dBFS (奈奎斯特) 条件下的双频频谱



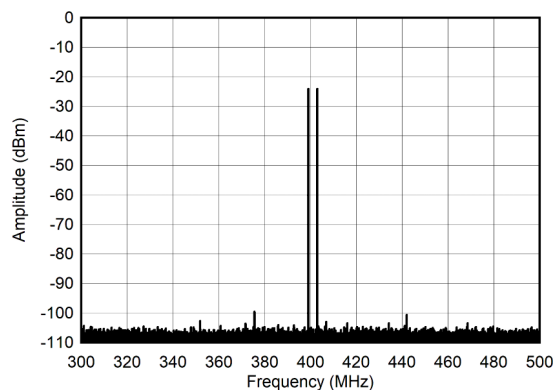
频率间隔 = 4MHz

图 4-282. 400MHz 和 -13dBFS (±100MHz) 条件下的双频频谱



频率间隔 = 4MHz

图 4-283. 400MHz 和 -30dBFS (奈奎斯特) 条件下的双频频谱

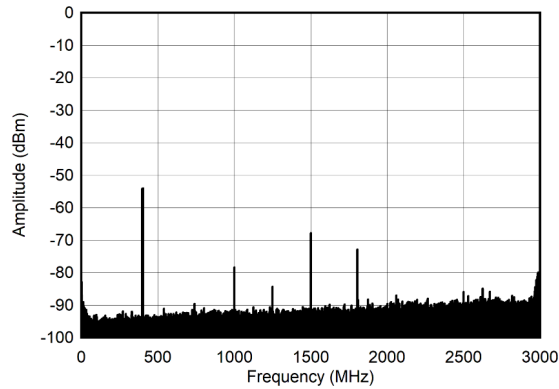


频率间隔 = 4MHz

图 4-284. 400MHz 和 -30dBFS (±100MHz) 条件下的双频频谱

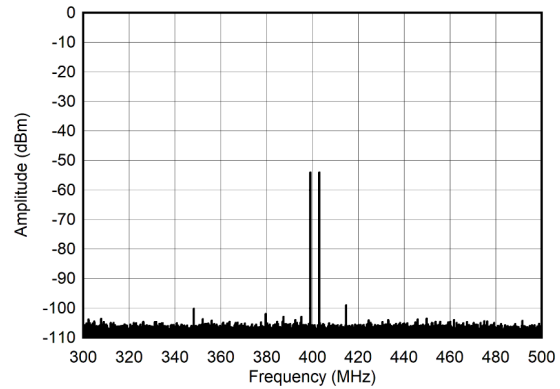
4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。默认条件: TX 输入数据速率 = 125MSPS, $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值), 交错模式, 第一个奈奎斯特区域输出, PLL 时钟模式, $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



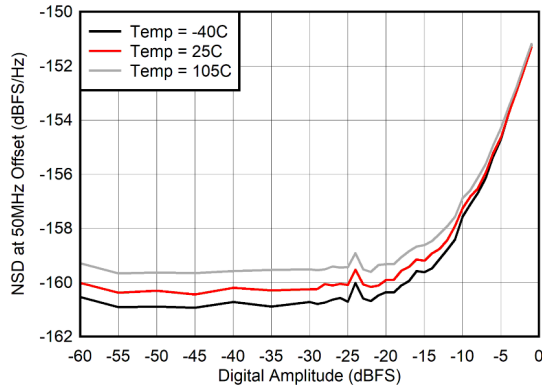
频率间隔 = 4MHz

图 4-285. 400MHz 和 -60dBFS (奈奎斯特) 条件下的双频频谱



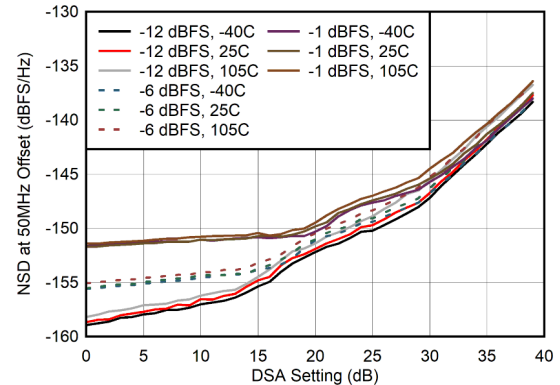
频率间隔 = 4MHz

图 4-286. 400MHz 和 -60dBFS ($\pm 100\text{MHz}$) 条件下的双频频谱



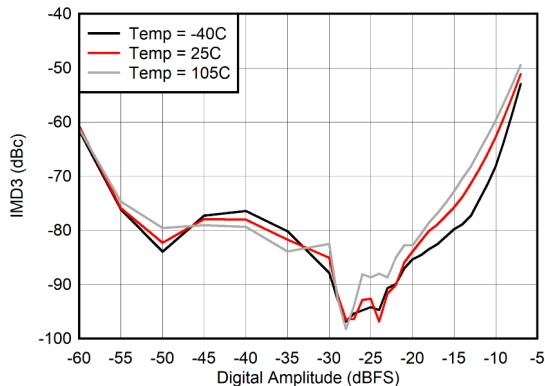
在 50MHz 偏移条件下测量

图 4-287. 400MHz 条件下的噪声频谱密度与数字振幅间的关系



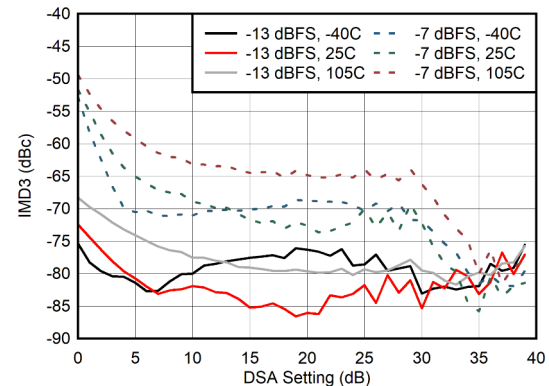
在 50MHz 偏移条件下测量

图 4-288. 400MHz 条件下的噪声频谱密度与 DSA 设置间的关系



频率间隔 = 4MHz

图 4-289. 400MHz 条件下 IMD3 与数字振幅间的关系



频率间隔 = 4MHz

图 4-290. 400MHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置间的关系

4.12.8 30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值，使用标称电源。默认条件：TX 输入数据速率 = 125MSPS， $f_{\text{DAC}} = 6000\text{MSPS}$ (48 倍插值)，交错模式，第一个奈奎斯特区域输出，PLL 时钟模式， $f_{\text{REF}} = 500\text{MHz}$ 。所有图的附加默认条件， $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ ， $\text{DSa} = 0\text{dB}$ ， $\text{Sin}(x)/x$ 启用， DSA 校准

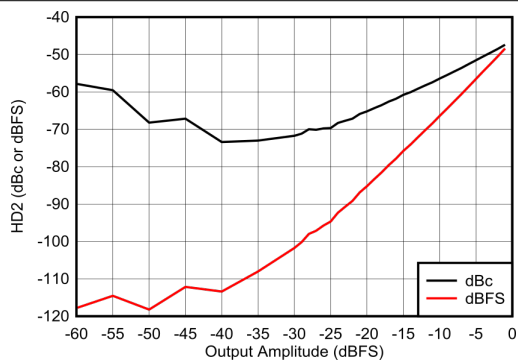


图 4-291. 400MHz 条件下 HD2 与振幅间的关系

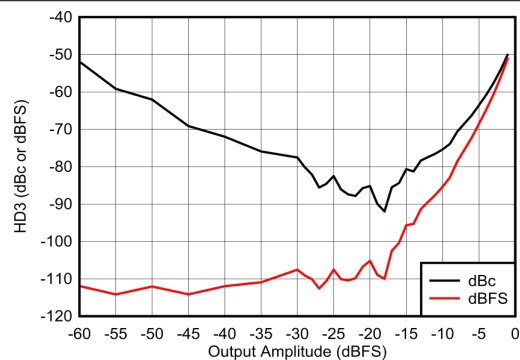
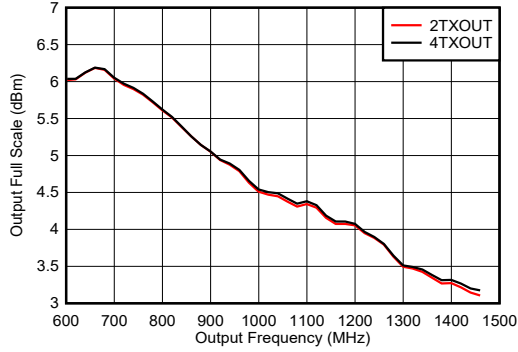


图 4-292. 400MHz 条件下 HD3 与振幅间的关系

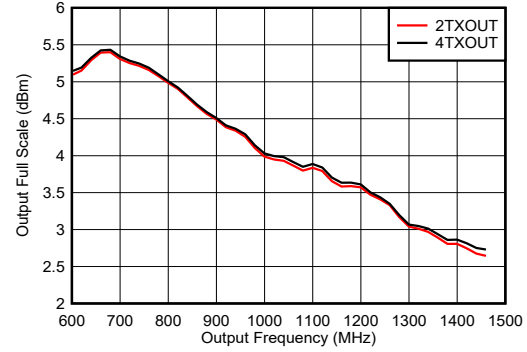
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



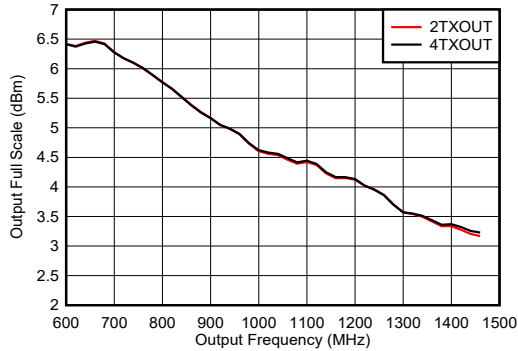
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8GHz 匹配

图 4-293. 5898.24MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率和通道间的关系, 直接模式



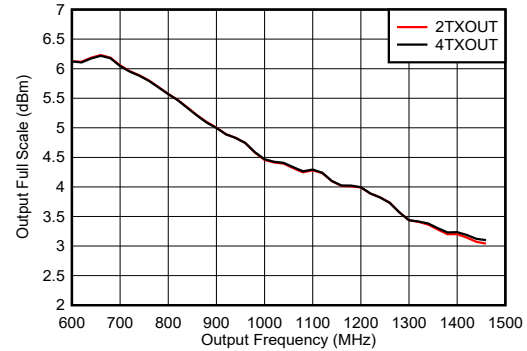
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8GHz 匹配

图 4-294. 8847.36MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率和通道间的关系, 直接模式



包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8GHz 匹配

图 4-295. 5898.24MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率和通道间的关系, 交错模式

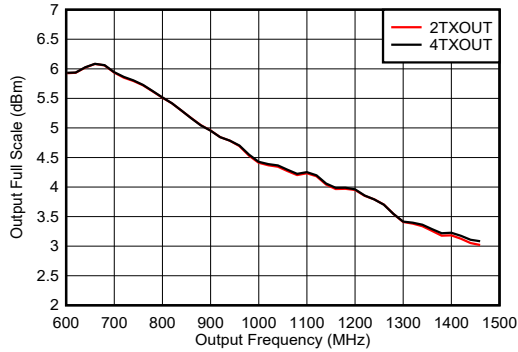


包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8GHz 匹配

图 4-296. 8847.36MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率和通道间的关系, 交错模式

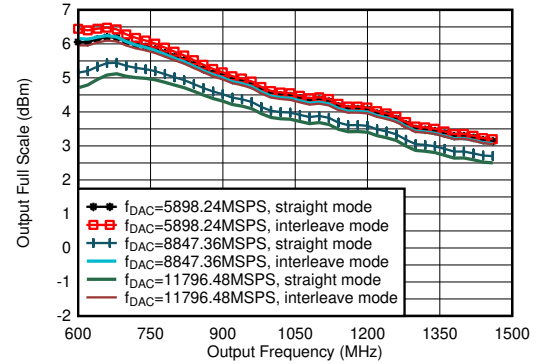
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



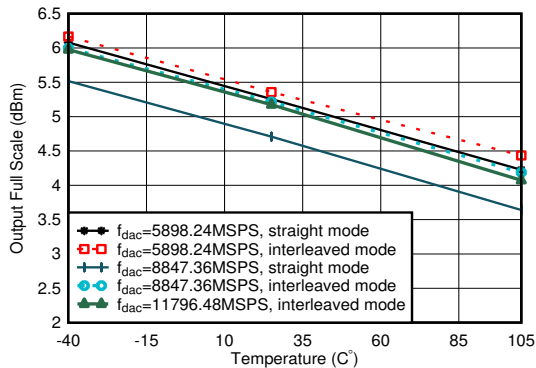
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8GHz 匹配

图 4-297. 11796.48MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率和通道间的关系, 交错模式



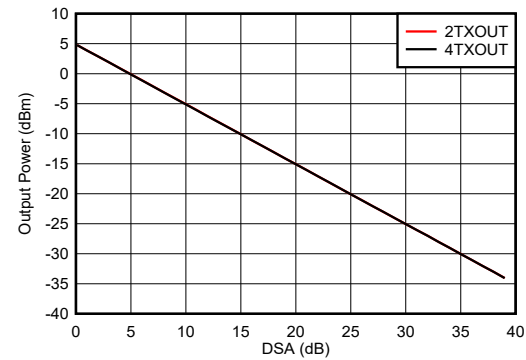
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8 GHz 匹配

图 4-298. TX 输出满量程与输出频率间的关系



包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 0.8 GHz 匹配

图 4-299. TX 输出满量程与温度间的关系

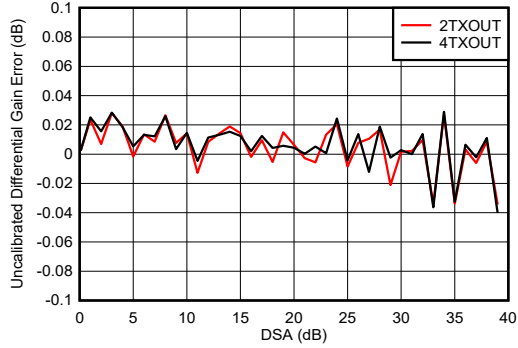


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, 匹配 0.8GHz

图 4-300. 0.85GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系

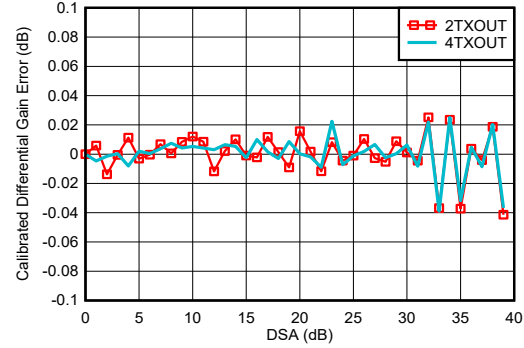
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



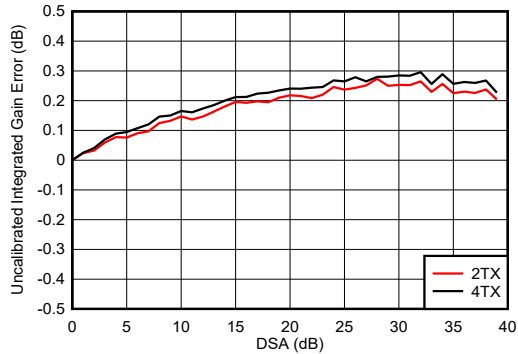
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-301. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



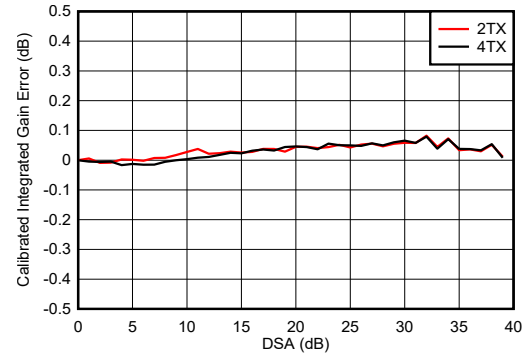
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-302. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 4-303. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

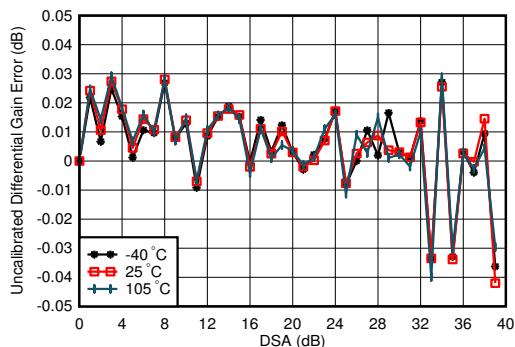


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 4-304. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

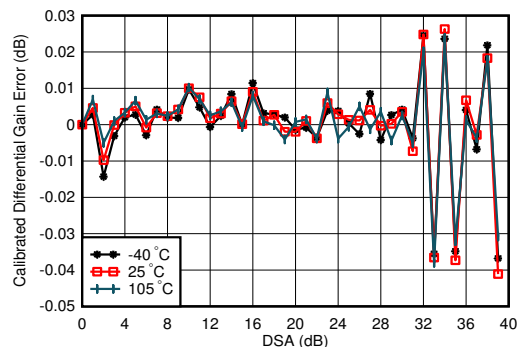
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



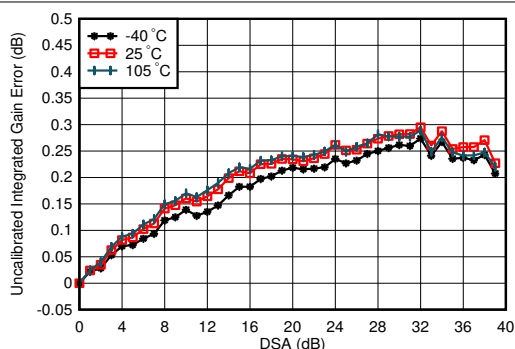
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-305. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



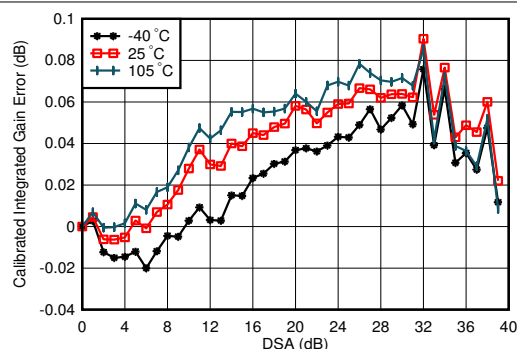
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-306. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 4-307. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

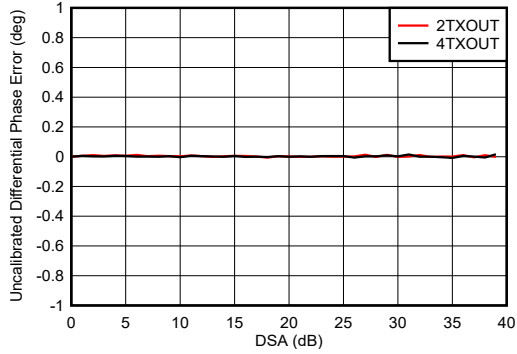


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + \text{DSA 设置}$

图 4-308. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

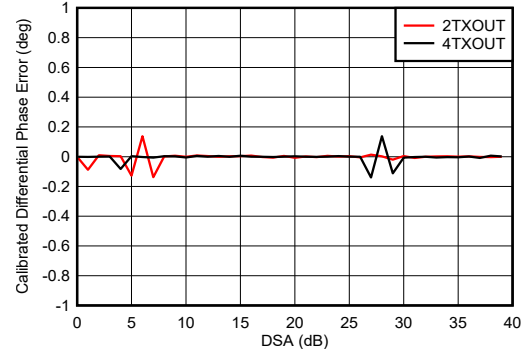
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



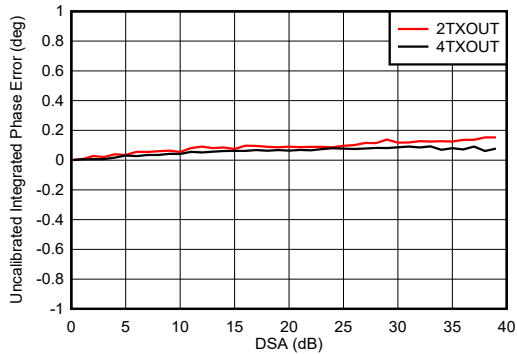
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-309. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



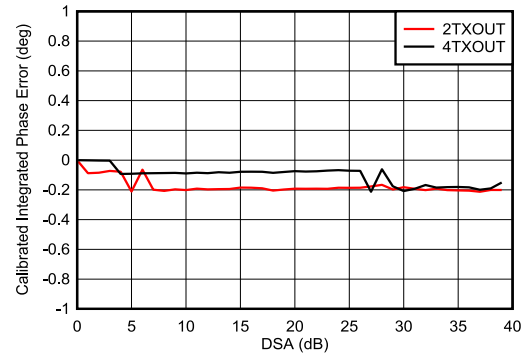
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$
任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 4-310. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-311. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

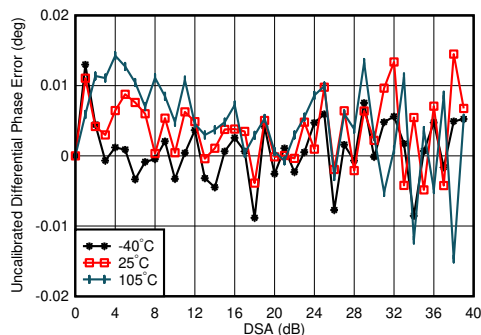


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-312. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

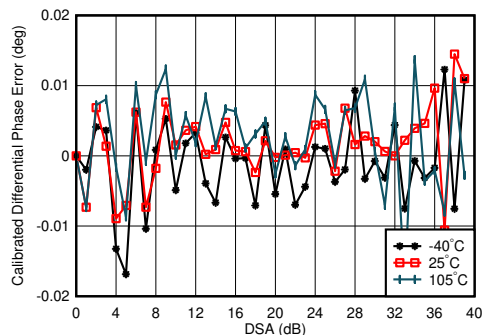
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



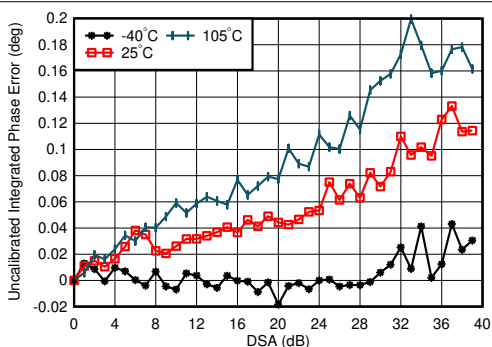
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}-1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-313. 0.85GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



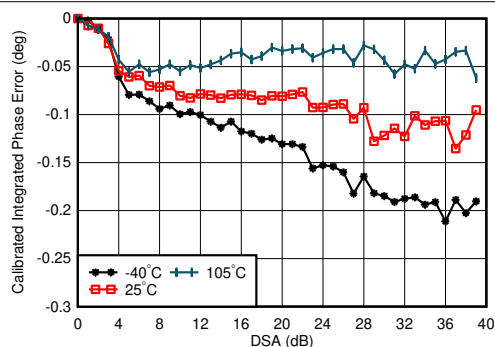
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}-1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-314. 0.85GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-315. 0.85GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

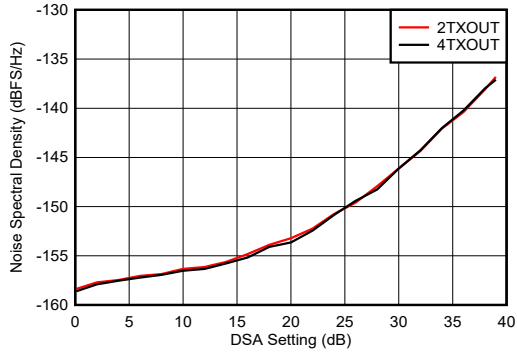


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-316. 0.85GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

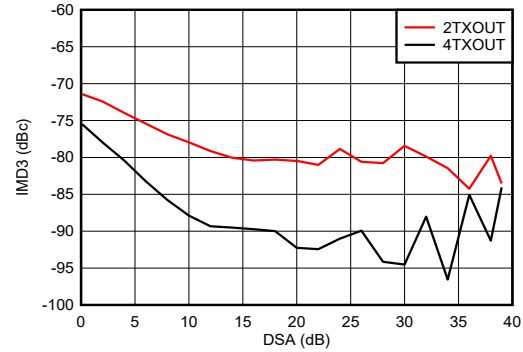
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



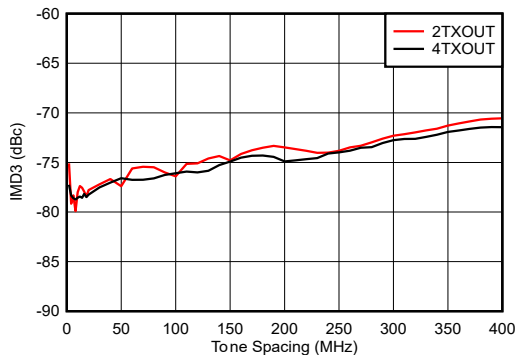
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 在 0.8GHz 条件下匹配, $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 4-317. 0.85GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系



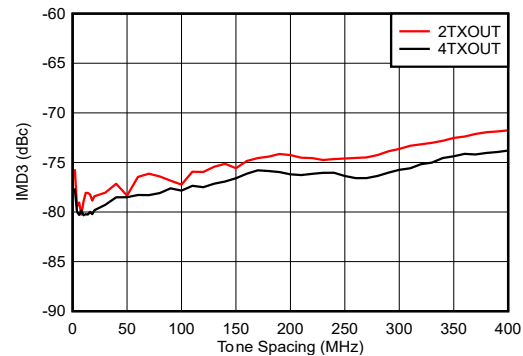
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-318. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系



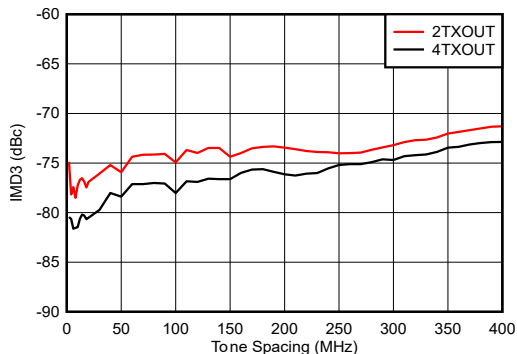
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-319. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系



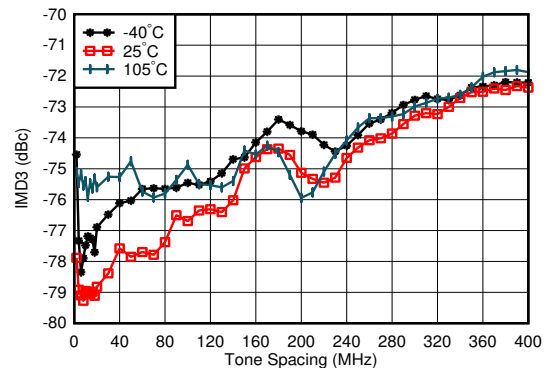
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-320. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-321. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系

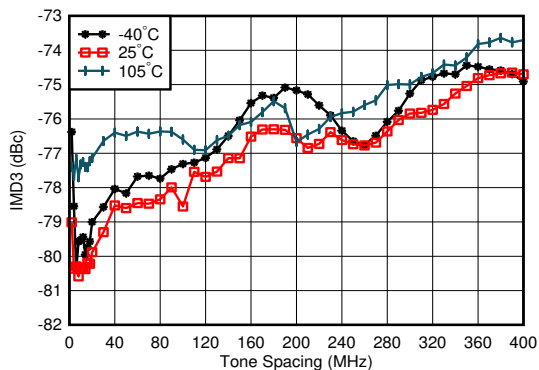


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS, 最差通道

图 4-322. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系

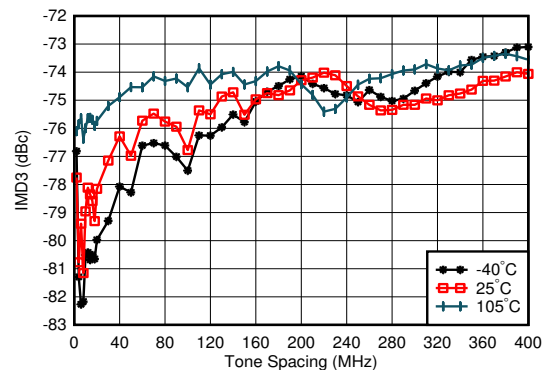
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



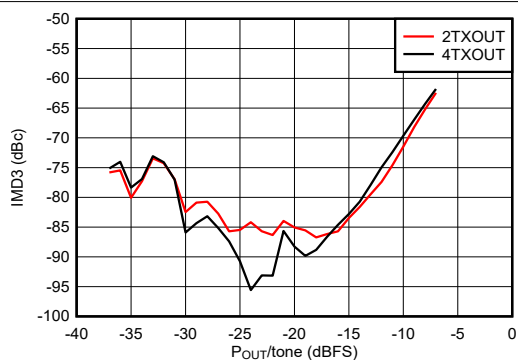
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单频幅度为 -13dBFS, 最差通道

图 4-323. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



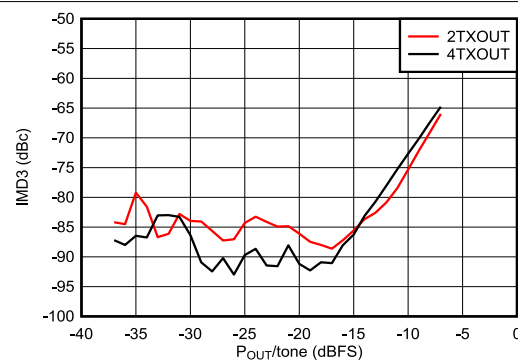
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配, 单频幅度为 -13dBFS, 最差通道

图 4-324. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



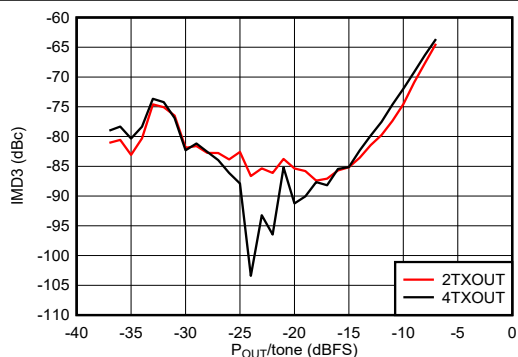
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配

图 4-325. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系



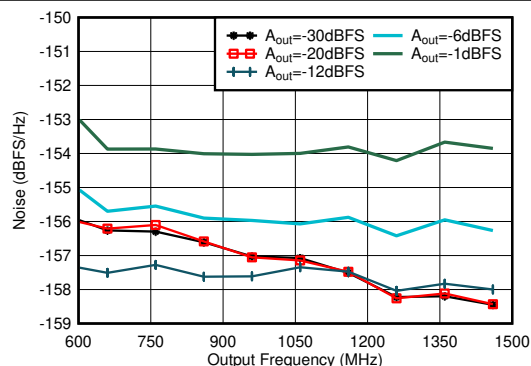
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配

图 4-326. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $f_{\text{CENTER}} = 0.85\text{GHz}$, $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$, 在 0.8GHz 条件下匹配

图 4-327. 0.85GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系

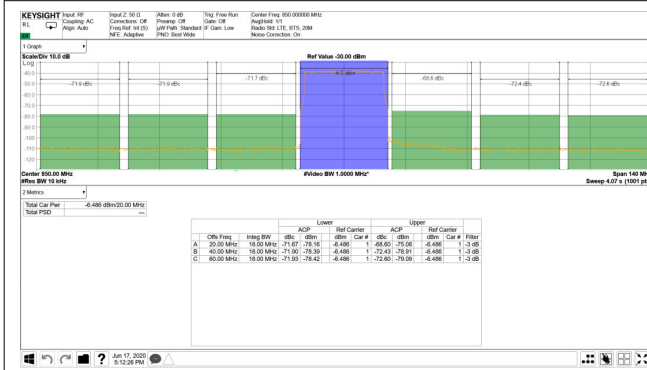


在 0.8 GHz 条件下匹配, 单音, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 40MHz 偏移, $\text{DSA} = 0\text{dB}$

图 4-328. 0.85GHz 条件下 TX 单音输出噪声与频率和振幅间的关系

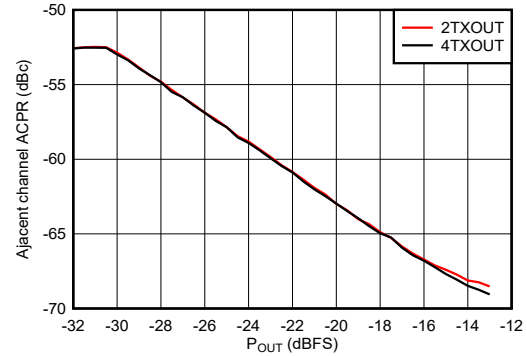
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



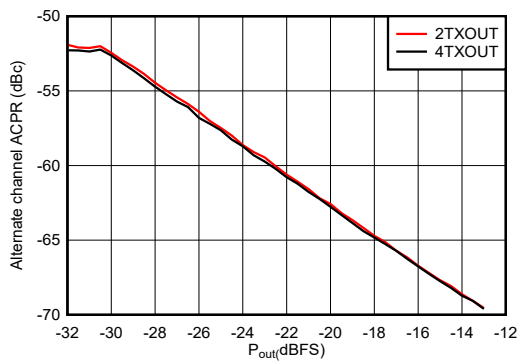
TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-329. 0.85GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



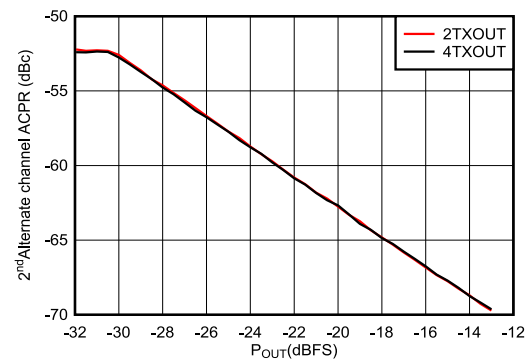
在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-330. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系



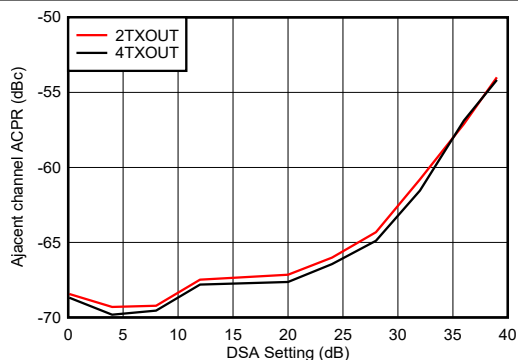
在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-331. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



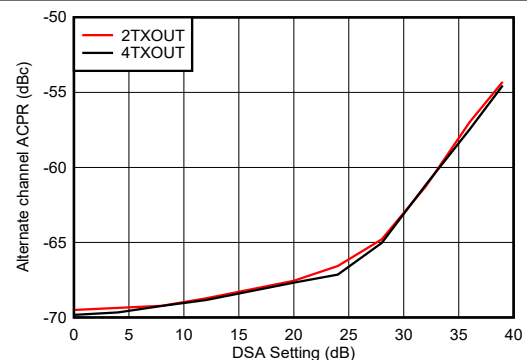
在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-332. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt2-ACPR 与数字电平间的关系



在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-333. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系

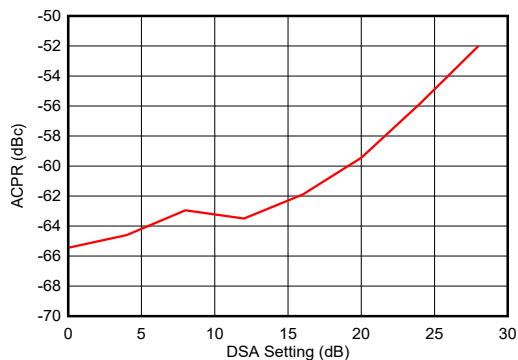


在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-334. 0.85GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系

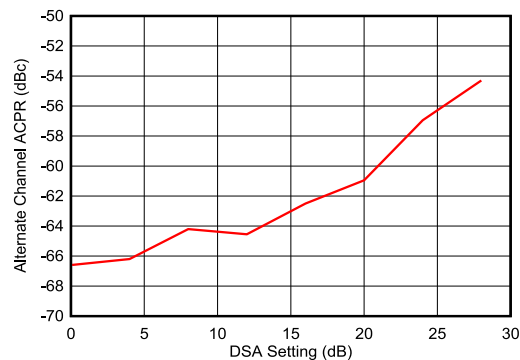
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



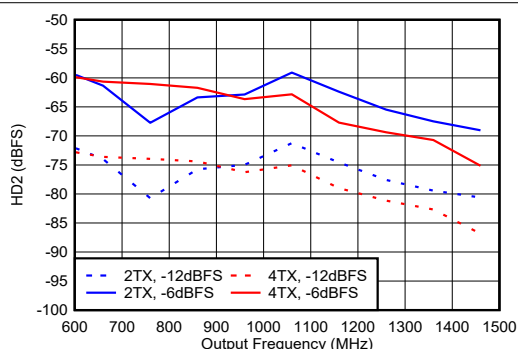
在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-335. 0.85GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与 DSA 间的关系



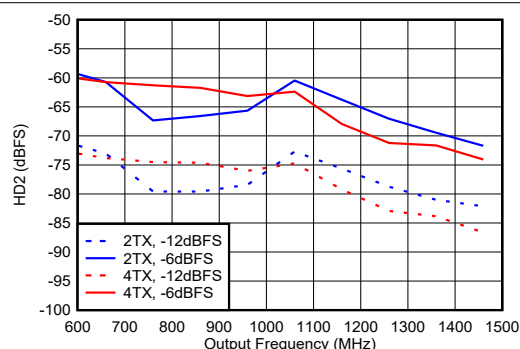
在 0.8GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-336. 0.85GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与 DSA 间的关系



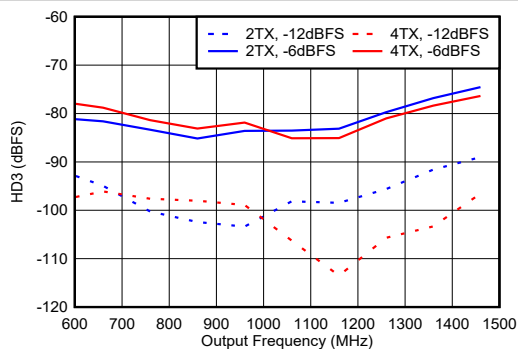
在 0.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{GSPS}$, 直接模式

图 4-337. 0.85GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系



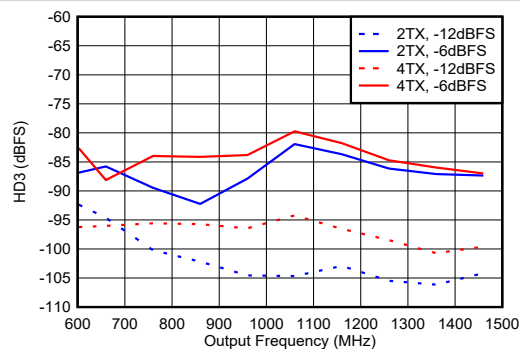
在 0.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{GSPS}$, 直接模式

图 4-338. 0.85GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系



在 0.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-339. 0.85GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系

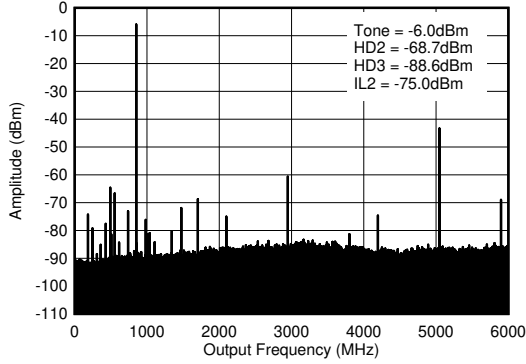


在 0.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-340. 0.85GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系

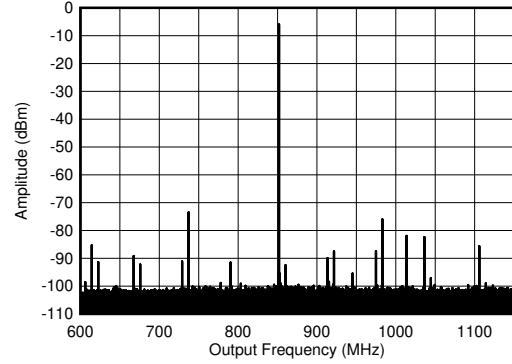
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



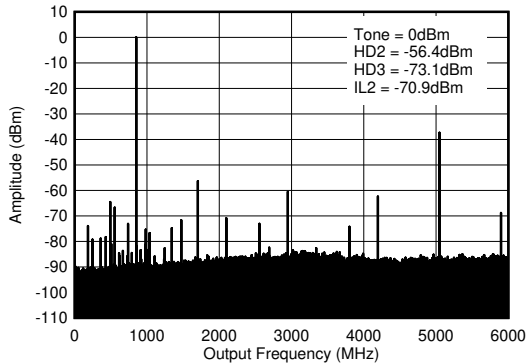
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILN = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-341. 0.85GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



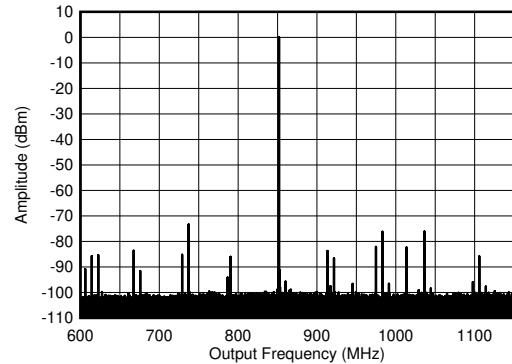
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-342. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILN = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-343. 0.85GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

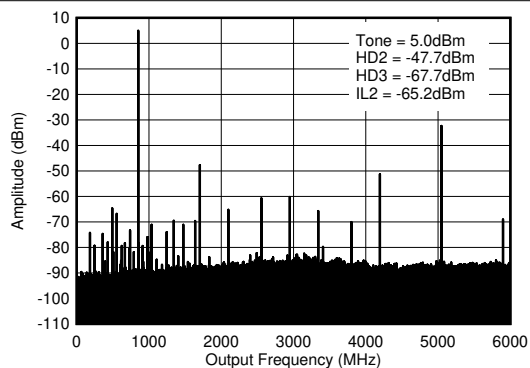


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-344. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

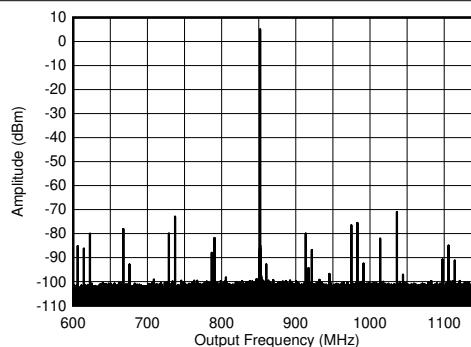
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



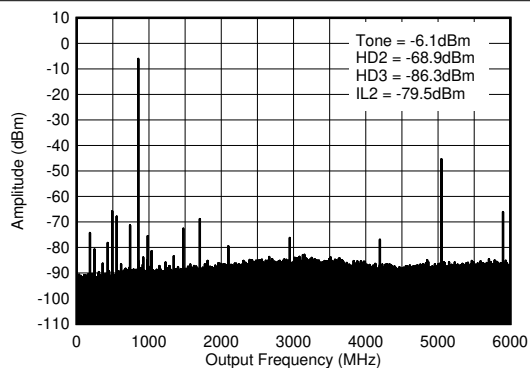
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗 $\text{ILn} = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-345. 0.85GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱



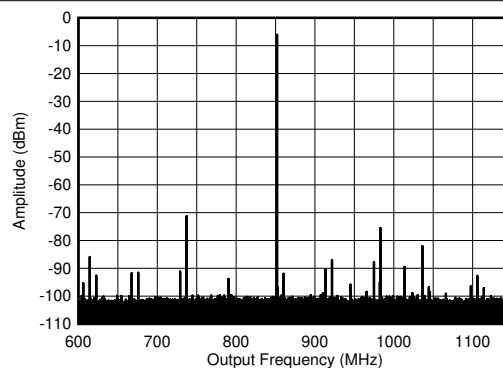
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 交错模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-346. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-347. 0.85GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

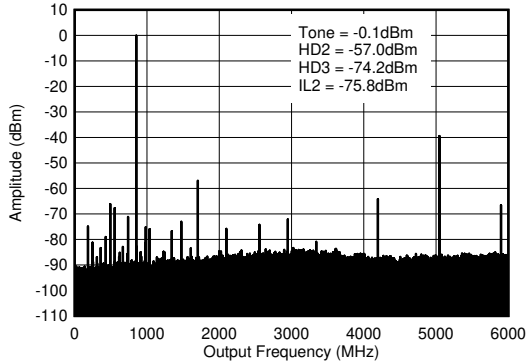


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-348. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

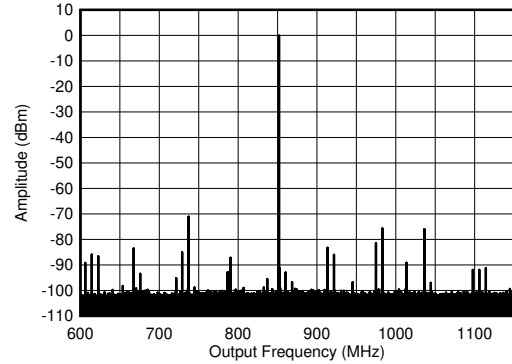
4.12.9 800MHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准。



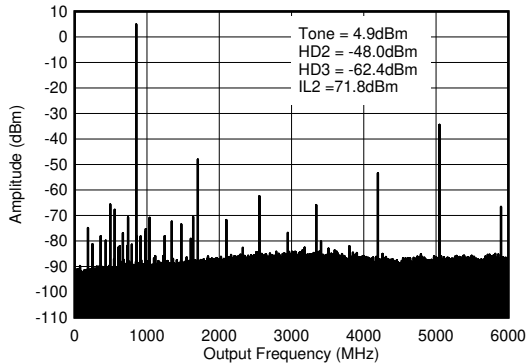
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。IL $_n = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-349. 0.85GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱



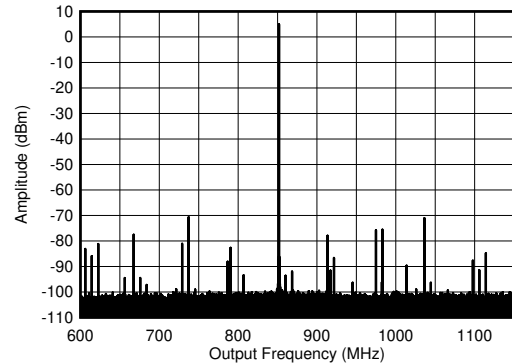
$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-350. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。IL $_n = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-351. 0.85GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱

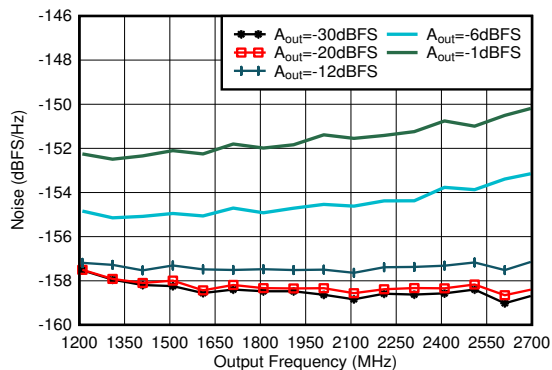


$f_{\text{DAC}} = 5898.24\text{MSPS}$, 直接模式, 0.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。

图 4-352. 0.85GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱

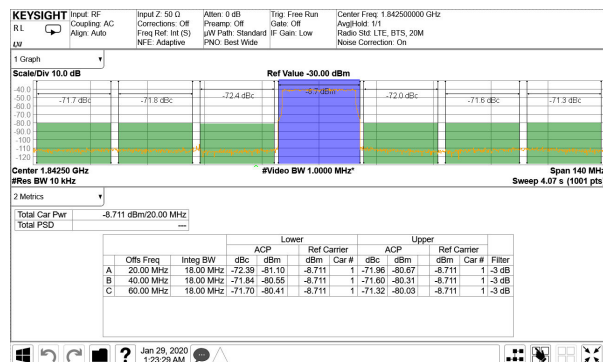
4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



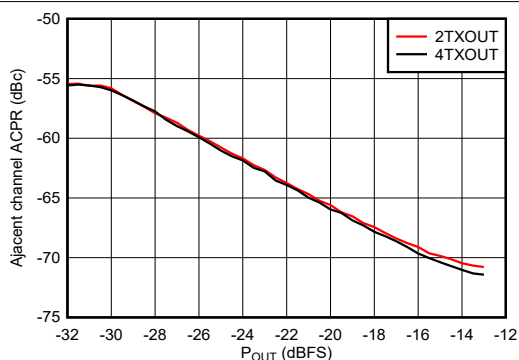
在 1.8GHz 条件下匹配, 单频, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 40MHz 偏移

图 4-353. 1.8GHz 条件下 TX 单音输出噪声与频率和振幅间的关系



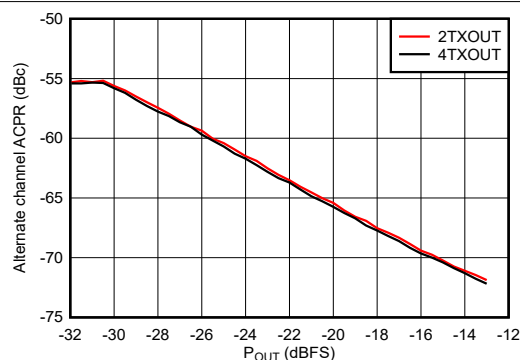
TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-354. 1.8425GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



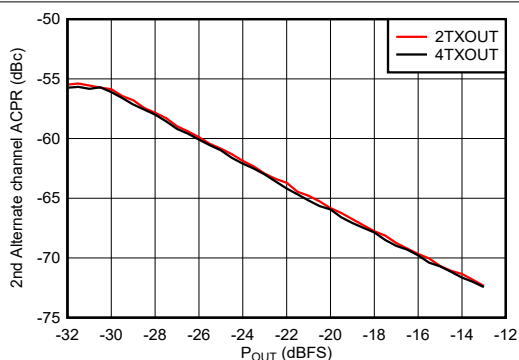
在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-355. 1.8425GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系



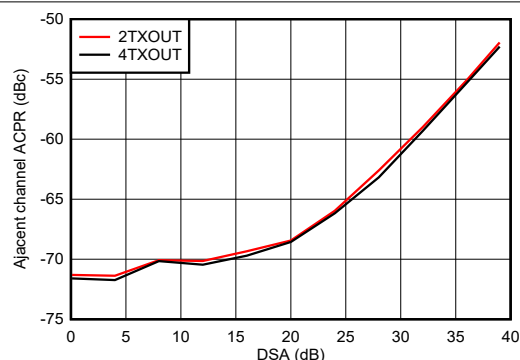
在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-356. 1.8425GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-357. 1.8425GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt2-ACPR 与数字电平间的关系

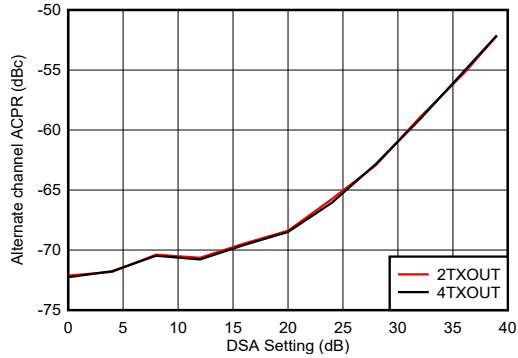


在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-358. 1.8GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系

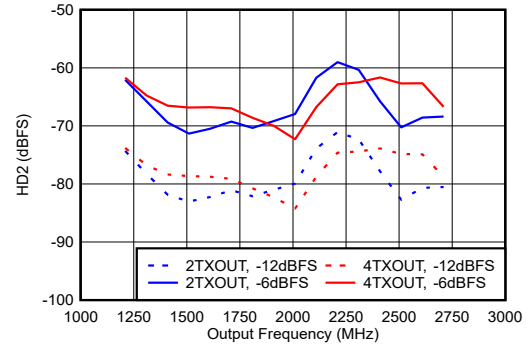
4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



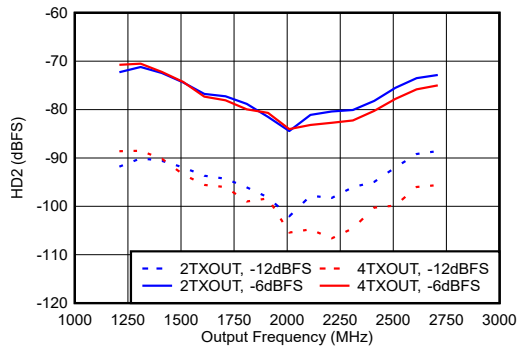
在 1.8GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-359. 1.8GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系



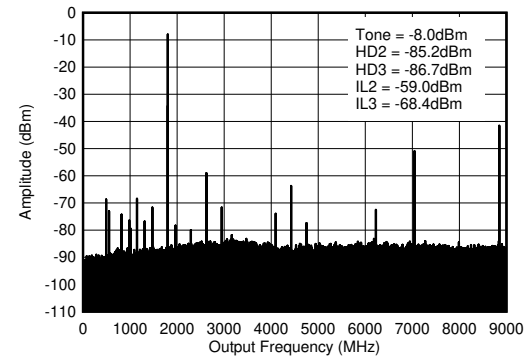
在 1.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-360. 1.8GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系



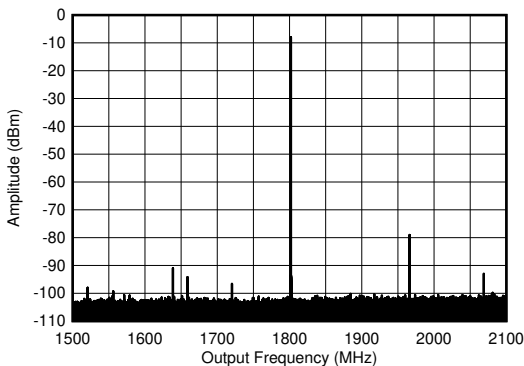
在 1.8GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-361. 1.8GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系



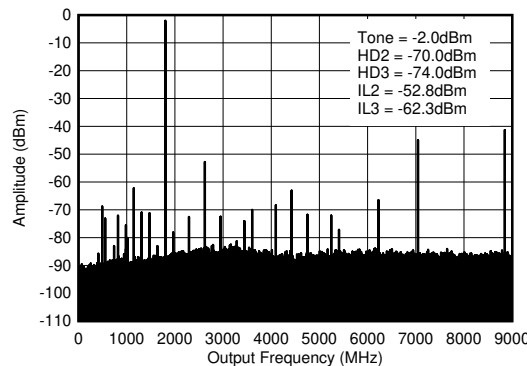
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-362. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-363. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

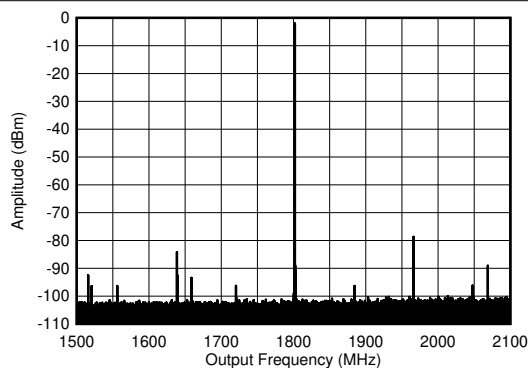


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-364. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

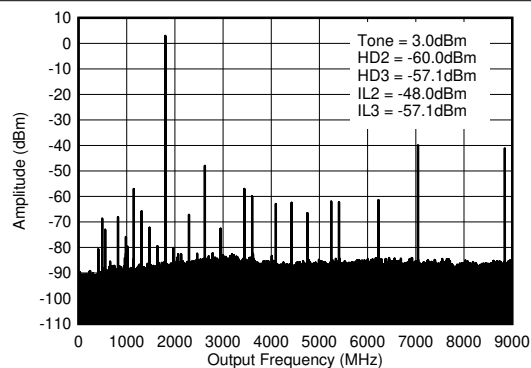
4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



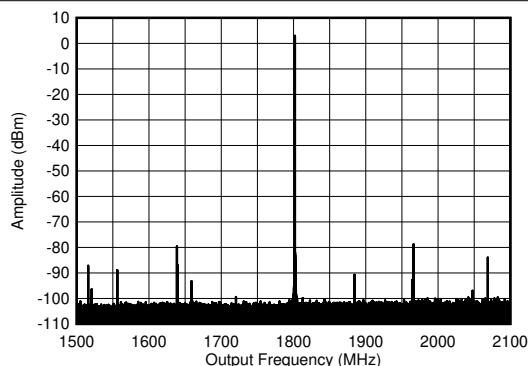
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-365. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱



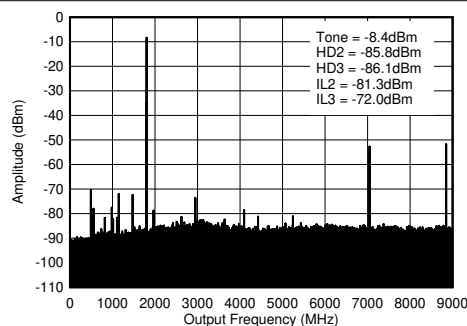
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-366. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱



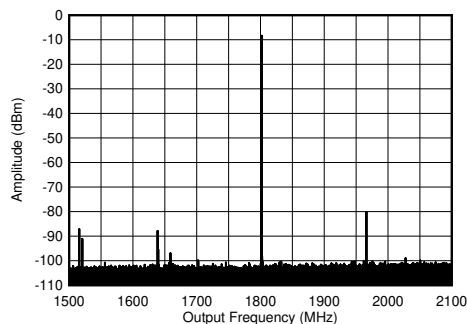
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-367. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



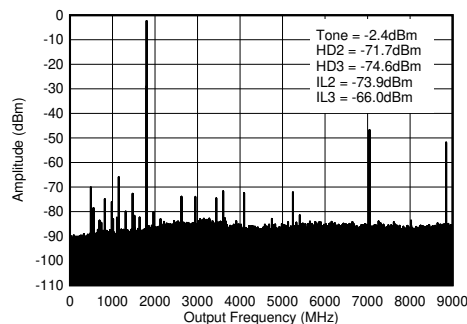
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-368. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-369. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

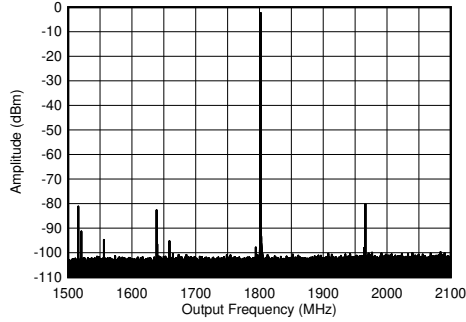


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-370. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱

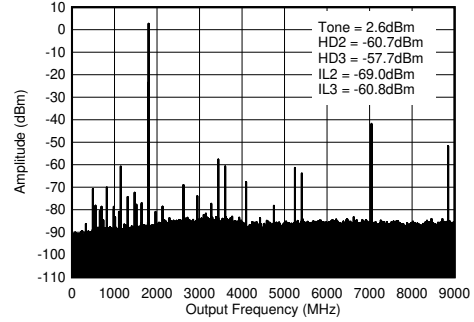
4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



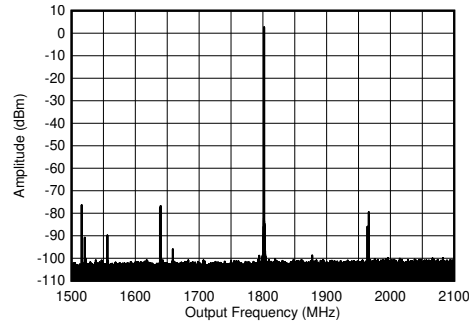
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-371. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。IL $_n = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-372. 1.8GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱

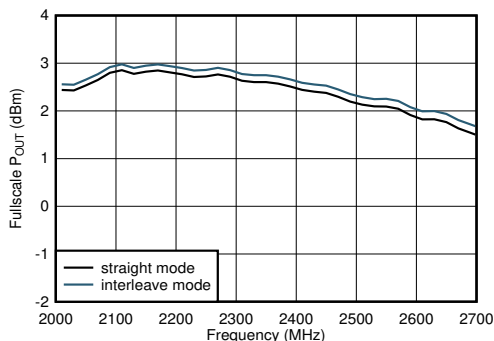


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 1.8GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-373. 1.8GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱

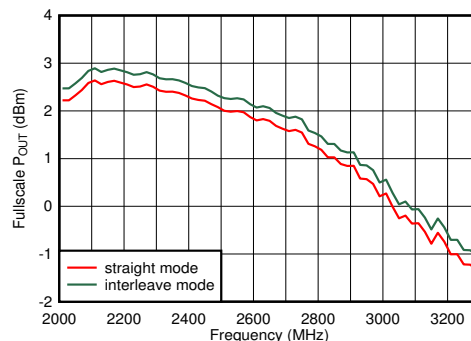
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSa} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSa 校准



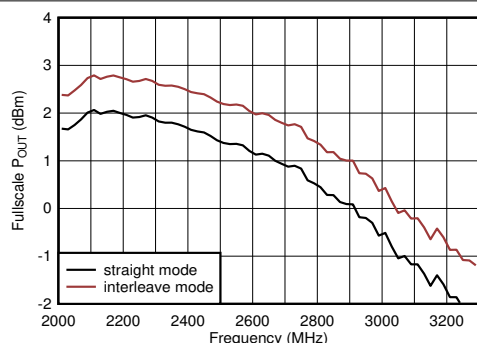
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSa} = 0$, 2.6GHz 匹配

图 4-374. 5898.24MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率间的关系



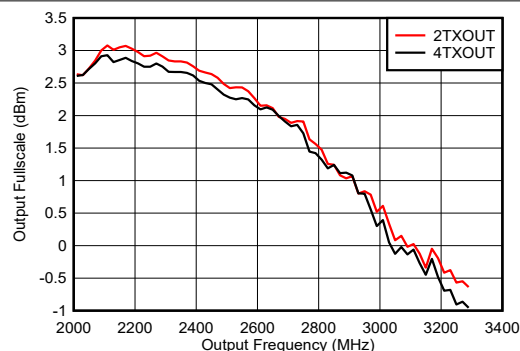
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSa} = 0$, 2.6GHz 匹配

图 4-375. 8847.36MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率间的关系



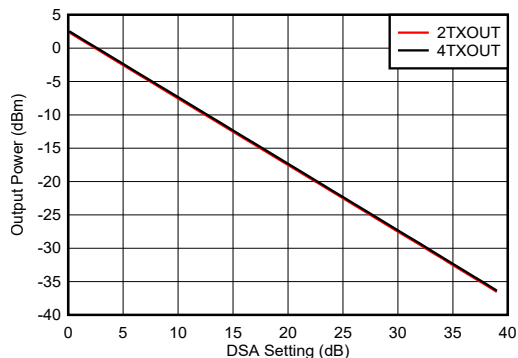
包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSa} = 0$, 2.6GHz 匹配

图 4-376. 11796.48MSPS 条件下 TX 满量程与射频频率间的关系



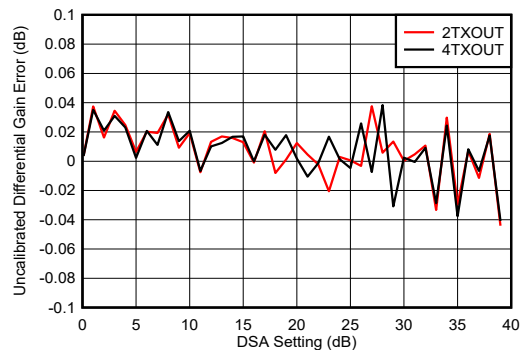
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSa} = 0$, 2.6GHz 匹配

图 4-377. TX 输出满量程与输出频率和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, 匹配 2.6GHz

图 4-378. 2.6GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系

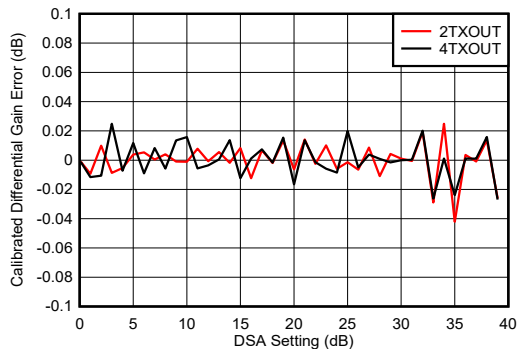


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-379. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

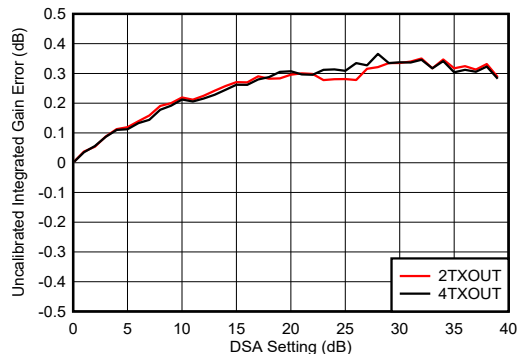
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



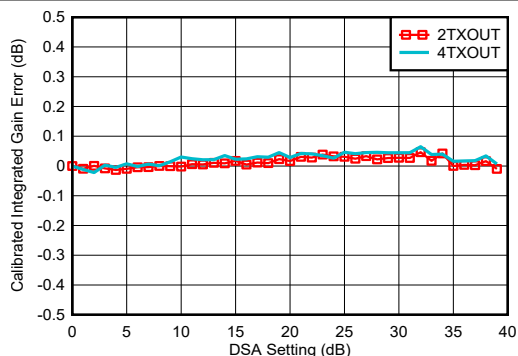
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-380. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



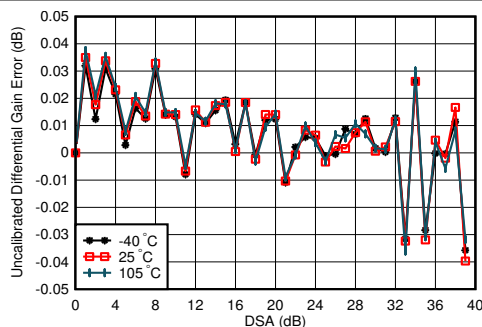
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-381. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-382. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

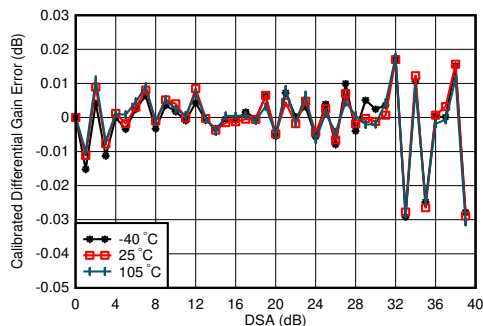


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-383. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

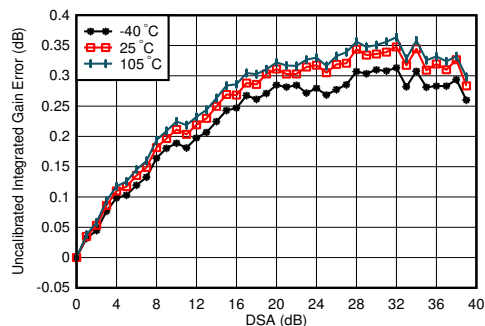
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



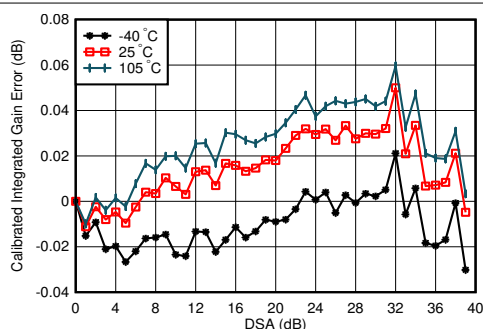
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-384. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



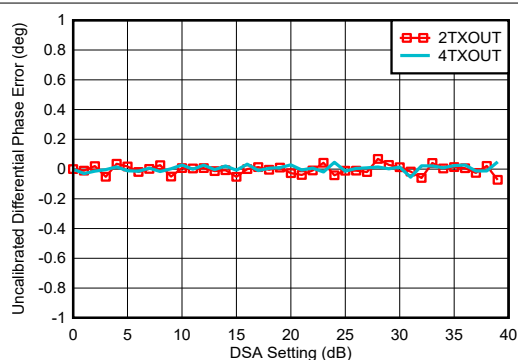
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-385. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-386. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

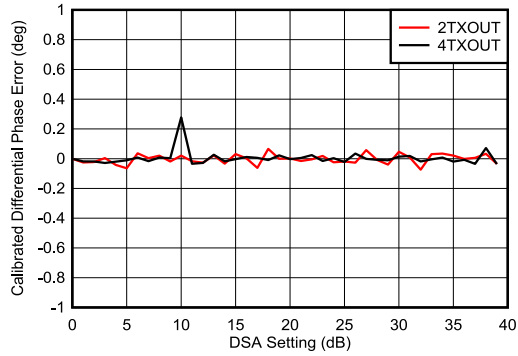


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-387. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

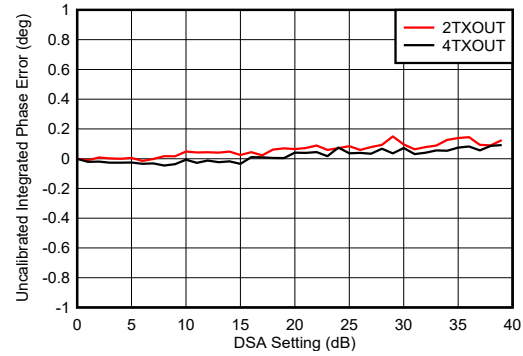
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



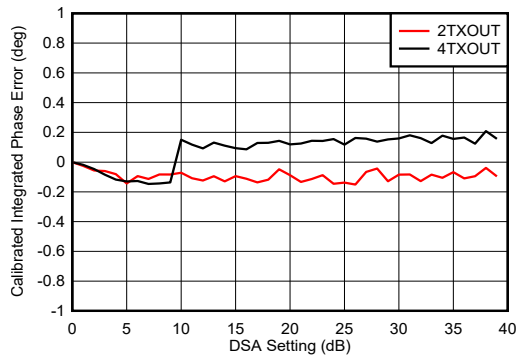
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$
任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 4-388. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



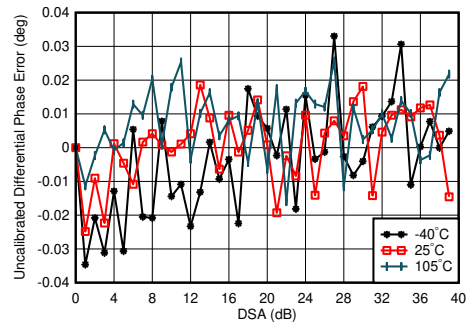
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-389. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-390. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

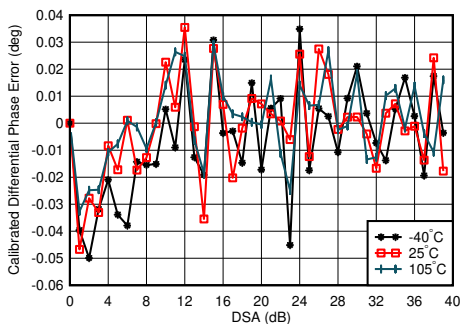


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-391. 2.6GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

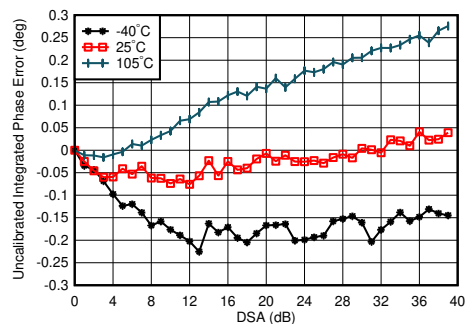
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



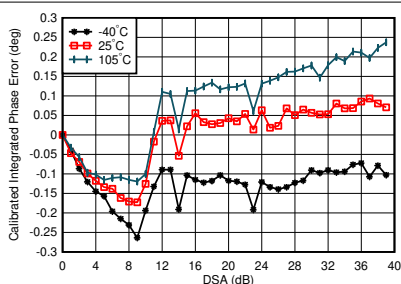
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-392. 2.6GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



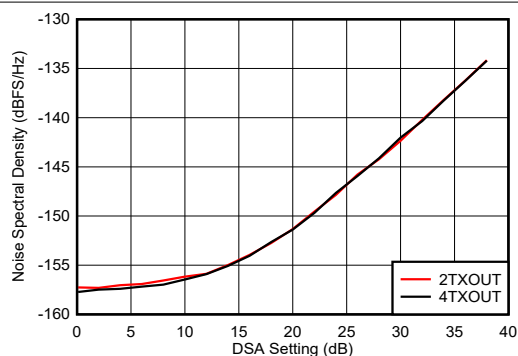
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-393. 2.6GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, 在 25°C 下, 随着 DSA 设置的变化, 通道中位数改变
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-394. 2.6GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

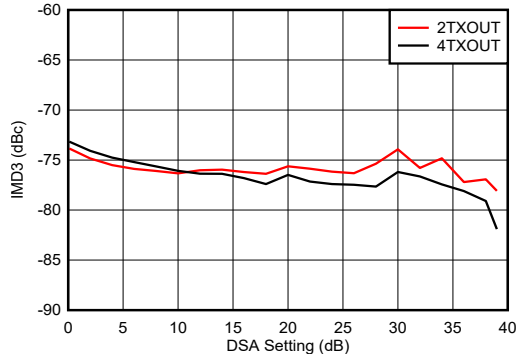


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 在 2.6GHz 条件下匹配, $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 4-395. 2.6GHz 条件下 TX 输出噪声与通道和衰减间的关系

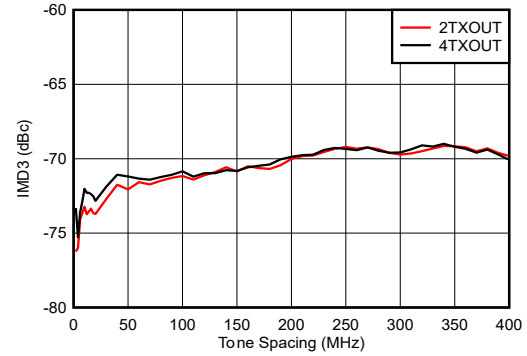
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



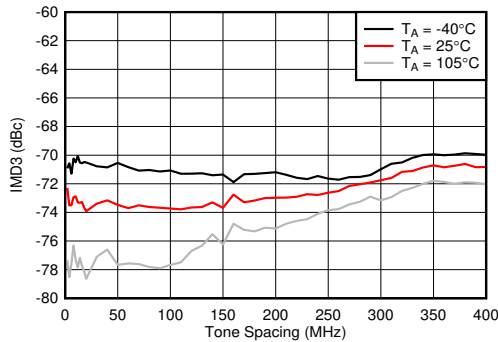
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$, 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-396. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系



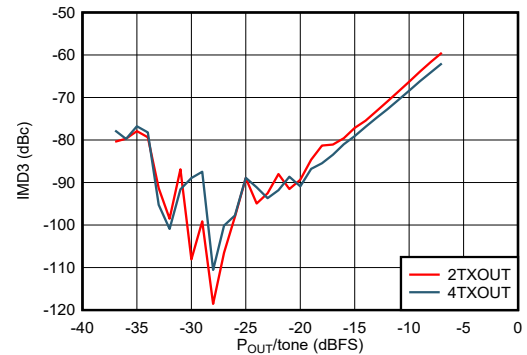
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$, 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-397. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系



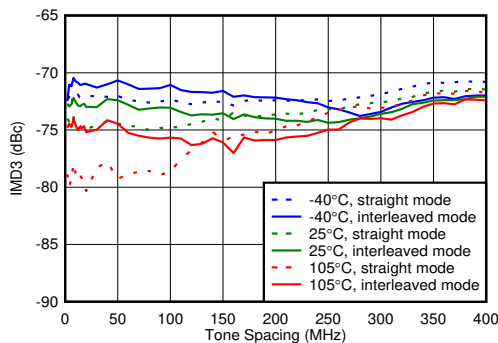
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$, 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS, 最差通道, dither = 1。

图 4-398. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



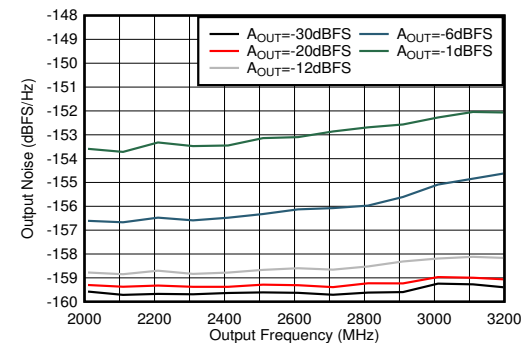
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$, $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$, dither = 1, 在 2.6GHz 条件下匹配

图 4-399. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, $f_{\text{CENTER}} = 2.6\text{GHz}$, 在 2.6GHz 条件下匹配, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-400. TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系

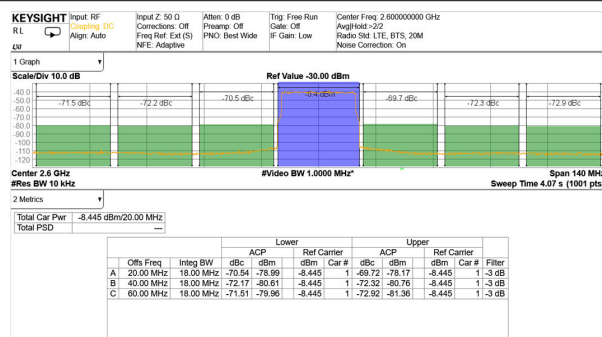


在 2.6GHz 条件下匹配, 单频, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 40MHz 偏移

图 4-401. 2.6GHz 条件下 TX 单音输出噪声与频率和振幅间的关系

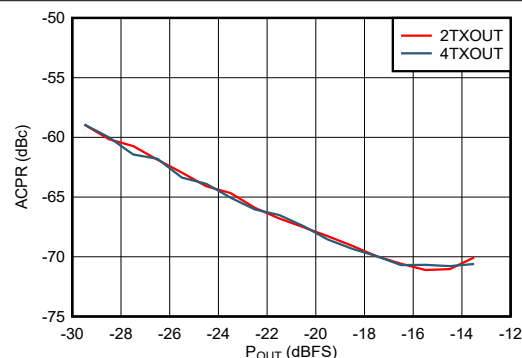
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



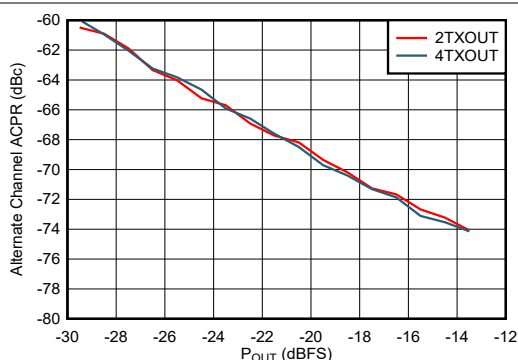
TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-402. 2.6GHz (频带 41) 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



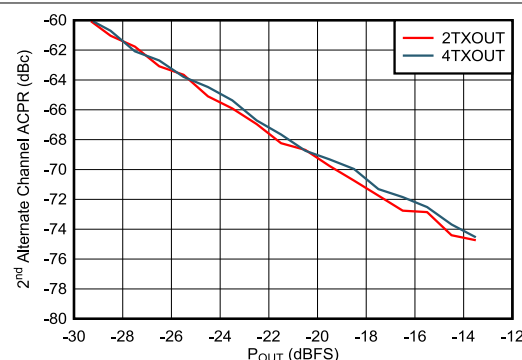
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-403. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系



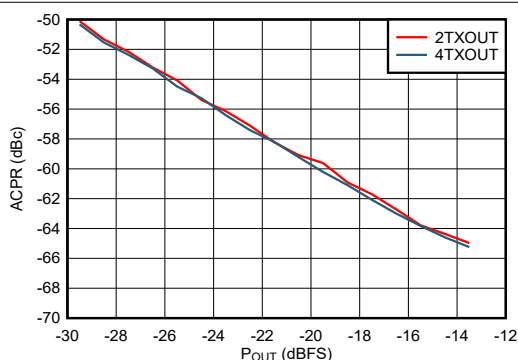
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-404. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



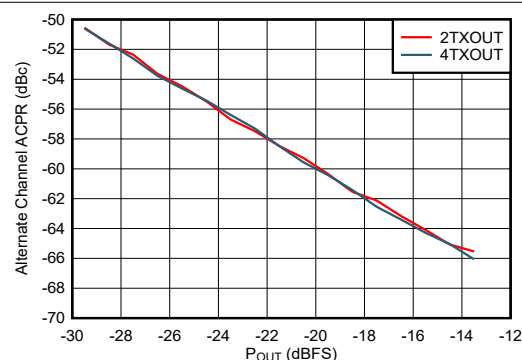
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-405. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt2-ACPR 与数字电平间的关系



在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-406. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与数字电平间的关系

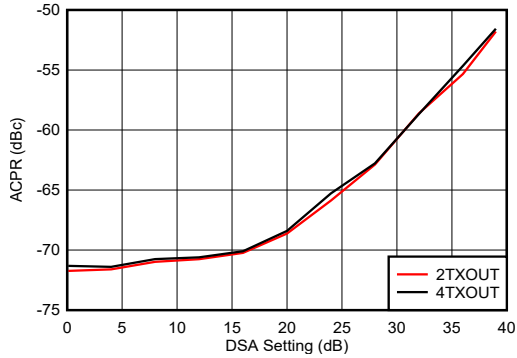


在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-407. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与数字电平间的关系

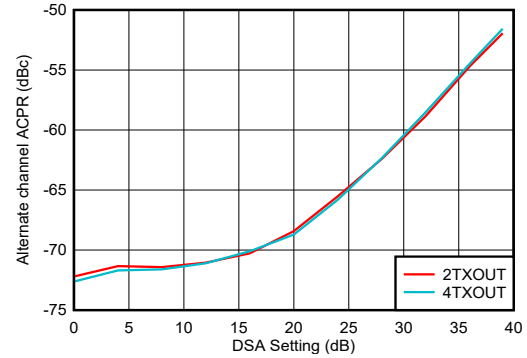
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



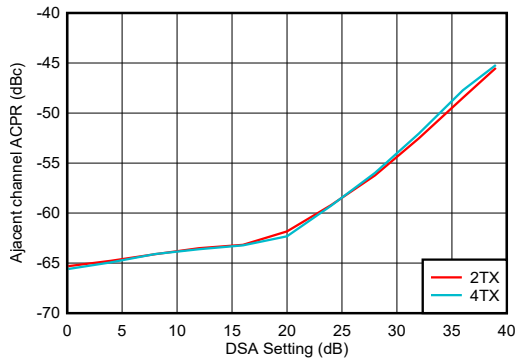
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-408. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系



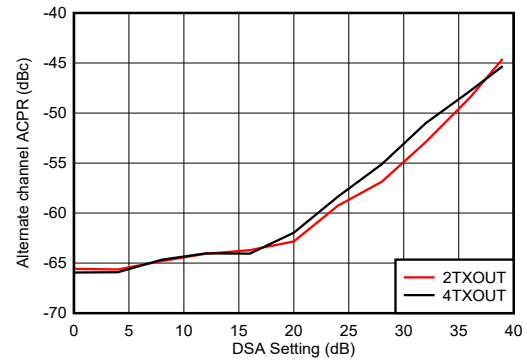
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-409. 2.6GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系



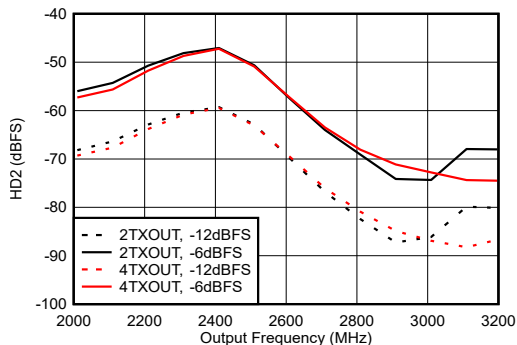
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-410. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与 DSA 间的关系



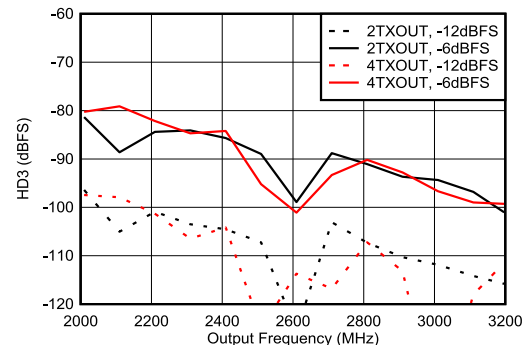
在 2.6GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-411. 2.6GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与 DSA 间的关系



在 2.6 GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-412. 2.6GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系

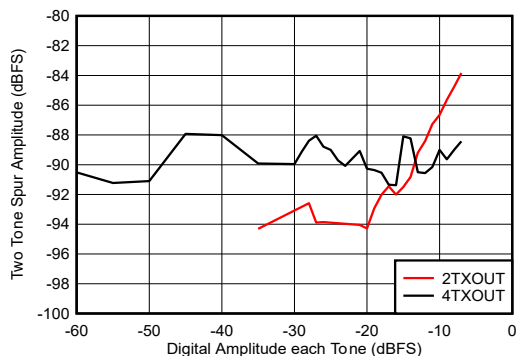


在 2.6 GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-413. 2.6GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系

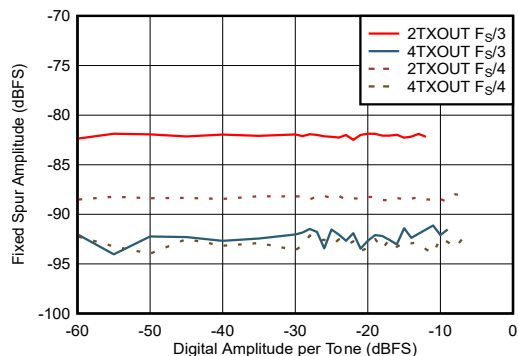
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



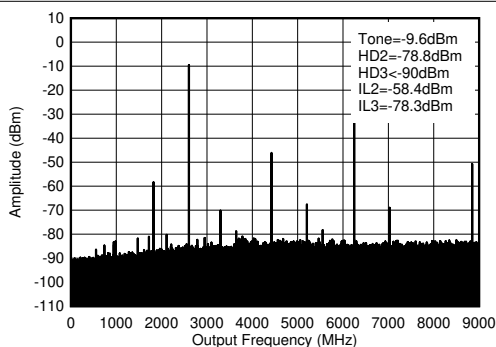
带内 = $2600\text{MHz} \pm 600\text{MHz}$, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 不包括 $F_s/3$ 和 $F_s/4$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-414. 2.6GHz 条件下双频带内 SFDR 与数字振幅间的关系



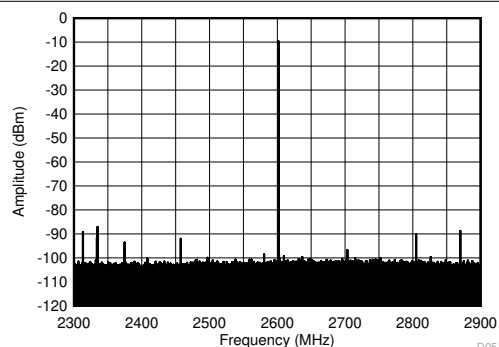
带内 = $2600\text{MHz} \pm 600\text{MHz}$, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-415. 2.6GHz 条件下双频带内固定杂散与数字振幅间的关系



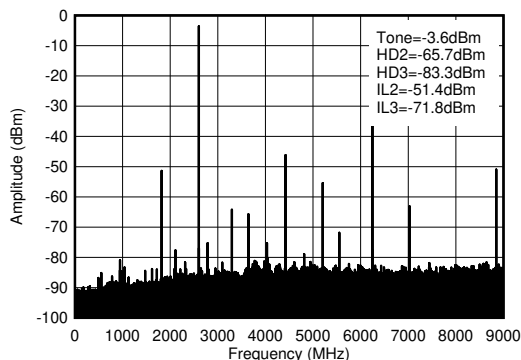
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-416. 2.6GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



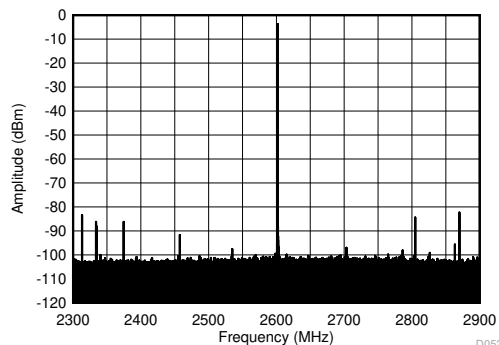
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-417. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-418. 2.6GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱

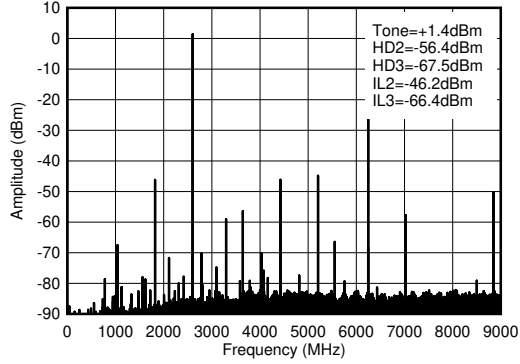


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-419. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

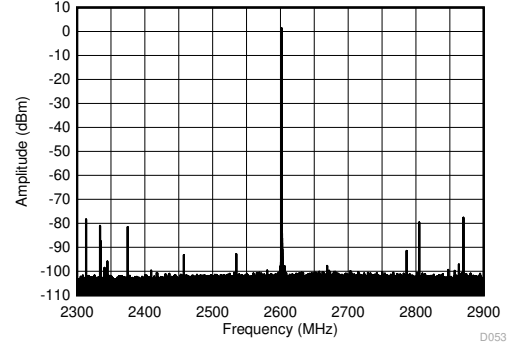
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



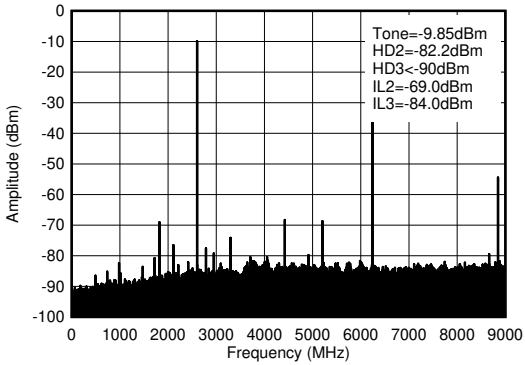
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。IL $_n = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$ 。

图 4-420. 2.6GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱



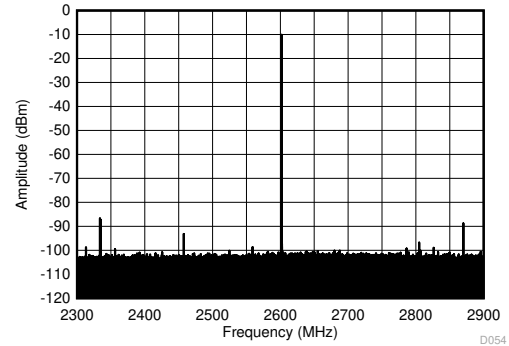
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-421. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。IL $_n = f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-422. 2.6GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

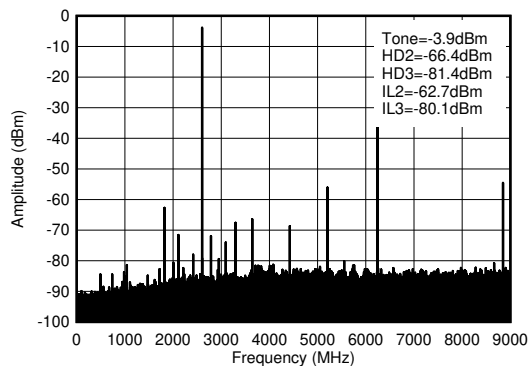


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-423. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

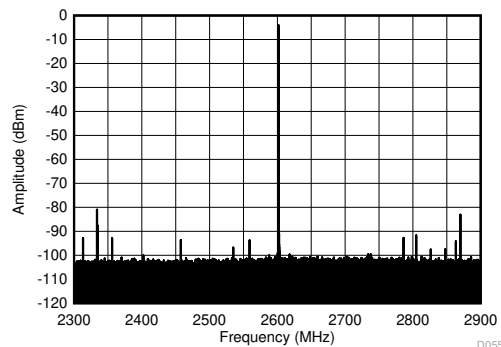
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



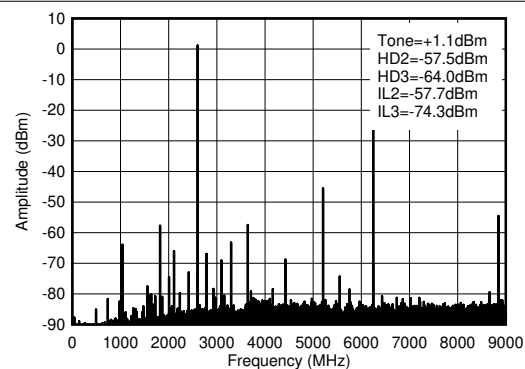
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-424. 2.6GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱



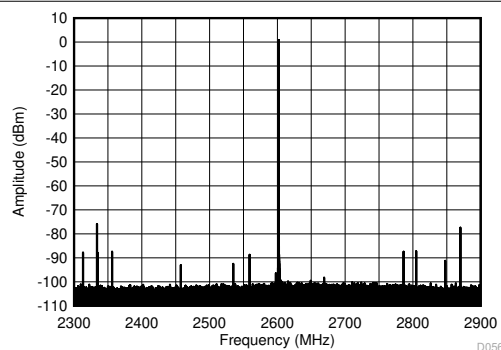
$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-425. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗。ILn = $f_s/n \pm f_{\text{OUT}}$, 并且是由于与数字时钟混合而导致此结果。

图 4-426. 2.6GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱

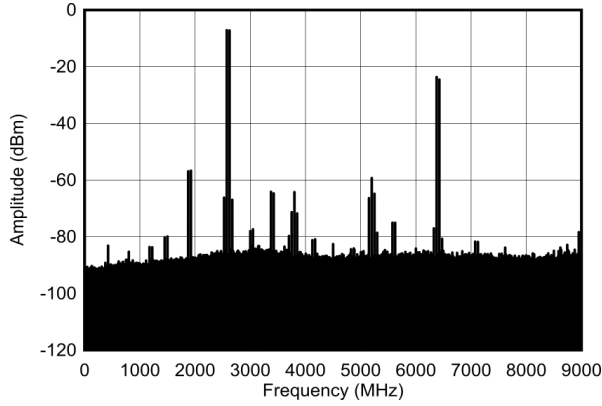


$f_{\text{DAC}} = 8847.36\text{MSPS}$, 直接模式, 2.6GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-427. 2.6GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱

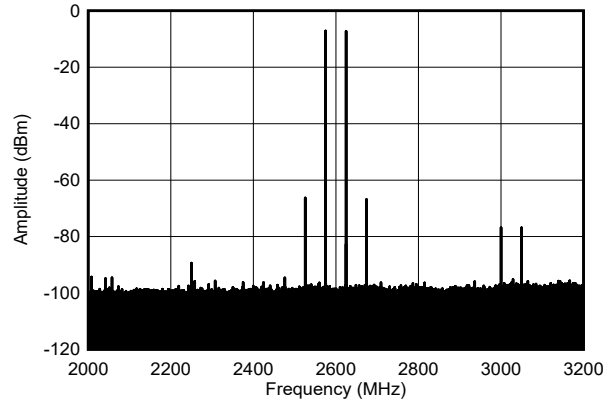
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



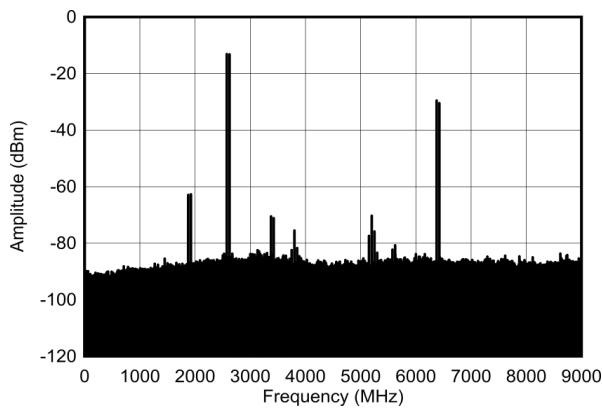
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-428. 2.6GHz、单音幅值为 -7dBFS (0 - f_{DAC}) 条件下的 TX 双音输出频谱



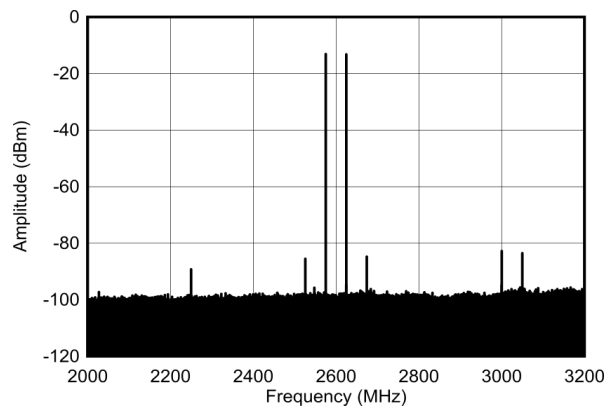
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-429. 2.6GHz、单音幅值为 -7dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-430. 2.6GHz、单音幅值为 -13dBFS (0 - f_{DAC}) 条件下的 TX 双音输出频谱

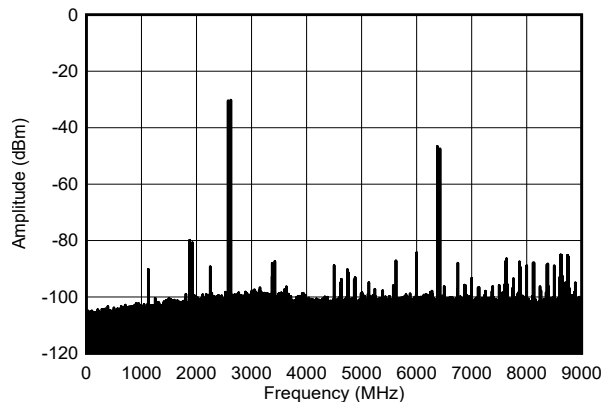


$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-431. 2.6GHz、单音幅值为 -13dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱

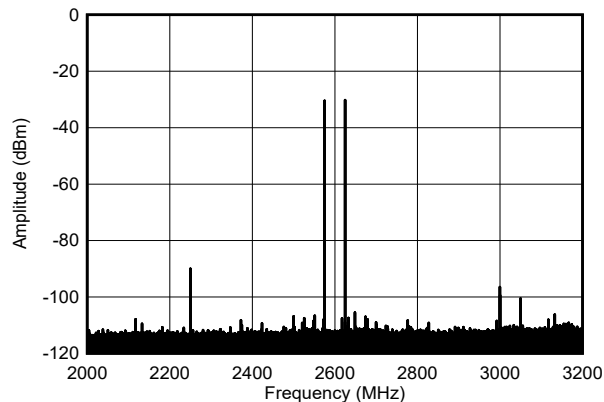
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



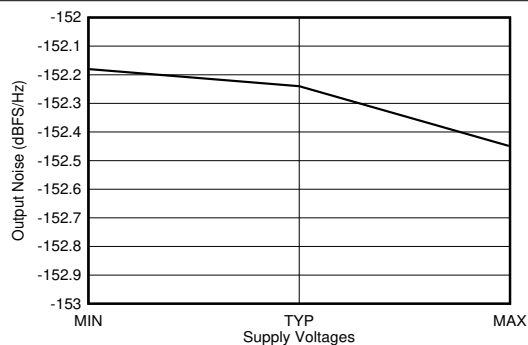
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-432. 2.6GHz、单音幅值为 -30dBFS ($0 - f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



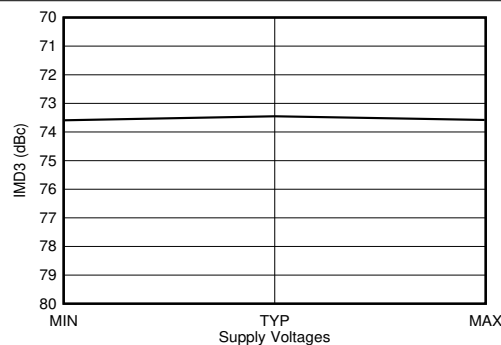
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-433. 2.6GHz、单音幅值为 -30dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



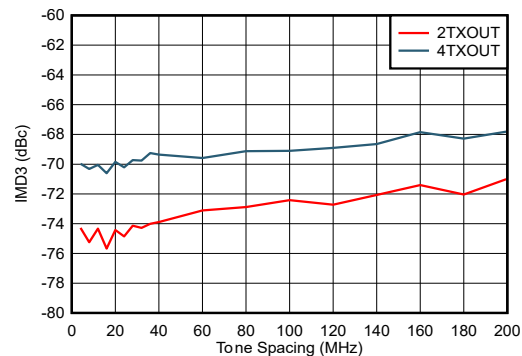
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配。偏移频率为 40MHz。输出功率 = -1dBFS。所有电源同时处于 MIN、TYP 或 MAX 电压。

图 4-434. 2.6GHz 条件下 TX 输出噪声与电源电压间的关系



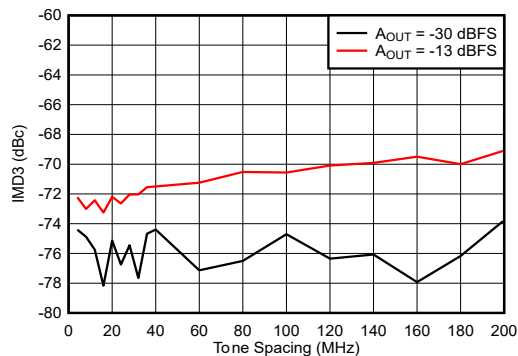
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 2.6GHz 匹配。偏移频率为 40MHz。输出功率 = -13dBFS。所有电源同时处于 MIN、TYP 或 MAX 电压。

图 4-435. 2.6GHz 条件下 TX IMD3 与电源电压间的关系



$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式

图 4-436. 2.6GHz 条件下 IMD3 与频率间隔和通道间的关系

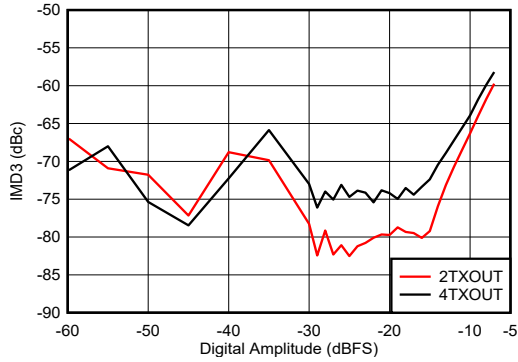


$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式

图 4-437. 2.6GHz 条件下 IMD3 与频率间隔和振幅间的关系

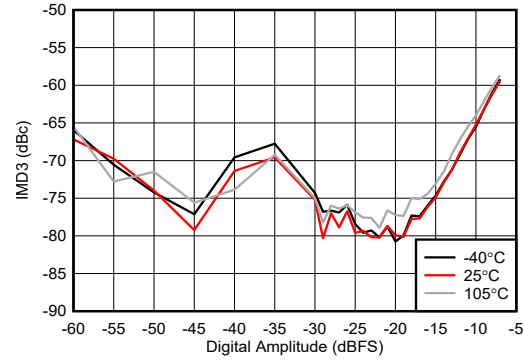
4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS, $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第一奈奎斯特区域输出, 内部 PLL, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 24 倍插值, $\text{DSA} = 0\text{dB}$, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准



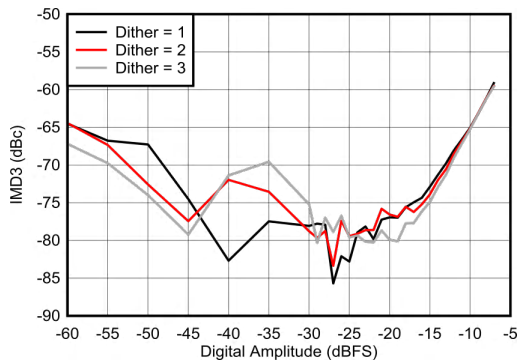
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式

图 4-438. 2.6GHz 条件下 IMD3 与数字振幅和通道间的关系



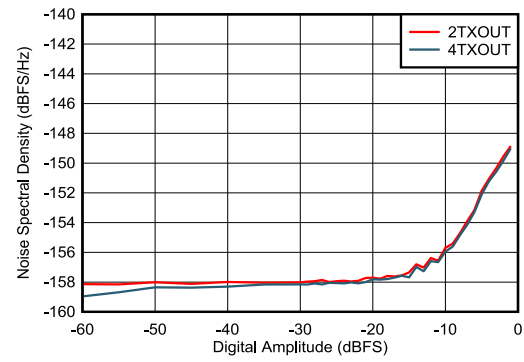
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式

图 4-439. 2.6GHz 条件下 IMD3 与数字振幅和温度间的关系



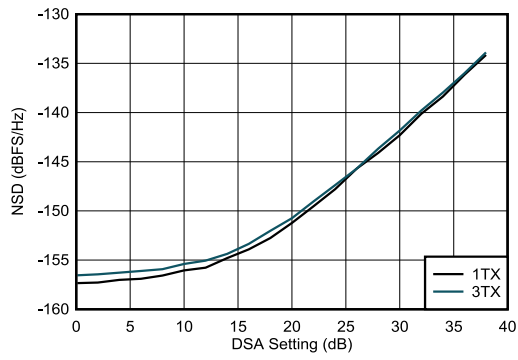
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式

图 4-440. 2.6GHz 条件下 IMD3 与数字振幅和抖动间的关系



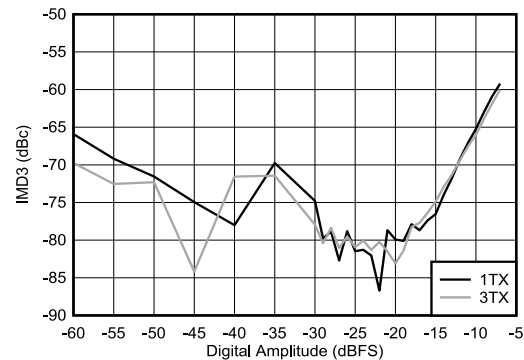
$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式, 50MHz 偏移

图 4-441. 2.6GHz 条件下 NSD 与数字振幅和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, 外部时钟模式, 50MHz 偏移

图 4-442. 2.6GHz 条件下 NSD 与数字振幅和温度间的关系

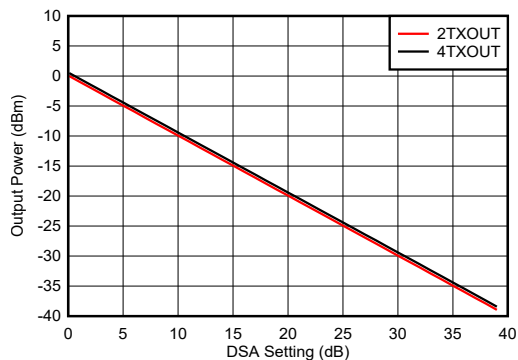


$f_{\text{DAC}} = f_{\text{CLK}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式

图 4-443. 2.6GHz 条件下的外部时钟附加相位噪声

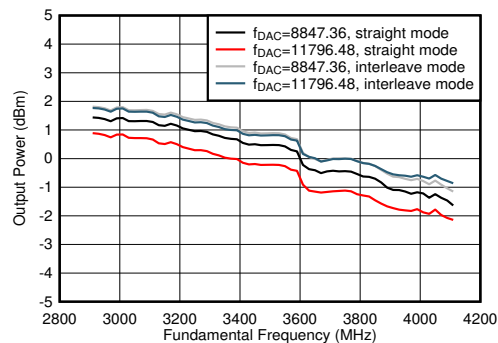
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



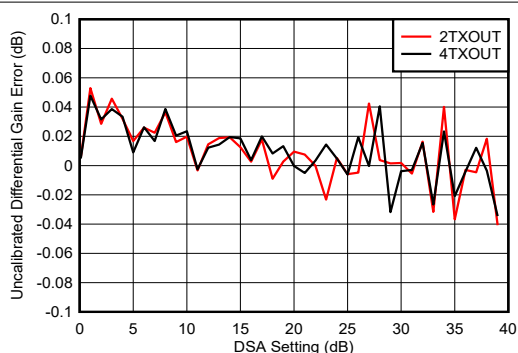
$A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, 3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-444. 3.5GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置间的关系



$A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, 3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

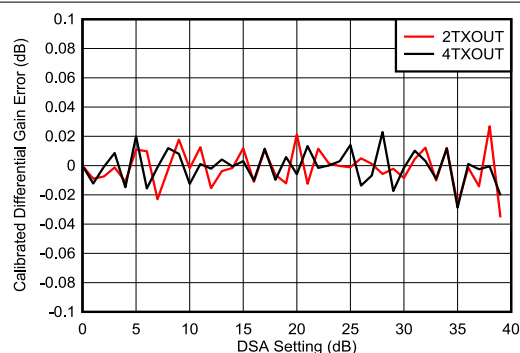
图 4-445. TX 输出功率与频率间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-446. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



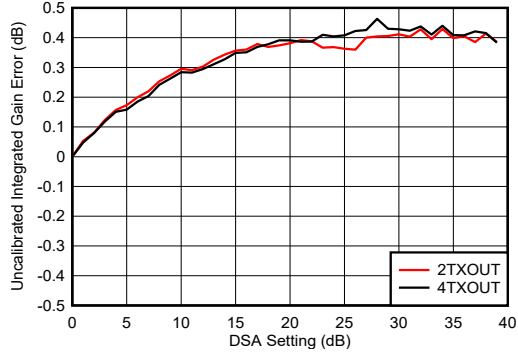
3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-447. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

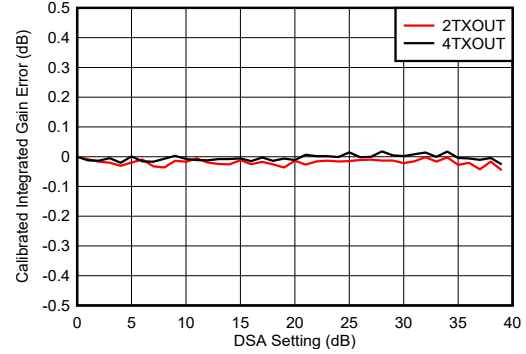
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

$$\text{积分增益误差} = P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

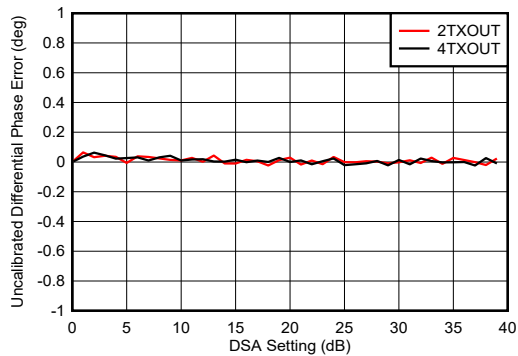
图 4-448. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

$$\text{积分增益误差} = P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$$

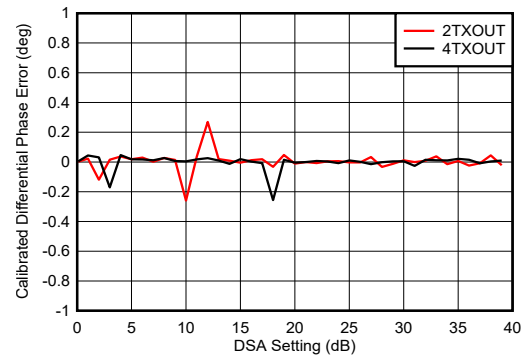
图 4-449. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$$

图 4-450. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



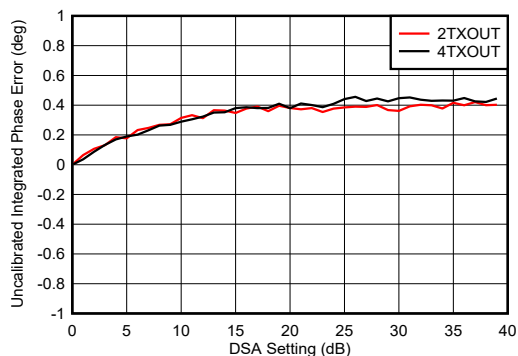
3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

$$\text{差分相位误差} = \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})。任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。$$

图 4-451. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

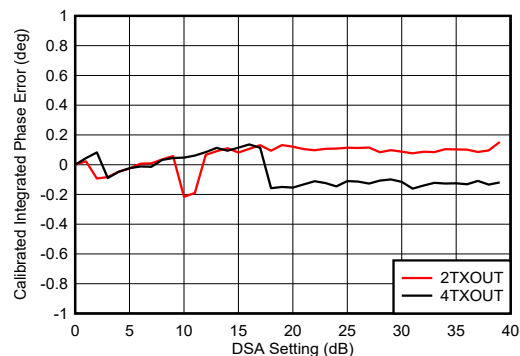
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

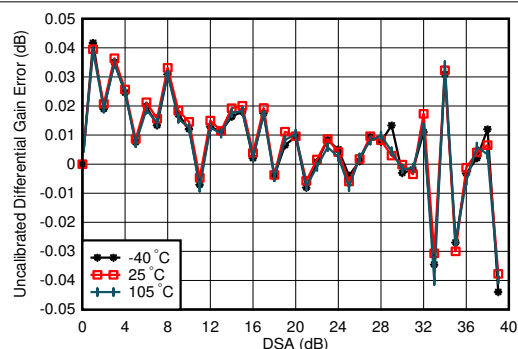
图 4-452. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

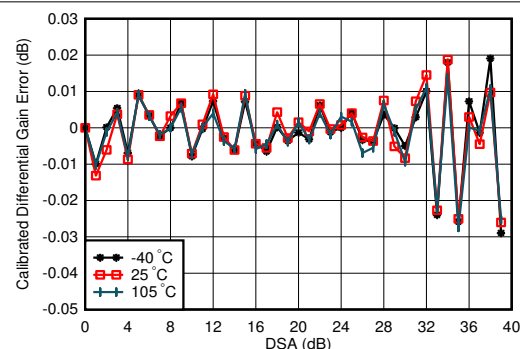
图 4-453. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-454. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



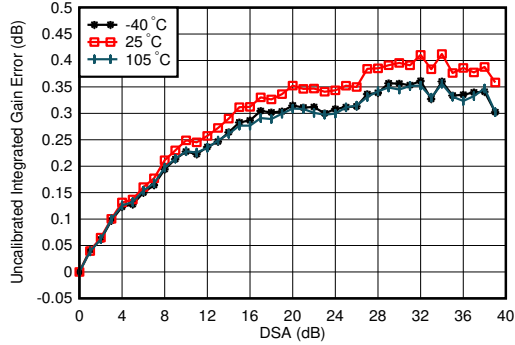
3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-455. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

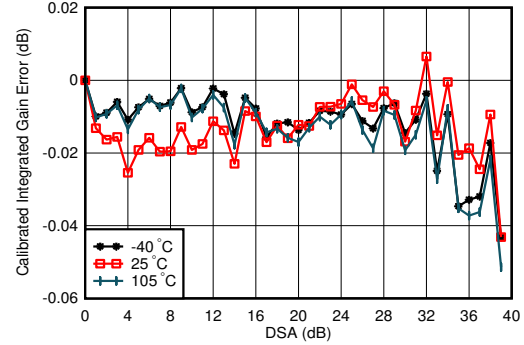
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



3.5GHz 匹配, 1TX

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

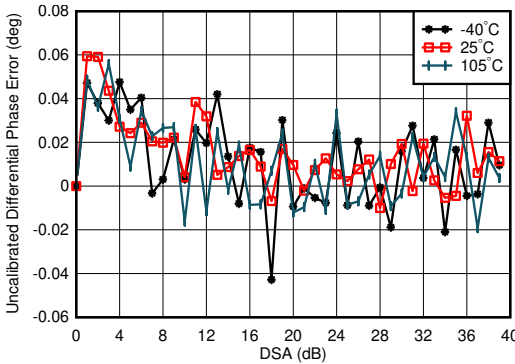
图 4-456. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

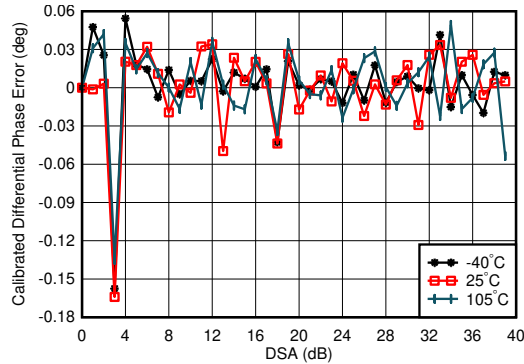
图 4-457. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-458. 3.5GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



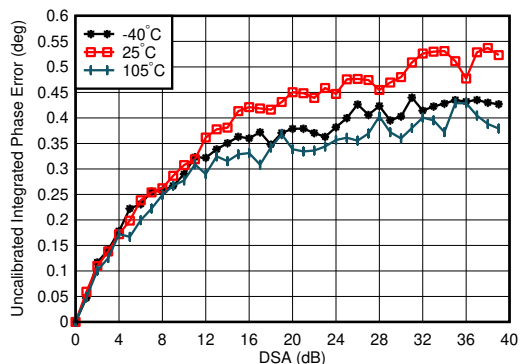
3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-459. 3.5GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

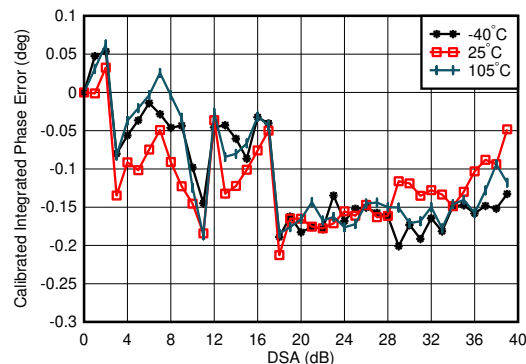
$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



3.5GHz 匹配, 1TX

积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

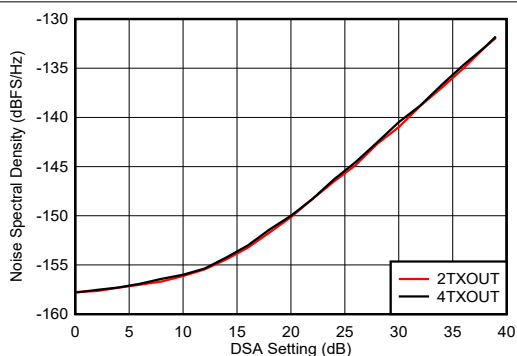
图 4-460. 3.5GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



3.5GHz 匹配, 1TX, 在 25°C 下校准

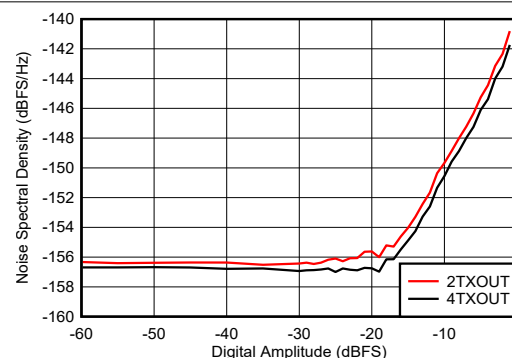
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-461. 3.5GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



A. $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 3.5 GHz 条件下匹配, $A_{\text{out}} = -13\text{dBFS}$ 。

图 4-462. 3.5 GHz 条件下 TX NSD 与 DSA 设置间的关系

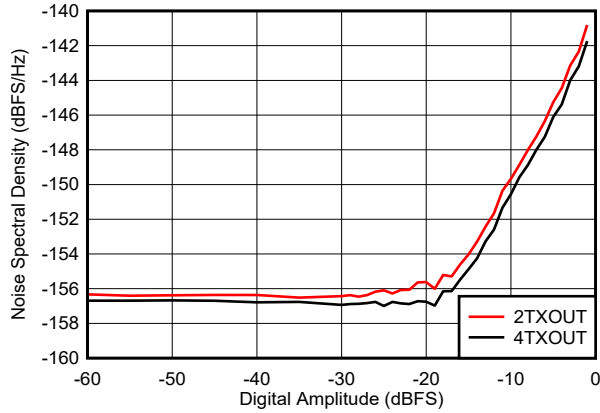


A. $f_{\text{DAC}} = 12\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-463. 3.75GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅和温度间的关系

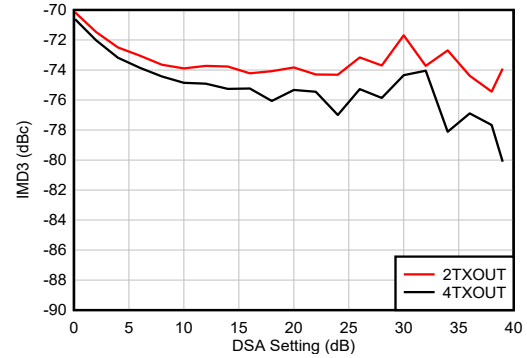
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



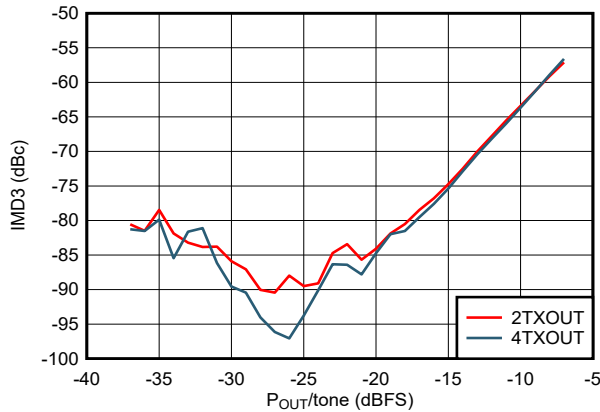
A. $f_{\text{DAC}} = 12\text{MSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-464. 3.75GHz 条件下 TX NSD 与数字振幅和通道间的关系



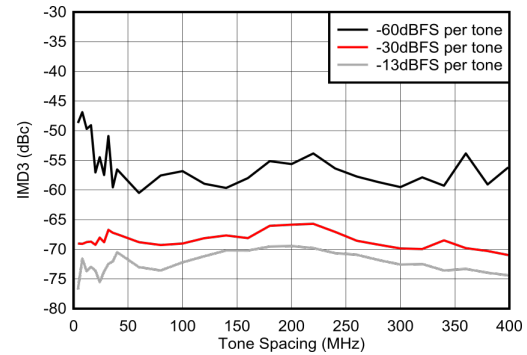
20MHz 频率间隔, 3.5GHz 匹配, 单音幅度为 -13dBFS , 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-465. 3.5GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系



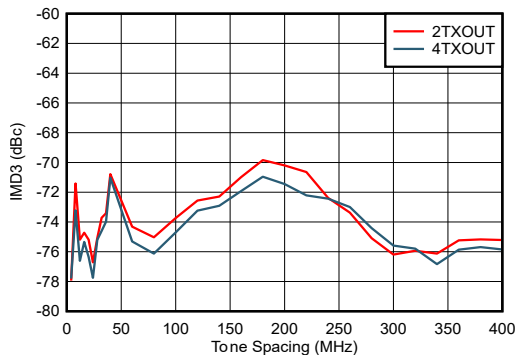
20MHz 频率间隔, 3.5GHz 匹配

图 4-466. 3.5GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅和通道间的关系



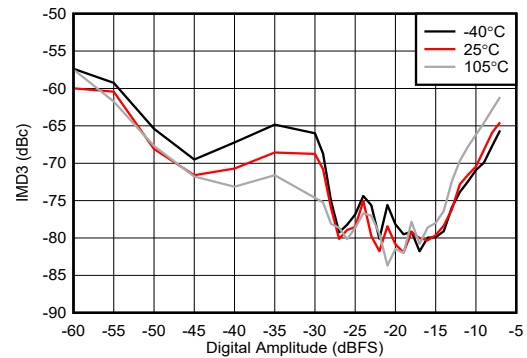
50MHz 频率间隔, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-467. 3.75GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和振幅间的关系



50MHz 频率间隔, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-468. 3.75GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系

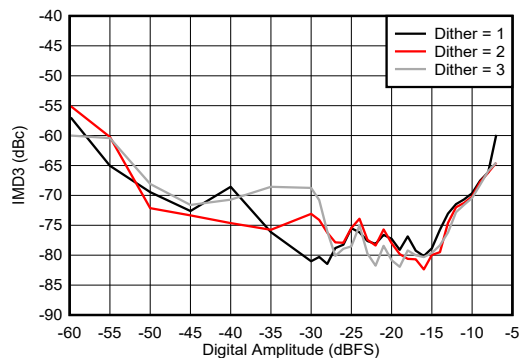


50MHz 频率间隔, 外部时钟模式, 非交错模式

图 4-469. 3.75GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅和温度间的关系

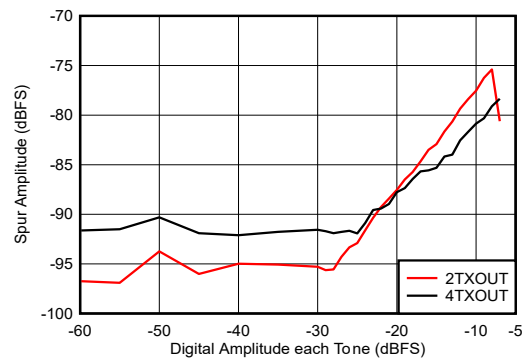
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

T_A = +25°C 时的典型值，使用标称电源。除非另有说明，否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、f_{DAC} = 11796.48MSPS、交错模式、A_{OUT} = -1dBFS、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、f_{REF} = 491.52MSPS、24 倍插值、DSA = 0dB、Sin(x)/x 启用和 DSA 校准



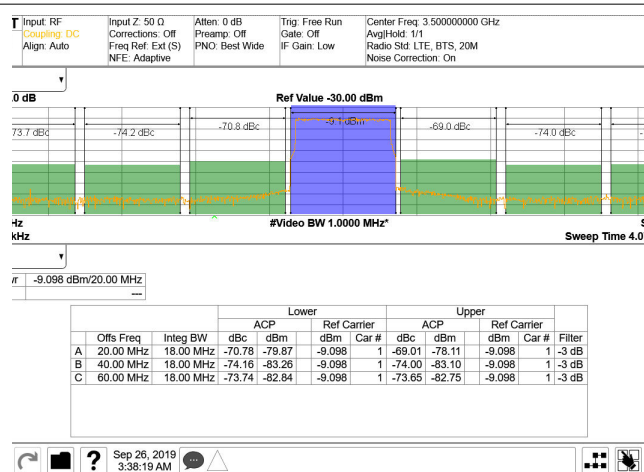
50MHz 频率间隔，外部时钟模式，非交错模式

图 4-470. 3.75GHz 条件下 TX IMD3 与数字振幅和抖动间的关系



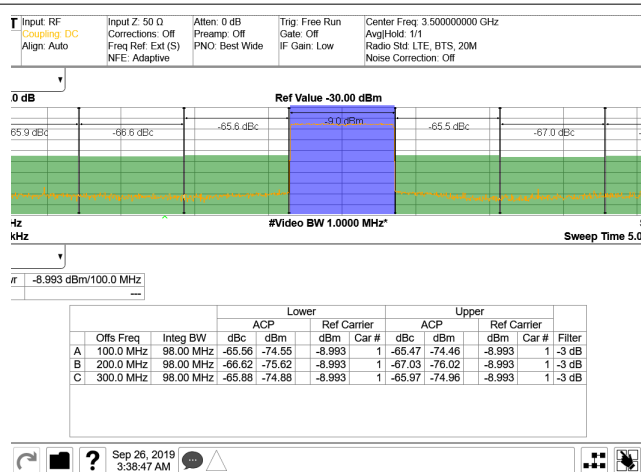
帶內 = 3.75GHz ± 600MHz, $f_{DAC} = 9\text{GSPS}$, 外部时钟模式, 非交错模式。

图 4-471. 3.75GHz 条件下双频带内 SFDR 与数字振幅间的关系



3.5GHz 匹配，单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-472. 3.5GHz (频带 42) 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



3.5GHz 匹配，单载波 100MHz BW NR TM1.1

图 4-473. 3.5GHz (频带 42) 条件下的 TX 100MHz NR 输出频谱

4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准

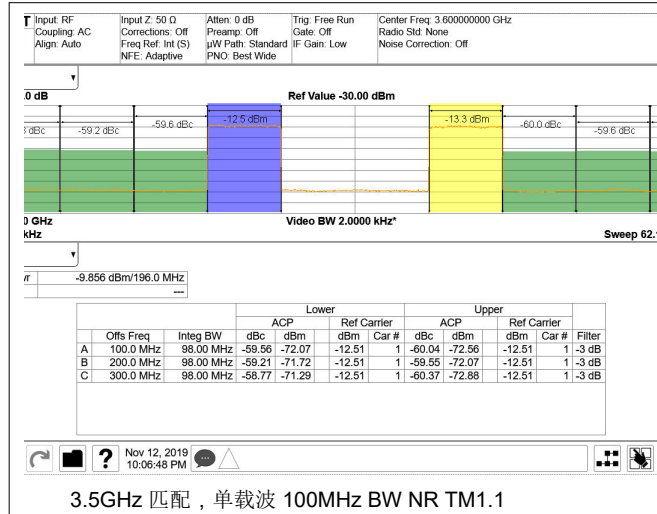


图 4-474. 3.45GHz 和 3.75GHz 条件下的 TX 2 载波 100MHz NR 输出频谱

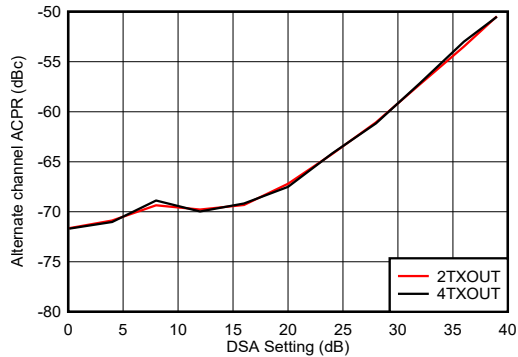


图 4-476. 3.5GHz 条件下的 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 设置间的关系

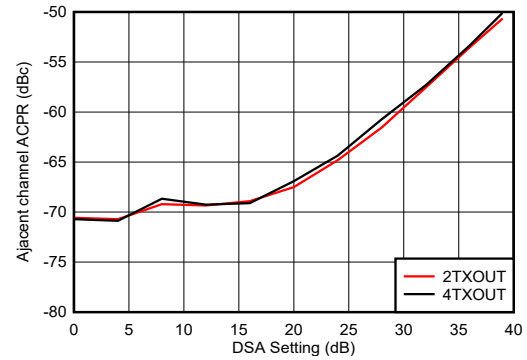


图 4-475. 3.5GHz 条件下的 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 设置间的关系

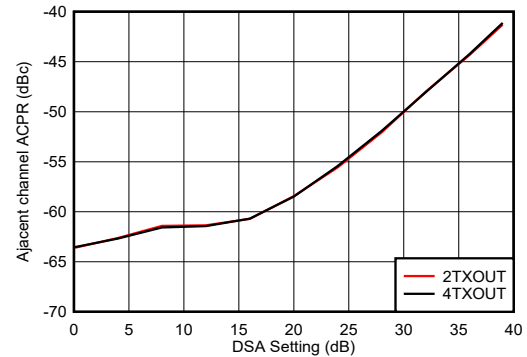
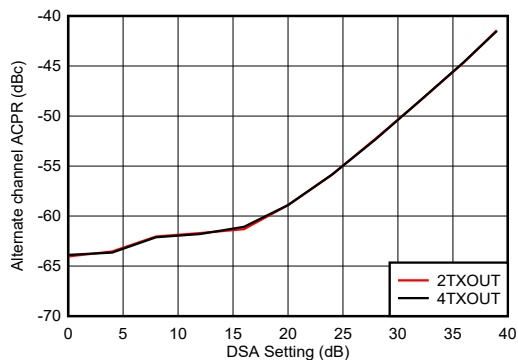


图 4-477. 3.5GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与 DSA 设置间的关系

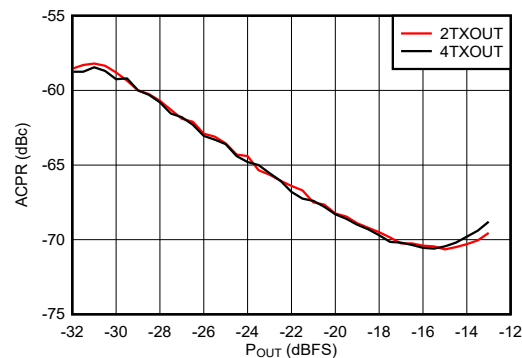
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



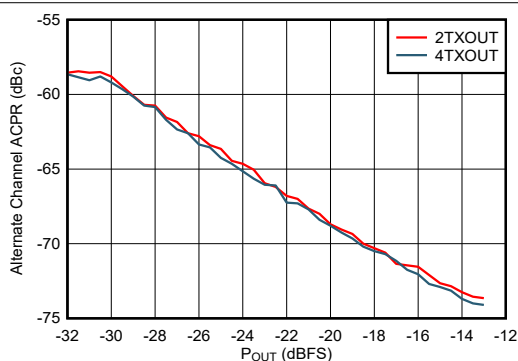
3.5GHz 匹配, 单载波 100MHz BW NR TM1.1

图 4-478. 3.5GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与 DSA 设置间的关系



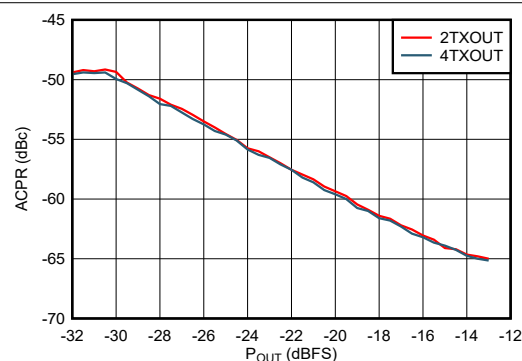
3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-479. 3.5GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系



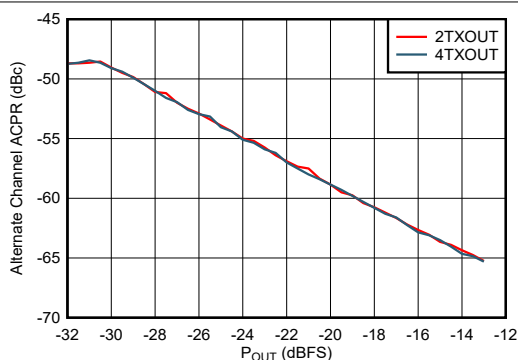
3.5GHz 匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-480. 3.5GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



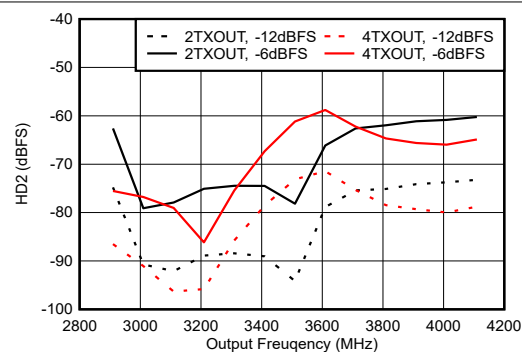
3.5GHz 匹配, 单载波 100MHz BW NR TM1.1

图 4-481. 3.5GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与数字电平间的关系



3.5GHz 匹配, 单载波 100MHz BW NR TM1.1

图 4-482. 3.5GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与数字电平间的关系

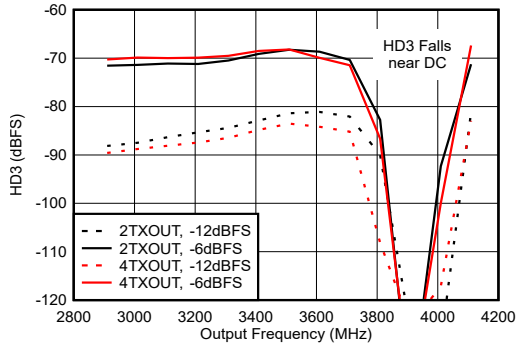


在 3.5 GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-483. 3.5GHz 条件下 TX 单音 HD2 与频率和数字电平间的关系

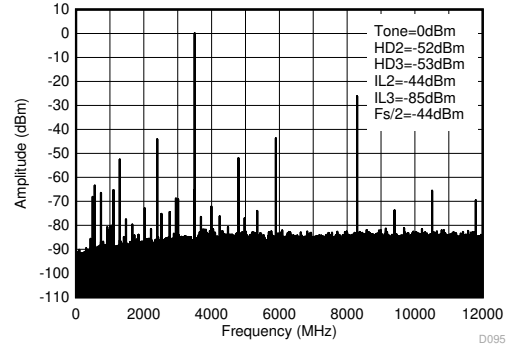
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



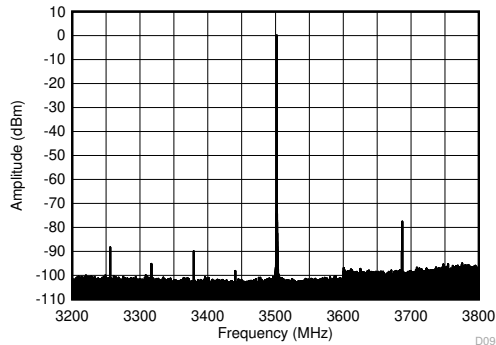
在 3.5GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率。低谷是由于 HD3 下降至接近直流。

图 4-484. 3.5GHz 条件下 TX 单音 HD3 与频率和数字电平间的关系



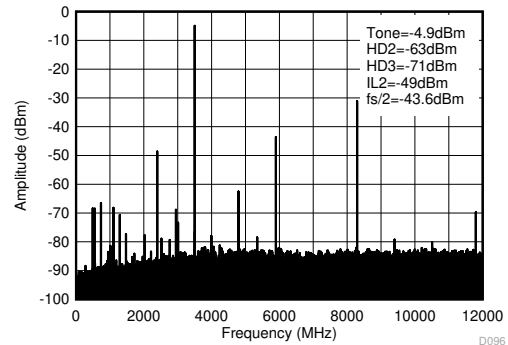
在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-485. 3.5GHz (0 - f_{DAC}) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



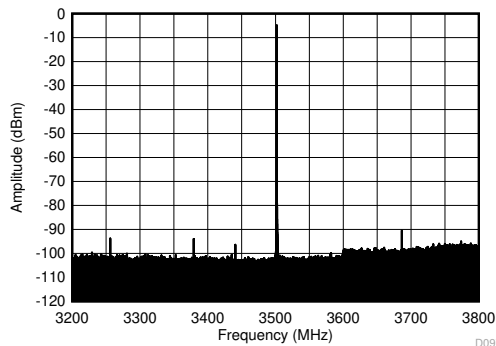
在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-486. 3.5GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



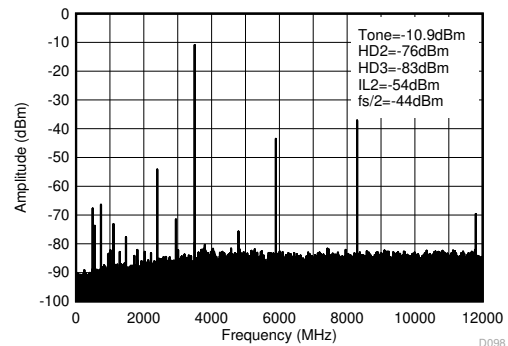
在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-487. 3.5GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱



在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-488. 3.5GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

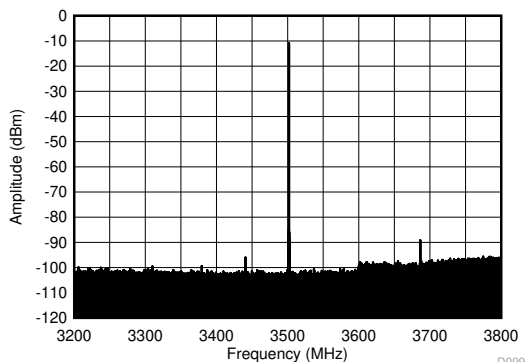


在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-489. 3.5GHz (0- f_{DAC}) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

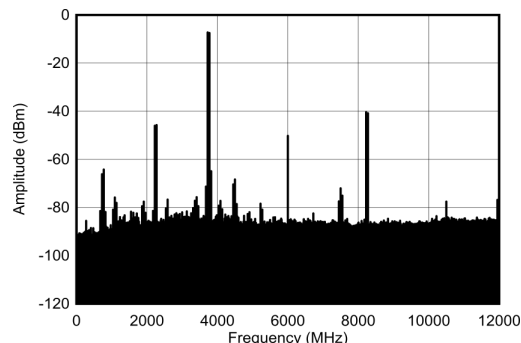
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



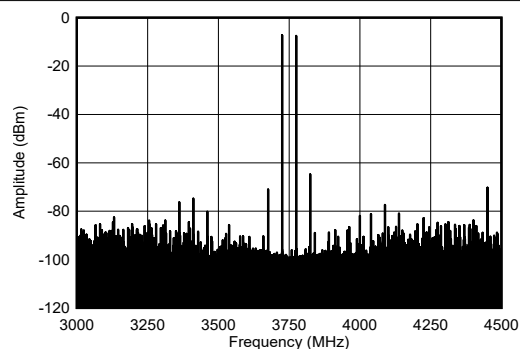
在 3.5GHz 下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式。

图 4-490. 3.5GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱



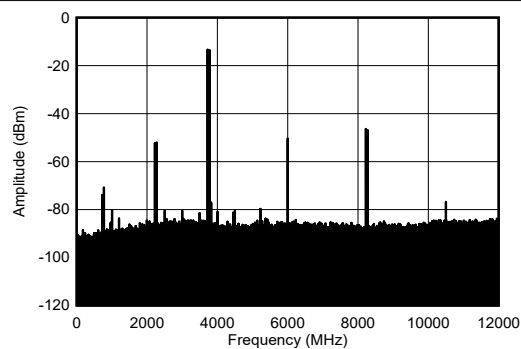
在 3.5GHz 条件下匹配, 50MHz 频率间隔, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 非交错模式。

图 4-491. 3.75GHz、单音幅值为 -7dBFS ($0 - f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



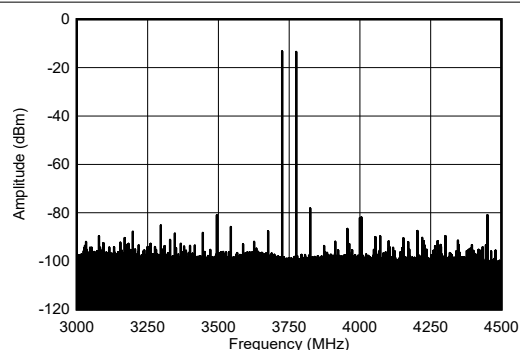
在 3.5GHz 条件下匹配, 50MHz 频率间隔, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 非交错模式。

图 4-492. 3.75GHz、单音幅值为 -7dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



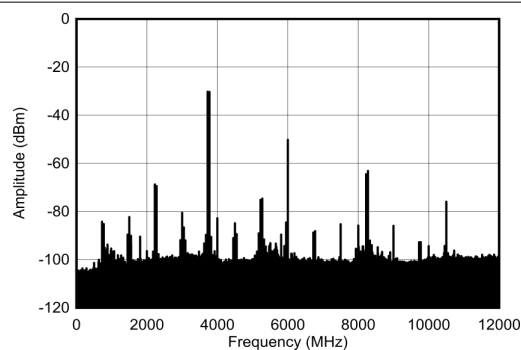
在 3.5GHz 条件下匹配, 50MHz 频率间隔, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 非交错模式。

图 4-493. 3.75GHz、单音幅值为 -13dBFS ($0 - f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 双音输出频谱



在 3.5GHz 条件下匹配, 50MHz 频率间隔, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 非交错模式。

图 4-494. 3.75GHz、单音幅值为 -13dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱

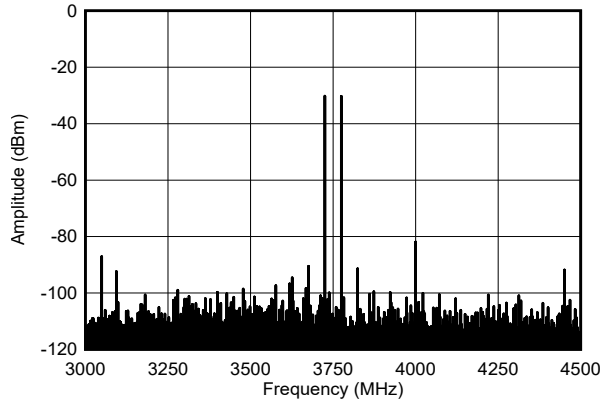


在 3.5GHz 条件下匹配, 50MHz 频率间隔, $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$, 非交错模式。

图 4-495. 3.75GHz、单音幅值为 -30dBFS ($0 - f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 双音输出频谱

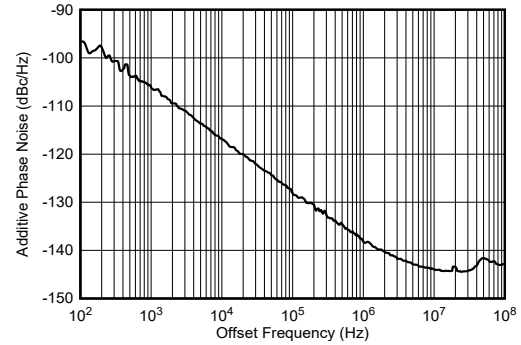
4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值，使用标称电源。除非另有说明，否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



在 3.5GHz 条件下匹配，50MHz 频率间隔， $f_{\text{DAC}} = 12\text{GSPS}$ ，非交错模式。

图 4-496. 3.75GHz、单音幅值为 -30dBFS ($\pm 600\text{MHz}$) 条件下的 TX 双音输出频谱

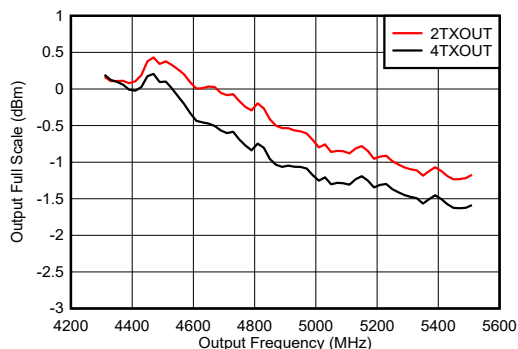


$f_{\text{DAC}} = f_{\text{CLK}} = 12\text{GSPS}$ ，非交错模式。

图 4-497. 3.7GHz 条件下的外部时钟附加相位噪声

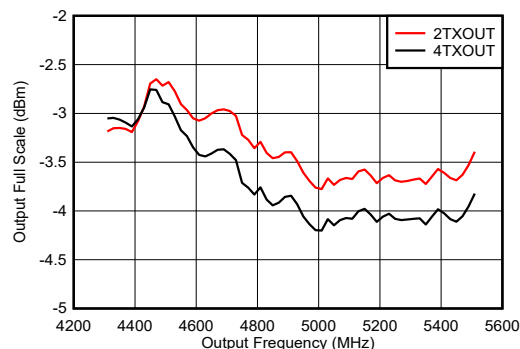
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



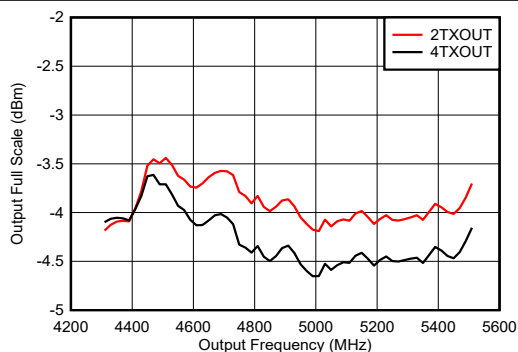
不包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 4.9GHz 匹配

图 4-498. 11796.48MSPS 条件下的 TX 满量程与射频频率和通道间的关系



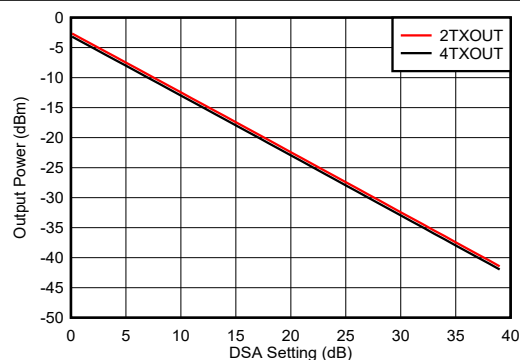
不包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 4.9GHz 匹配

图 4-499. 5898.24MSPS、混合模式、第二奈奎斯特区域条件下的 TX 满量程与射频频率和通道间的关系



不包括 PCB 和电缆损耗, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, $\text{DSA} = 0$, 4.9GHz 匹配

图 4-500. 8847.36MSPS、混合模式、第二奈奎斯特区域条件下的 TX 满量程与射频频率和通道间的关系

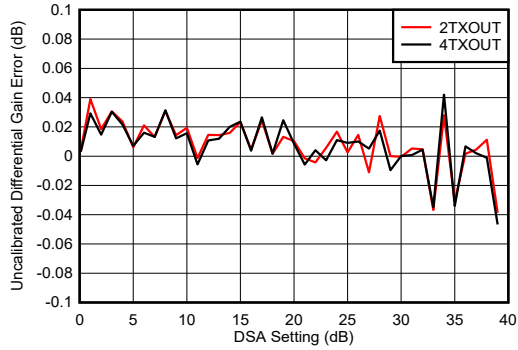


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, $A_{\text{out}} = -0.5\text{dBFS}$, 匹配 4.9GHz

图 4-501. 4.9GHz 条件下 TX 输出功率与 DSA 设置和通道间的关系

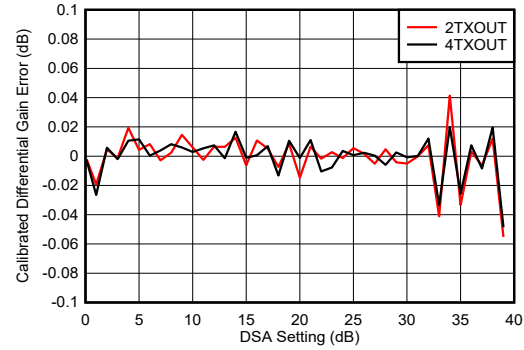
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



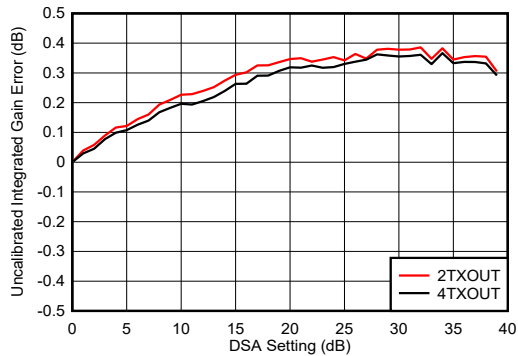
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、在 4.9GHz 条件下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-502. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



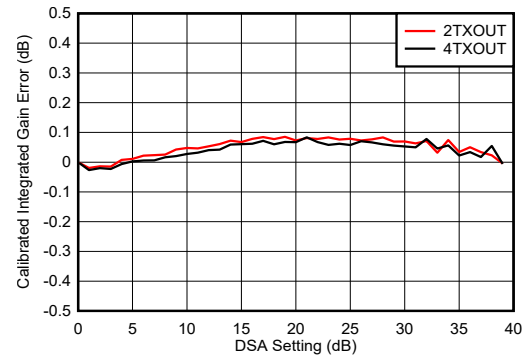
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、在 4.9GHz 条件下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-503. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、在 4.9GHz 条件下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-504. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

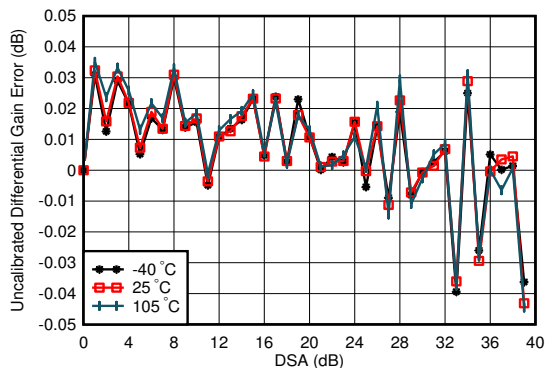


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、在 4.9GHz 条件下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-505. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和通道间的关系

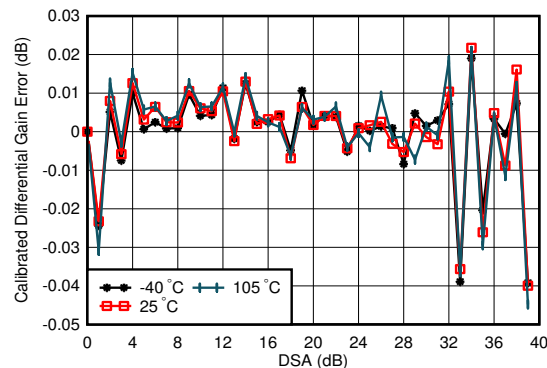
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



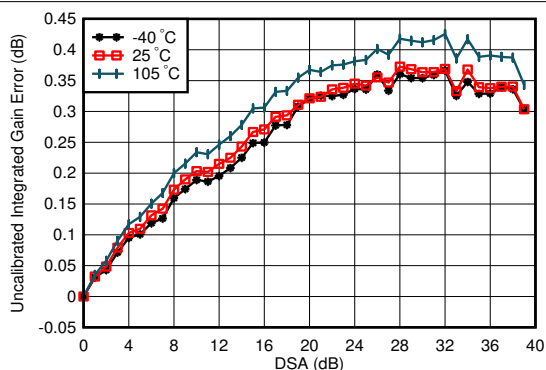
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-506. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



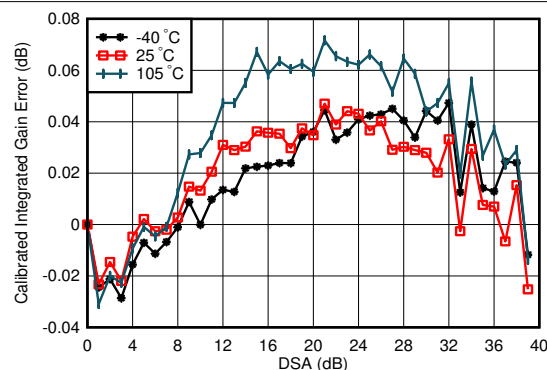
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) + 1$

图 4-507. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-508. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

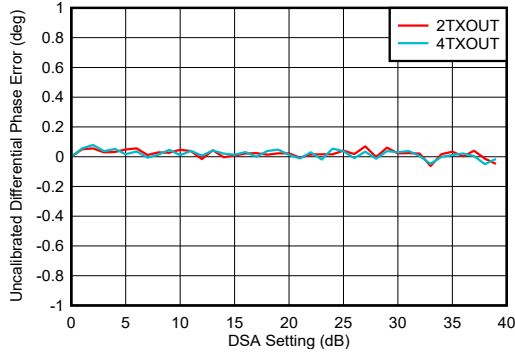


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分增益误差 = $P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置}) - P_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} = 0) + (\text{DSA 设置})$

图 4-509. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分增益误差与 DSA 设置和温度间的关系

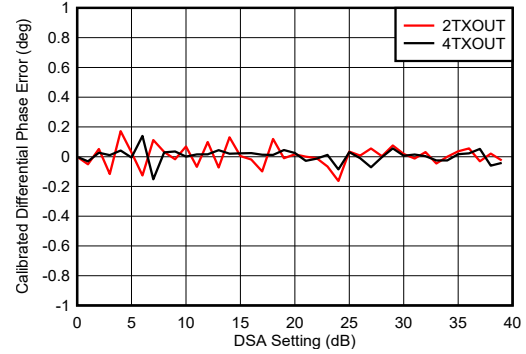
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

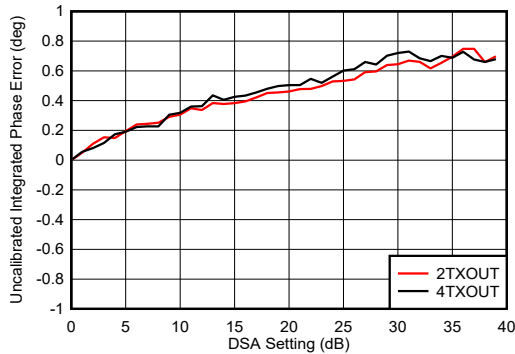
图 4-510. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

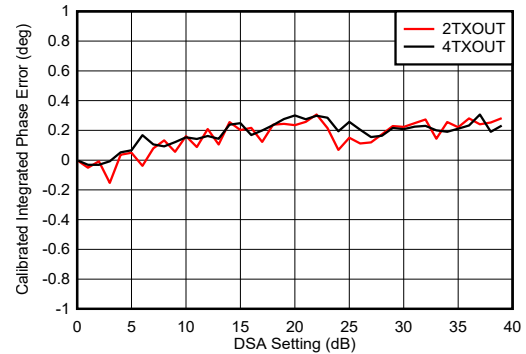
任何 DSA 设置下都可能出现相位 DNL 峰值。

图 4-511. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-512. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

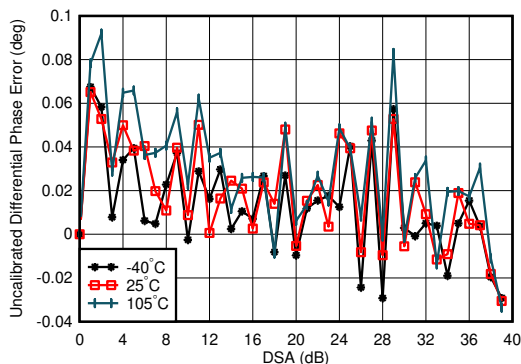


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-513. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和通道间的关系

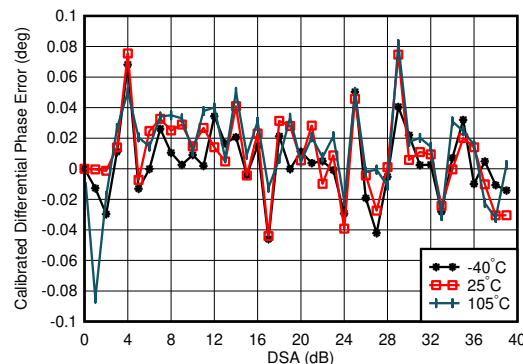
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



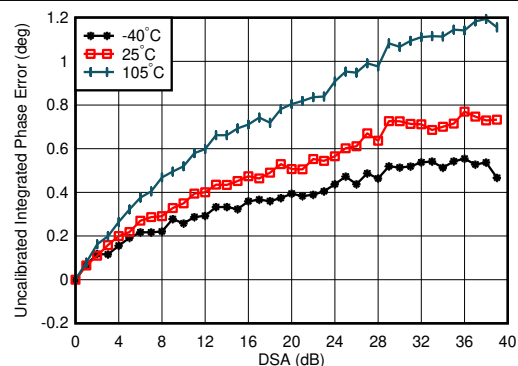
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-514. 4.9GHz 条件下 TX 未校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



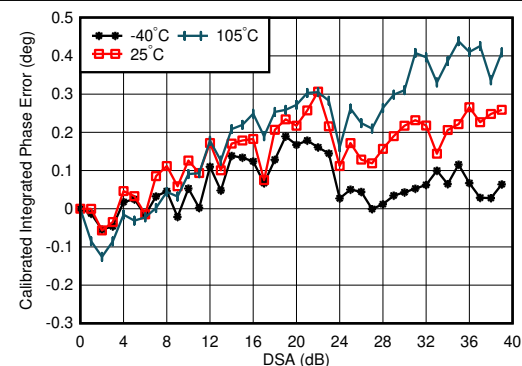
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
差分相位误差 = $\text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}_{\text{OUT}}(\text{DSA 设置})$

图 4-515. 4.9GHz 条件下 TX 校准差分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-516. 4.9GHz 条件下 TX 未校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

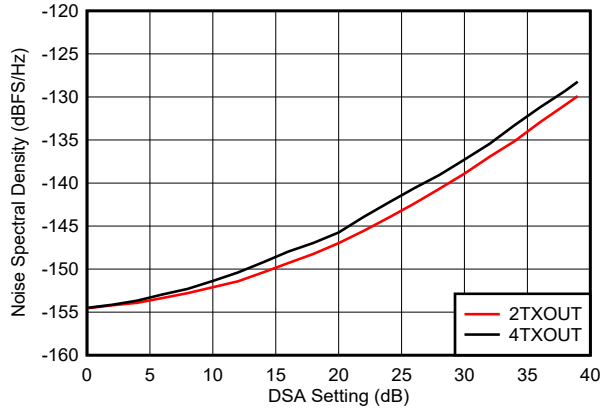


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 下匹配
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-517. 4.9GHz 条件下 TX 校准积分相位误差与 DSA 设置和温度间的关系

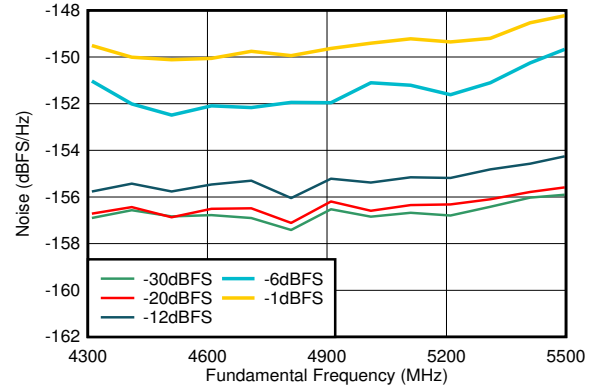
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



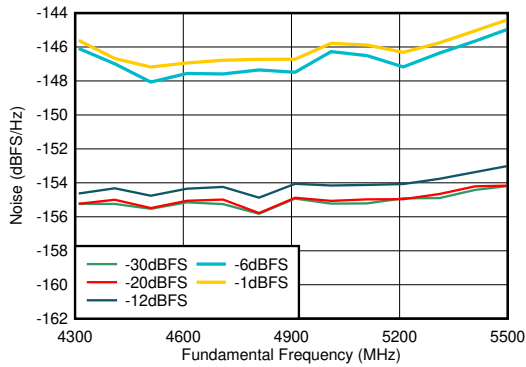
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,
 $P_{\text{OUT}} = -13\text{dBFS}$

图 4-518. 4.9GHz 条件下 TX 输出噪声与 DSA 设置和通道间的关系



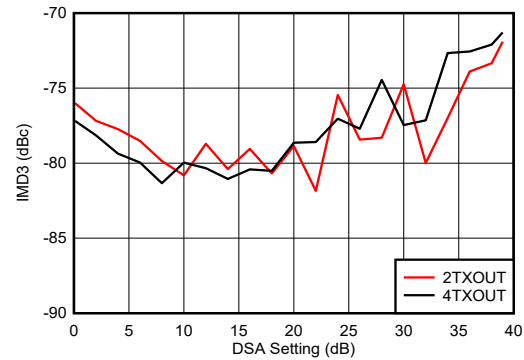
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9 GHz 条件下匹配,
 $A_{\text{out}} = -13\text{dBFS}$ 。

图 4-519. 4.9GHz 条件下 TX NSD 与输出频率和数字振幅间的关系 (DSA = 0dB)



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9 GHz 条件下匹配,
 $A_{\text{out}} = -13\text{dBFS}$ 。

图 4-520. 4.9GHz 条件下 TX NSD 与输出频率和数字振幅间的关系 (DSA = 6dB)

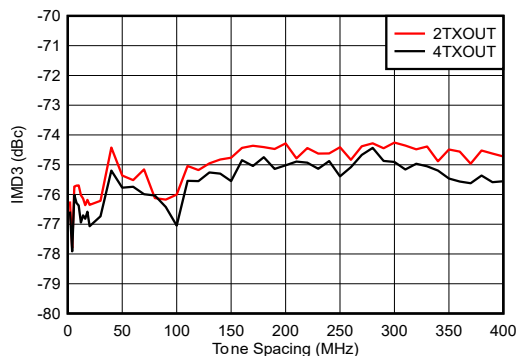


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,
 $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-521. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与 DSA 设置间的关系

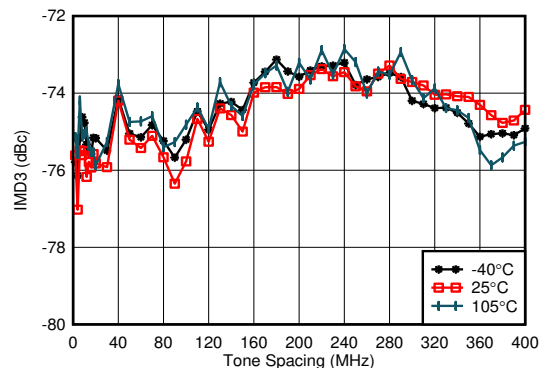
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



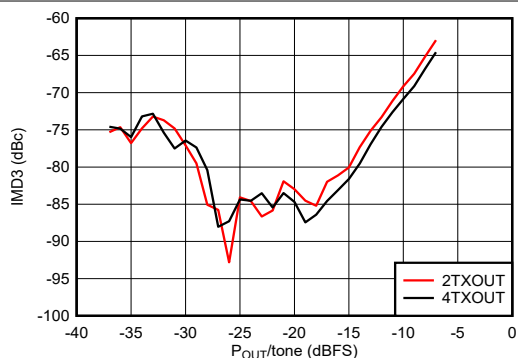
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,
 $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$, 单音幅度为 -13dBFS

图 4-522. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和通道间的关系



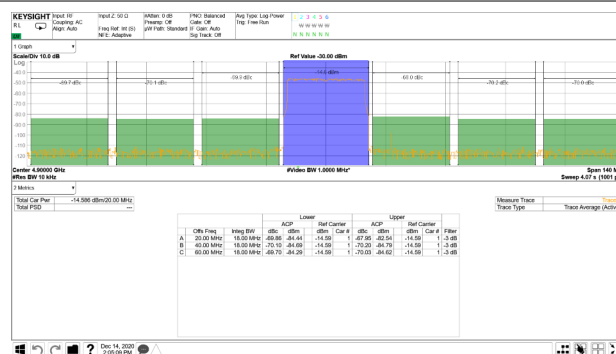
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,
 $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$, 单音幅度为 -13dBFS , 最差通道

图 4-523. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与频率间隔和温度间的关系



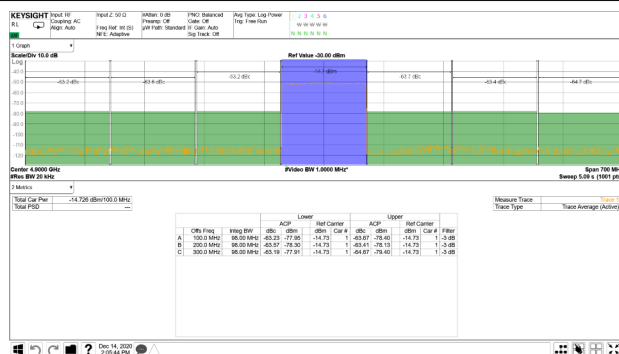
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 在 4.9GHz 条件下匹配,
 $f_{\text{CENTER}} = 4.9\text{GHz}$, $f_{\text{SPACING}} = 20\text{MHz}$

图 4-524. 4.9GHz 条件下 TX IMD3 与数字电平间的关系



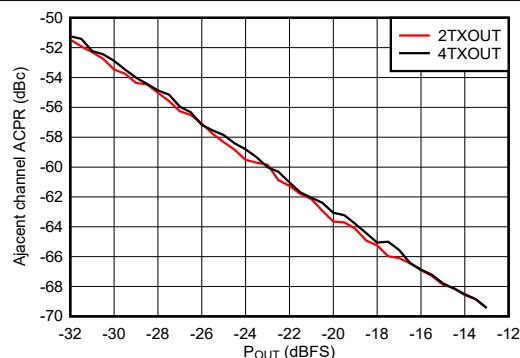
TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-525. 4.9GHz 条件下的 TX 20MHz LTE 输出频谱



TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-526. 4.9GHz 条件下的 TX 100MHz NR 输出频谱

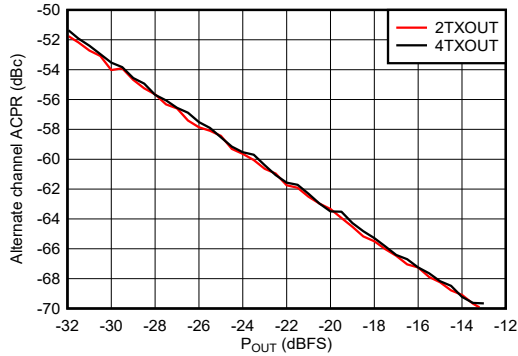


在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-527. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与数字电平间的关系

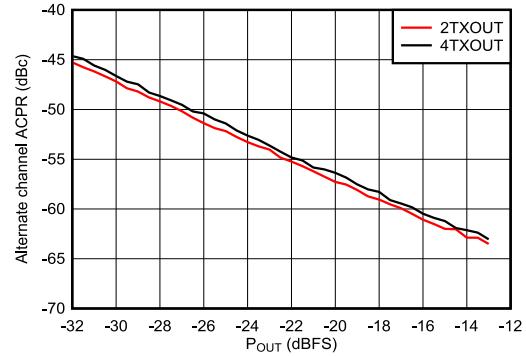
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



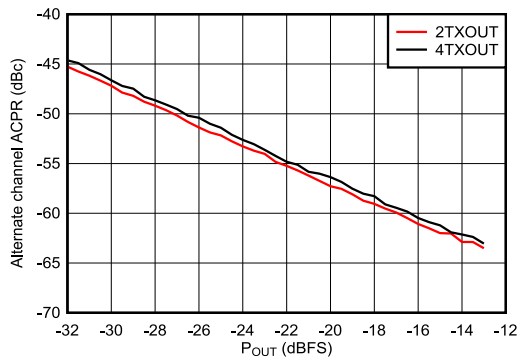
在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-528. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与数字电平间的关系



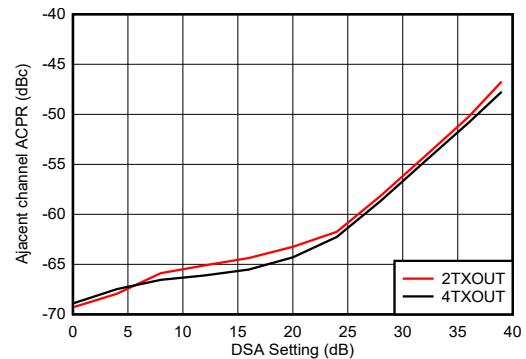
在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-529. 4.9GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与数字电平间的关系



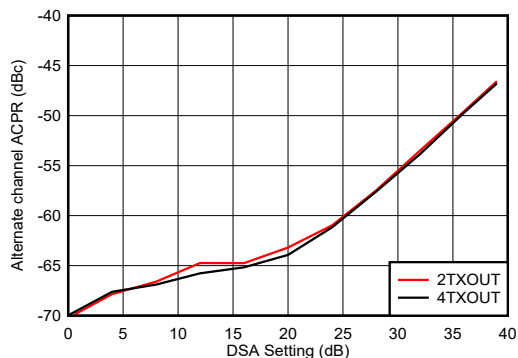
在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-530. 4.9GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与数字电平间的关系



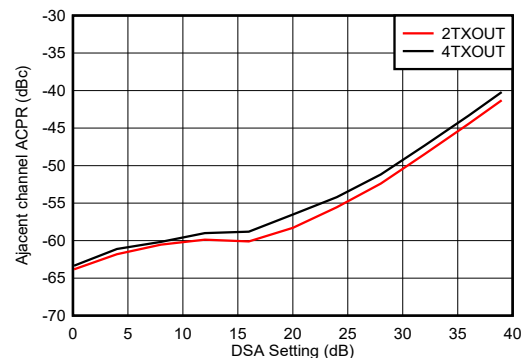
在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-531. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE ACPR 与 DSA 间的关系



在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 20MHz BW TM1.1 LTE

图 4-532. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE alt-ACPR 与 DSA 间的关系

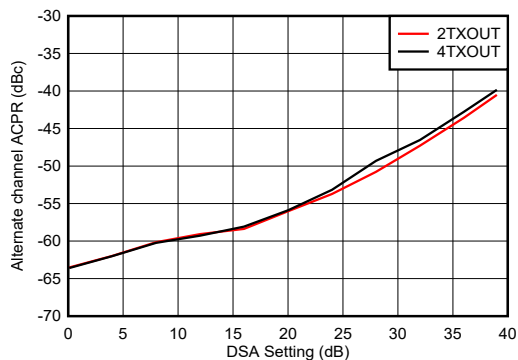


在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-533. 4.9GHz 条件下 TX 100MHz NR ACPR 与 DSA 间的关系

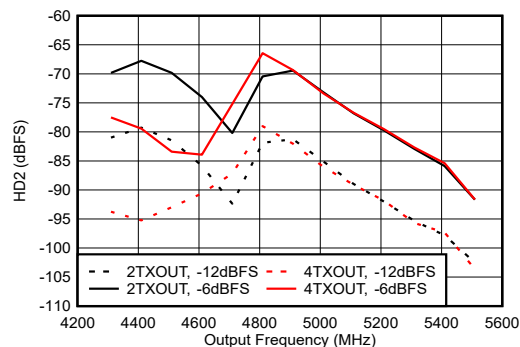
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



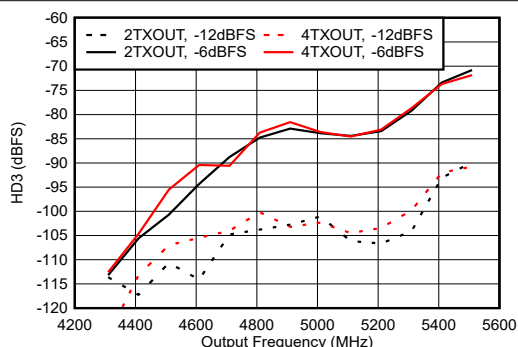
在 4.9GHz 条件下匹配, 单载波 100MHz BW TM1.1 NR

图 4-534. 4.9GHz 条件下 TX 100MHz NR alt-ACPR 与 DSA 间的关系



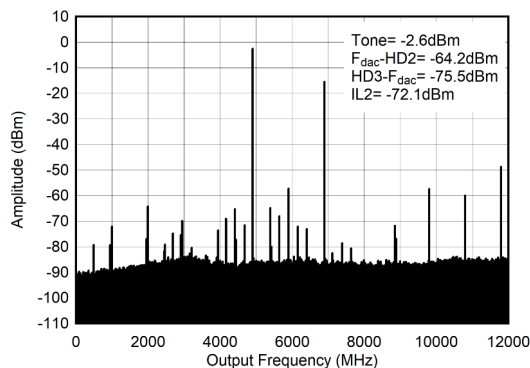
在 4.9 GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-535. 4.9GHz 条件下 TX HD2 与数字振幅和输出频率间的关系



在 4.9GHz 条件下匹配, $f_{\text{DAC}} = 11.79648\text{GSPS}$, 交错模式, 标准化为谐波频率下的输出功率

图 4-536. 4.9GHz 条件下 TX HD3 与数字振幅和输出频率间的关系

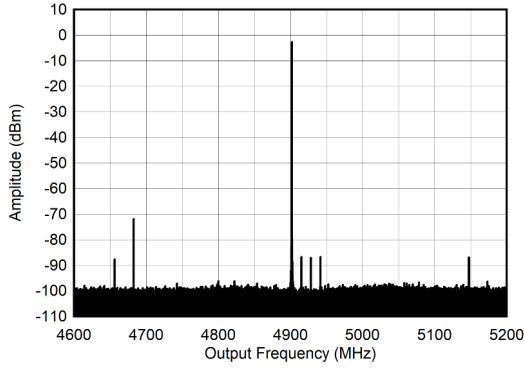


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗 $IL_n = f_S/n \pm f_{\text{OUT}}$

图 4-537. 4.9GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-1dBFS) 输出频谱

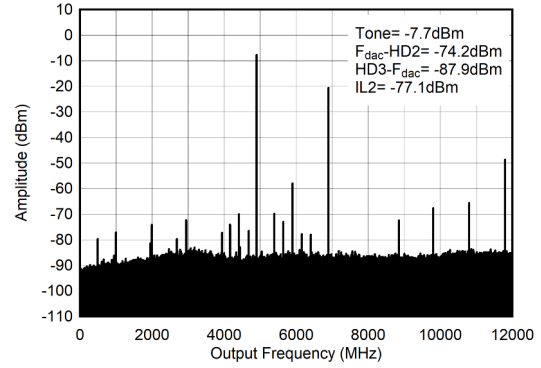
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



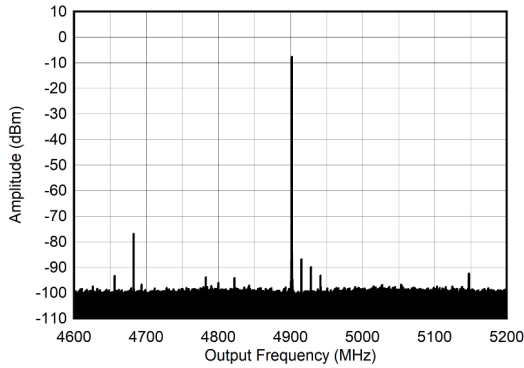
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-538. 4.9GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-1dBFS) 输出频谱



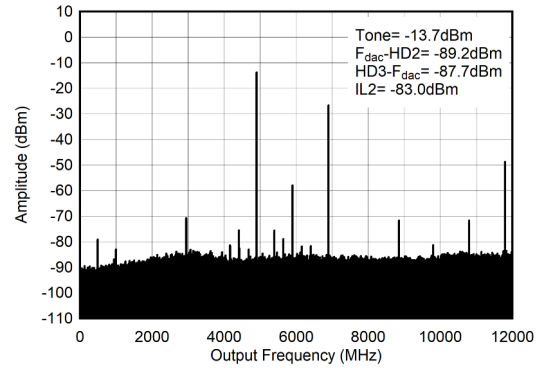
$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗 $IL_n = f_S/n \pm f_{\text{OUT}}$

图 4-539. 4.9GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单频 (-6dBFS) 输出频谱



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-540. 4.9GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-6dBFS) 输出频谱

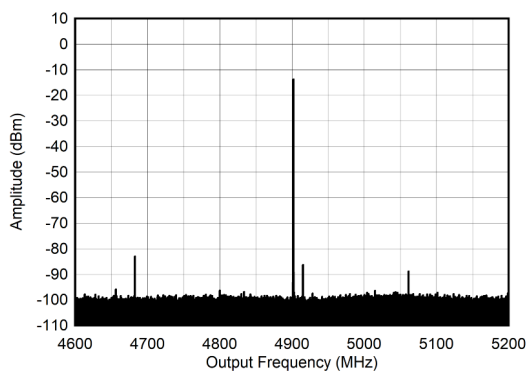


$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗 $IL_n = f_S/n \pm f_{\text{OUT}}$

图 4-541. 4.9GHz ($0-f_{\text{DAC}}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

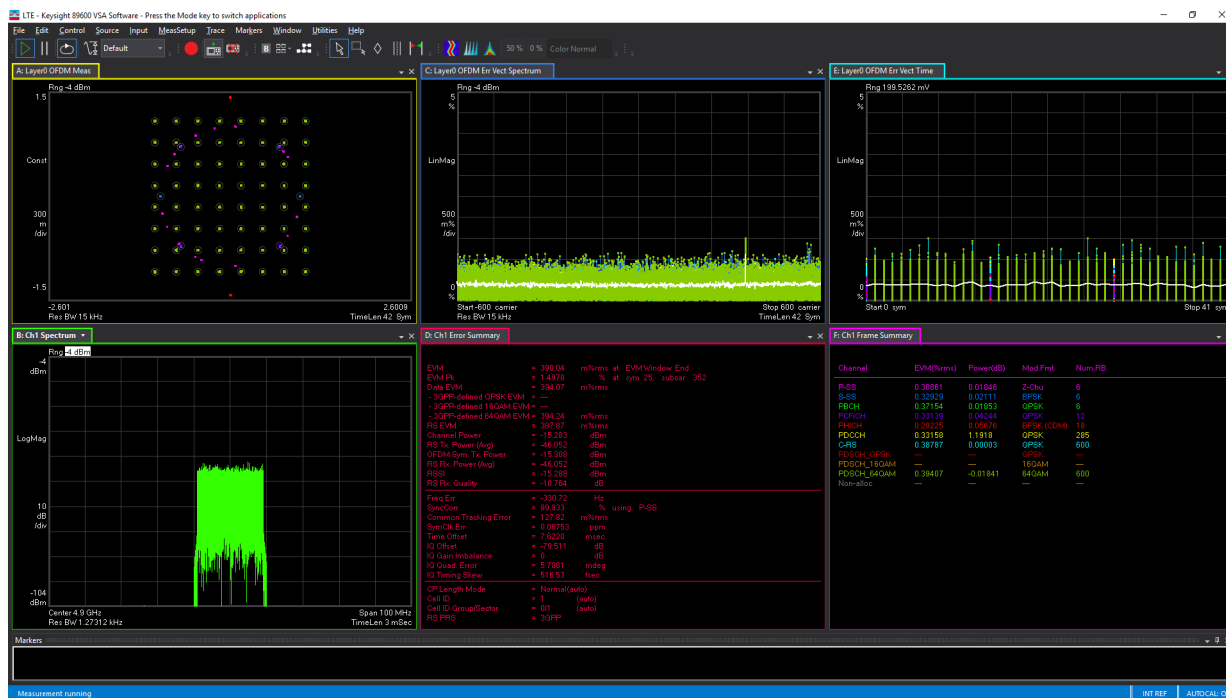
4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 491.52MSPS、 $f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$ 、交错模式、 $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$ 、第一奈奎斯特区域输出、内部 PLL、 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$ 、24 倍插值、 $\text{DSA} = 0\text{dB}$ 、 $\text{Sin}(x)/x$ 启用和 DSA 校准



$f_{\text{DAC}} = 11796.48\text{MSPS}$, 交错模式, 4.9GHz 匹配, 包括 PCB 和电缆损耗

图 4-542. 4.9GHz ($\pm 300\text{MHz}$) 条件下的 TX 单音 (-12dBFS) 输出频谱

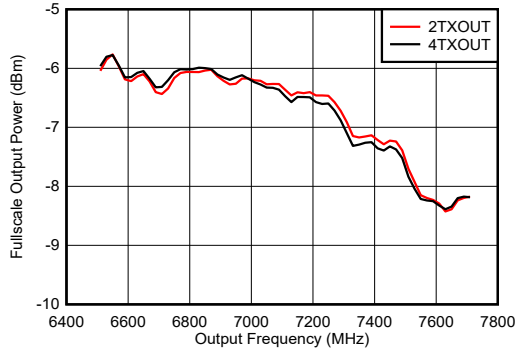


TM1.1, $P_{\text{OUT_RMS}} = -13\text{dBFS}$

图 4-543. 4.9GHz 条件下 TX 20MHz LTE 误差矢量幅度

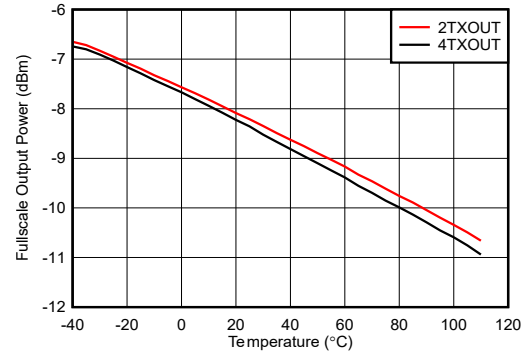
4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



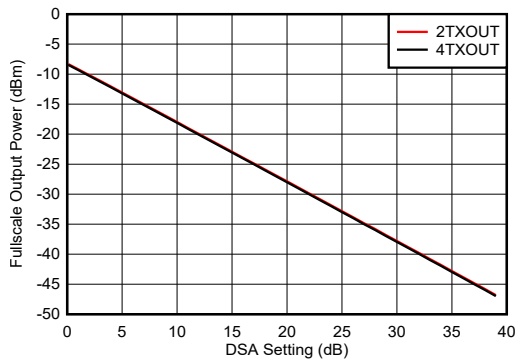
不包括 PCB 和电缆损耗

图 4-544. TX 满量程与射频频率和通道间的关系



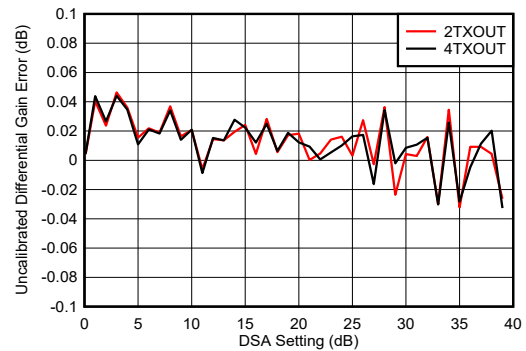
不包括 PCB 和电缆损耗

图 4-545. 7.1GHz 条件下 TX 满量程与温度和通道间的关系



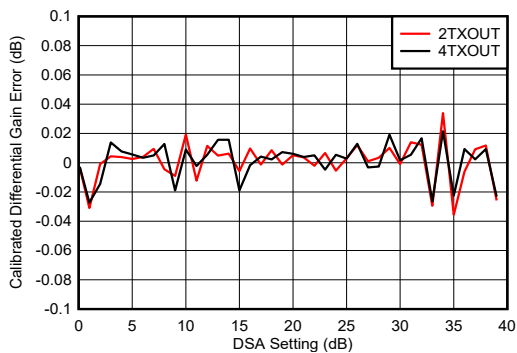
不包括 PCB 和电缆损耗

图 4-546. 7.1GHz 条件下 TX 满量程与 DSA 设置和通道间的关系



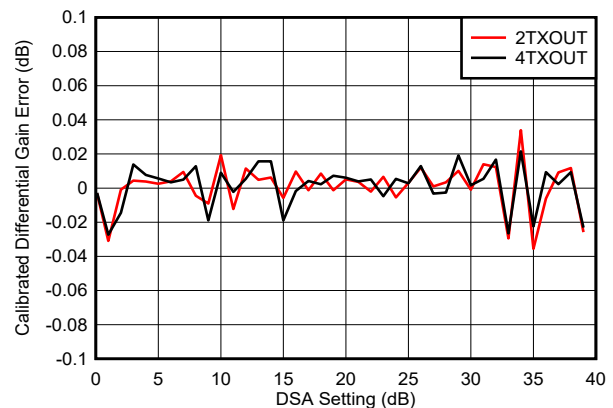
差分增益误差 = 增益 (DSA 设置 - 1) - 增益 (DSA 设置)

图 4-547. 7.1GHz 条件下未校准差分增益误差与通道间的关系



差分增益误差 = 增益 (DSA 设置 - 1) - 增益 (DSA 设置)

图 4-548. 7.1GHz 条件下未校准差分增益误差与温度间的关系

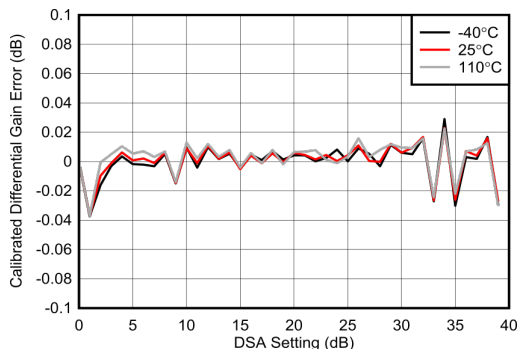


差分增益误差 = 增益 (DSA 设置 - 1) - 增益 (DSA 设置)

图 4-549. 7.1GHz 条件下校准差分增益误差与通道间的关系

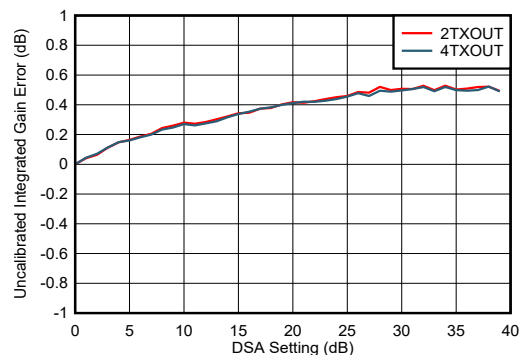
4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



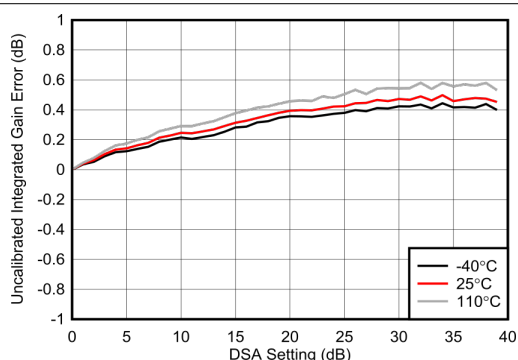
差分增益误差 = 增益 (DSA 设置 - 1) - 增益 (DSA 设置)

图 4-550. 7.1GHz 条件下校准差分增益误差与温度间的关系



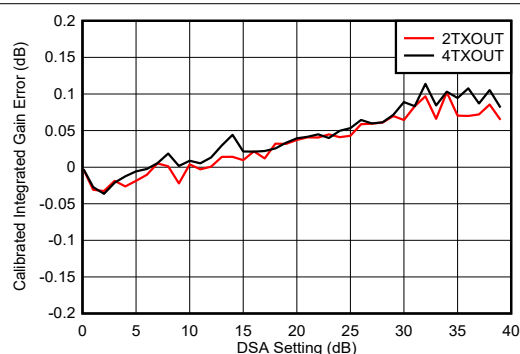
积分增益误差 = 增益 (DSA 设置) - 增益 (DSA 设置 = 0)。

图 4-551. 7.1GHz 条件下未校准积分增益误差与通道间的关系



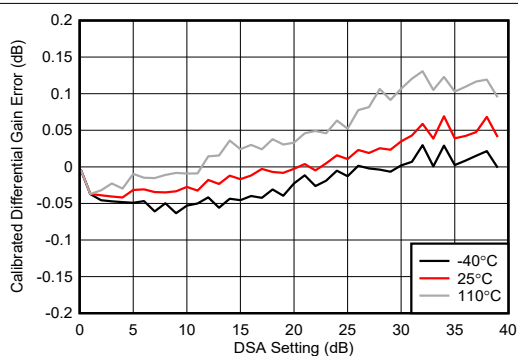
积分增益误差 = 增益 (DSA 设置) - 增益 (DSA 设置 = 0)。

图 4-552. 7.1GHz 条件下未校准积分增益误差与温度间的关系



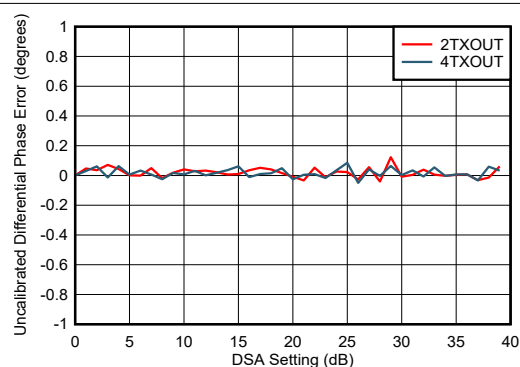
积分增益误差 = 增益 (DSA 设置) - 增益 (DSA 设置 = 0)。

图 4-553. 7.1GHz 条件下校准积分增益误差与通道间的关系



积分增益误差 = 增益 (DSA 设置) - 增益 (DSA 设置 = 0)。

图 4-554. 7.1GHz 条件下校准积分增益误差与温度间的关系

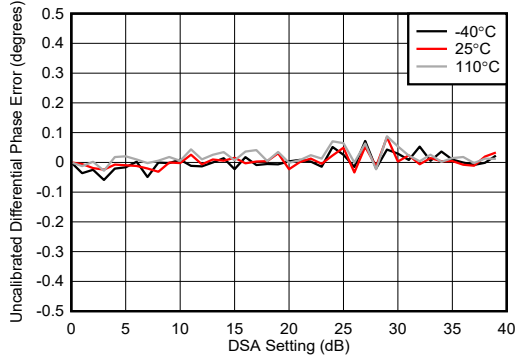


差分相位误差 = $\text{Phase} (\text{ DSA 设置 } - 1) - \text{Phase} (\text{ DSA 设置 })$

图 4-555. 7.1GHz 条件下未校准差分相位误差与通道间的关系

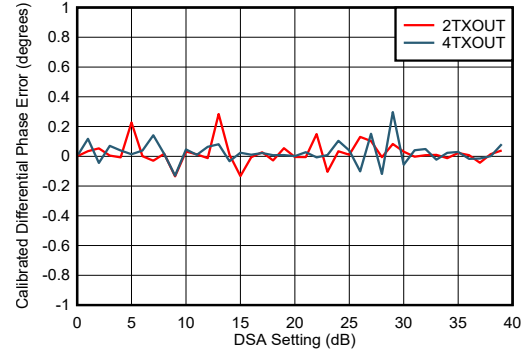
4.12.14 7.1GHz 下的TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



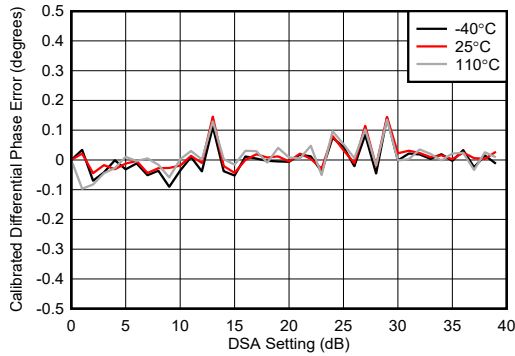
差分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}(\text{DSA 设置})$

图 4-556. 7.1GHz 条件下未校准差分相位误差与温度间的关系



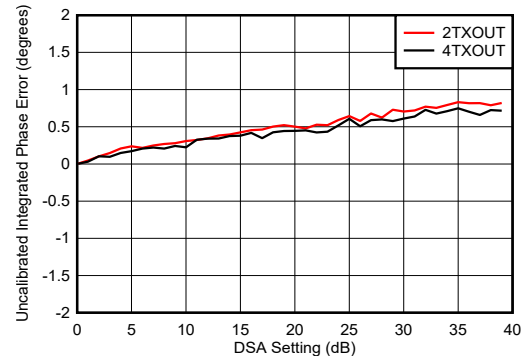
差分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}(\text{DSA 设置})$

图 4-557. 7.1GHz 条件下校准差分相位误差与通道间的关系



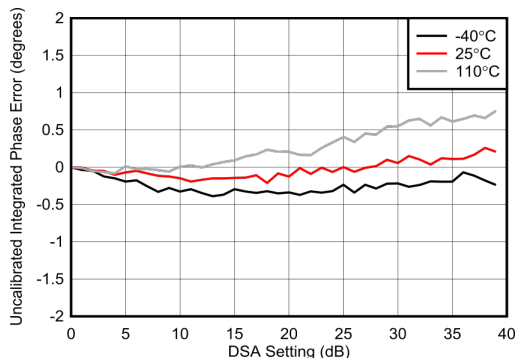
差分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置} - 1) - \text{Phase}(\text{DSA 设置})$

图 4-558. 7.1GHz 条件下校准差分相位误差与温度间的关系



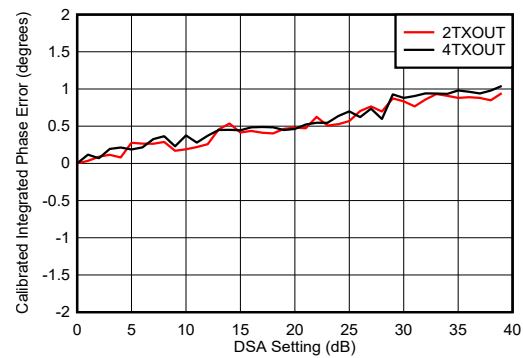
积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-559. 7.1GHz 条件下未校准积分相位误差与通道间的关系



积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-560. 7.1GHz 条件下未校准积分相位误差与温度间的关系

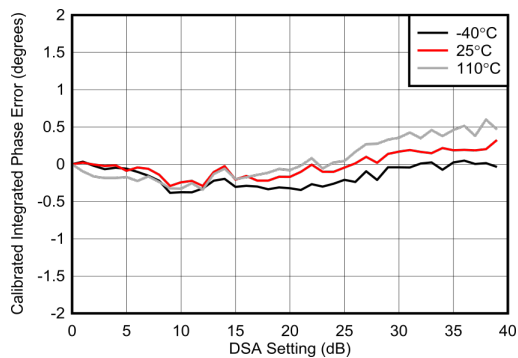


积分相位误差 = $\text{Phase}(\text{DSA 设置}) - \text{Phase}(\text{DSA 设置} = 0)$

图 4-561. 7.1GHz 条件下校准积分相位误差与通道间的关系

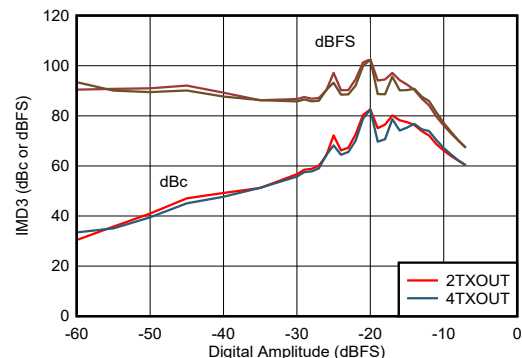
4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



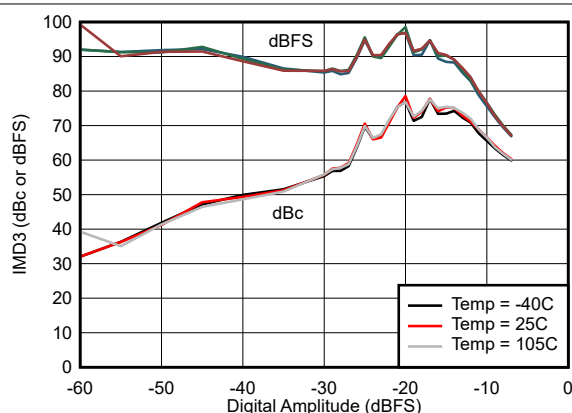
积分相位误差 = Phase (DSA 设置) - Phase (DSA 设置 = 0)

图 4-562. 7.1GHz 条件下校准积分相位误差与温度间的关系



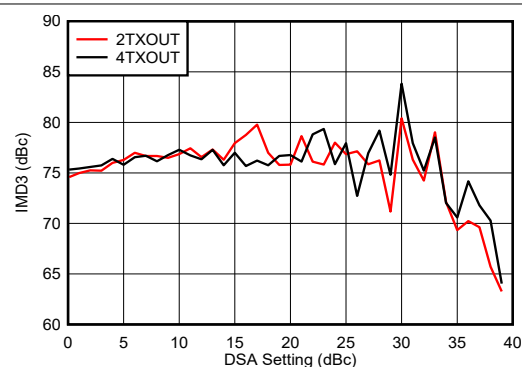
频率间隔 = 50MHz

图 4-563. 7.1GHz 条件下 IMD3 与数字振幅和通道间的关系



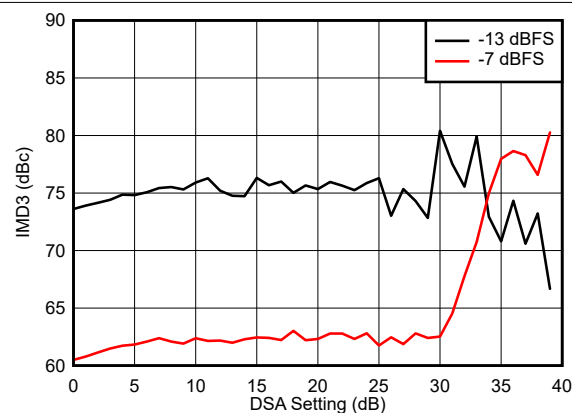
频率间隔 = 50MHz

图 4-564. 7.1GHz 条件下 IMD3 与数字振幅和温度间的关系



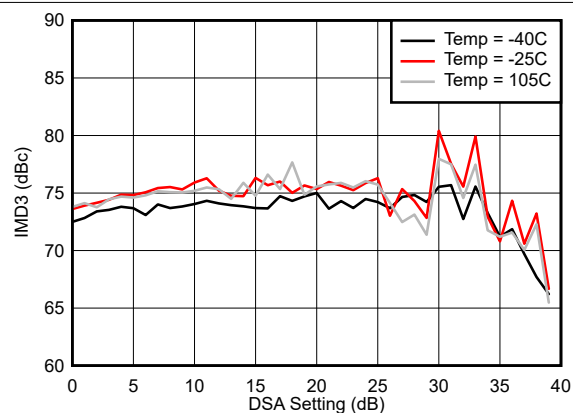
频率间隔 = 50MHz

图 4-565. 7.1GHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置和通道间的关系



频率间隔 = 50MHz

图 4-566. 7.1GHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置和数字振幅间的关系



频率间隔 = 50MHz

图 4-567. 7.1GHz 条件下 IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系

4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。

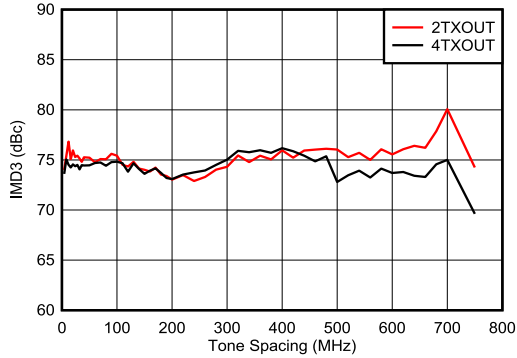


图 4-568. 7.1GHz 条件下 IMD3 与频率间隔和通道间的关系

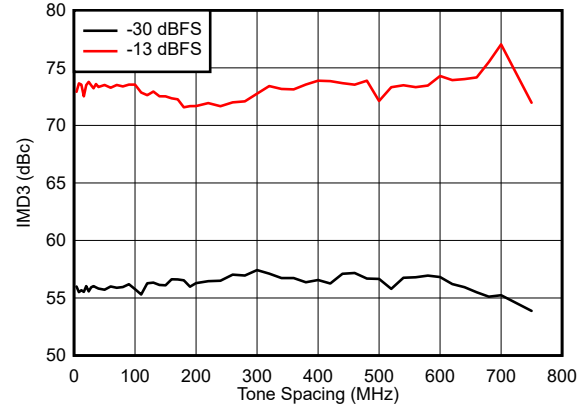


图 4-569. 7.1GHz 条件下 IMD3 与频率间隔和数字振幅间的关系

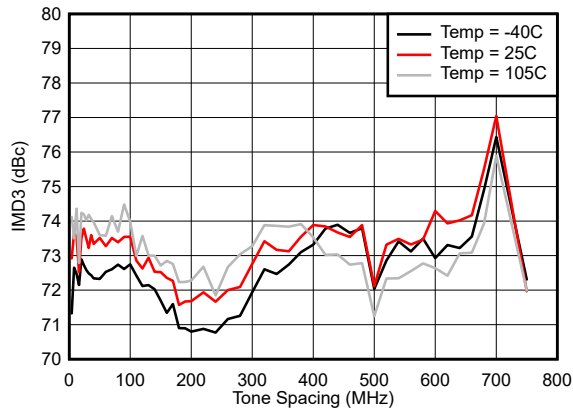
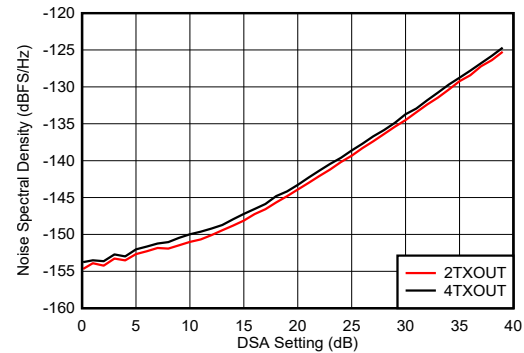
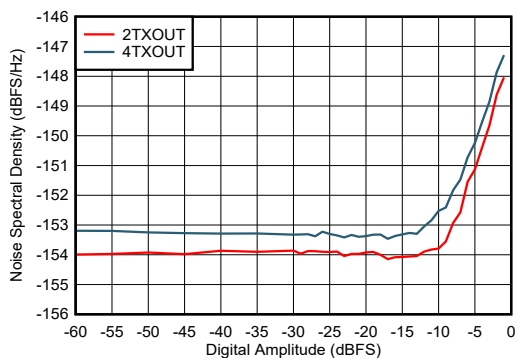


图 4-570. 7.1GHz 条件下 IMD3 与频率间隔和温度间的关系



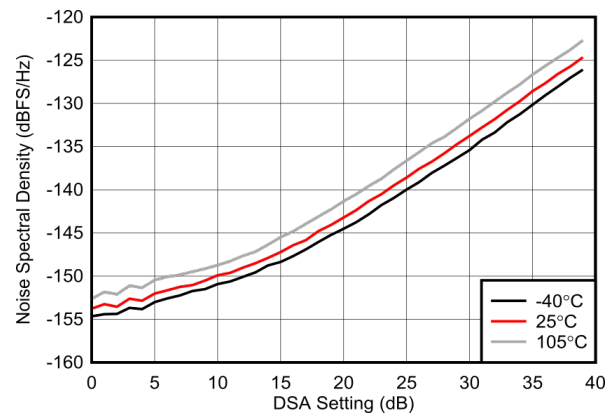
单音幅值为 -12dBFS, 偏移频率为 50MHz

图 4-571. 7.1GHz 条件下 NSD 与 DSA 设置和通道间的关系



偏移频率为 50MHz

图 4-572. 7.1GHz 条件下 NSD 与 DSA 设置和振幅间的关系

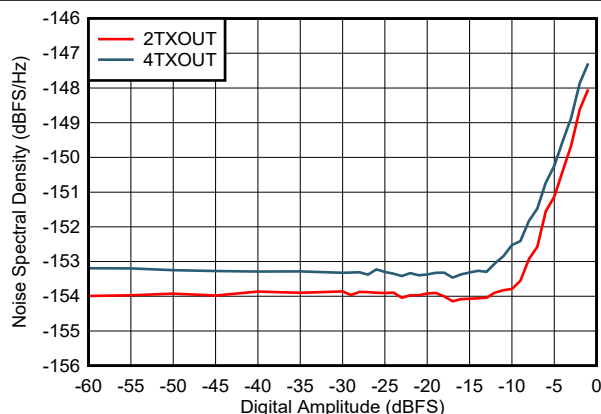


单音幅值为 -12dBFS, 偏移频率为 50MHz

图 4-573. 7.1GHz 条件下 NSD 与 DSA 设置和温度间的关系

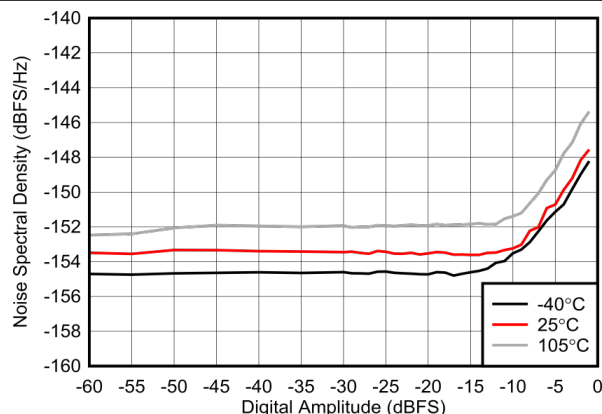
4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



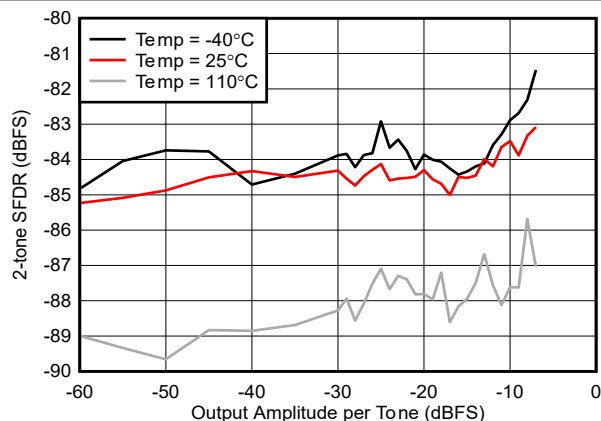
偏移频率为 50MHz

图 4-574. 7.1GHz 条件下 NSD 与数字振幅和通道间的关系



偏移频率为 50MHz

图 4-575. 7.1GHz 条件下 NSD 与数字振幅和温度间的关系



50MHz 音调间隔, 带内 = 7100MHz $\pm$ 200MHz, 单独不包括 IMD3 元件

图 4-576. 7.1GHz 条件下双频带内 SFDR 与输出振幅间的关系

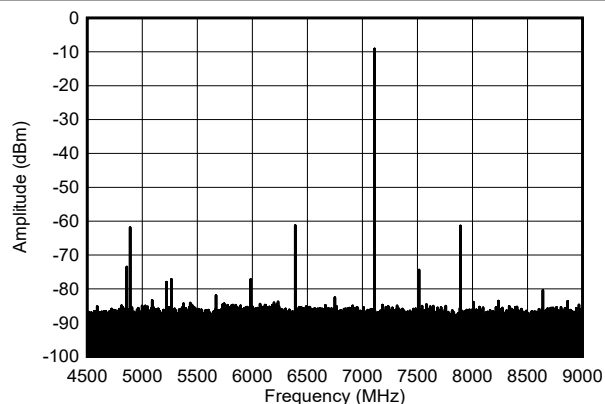


图 4-577. 7.1GHz、-1dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音输出频谱

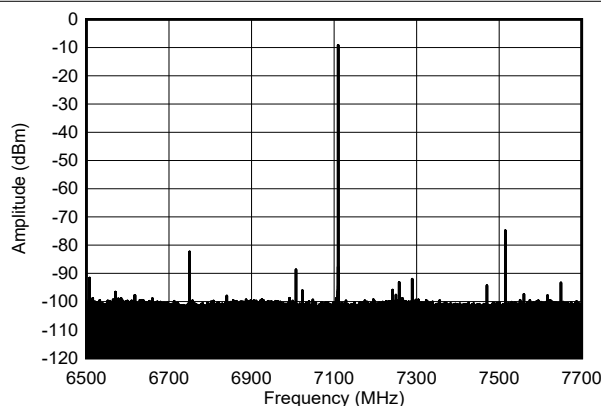


图 4-578. 7.1GHz、-1dBFS (窄跨) 条件下的单音输出频谱

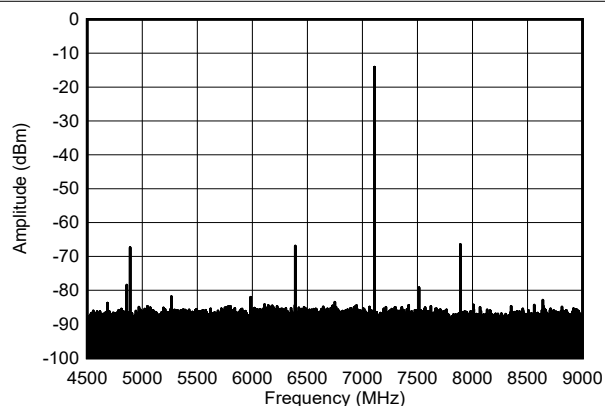


图 4-579. 7.1GHz、-6dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音输出频谱

4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。

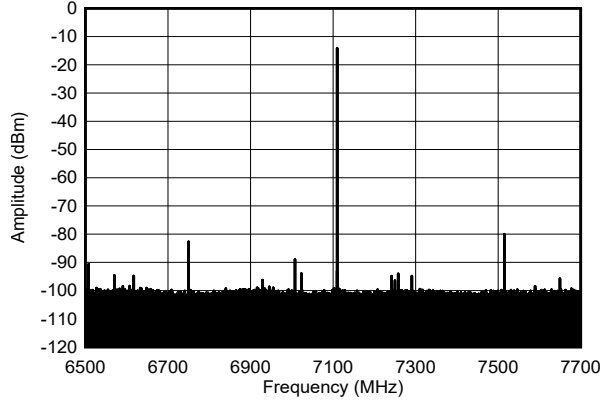


图 4-580. 7.1GHz、-6dBFS (窄跨) 条件下的单音输出频谱

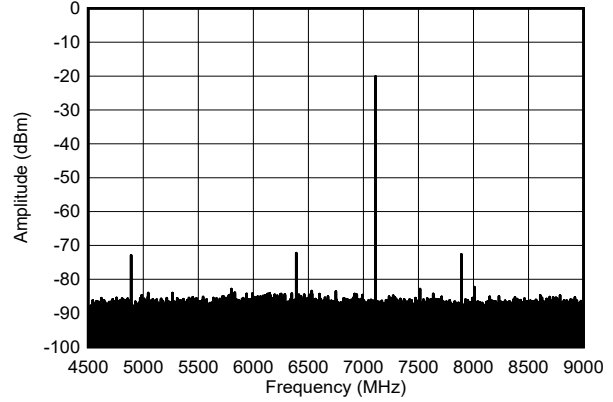


图 4-581. 7.1GHz、-12dBFS (奈奎斯特) 条件下的单音输出频谱

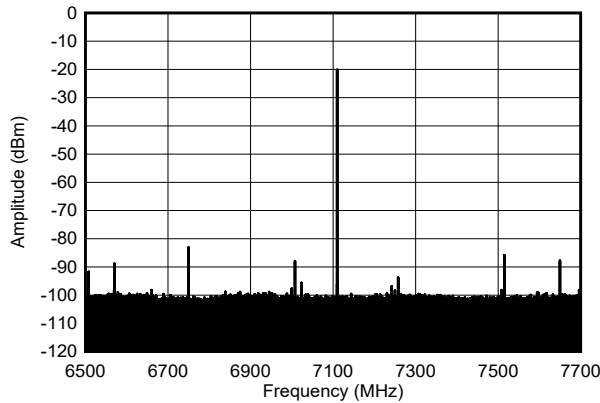
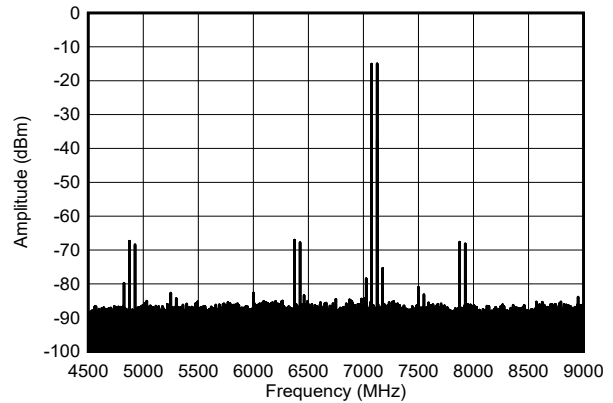
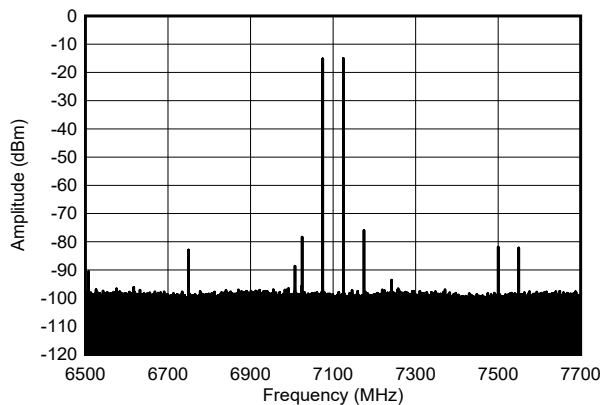


图 4-582. 7.1GHz、-12dBFS (窄跨) 条件下的单音输出频谱



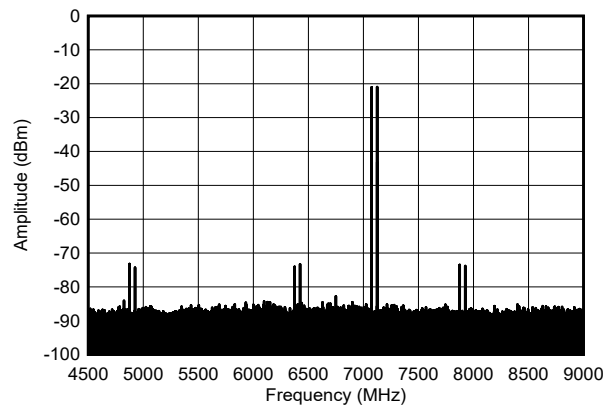
50MHz 频率间隔

图 4-583. 7.1GHz、单音幅值为 -7dBFS (奈奎斯特) 条件下的双音输出频谱



50MHz 频率间隔

图 4-584. 7.1GHz、单音幅值为 -7dBFS (窄跨) 条件下的双音输出频谱

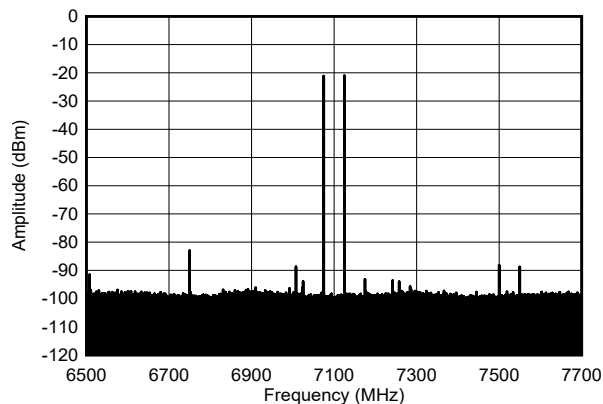


50MHz 频率间隔

图 4-585. 7.1GHz、单音幅值为 -13dBFS (奈奎斯特) 条件下的双音输出频谱

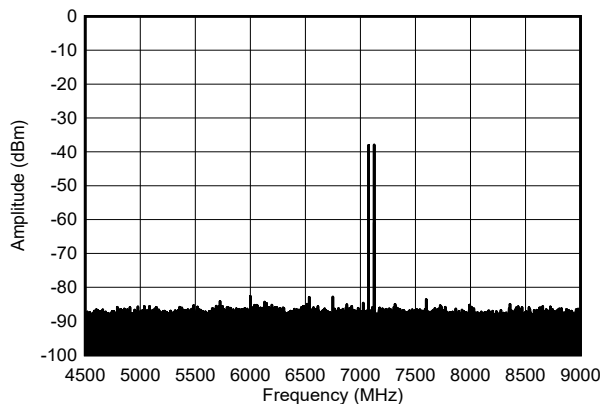
4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性 (续)

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 TX 输入数据速率 = 500MSPS, $f_{\text{DAC}} = 9000\text{MSPS}$, 非交错模式, $A_{\text{OUT}} = -1\text{dBFS}$, 第二奈奎斯特区域输出, 外部时钟模式, 18 倍插值, DSA = 0dB, $\text{Sin}(x)/x$ 启用, DSA 校准, 7.1GHz 匹配。



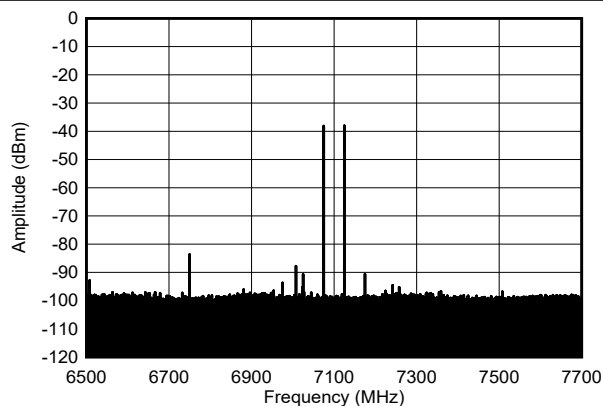
50MHz 频率间隔

图 4-586. 7.1GHz、单音幅值为 -13dBFS (窄跨) 条件下的双音输出频谱



50MHz 频率间隔

图 4-587. 7.1GHz、单音幅值为 -30dBFS (奈奎斯特) 条件下的双音输出频谱



50MHz 频率间隔

图 4-588. 7.1GHz、单音幅值为 -30dBFS (窄跨) 条件下的双音输出频谱

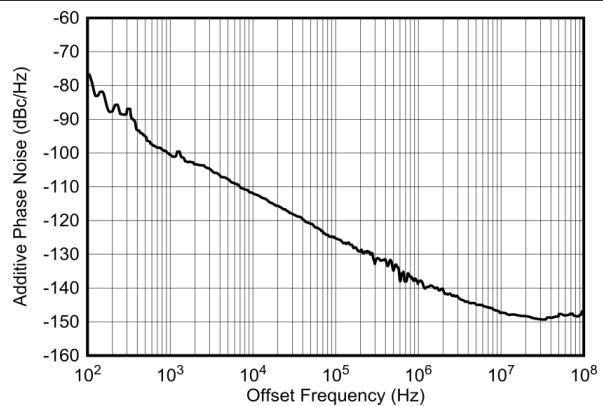
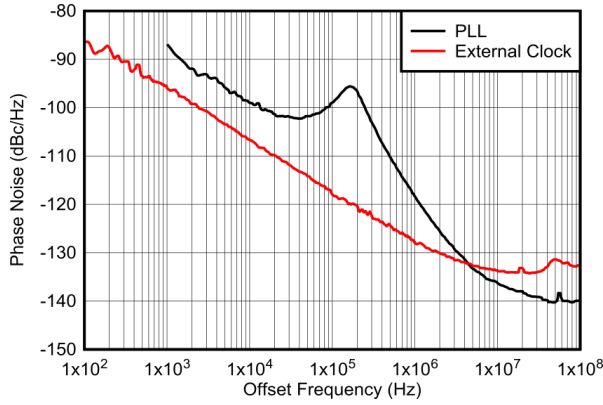


图 4-589. 7.1GHz 条件下的外部时钟附加相位噪声

4.12.15 PLL 和时钟典型特性

$T_A = +25^\circ\text{C}$ 时的典型值, 使用标称电源。除非另有说明, 否则 $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MHz}$, 在 TX 输出端测量的相位噪声



在 TX 输出端测量, 通过 $20 \cdot \log_{10}(12\text{GHz}/F_{\text{OUT}})$ 标准化为 12GHz

图 4-590. 12GHz 条件下 PLL 和外部时钟的相位噪声与偏移频率间的关系

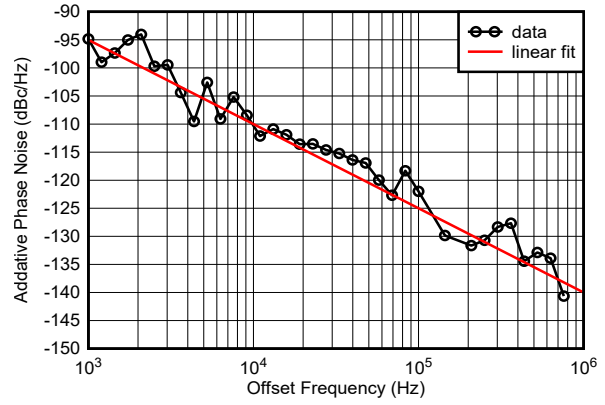
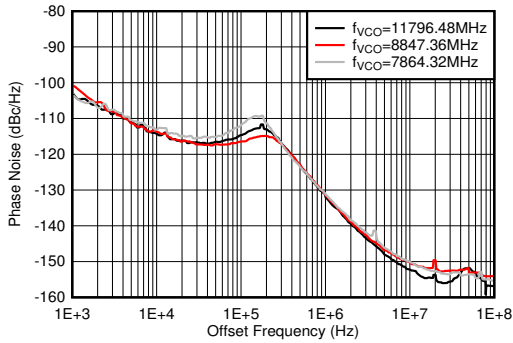
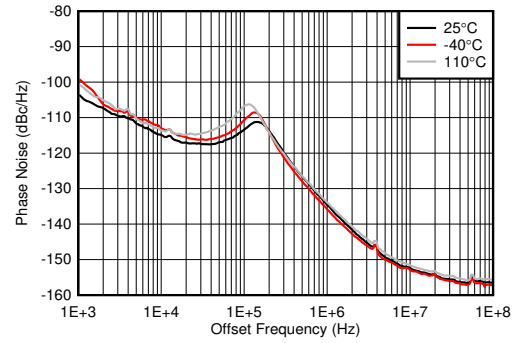


图 4-591. 9.61GHz 条件下的 RX 附加相位噪声



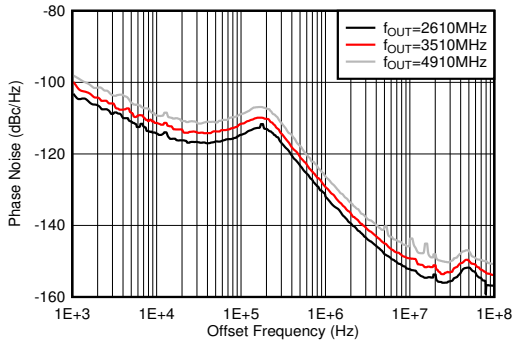
PLL 启用, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-592. $f_{\text{OUT}} = 2610\text{MHz}$ 时相位噪声与偏移频率和 f_{VCO} 间的关系



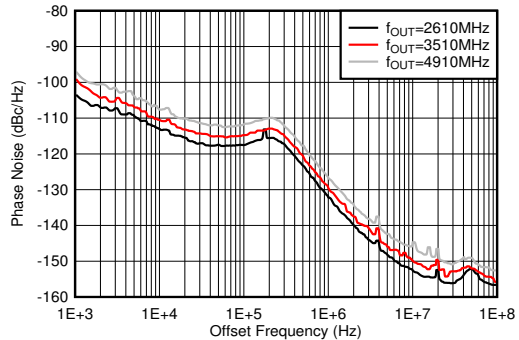
PLL 启用, $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-593. $f_{\text{OUT}} = 1910\text{MHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系



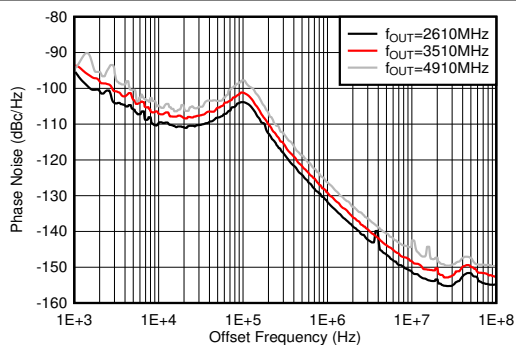
PLL 启用, $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-594. 25°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



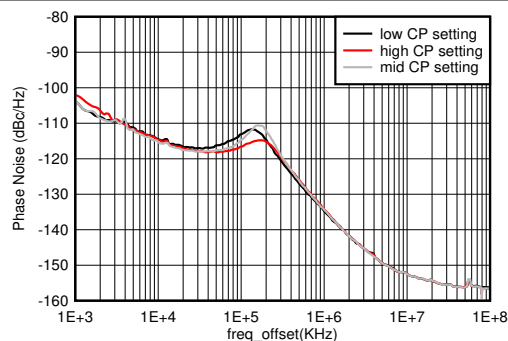
PLL 启用, $f_{\text{VCO}} = 11796.48\text{MHz}$, $f_{\text{REF}} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-595. -40°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



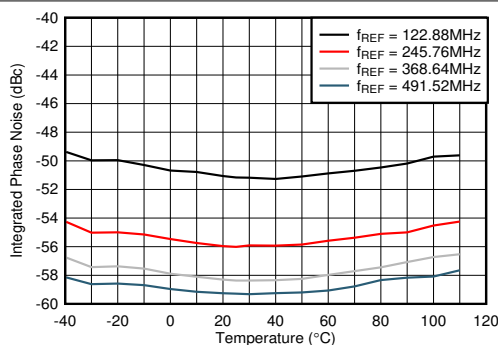
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-596. 110°C 条件下 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



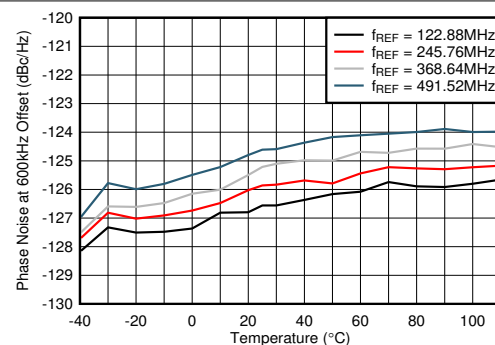
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-597. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 CP 设置间的关系



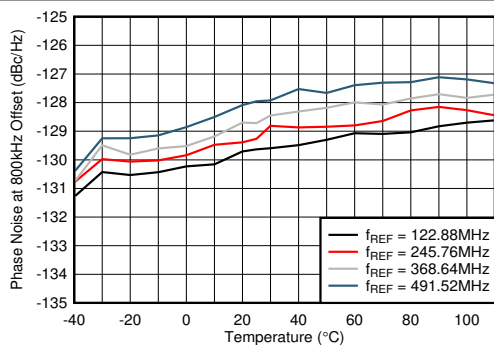
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 1kHz 至 100MHz, 单侧集成带宽, 在 2TXOUT 测量

图 4-598. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 积分相位噪声与温度和 f_{REF} 间的关系



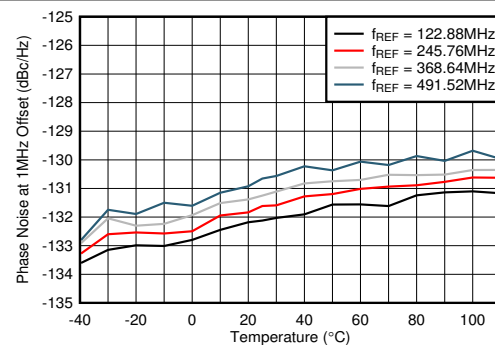
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-599. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (600kHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



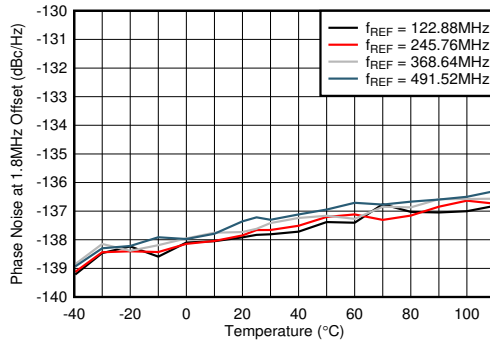
A. PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-600. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (800kHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



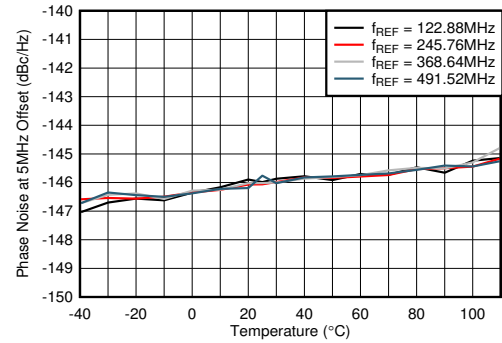
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-601. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (1MHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



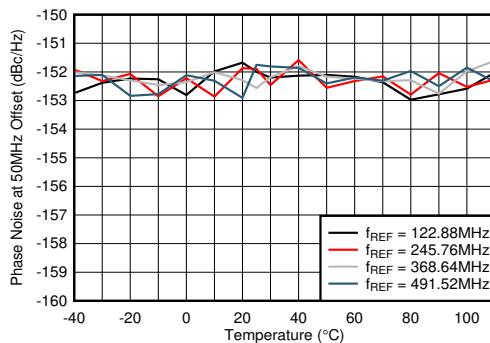
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-602. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (1.8MHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



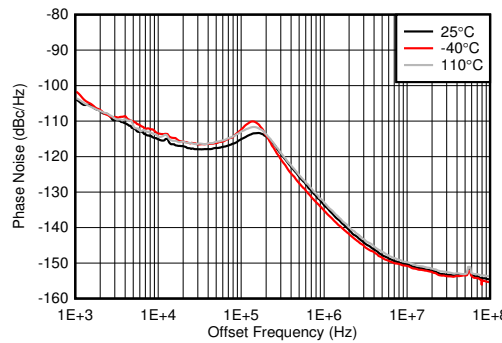
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-603. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (5MHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



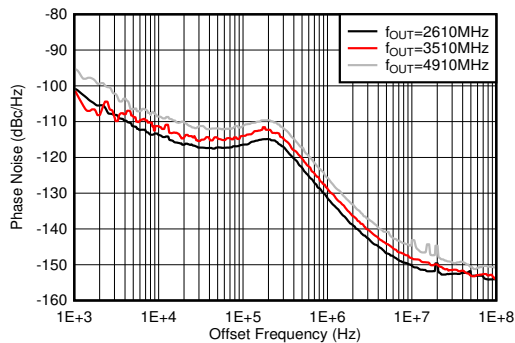
PLL 启用, $f_{VCO} = 11796.48\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-604. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 12GHz VCO 相位噪声 (50MHz 偏移条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



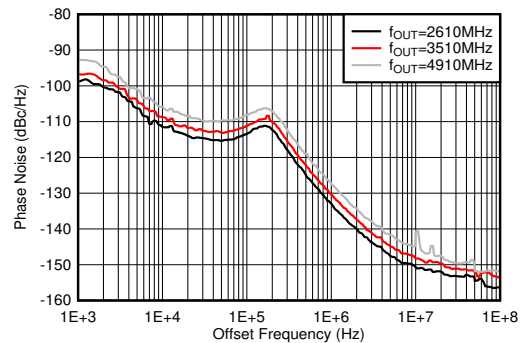
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-605. $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系



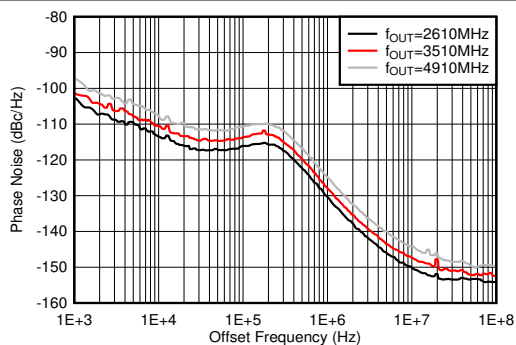
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-606. 25°C 条件下 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



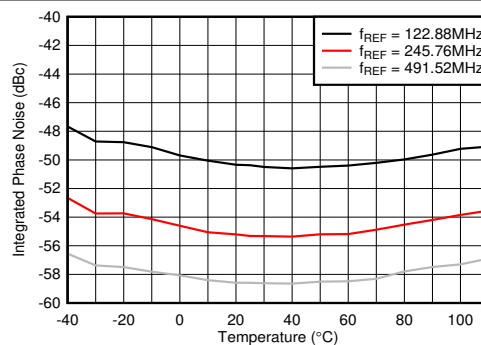
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-607. -40°C 条件下 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



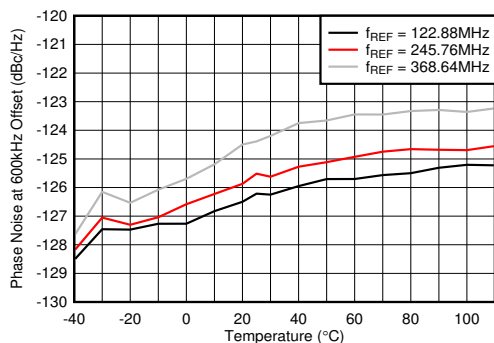
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-608. 110°C 条件下 10GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



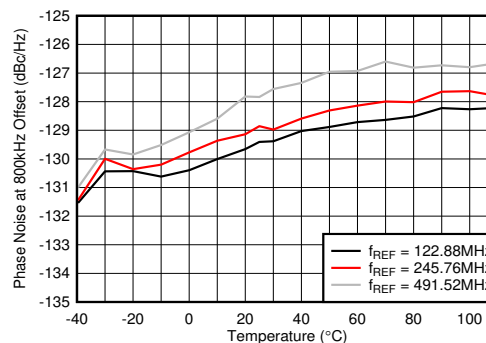
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 1kHz 至 100MHz, 单侧集成带宽, 在 2TXOUT 测量

图 4-609. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 积分相位噪声与温度和 f_{REF} 间的关系



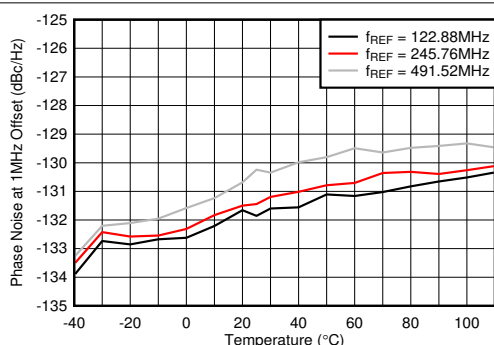
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-610. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (600kHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



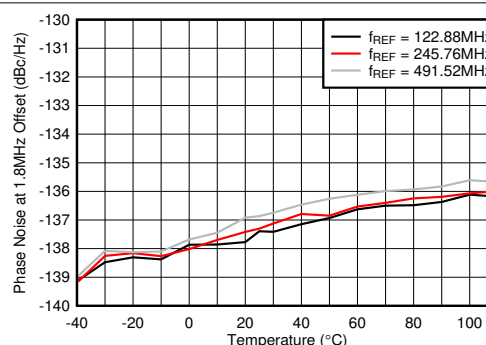
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-611. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (800kHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



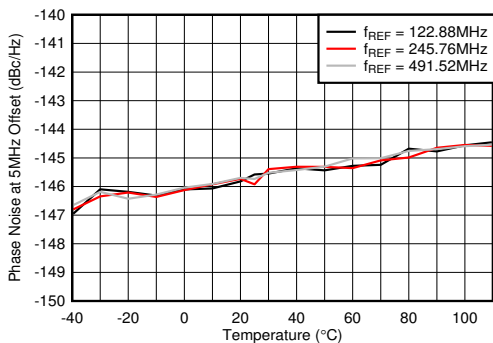
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-612. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (1MHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



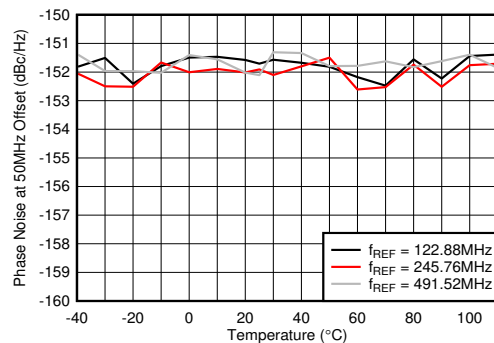
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-613. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (1.8MHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



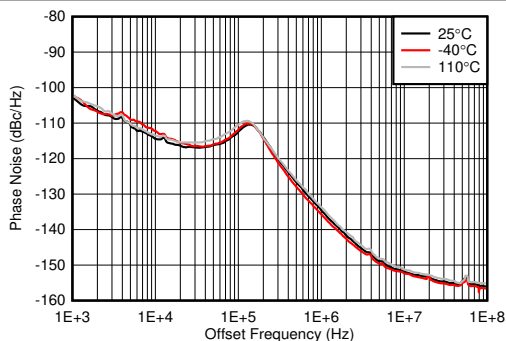
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-614. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (5MHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



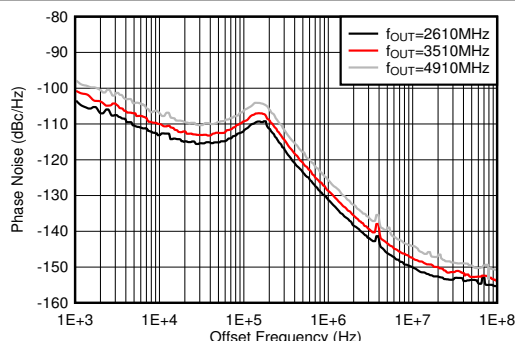
PLL 启用, $f_{VCO} = 9830.4\text{MHz}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-615. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 10GHz VCO 相位噪声 (50MHz 条件下) 与温度和 f_{REF} 间的关系



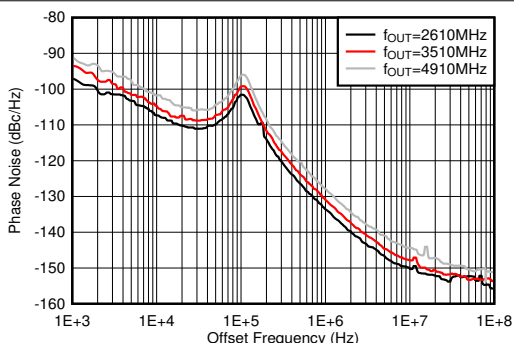
PLL 启用, $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-616. $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$ 时 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系



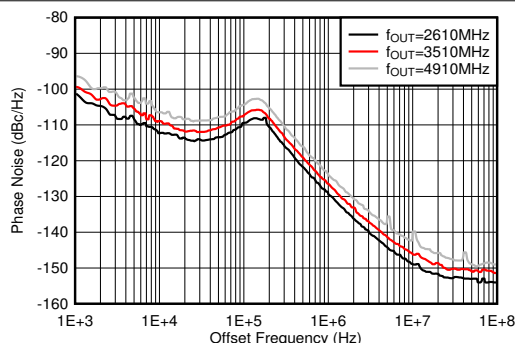
PLL 启用, $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-617. 25°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



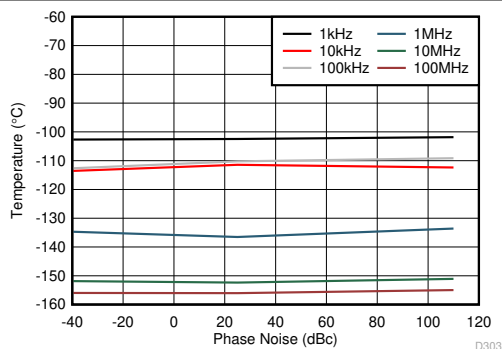
PLL 启用, $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-618. -40°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



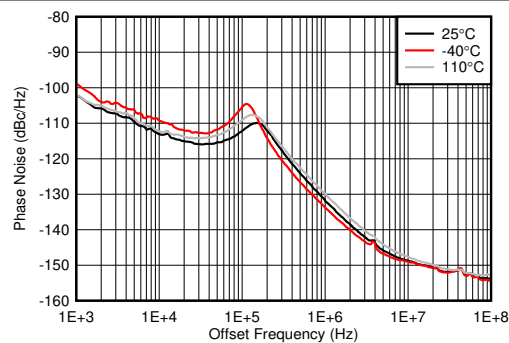
PLL 启用, $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-619. 110°C 条件下 9GHz VCO 相位噪声与偏移频率和 f_{OUT} 间的关系



PLL 启用, $f_{VCO} = 8847.36\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 最小 LPF 带宽, 在 2TXOUT 测量

图 4-620. $f_{OUT} = 2.6\text{GHz}$ 时 9GHz VCO 相位噪声与温度和偏移频率间的关系



PLL 启用, $f_{VCO} = 7864.32\text{MHz}$, $f_{REF} = 491.52\text{MSPS}$, 在 2TXOUT 测量

图 4-621. $f_{OUT} = 1910\text{MHz}$ 时 8GHz VCO 相位噪声与偏移频率和温度间的关系

5 器件和文档支持

5.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

5.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

5.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

5.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

5.5 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

6 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from JUNE 5, 2023 to MAY 1, 2025 (from Revision B (June 2023) to Revision C (May 2025))	Page
• RX 输入最大功率这一参数已从 RF ADC 电气特性部分移至绝对最大额定值部分	4

Changes from JULY 14, 2022 to JUNE 5, 2023 (from Revision A (July 2022) to Revision B (June 2023))	Page
• 将“器件信息”更改为 <i>封装信息</i> 表	1
• 将 I_{IH} 和 I_{IL} 单位更改为 μA	23
• 从“TX 典型特性和规格接头”中删除了“TX 时钟抖动已启用”	76
• 将第一奈奎斯特区域输出更改为 节 4.12.14 接头中第二奈奎斯特区域输出	143

Changes from MARCH 1, 2022 to JULY 14, 2022 (from Revision * (March 2022) to Revision A (July 2022))	Page
• 从 DSA 和 NCO 特性中删除了 FB	1
• ADC 采样率分频器	21
• 将 2.6GHz 更改为 1.8GHz 匹配	50

• 从条件和抖动图中删除了抖动 = 1.....	76
• 从条件中删除了 DITHER = 1.....	89
• 从条件中删除了 Dither = 1.....	102
• 从条件中删除了抖动 = 1.....	106
• 将 OTX 替换为 1TX.....	120
• 从条件和抖动图中删除了 Dither = 1.....	120
• 从条件中删除了 Dither = 1.....	132
• 从条件中删除了抖动 = 1.....	143

7 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE7903IABJ	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE7903I
AFE7903IABJ.B	Active	Production	FCBGA (ABJ) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
AFE7903IALK	Active	Production	FCBGA (ALK) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	No	SNPB	Level-3-220C-168 HR	-40 to 85	AFE7903 SNPB
AFE7903IALK.B	Active	Production	FCBGA (ALK) 400	90 JEDEC TRAY (5+1)	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

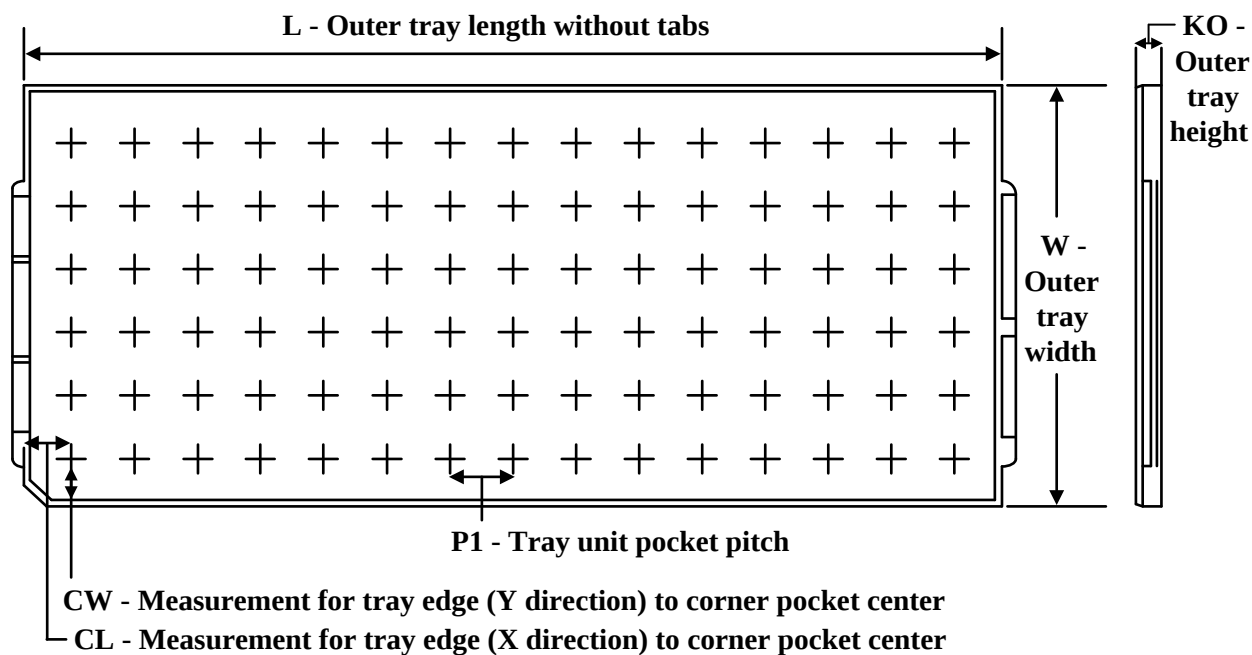
⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TRAY


Chamfer on Tray corner indicates Pin 1 orientation of packed units.

*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	Unit array matrix	Max temperature (°C)	L (mm)	W (mm)	K0 (μm)	P1 (mm)	CL (mm)	CW (mm)
AFE7903IABJ	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7903IABJ	ABJ	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7903IALK	ALK	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2
AFE7903IALK	ALK	FCBGA	400	90	6 x 15	150	315	135.9	7620	19.5	21	19.2

FCBGA - 2.65 mm max height

Technical drawing of a 400X ball grid array (BGA) component. The drawing includes three views: a top view showing the overall dimensions (17.2 x 17.2 mm) and a 16x16 grid of balls; a side view showing the component's profile with dimensions for the balls (0.76 mm diameter, 0.56 mm height) and the component body (2.65 mm total height, 2.29 mm body height); and a detailed view of the ball grid showing a 16x16 array of balls with a pitch of 0.55 mm. The drawing also includes various callouts for dimensions, tolerances, and material specifications.

Top View:

- Overall dimensions: 17.2 x 17.2 mm.
- Inner dimensions: 16.8 x 16.8 mm.
- Feature A: 16.8 mm.
- Feature B: 16.8 mm.
- Feature C: 16 mm.

Side View:

- Overall height: 2.65 mm.
- Body height: 2.29 mm.
- Ball diameter: 0.76 mm.
- Ball height: 0.56 mm.
- Feature A: 0.2 C.
- Feature B: 0.12 C.
- Feature C: 0.12 C.
- Seating Plane: NOTE 4.

Ball Grid View:

- Grid dimensions: 15.2 TYP x 15.2 TYP.
- Ball pitch: 0.55 mm.
- Ball diameter: 0.45 mm.
- Feature A: 0.8 TYP.
- Feature B: 0.9 TYP.
- Feature C: 0.8 TYP.
- Feature D: 0.8 TYP.
- Feature E: 0.8 TYP.
- Feature F: 0.8 TYP.
- Feature G: 0.8 TYP.
- Feature H: 0.8 TYP.
- Feature I: 0.8 TYP.
- Feature J: 0.8 TYP.
- Feature K: 0.8 TYP.
- Feature L: 0.8 TYP.
- Feature M: 0.8 TYP.
- Feature N: 0.8 TYP.
- Feature O: 0.8 TYP.
- Feature P: 0.8 TYP.
- Feature Q: 0.8 TYP.
- Feature R: 0.8 TYP.
- Feature S: 0.8 TYP.
- Feature T: 0.8 TYP.
- Feature U: 0.8 TYP.
- Feature V: 0.8 TYP.
- Feature W: 0.8 TYP.
- Feature X: 0.8 TYP.
- Feature Y: 0.8 TYP.
- Feature Z: 0.8 TYP.

Notes:

- NOTE 3: 50X C A B, 18X C.
- NOTE 4: SEATING PLANE.

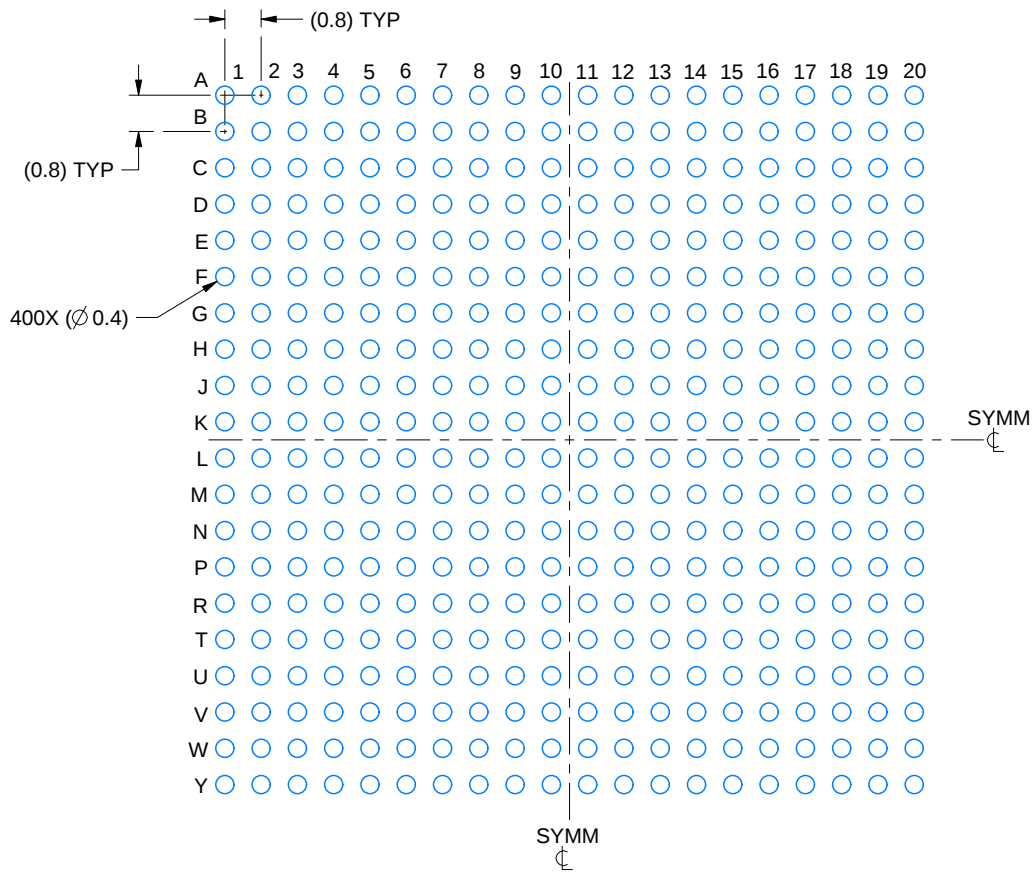
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum C.
4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
5. The lids are electrically floating (e.g. not tied to GND).

EXAMPLE BOARD LAYOUT

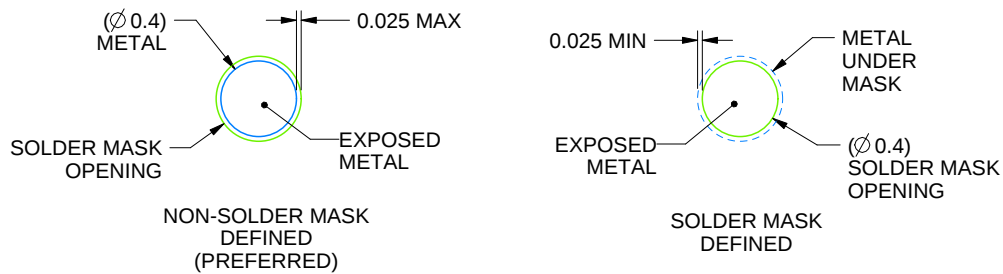
ABJ0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221311/D 03/2023

NOTES: (continued)

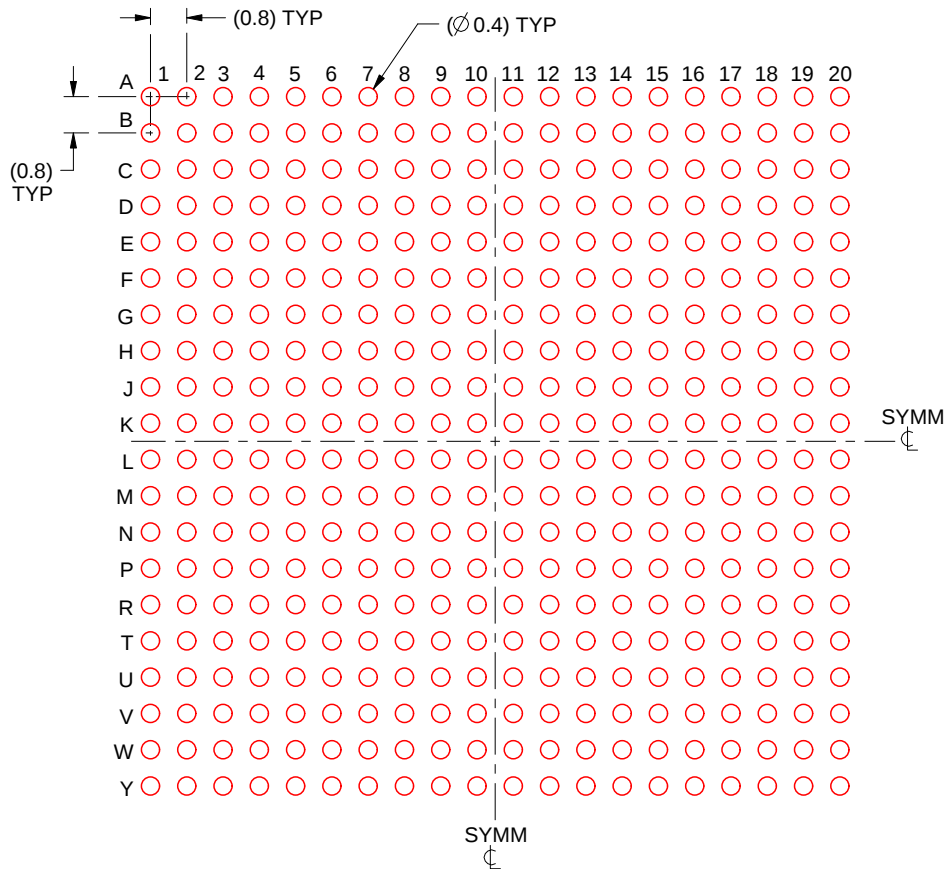
6. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ABJ0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL
 SCALE:6X

4221311/D 03/2023

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

FCBGA - 2.65 mm max height

Technical drawing of a 400X ball grid array (BGA) component. The drawing includes three views: a top view showing the square footprint with dimensions 17.2 (16.8) and 17.2 (16.8); a side view showing the component profile with dimensions 2.65 (2.29) and 0.76 (0.56); and a bottom view showing the ball grid with dimensions 15.2 TYP and 0.8 TYP. The bottom view also includes a grid of 20x20 balls, a center line, and a note "400X Ø 0.55 0.45". A table at the bottom left contains the following information: 50X, 18X, C, A, B, C, NOTE 3.

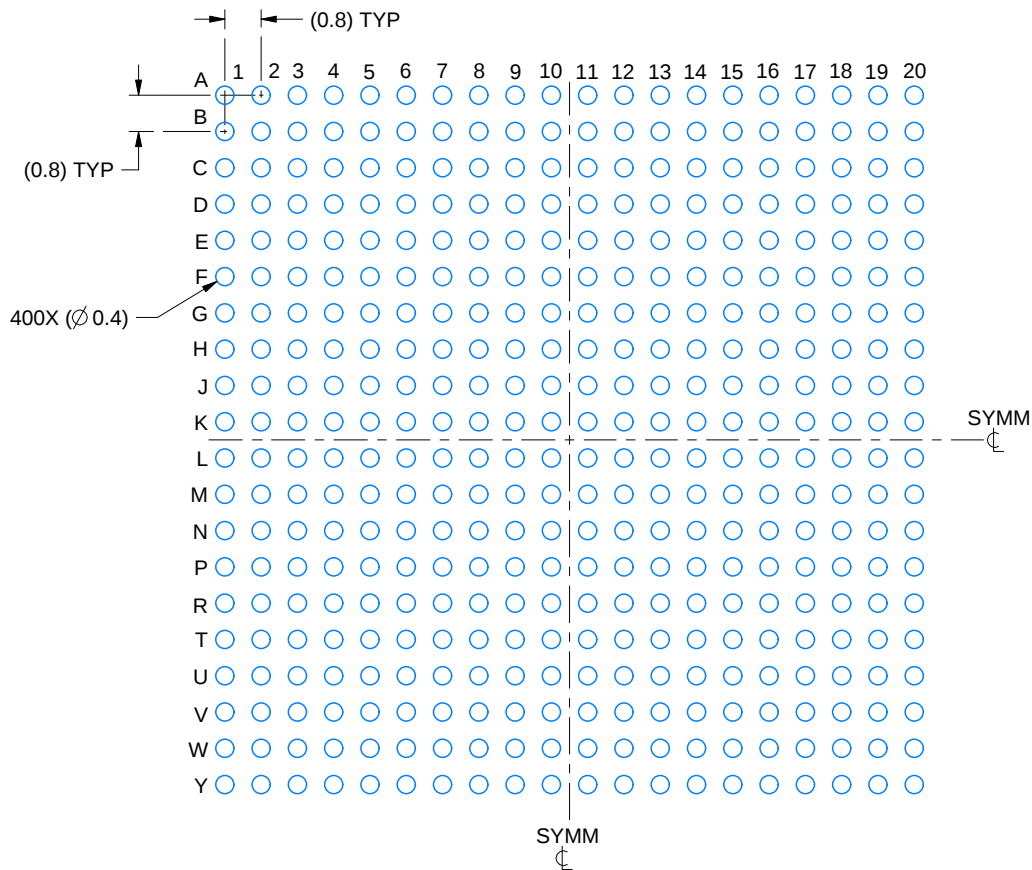
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, parallel to primary datum C.
4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.
5. Pb-Free die bump and SnPb solder ball.
6. The lids are electrically floating (e.g. not tied to GND).

EXAMPLE BOARD LAYOUT

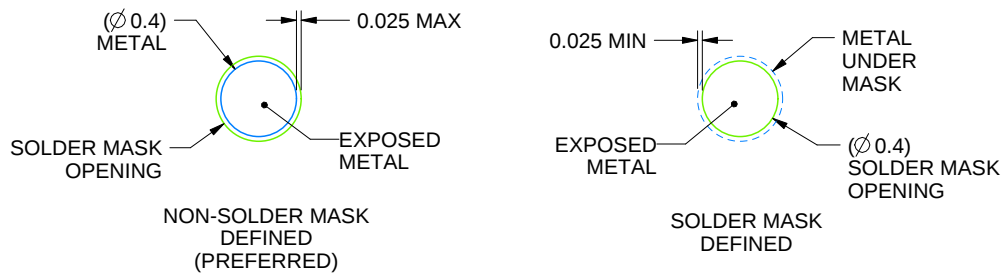
ALK0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4225930/C 03/2023

NOTES: (continued)

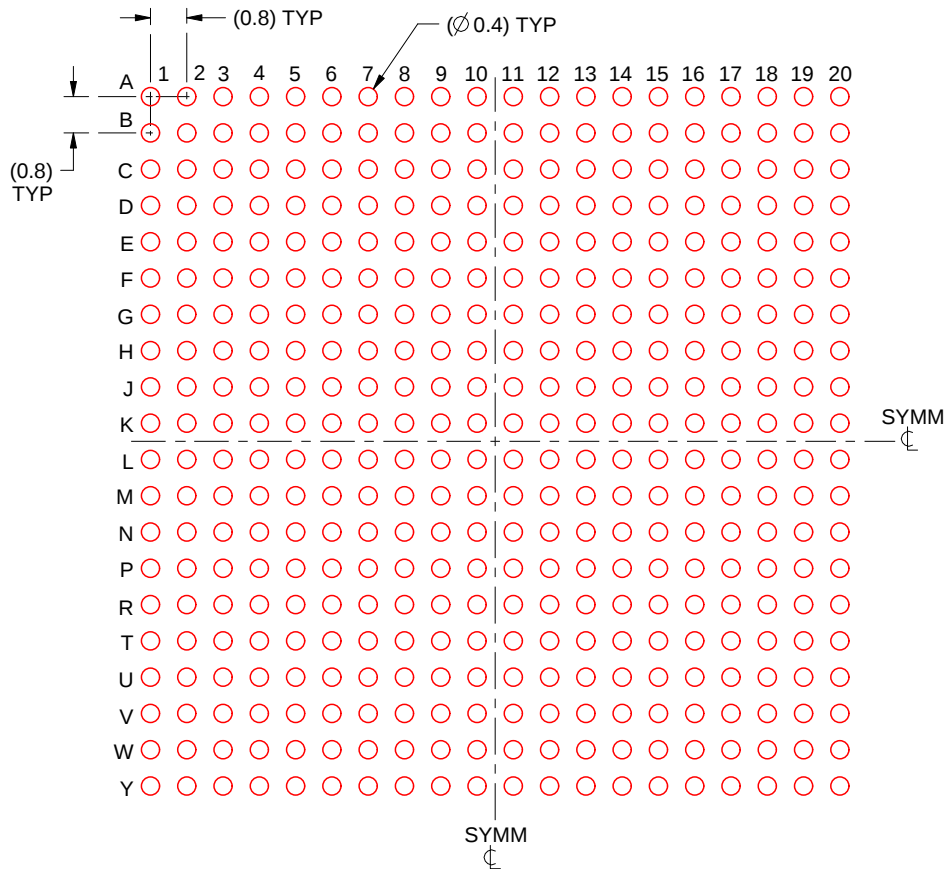
7. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ALK0400A

FCBGA - 2.65 mm max height

BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.15 mm THICK STENCIL
 SCALE:6X

4225930/C 03/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月